

科创板风险提示

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



苏州联讯仪器股份有限公司

Semight Instruments Co., Ltd.

(苏州高新区泰山路 315 号)

首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

一、发行人上市的目的

公司是国内领先的高端测试仪器设备企业，主营业务为电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务，专业为全球高速通信和半导体等领域用户提供高速率、高精度、高效率的核心测试仪器设备，助力人工智能、新能源、半导体等前沿科技行业提升产品开发和量产效率，是国家重大战略需求领域实现核心基础仪器设备国产化攻坚与自主可控的重要力量。

通过本次上市，公司一方面可以进一步拓宽融资渠道，提升核心业务领域经营规模和研发投入，巩固市场领先地位、增强竞争优势并实现可持续发展；另一方面也有利于公司优化治理结构、吸引优秀人才，进一步增强、完善团队能力建设和公司治理水平，为股东和行业持续创造价值。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

公司严格按照上市公司治理标准建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会、董事会专门委员会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金将投资于下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目、车规芯片测试设备研发及产业化建设项目、存储测试设备研发及产业化建设项目、数字测试仪器研发及产业化建设项目和下一代测试仪表设备研发中心建设项目。本次募集资金投资项目均将围绕公司主营业务，将在夯实技术水平、丰富产品线布局、巩固市场领先地位并增强竞争优势等方面助力公司经营战略的实施，提升公司经营规模和盈利能力，是公司推进未来发展规划重要举措。

四、持续经营能力及未来发展规划

报告期内，公司收入规模持续增长，相关电子测量仪器和半导体测试设备已逐步实

现在高速通信和半导体等领域的产业化落地，行业认可度稳步提升，在多个产品细分赛道已成长为国内龙头企业，公司具备持续经营能力。

高端科学仪器设备的研发是推动科学和技术发展的重要力量，公司将坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求开展技术研究，并依托强大的平台级核心技术体系，持续实现高端测试仪器设备的突破，提高我国高端科学仪器设备的自主可控水平，助力全球人工智能、新能源、半导体等前沿科技行业提升产品开发和量产效率。

电子测量仪器方面，公司将持续关注与把握技术发展的前沿动态，一方面，持续向更高速率、更大带宽等性能指标迭代，向高集成度、高灵活度的发展方向创新；另一方面，持续挖掘精密源表作为底层硬件的技术潜力，不断拓宽产品线，以满足下游领域复杂度更高、精度更高、范围更广的测试需求。半导体测试设备方面，公司将持续关注半导体前沿技术应用与测试需求，一方面，不断巩固和深化在光电子器件测试、功率器件测试与半导体集成电路测试领域的纵向竞争力；另一方面拓宽下游应用领域，加速推进在存储器件测试等领域的横向拓展。

公司将持续投入资金和人力资源，加强研发技术团队建设，完善内部管理，不断提升产业化运营能力，并有效发挥资本市场助力功能，不断巩固竞争优势、提升市场地位，力争成为国际高端测试仪器设备行业的领导者。

董事长签字：

胡海洋

胡海洋



本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次公开发行新股数量 2,566.6667 万股，占发行后总股本的比例为 25%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币 81.88 元
发行日期	2026 年 4 月 14 日
拟上市的证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	10,266.6667 万股
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2026 年 4 月 20 日

目 录

声 明	1
致投资者的声明	2
一、发行人上市的目的	2
二、发行人现代企业制度的建立健全情况	2
三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划	2
四、持续经营能力及未来发展规划	2
本次发行概况	4
目 录	5
第一节 释义	9
一、一般释义	9
二、专业释义	13
第二节 概览	17
一、重大事项提示	17
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况	20
三、本次发行情况	21
四、发行人主营业务经营情况	23
五、发行人符合科创板定位情况	34
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标	34
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况	35
八、发行人选择的具体上市标准	37
九、发行人公司治理特殊安排	37
十、募集资金运用与未来发展规划	37
十一、其他对发行人有重大影响的事项	38
第三节 风险因素	39
一、与发行人相关的风险	39
二、与行业相关的风险	41
三、其他风险	42
第四节 发行人基本情况	43

一、发行人基本情况	43
二、发行人设立情况	43
三、发行人报告期内股本和股东变化情况	46
四、发行人成立以来重要事件（含报告期内的重大资产重组）	48
五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况	48
六、发行人股权结构	48
七、发行人分公司、子公司及参股公司情况	50
八、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况	55
九、发行人特别表决权股份或类似安排的情况	65
十、发行人协议控制架构的情况	65
十一、发行人股本情况	65
十二、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员	71
十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排	83
十四、发行人员工情况	84
第五节 业务与技术	88
一、发行人主营业务及主要产品情况	88
二、发行人所处行业的基本情况	120
三、发行人销售情况和主要客户	157
四、发行人采购情况和主要供应商	161
五、发行人与业务相关的主要资源要素情况	164
六、发行人核心技术与技术研发情况	171
七、发行人安全生产及环境保护情况	185
八、发行人境外经营情况	186
第六节 财务会计信息与管理层分析	187
一、财务报表	187
二、审计意见、关键审计事项	191
三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况	194
四、分部信息	195
五、主要会计政策及会计估计	196

六、非经常性损益情况	220
七、税项	221
八、主要财务指标	224
九、经营成果分析	225
十、资产质量分析	252
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析	270
十二、重大投资或重大资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项	279
十三、资产负债表期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项	280
十四、盈利预测	280
十五、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况	280
第七节 募集资金运用与未来发展规划	285
一、募集资金运用概况	285
二、未来发展规划	287
第八节 公司治理与独立性	291
一、发行人报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况	291
二、发行人内部控制情况	291
三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况	292
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况	292
五、发行人独立运行情况	293
六、同业竞争	295
七、关联方及关联关系	295
八、关联交易	299
第九节 投资者保护	305
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序	305
二、发行人股利分配政策	305
三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况	312
第十节 其他重要事项	313

一、重大合同	313
二、对外担保情况	316
三、重大诉讼、仲裁或其他事项	316
第十一节 声明	319
一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明	319
二、发行人控股股东、实际控制人声明	320
三、保荐人（主承销商）声明	321
四、发行人律师声明	324
五、会计师事务所声明	325
六、资产评估机构声明	326
七、验资机构声明	328
八、验资复核机构声明	330
第十二节 附件	331
一、备查文件	331
二、查阅时间及地点	331
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.....	333
附件二：与投资者保护相关的承诺	335
附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项	362
附件四：公司治理制度的建立健全及运行情况	363
附件五：公司专利具体情况	365
附件六：募集资金运用情况	382
附件七：公司租赁情况	395

第一节 释义

在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有以下含义：

一、一般释义

联讯有限	指	苏州联讯仪器有限公司，系发行人前身
联讯仪器、公司、本公司、发行人	指	苏州联讯仪器股份有限公司
本次发行	指	本次发行人首次公开发行 2,566.6667 万股 A 股股票的行为
联睿光通	指	苏州联睿光通企业管理中心（有限合伙），发行人员工持股平台之一，发行人实际控制人的一致行动人
博睿光通	指	苏州博睿光通企业管理中心（有限合伙），发行人员工持股平台之一，发行人实际控制人的一致行动人
博恒睿哲	指	苏州博恒睿哲企业管理中心（有限合伙），发行人员工持股平台之一，发行人实际控制人的一致行动人
鑫瑞集诚	指	鑫瑞集诚（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
中小企业发展基金	指	江苏中小企业发展基金（有限合伙），系发行人股东
芯未来一期	指	广东芯未来一期创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
南山架桥	指	深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
华峰测控	指	北京华峰测控技术股份有限公司，系发行人股东
聚源创投	指	聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙），系发行人股东
硅星创投	指	苏州硅星创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
高新枫桥	指	苏州高新枫桥新兴产业投资有限公司，系发行人股东
永鑫开拓	指	苏州永鑫开拓创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
金谷汇枫	指	苏州金谷汇枫创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
凯烁安明	指	嘉兴凯烁安明股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
凯烁邦盛	指	嘉兴凯烁邦盛股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
永鑫融耀	指	苏州永鑫融耀创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
海通创新	指	海通创新证券投资有限公司，系发行人股东
架桥富凯	指	深圳市架桥富凯二十五号投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
恒奕泰二期	指	广东恒奕泰二期股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
武汉光创	指	武汉光创股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
茵联启芯	指	苏州茵联启芯股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
柯桥长枫	指	绍兴柯桥长枫股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
国风投	指	国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙），系发行人股东

联讯赛麦特	指	苏州联讯赛麦特半导体有限公司，系发行人子公司
武汉联讯	指	武汉联讯仪器有限公司，系发行人子公司
杭州联讯	指	杭州联讯仪器有限公司，系发行人子公司
新加坡联讯	指	NEXUSTEST PTE. LTD.，系发行人子公司
日本联讯	指	Semi next 株式会社，系发行人子公司
马来西亚联讯	指	NEXUSTEST TECHNOLOGY SDN.BHD.，系发行人子公司
泰国联讯	指	NEXUSTEST (THAILAND) CO., LTD.，系发行人子公司
美国联讯	指	NEXUSTEST TECHNOLOGIES INC.，系发行人子公司
韩国联讯	指	NEXUSTEST KOREA CO., LTD.，系发行人子公司
思诺威	指	思诺威科技（无锡）有限公司，系发行人参股公司
合晶诺	指	苏州合晶诺科技有限公司，系发行人参股公司
联讯众创	指	武汉联讯众创仪器有限公司，系发行人报告期内曾控股（持有90.00%的股权）的子公司，已于2022年4月注销
联讯睿哲	指	苏州联讯睿哲软件技术有限公司，系发行人报告期内曾经的全资子公司，已于2022年11月注销
上海麦萱	指	上海麦萱创意设计中心
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics Inc.
LightCounting	指	一家专注于 AI 集群、数据中心和光网络的行业分析公司
Keysight、是德科技	指	Keysight Technologies, Inc.
Anritsu、安立	指	Anritsu Corporation
Tektronix、泰克	指	Tektronix Inc.
EXFO	指	EXFO Inc.
NI、美国国家仪器	指	National Instruments Corporation
Advantest、爱德万	指	Advantest Corporation
Teradyne、泰瑞达	指	Teradyne, Inc.
HighFinesse	指	HighFinesse Laser and Electronic Systems GmbH
Aehr	指	Aehr Test Systems
Alphax	指	Alphax 株式会社
QualiTau	指	QualiTau, Inc.
SPEA	指	SPEA S.p.A.
致茂电子、Chroma	指	致茂电子股份有限公司（Chroma ATE Inc.）
Pentamaster	指	Pentamaster International Limited
FormFactor	指	Formfactor, Inc.
旺矽科技	指	旺矽科技股份有限公司（MPI Corporation）
圣昊光电	指	河北圣昊光电科技有限公司

镭神技术	指	镭神技术（深圳）有限公司
鼎阳科技	指	深圳市鼎阳科技股份有限公司
普源精电	指	普源精电科技股份有限公司
长川科技	指	杭州长川科技股份有限公司
联动科技	指	佛山市联动科技股份有限公司
广立微	指	杭州广立微电子股份有限公司
光迅科技	指	武汉光迅科技股份有限公司及其合并报表范围内的子公司
士兰微	指	杭州士兰微电子股份有限公司及其合并报表范围内的子公司
海信集团	指	青岛海信宽带多媒体技术有限公司、广东海信宽带科技有限公司等同一控制下公司
中际旭创	指	中际旭创股份有限公司及其合并报表范围内的子公司
新易盛	指	成都新易盛通信技术股份有限公司及其合并报表范围内的子公司
三安光电	指	三安光电股份有限公司及其合并报表范围内的子公司
赛丽科技	指	赛丽科技（苏州）有限公司及其同一控制下公司
博通、Broadcom	指	Avago Technologies U.S. INC., 2015年Avago Technologies U.S. INC.宣布收购 Broadcom Corp.时，明确交易完成后新公司将沿用“Broadcom”品牌
Lumentum	指	Lumentum Holdings Inc.及其同一控制下公司
讯速信远	指	成都讯速信远科技有限公司、讯速信远科技（苏州）有限公司等同一控制下公司
日本住友	指	住友电工器件创新股份有限公司（住友电气工业株式会社子公司）
安森美、ONSEMI	指	ON Semiconductor Corporation 及其合并报表范围内的子公司
高意、Coherent	指	Finisar Corporation，于2019年被II-VI公司收购，2022年II-VI公司与Coherent合并，合并后更名“高意 Coherent”
株洲中车	指	株洲中车时代半导体有限公司
芯联集成	指	芯联集成电路制造股份有限公司及其合并报表范围内的子公司
芯聚能	指	广东芯聚能半导体有限公司及其同一控制下公司
比亚迪半导体	指	比亚迪半导体股份有限公司及其同一控制下公司
瞻芯电子	指	浙江瞻芯电子科技有限公司
长飞先进	指	安徽长飞先进半导体股份有限公司及其同一控制下公司
Power Master	指	Power Master Semiconductor Co., Ltd.
英飞凌、Infineon	指	Infineon Technologies AG
燕东微	指	北京燕东微电子股份有限公司
华工正源	指	武汉华工正源光子技术有限公司及其同一控制下公司
日本古河	指	日本古河电气工业株式会社
X-FAB	指	X-FAB Silicon Foundries SE
环球广电	指	Applied Optoelectronics, Inc.及其同一控制下公司

光彩芯辰	指	光彩芯辰（浙江）科技有限公司
源杰科技	指	陕西源杰半导体科技股份有限公司
艾睿电子	指	艾睿电子中国有限公司及其同一控制下公司
PANGAEA	指	PANGAEA (H.K.) LIMITED
矽电股份	指	矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其修订
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	现行《苏州联讯仪器股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《苏州联讯仪器股份有限公司章程（草案）》，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过并于本次发行上市后生效
股东会	指	苏州联讯仪器股份有限公司股东大会、股东会
董事会	指	苏州联讯仪器股份有限公司董事会
监事会	指	苏州联讯仪器股份有限公司监事会，已取消
《股东会议事规则》	指	《苏州联讯仪器股份有限公司股东会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《苏州联讯仪器股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《苏州联讯仪器股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事工作制度》	指	《苏州联讯仪器股份有限公司独立董事工作制度》
《董事会秘书工作制度》	指	《苏州联讯仪器股份有限公司董事会秘书工作制度》
《对外担保管理制度》	指	《苏州联讯仪器股份有限公司对外担保管理制度》
《投资者关系管理制度》	指	《苏州联讯仪器股份有限公司投资者关系管理制度》
《信息披露管理制度》	指	《苏州联讯仪器股份有限公司信息披露管理制度》
《关联交易管理制度》	指	《苏州联讯仪器股份有限公司关联交易管理制度》
《募集资金管理制度》	指	《苏州联讯仪器股份有限公司募集资金管理制度》
招股说明书	指	苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
《注册管理办法》	指	《首次公开发行股票注册管理办法》
《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
社会公众股、A 股	指	发行人根据本招股说明书向社会公开发行的面值为 1 元的人民币普通股
保荐人、主承销商、中信	指	中信证券股份有限公司

证券		
发行人会计师、申报会计师、审计机构、容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、申报律师、德恒律师	指	北京德恒律师事务所
资产评估机构、江苏中企华	指	江苏中企华中天资产评估有限公司
Frost&Sullivan	指	弗若斯特沙利文公司，是一家国际咨询公司
报告期、报告期内、报告期各期	指	2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月
报告期末	指	2025 年 9 月 30 日
报告期各期末	指	2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 9 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、专业释义

集成电路、芯片、IC	指	Integrated Circuit，按照特定电路设计，通过特定的集成电路技术，采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品
裸芯片、Die	指	经前道制造工序，已具备芯片功能、划片后但未经封装的裸芯片
KGD	指	Known Good Die，晶圆测试并裂片后检验合格的裸芯片
KGD 测试	指	在晶圆裂片后、封装前对裸芯片进行测试，以验证其功能
CoC	指	Chip-on-Carrier，一种常见的光芯片封装形式，将裸芯片直接贴装在封装基板上，金线键合进行电气连接
光模块、光通信模块	指	实现光电转换的器件，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号
夹具、治具	指	芯片测试过程中用来固定待测器件，使之始终占有正确的位置，以接受施工或检测的装置
Socket	指	芯片测试座，半导体器件测试配件，用于 KGD 测试和 FT 测试
探针卡	指	应用于半导体晶圆测试的硬件，是测试机与待测晶圆的接触媒介
Chiplet	指	芯粒，一种先进封装技术，通过集成多个小芯片（Die）提升芯片性能，降低制造成本
WLBI	指	Wafer Level Burn In，晶圆级老化测试
WLR	指	Wafer Level Reliability，晶圆可靠性测试
WAT 测试	指	晶圆允收测试（Wafer Acceptance Test），在工艺流程结束后对芯片进行的电性测量，用于检验各段工艺流程是否符合标准
CP 测试	指	晶圆测试（Circuit Probing），在芯片制作流程中处于晶圆制造和封装之间，在晶圆裂片前对裸露的芯片进行测试，以验证其功能

FT 测试	指	终测（Final Test），在芯片完成封装后，对芯片功能进行测试
AOI	指	自动光学检测（Automated Optical Inspection），指通过相机采集工件图像，根据图像的像素分布、亮度与颜色等信息，对视觉图像进行处理与解释，并将其与数据库中的数据进行比较，从而识别出被检测工件的缺陷，可广泛应用于半导体、PCB、消费电子等领域
分立器件	指	以半导体材料为基础的，具有固定单一特性和功能的电子器件
功率器件	指	用于电能变换和控制电路的分立器件，是半导体分立器件中的主要产品，具体包括功率二极管、功率晶体管（MOSFET、IGBT 等）、功率晶闸管等不同品类
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor 的缩写，利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种功率晶体管
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor，绝缘栅双极型晶体管
氮化镓、GaN	指	Gallium Nitride，氮和镓的化合物，属于第三代半导体材料，常被用于制作新一代高温高频大功率器件
碳化硅、SiC	指	Silicon Carbide，硅和碳的组成的化合物半导体材料，属于第三代半导体材料，能够适应高温、高频、抗辐射、大功率的应用场合，多用于半导体照明领域、各类电机系统、新能源汽车和不间断电源等领域
IDM	指	垂直整合制造企业（亦指该等企业的商业模式），指半导体器件设计、晶圆制造、封装测试、销售等环节由同一家企业完成的商业模式
UPH	指	Unit Per Hour 的缩写，表示每小时的产量
脉冲	指	电子技术中经常运用的一种脉搏似的短暂起伏的电冲击
LCR	指	电感（Inductance）、电容（Capacitance）、电阻（Resistance）的缩写，系三项电气性能指标
NRZ	指	Not Return to Zero（不归零码）的缩写，是一种基础的数字信号编码方式，采用两种电平来表示二进制 1/0，逻辑 0 是低电平，逻辑 1 是高电平，每个时钟周期可传输 1bit 信息
PAM4	指	4-Level Pulse Amplitude Modulation（四电平脉冲幅度调制）的缩写，通过使用四个电压电平对数据进行编码，实现每个符号周期传输 2bit 信息（如 00、01、10、11），相比 NRZ 技术，PAM4 能在相同带宽下实现传输速率翻倍，是一种高速数字信号调制技术
制程	指	在生产芯片过程中，集成电路的精细度，亦指 IC 内电路与电路之间的距离
封装测试	指	对经过划片的晶圆进行封装，完成后进行成品测试
分选机	指	英文名“Handler”，根据电子器件不同的性质，对其进行分级筛选的设备
探针台	指	英文名“Prober”，一种半导体检测装备，用于晶圆加工之后、封装工艺之前的晶圆测试环节
频率范围	指	测量仪器可以测量的最低频率至最高频率之间的范围
通道数	指	通道数代表可以同时进行测试分析的通道数量，通道数越多测试效率越高
数据中心	指	全球协作的特定设备网络，用来在 Internet 网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息
5G、6G	指	第五代移动通信技术、第六代移动通信技术

PXIe	指	一种模块化仪器系统，采用开放式标准，厂商可遵照此标准设计生产合规的产品，同时该标准的内容用于确保不同制造商的模块能在来自其他制造商的机箱里正常运行，具备数据传输速率高的优点
PON	指	Passive Optical Network（无源光纤网络）的缩写，光配线网中不含有任何电子器件及电子电源，全部由光分路器等无源器件组成，不需要有源电子设备
EPON	指	Ethernet Passive Optical Network（以太网无源光网络）的缩写，是基于以太网的 PON 技术，采用点到多点结构、无源光纤传输，在以太网之上提供多种业务
GPON	指	Gigabit-Capable Passive Optical Networks（具有千兆位功能的无源光网络）的缩写，基于 ITU-TG.984.x 标准的最新一代宽带无源光综合接入标准，具有高带宽、大覆盖范围、用户接口丰富等优点
XG(S)-PON	指	在 GPON 基础上演进的下一代增强型 GPON 技术，包括 XG-PON 和 XGS-PON，即非对称 10GPON 和对称 10GPON
PCB	指	Printed Circuit Board，一种重要的电子部件，是电子元器件的支撑体和电子元器件电气连接的载体，由于采用电子印刷术制作而成，故被称为“印刷”电路板
PCBA	指	电子元件组装到 PCB 上之后形成的印制电路板装配体
FPGA	指	Field Programmable Gate Array，现场可编程逻辑门阵列，是在 PAL、GAL 等可编程器件的基础上进一步发展的产物，作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
ADC	指	Analog to Digital Converter，模数转换器，将模拟输入信号转换成数字信号，如将温度、压力、电流等转换成更易储存、处理的数字形式
带宽	指	输入信号通过示波器后衰减 3dB 时的最低频率视为该示波器的带宽，带宽决定了示波器所能检测到的信号频率范围
噪声	指	信号的频谱纯度，可影响调制信号的性能。噪声越小，输出信号性能越好
LIV 测试	指	Light-Intensity-Voltage 测试，一种用于评估光电材料、芯片和器件性能的测试方法
DUT	指	Device Under Test 的缩写，指待测器件
Ω 、 $M\Omega$	指	欧、兆欧，电阻单位
aA、fA、pA、nA、 μA 、mA、A	指	阿安、飞安、皮安、纳安、微安、毫安、安，电流单位， $1A=10^3mA=10^6\mu A=10^9nA=10^{12}pA=10^{15}fA=10^{18}aA$
nV、 μV 、mV、V	指	纳伏、微伏、毫伏、伏，电压单位， $1V=10^3mV=10^6\mu V=10^9nV$
Hz、MHz、GHz	指	赫兹、兆赫兹、吉赫兹，频率单位， $1GHz=10^3MHz=10^6Hz$
W	指	瓦，功率单位
Sa/s、GSa/s	指	Sa/s 为 sample/second 的缩写，即每秒钟的采样数，也称采样率。 $1GSa/s=1,000,000,000Sa/s$
dB	指	用于表示信号强度相对值的单位，经常用于表示光信号的衰减
bit	指	比特，数据位单位
波特率	指	单位时间内传送的码元符号（Symbol）的数量，常用单位波特（Baud）

本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是

由于四舍五入所致。

本招股说明书引用的第三方数据或结论，均已注明资料来源，确保权威、客观、独立并符合时效性要求。其中部分数据或结论来自于 Frost&Sullivan 出具的研究报告，以上报告系发行人向 Frost&Sullivan 购买，并非专门为本次发行准备，且发行人未提供帮助；除向 Frost&Sullivan 购买行业研究报告外，发行人未就第三方数据支付费用。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

（一）特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”章节全文，并特别关注下列风险：

1、产品研发与技术开发风险

报告期内，公司研发投入金额分别为 5,357.28 万元、10,471.57 万元、19,143.44 万元和 20,052.87 万元，公司研发投入金额持续增长。按照应用领域分类，公司产品主要应用于光通信、碳化硅功率器件、半导体集成电路等领域，2025 年 1-9 月主营业务收入中，光通信占比 78.94%、碳化硅功率器件占比 19.04%、半导体集成电路占比 2.02%，未来随着应用领域的拓展、市场需求的变动以及技术水平的提升，公司需结合下游市场需求和行业技术发展趋势，对公司的现有技术和产品进行持续迭代和升级以保持核心竞争力。公司研发项目具有资金投入规模大、技术难度高、项目周期长的特点，如果公司未能及时跟上光通信行业技术迭代速度或发展方向，或未能准确把握功率器件测试、半导体集成电路电性能测试的发展趋势或前沿技术发展需求，或存储芯片测试设备等新产品研发或送样验证不及预期，或未来研发资金不足，导致公司产品性能提升和产品矩阵拓展相关的研发项目无法按计划取得成果，甚至出现研发失败的情形，将对公司业务发展造成不利影响。

2、毛利率波动风险

报告期内，公司综合毛利率分别为43.61%、60.50%、63.63%和59.14%。公司产品毛利率水平受产品销售价格、销售策略、成本波动、市场竞争等多个因素共同影响，不同产品之间的毛利率存在差异，产品结构占比波动亦会对综合毛利率产生影响。未来，

公司如果无法持续进行技术创新或者行业竞争加剧、产品领先优势下降，或者公司产品销售价格、成本控制能力、产品结构发生较大不利变动，都将可能导致公司毛利率水平出现波动，给公司的经营带来一定风险。

3、应收账款坏账损失的风险

报告期各期末，公司应收账款的账面余额分别为 8,962.97 万元、13,559.08 万元、25,455.43 万元和 40,001.69 万元，占当期营业收入的比例分别为 41.81%、49.16%、32.28% 和 37.24%，应收账款坏账准备分别为 717.27 万元、1,690.54 万元、2,355.94 万元和 3,295.39 万元。报告期各期末，公司存在部分应收账款逾期情况，公司对存在重大收回不确定性的应收账款单项计提坏账准备。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额可能进一步增加，较高的应收账款余额会影响公司的资金周转效率、限制公司业务的快速发展。如果公司采取的收款措施不力或客户经营状况发生不利变化，则公司应收账款发生逾期及坏账损失风险的可能性将会增加。

4、存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货的账面余额分别为 7,410.40 万元、17,718.61 万元、34,749.41 万元和 47,392.62 万元，其跌价准备分别为 337.83 万元、621.97 万元、1,307.11 万元和 2,022.49 万元，呈现快速增长态势。随着公司业务规模的持续扩大，预计未来存货规模或将相应上升。虽然公司采用“以销定产，适当备货”的生产模式，以客户订单需求为导向组织生产，但产品从原材料采购、生产出货至客户签收或验收需要经历一定周期，若未来市场环境出现重大不利变化、产品更新迭代或客户需求变化等原因导致公司原材料等出现积压、库存商品等出现滞销或贬值，公司存货将面临产生跌价损失的风险，从而影响公司的经营业绩和财务状况。

5、贸易环境变化及境外收入和采购波动风险

报告期内，公司产品出口地包括日本、东南亚等国家或地区，公司主营业务收入中，境外收入金额分别为 2,872.86 万元、2,467.48 万元、11,660.79 万元和 25,963.44 万元，占同期主营业务收入的比例分别为 13.54%、9.17%、14.89%和 32.59%，公司境外收入金额和占比均呈现上升趋势；报告期各期，公司原材料采购中境外采购金额分别为 1,347.33 万元、4,414.50 万元、6,388.15 万元、6,489.38 万元，境外采购占比分别为 9.34%、19.09%、13.93%以及 14.55%。公司将“出海”作为战略发展的重要一环，持续大力拓

展海外市场客户。近年来，国际贸易环境波动变化，美国相继公布了多项对进口自中国的产品加征关税等贸易保护措施。如果上述出口和原材料采购涉及区域的贸易政策、监管政策未来发生重大不利变化，或受不可控的其他政治、经济因素影响，致使上述区域市场需求和供给出现大幅波动，将影响公司海外市场的开拓和供应链稳定性，进而存在境外收入和采购波动的风险。

6、经营业绩下滑风险

报告期内，公司营业收入分别为 21,439.06 万元、27,579.31 万元、78,862.99 万元和 80,562.15 万元，归属于母公司股东的净利润分别为-3,807.00 万元、-5,539.38 万元、14,049.48 万元和 9,664.30 万元；得益于下游应用领域市场需求持续强劲、高端测试仪器设备国产替代进程提速、公司核心产品性能持续突破并获得境内外优质客户广泛认可、产品线不断丰富并持续拓宽应用场景等因素，公司报告期内营业收入实现大幅增长，2024 年度及 2025 年 1-9 月均实现盈利。如未来受到光通信、碳化硅功率器件等行业周期、市场波动、下游市场需求变化、公司新产品的研发和推广不及预期、原材料成本上升、公司研发投入加大、已实施或新增股权激励导致的大额股份支付费用等影响，且公司未能采取有效措施及时应对上述变化，公司将面临经营业绩下滑的风险，极端情况下有可能存在上市当年营业利润同比下滑超过 50%甚至亏损的风险。

7、募投项目新增折旧及研发人员薪酬影响公司盈利能力的风险

报告期各期，公司固定资产每年计提折旧金额分别为 192.06 万元、391.87 万元、925.15 万元和 1,457.96 万元，研发人员薪酬分别为 2,789.76 万元、5,463.76 万元、10,740.88 万元和 10,846.06 万元，固定资产折旧及研发人员薪酬金额逐年增加。根据本次募投项目实施计划，公司拟投入 17.11 亿元，项目建成后预计每年将新增折旧摊销金额 3,622.13 万元，每年将新增研发人员薪酬 37,256.22 万元。若本次募投项目在实施过程中，产业政策、市场环境、技术、管理、人才等方面出现重大不利变化，将影响项目的实施进度，致使项目的实际效益情况与公司预测存在差异，募投项目新增的折旧摊销及研发人员薪酬将对公司盈利能力造成不利影响。

（二）本次发行相关主体作出的重要承诺

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人已作出关于业绩下滑情形的相关承诺，主要内容如下：发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企

业届时所持股份锁定期限 12 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个月。

本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”。

（三）本次发行前滚存利润分配方案及本次发行后股利分配政策

本公司提示投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体内容详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序”及“二、发行人股利分配政策”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况

发行人名称	苏州联讯仪器股份有限公司	成立日期	2017 年 3 月 15 日
注册资本	7,700.0000 万元	法定代表人	胡海洋
注册地址	苏州高新区湘江路 1508 号 5 幢	主要生产经营地址	苏州高新区泰山路 315 号
控股股东	胡海洋	实际控制人	胡海洋、黄建军、杨建
行业分类	C40 仪器仪表制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无

（二）本次发行的有关中介机构

保荐人	中信证券股份有限公司	主承销商	中信证券股份有限公司
发行人律师	北京德恒律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	资产评估机构	江苏中企华中天资产评估有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		本次发行的保荐人及主承销商中信证券的子公司中信证券投资有限公司通过持有发行人股东聚源创投 8.3333% 的财产份额间接持有发行人 0.1365% 股份；此外中信证券及子公司中信证券投资有限公司通过投资其他主体间接持有发行人股份，穿透后合计持股比例约 0.00000011%。除上述情形外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理	

	人员、经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他利益关系

（三）本次发行其他有关中介机构

股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	收款银行	中信银行北京瑞城中心支行
其他与本次发行有关的机构	无		

三、本次发行情况

（一）本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	2,566.6667 万股	占发行后总股本比例	25%
其中：发行新股数量	2,566.6667 万股	占发行后总股本比例	25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	10,266.6667 万股		
每股发行价格	81.88 元		
发行市盈率	63.64（发行价格除以每股收益，每股收益按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	10.50 元（按 2025 年 9 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	1.72 元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	26.45 元（按 2025 年 9 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	1.29 元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	3.10 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）		
预测净利润	无		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外		
承销方式	余额包销		

募集资金总额	210,158.67 万元
募集资金净额	190,708.02 万元
募集资金投资项目	下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目
	车规芯片测试设备研发及产业化建设项目
	存储测试设备研发及产业化建设项目
	数字测试仪器研发及产业化建设项目
	下一代测试仪表设备研发中心建设项目
发行费用概算	本次发行费用明细包括： 1、承销及保荐费：保荐费（含辅导费及持续督导费）1,050.00 万元（前期已费用化的 20.00 万元不计入发行费用），承销费 13,930.00 万元，承销费率为参考市场承销费率平均水平，经双方友好协商确定。承销与保荐费按项目进度分阶段支付； 2、审计及验资费：1,993.96 万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素确定，按照项目进度分阶段支付； 3、律师费：1,876.04 万元，基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、后续合作意愿和工作水平等因素，结合本次服务的实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付； 4、用于本次发行的信息披露费：542.45 万元； 5、发行手续费及其他费用：58.19 万元。 注：（1）以上各项费用均为不含增值税金额；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。
高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员与核心员工通过资产管理计划参与本次发行战略配售，参与战略配售的数量合计为 2,552,515 股，获配金额为 208,999,928.20 元。资管计划获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 36 个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人安排相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，参与战略配售的数量为 770,000 股，获配金额为 63,047,600.00 元。中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
公开发售股份股东名称、持股数量及公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用

（二）本次发行上市的重要日期

刊登初步询价公告日期	2026 年 4 月 3 日
初步询价日期	2026 年 4 月 9 日
刊登发行公告日期	2026 年 4 月 13 日
申购日期	2026 年 4 月 14 日
缴款日期	2026 年 4 月 16 日
股票上市日期	本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市

（三）本次发行的战略配售情况

1、参与规模及对象

本次发行最终战略配售数量为 5,133,333 股，占本次发行数量的 20.00%。本次发行最终战略配售结果如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数（股）	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额（元）	限售期（月）
1	中信证券投资有限公司	参与科创板跟投的保荐人相关子公司	770,000	3.00%	63,047,600.00	24
2	中信证券资管联讯仪器员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“联讯仪器员工1号资管计划”）	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	2,308,304	8.99%	189,003,931.52	36
3	中信证券资管联讯仪器员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划（以下简称“联讯仪器员工2号资管计划”）		244,211	0.95%	19,995,996.68	36
4	兆易创新科技集团股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	650,587	2.53%	53,270,063.56	12
5	上海华虹投资发展有限公司		488,519	1.90%	39,999,935.72	12
6	北京电控产业投资有限公司		244,259	0.95%	19,999,926.92	12
7	苏州东山产业投资有限公司		244,259	0.95%	19,999,926.92	12
8	杭州士兰微电子股份有限公司		183,194	0.71%	14,999,924.72	12
合计			5,133,333	20.00%	420,317,306.04	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）（以下简称“《实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

1、中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中证投资”）；

2、联讯仪器员工1号资管计划、联讯仪器员工2号资管计划（联讯仪器员工1号资管计划和联讯仪器员工2号资管计划以下合称简称“联讯仪器员工资管计划”或“员工资管计划”）；

3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

2、保荐人相关子公司跟投

（1）跟投主体

本次发行的保荐人（主承销商）按照《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）和《实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中证投资。

（2）跟投规模

根据《实施细则》要求，中证投资跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票规模的规模分档确定：

- 1）发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；
- 2）发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；
- 3）发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；
- 4）发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。

中证投资本次获配股数为770,000股，跟投比例为本次公开发行数量的3.00%，获配金额为63,047,600.00元。

3、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划

（1）联讯仪器员工1号资管计划基本情况

联讯仪器员工1号资管计划参与战略配售的数量为2,308,304股，占本次公开发行股份数量的8.99%，获配金额189,003,931.52元。

产品名称：中信证券资管联讯仪器员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划

设立时间：2026年2月10日

备案时间：2026年2月13日

募集资金规模：18,900.40万元

认购资金上限：18,900.40万元

管理人：中信证券资产管理有限公司（以下简称“中信资管”）

实际支配主体：中信资管，实际支配主体非发行人高级管理人员

根据发行人提供的说明及联讯仪器员工 1 号资管计划各份额持有人的用工合同，参与认购联讯仪器员工 1 号资管计划的发行人高级管理人员和核心员工为 27 名，均与发行人或发行人全资子公司签署劳动合同、建立劳动关系。联讯仪器员工 1 号资管计划的委托人姓名、劳动合同签署单位、主要职务、人员类型、认购金额及持有资产管理计划份额比例等情况如下：

序号	姓名	劳动合同签署单位	职务	人员类型	所属部门	认购金额 (万元)	资管计划份 额比例
1	胡海洋	发行人	董事长	核心员工	董事长	4,768.00	25.23%
2	黄建军	发行人	董事、总经理	高级管理人员	总经理	5,195.00	27.49%
3	杨建	发行人	董事、副总经理	高级管理人员	销售中心	1,638.00	8.67%
4	廉哲	发行人	董事、副总经理	高级管理人员	仪器与测试 机事业部	2,176.00	11.51%
5	廖金	发行人	董事会秘书、财务负责人、副总经理	高级管理人员	财务中心	976.00	5.16%
6	赵山	发行人	研发副总	核心员工	芯片测试装 备事业部	490.00	2.59%
7	邓寒	发行人	高级供应链总监	核心员工	供应链中心	380.00	2.01%
8	郭孝明	发行人	高级研发总监	核心员工	芯片老化装 备事业部	373.00	1.97%
9	张纪	发行人	高级销售总监	核心员工	销售中心	320.00	1.69%
10	潘朝松	发行人	高级研发总监	核心员工	仪器与测试 机事业部	290.00	1.53%
11	邵毅男	发行人	研发总监	核心员工	仪器与测试 机事业部	250.00	1.32%
12	吴永红	发行人	高级总监	核心员工	海外制造与 服务中心	250.00	1.32%
13	生兆东	发行人	研发总监	核心员工	仪器与测试 机事业部	183.00	0.97%
14	丁浩	武汉联讯	研发总监	核心员工	仪器与测试 机事业部	160.40	0.85%
15	张杰	发行人	工程总监	核心员工	芯片老化装 备事业部	133.00	0.70%
16	刘珊珊	发行人	总经理助理	核心员工	总经办	133.00	0.70%
17	施志虎	发行人	研发总监	核心员工	芯片测试装 备事业部	131.00	0.69%
18	张新建	发行人	研发总监	核心员工	芯片老化装 备事业部	120.00	0.63%
19	魏雷	发行人	销售总监	核心员工	销售中心	117.00	0.62%

序号	姓名	劳动合同签署单位	职务	人员类型	所属部门	认购金额 (万元)	资管计划份额比例
20	唐仁伟	发行人	研发总监	核心员工	仪器与测试机事业部	117.00	0.62%
21	林甲威	新加坡联讯	副总经理	核心员工	新加坡子公司	100.00	0.53%
22	陈晓东	发行人	董事、研发总监	核心员工	仪器与测试机事业部	100.00	0.53%
23	周晓峰	发行人	应用经理	核心员工	仪器与测试机事业部	100.00	0.53%
24	张盼盼	发行人	销售总监	核心员工	销售中心	100.00	0.53%
25	梁仕帮	发行人	销售总监	核心员工	销售中心	100.00	0.53%
26	李帆	发行人	研发总监	核心员工	芯片老化装备事业部	100.00	0.53%
27	李永国	发行人	销售总监	核心员工	销售中心	100.00	0.53%
合计						18,900.40	100.00%

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

（2）联讯仪器员工 2 号资管计划基本情况

联讯仪器员工 2 号资管计划参与战略配售的数量为 244,211 股，占本次公开发行股份数量的 0.95%，获配金额 19,995,996.68 元。

产品名称：中信证券资管联讯仪器员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划

设立时间：2026 年 2 月 10 日

备案时间：2026 年 2 月 24 日

募集资金规模：2,499.50 万元

认购资金上限：1,999.60 万元

管理人：中信证券资产管理有限公司

实际支配主体：中信资管，实际支配主体非发行人高级管理人员

根据发行人提供的说明及联讯仪器员工 2 号资管计划各份额持有人的用工合同，参与认购联讯仪器员工 2 号资管计划的发行人高级管理人员和核心员工为 35 名，均与发行人或发行人全资子公司签署劳动合同、建立劳动关系。联讯仪器员工 2 号资管计划的委托人姓名、劳动合同签署单位、主要职务、人员类型、认购金额及持有资产管理计划份额比例等情况如下：

序号	姓名	劳动合同 签署单位	职务	人员类型	所属部门	认购金额 (万元)	资管计 划份额 比例
1	金鹏	发行人	研发总监	核心员工	芯片测试装备事 业部	114.00	4.56%
2	冯云	发行人	高级研发经理	核心员工	芯片测试装备事 业部	108.00	4.32%
3	黄芳	发行人	销售总监	核心员工	销售中心	104.00	4.16%
4	华强	发行人	研发总监	核心员工	仪器与测试机事 业部	104.00	4.16%
5	于建波	发行人	高级研发经理	核心员工	芯片测试装备事 业部	100.00	4.00%
6	徐鹏嵩	发行人	高级经理	核心员工	芯片老化装备事 业部	87.50	3.50%
7	徐立	发行人	高级研发经理	核心员工	仪器与测试机事 业部	87.50	3.50%
8	陈煌娟	发行人	高级研发主管	核心员工	仪器与测试机事 业部	87.50	3.50%
9	彭兴贵	发行人	主任工程师	核心员工	仪器与测试机事 业部	87.50	3.50%
10	马耀文	发行人	高级经理	核心员工	仪器与测试机事 业部	83.00	3.32%
11	贺江云	发行人	高级研发经理	核心员工	仪器与测试机事 业部	75.00	3.00%
12	周春美	发行人	高级 PMC 经理	核心员工	供应链中心	75.00	3.00%
13	程妍	发行人	高级采购经理	核心员工	供应链中心	75.00	3.00%
14	王晋东	发行人	资深热管理工 程师	核心员工	芯片测试装备事 业部	75.00	3.00%
15	王峰	发行人	高级测试经理	核心员工	仪器与测试机事 业部	75.00	3.00%
16	胡国锋	发行人	研发总监	核心员工	仪器与测试机事 业部	73.00	2.92%
17	秦昊	发行人	人事总监	核心员工	人力资源部	73.00	2.92%
18	项加平	发行人	工程总监	核心员工	仪器与测试机事 业部	73.00	2.92%
19	陈雄文	发行人	测试总监	核心员工	芯片老化装备事 业部	73.00	2.92%
20	陈松伟	发行人	高级软件经理	核心员工	芯片老化装备事 业部	71.00	2.84%
21	郑金梅	发行人	高级量产采购 经理	核心员工	供应链中心	67.00	2.68%
22	马文娟	发行人	供应链高级经 理	核心员工	仪器与测试机事 业部	58.00	2.32%
23	朱良	发行人	高级 FAE 经理	核心员工	仪器与测试机事 业部	58.00	2.32%
24	陈远来	发行人	主管硬件工程 师	核心员工	芯片老化装备事 业部	58.00	2.32%

序号	姓名	劳动合同 签署单位	职务	人员类型	所属部门	认购金额 (万元)	资管计 划份额 比例
25	屠若宇	发行人	产品质量经理	核心员工	质量部	56.00	2.24%
26	姚慧	发行人	经理	核心员工	财务中心	56.00	2.24%
27	许昌平	武汉联讯	主管 FPGA 工 程师	核心员工	仪器与测试机事 业部	54.00	2.16%
28	张艺森	发行人	机械经理	核心员工	芯片测试装备事 业部	54.00	2.16%
29	杜佳伟	发行人	固件开发经理	核心员工	仪器与测试机事 业部	50.00	2.00%
30	王茂庆	发行人	主管 FPGA 硬 件工程师	核心员工	仪器与测试机事 业部	50.00	2.00%
31	闫亚超	发行人	研发经理	核心员工	仪器与测试机事 业部	50.00	2.00%
32	张婷婷	发行人	执行副总助理	核心员工	财务中心	50.00	2.00%
33	张迪	杭州联讯	研发总监	核心员工	仪器与测试机事 业部	50.00	2.00%
34	周立东	发行人	软件经理	核心员工	芯片测试装备事 业部	46.00	1.84%
35	罗跃浩	发行人	研发经理	核心员工	仪器与测试机事 业部	41.50	1.66%
合计						2,499.50	100.00%

注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

注 2：联讯仪器员工 2 号资管计划募集资金的 80% 用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款为 1,999.60 元。

4、其他参与战略配售的投资者

除上述参与科创板跟投的保荐人相关子公司和员工资管计划外，公司引入“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”参与战略配售。兆易创新科技集团股份有限公司共获配 650,587 股，获配金额为 53,270,063.56 元；上海华虹投资发展有限公司共获配 488,519 股，获配金额为 39,999,935.72 元；北京电控产业投资有限公司共获配 244,259 股，获配金额为 19,999,926.92 元；苏州东山产业投资有限公司共获配 244,259 股，获配金额为 19,999,926.92 元；杭州士兰微电子股份有限公司共获配 183,194 股，获配金额为 14,999,924.72 元。

5、配售条件

参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，并在规定时间内足额缴付认购资金。

6、限售期限

中证投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

联讯仪器员工资管计划基于对公司未来发展的信心以及与公司共同成长意愿自愿承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 36 个月。

其他参与战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

四、发行人主营业务经营情况

（一）主营业务概况

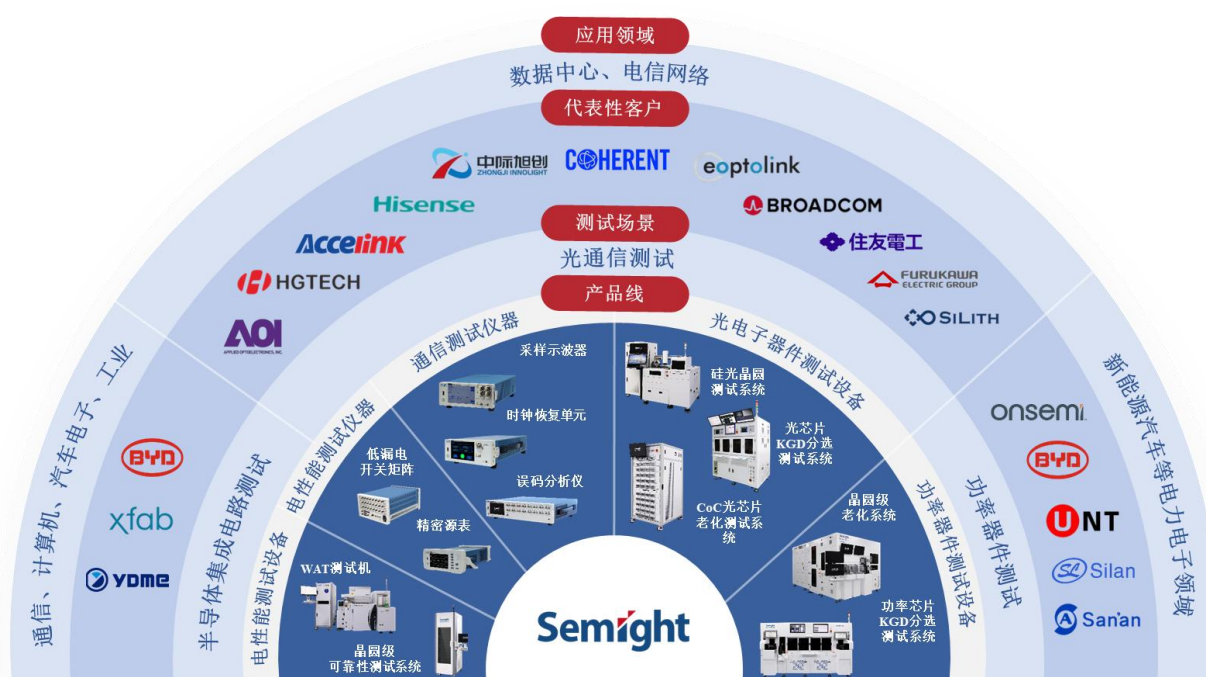
联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设备企业，主营业务为电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务，专业为全球高速通信和半导体等领域用户提供高速率、高精度、高效率的核心测试仪器设备，助力人工智能、新能源、半导体等前沿科技行业提升产品开发和量产效率，是国家重大战略需求领域实现核心基础仪器设备国产化攻坚与自主可控的重要力量。

公司电子测量仪器包括通信测试仪器和电性能测试仪器，通信测试仪器主要面向光通信测试，包括采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪等核心测试仪器；电性能测试仪器主要包括精密源表和低漏电开关矩阵，广泛应用于通信和半导体等领域的高精度电学测试。公司半导体测试设备包括主要面向光通信测试的光电子器件测试设备（CoC光芯片老化测试系统、光芯片KGD分选测试系统、硅光晶圆测试系统等），主要面向功率器件测试的功率器件测试设备（晶圆级老化系统、功率芯片KGD分选测试系统等），以及主要面向半导体集成电路测试的电性能测试设备（WAT测试机和晶圆级可靠性测试系统）。公司是业内极少数覆盖光通信产业链中模块、芯片、晶圆等核心环节测试需求的厂商，全球少数、国内极少数量产供货400G、800G、1.6T高速光模块核心测试仪器的厂商，全球第二家推出目前业内最高水平1.6T光模块全部核心测试仪器的厂商；国内极少数可提供PXIe插卡式源表、低漏电开关矩阵、高压源表、脉冲源等多产品矩阵的

电性能测试仪器厂商；国内极少数同时实现晶圆级老化测试设备、裸芯片级分选测试设备产业化应用的厂商，国内少数具备精密源表等核心测试部件自主能力的半导体测试设备厂商，产品核心性能指标业内领先。

成立至今，公司凭借在光通信领域核心测试仪器设备的技术研发和产业化应用的成功实践，逐步掌握了自主知识产权核心芯片及自研核心算法、硬件板卡、超精密运动系统等测试行业关键前沿技术能力，形成了以高速信号处理、微弱信号处理和超精密运动控制为核心的平台级核心技术体系。依托强大的平台级核心技术体系，公司一方面不断巩固和深化在光通信领域的纵向竞争力，另一方面也成功实现在功率器件、半导体集成电路等领域的横向拓展，形成了丰富的产品矩阵，在上述各领域里构筑起显著竞争优势。

图：公司“主要产品—产品线—测试场景—应用领域”关系图



在光通信领域，公司主要为用户提供通信测试仪器、光电子器件测试设备和电性能测试仪器，是业内极少数覆盖光通信全产业链核心测试环节的企业。其中，通信测试仪器市场长期被Keysight、Anritsu等美日企业垄断，近年来，随着人工智能等下游应用领域对数据传输速度要求日益提升，光通信产品速率迭代随之加快，测试仪器带宽与速率等核心性能指标迭代相应提速，进一步加大了国内测试仪器企业的追赶难度；公司是目前全球少数、国内极少数量产供货400G、800G、1.6T高速光模块核心测试仪器的厂商，面向400G、800G高速光模块测试需求的50GHz采样示波器、56GBaud时钟恢复单元、800Gbps误码分析仪等核心产品报告期内实现大规模量产供货；公司已推出满足目前业

内最高水平1.6T光模块测试需求的65GHz采样示波器、120GBaud时钟恢复单元、1.6Tbps误码分析仪，是全球第二家推出1.6T光模块全部核心测试仪器的厂商，三款产品均已实现量产供货；根据Frost&Sullivan数据，2024年公司在中國光通信测试仪器市场份额排名第三，也是前五中唯一的本土企业。除通信测试仪器外，公司面向光通信领域用户提供CoC光芯片老化测试系统、光芯片KGD分选测试系统、硅光晶圆测试系统等光电子器件测试设备，全面覆盖封装级光芯片、裸Die级光芯片、晶圆级硅光芯片等光通信产业链上游核心环节测试需求，硅光晶圆测试系统于2024年度实现收入；根据Frost&Sullivan数据，2024年公司在中國光电子器件测试设备市场份额中排名第一。公司在光通信领域已覆盖集团一、中际旭创、新易盛、光迅科技、海信集团、华工正源、赛丽科技、Lumentum、Coherent、Broadcom、环球广电、日本住友、日本古河等国内外主流光通信产业链客户。

在功率器件领域，公司面向车规级应用场景下功率器件日益严苛的可靠性要求，依托在光电子器件测试设备领域底层核心技术的深度积累和延伸应用，进一步拓展了主要面向车规级应用场景的功率器件测试设备产品线，两款核心产品晶圆级老化系统、功率芯片KGD分选测试系统均已实现产业化应用。根据Frost&Sullivan数据，2024年中国碳化硅功率器件晶圆级老化系统市场中，公司市场份额排名第一；2023-2024年中国功率芯片KGD分选测试系统市场中，公司市场份额排名第三、本土企业第一。公司在功率器件领域已覆盖比亚迪半导体、芯联集成、士兰微、三安光电、芯聚能、长飞先进、株洲中车、瞻芯电子、ONSEMI、Power Master等国内外主流功率芯片厂商。

在半导体集成电路领域，公司主要为用户提供电性能测试仪器及设备。电性能测试仪器方面，公司核心产品精密源表最小电流分辨率已突破至0.1fA，与国际最高水平的差距持续缩小，且公司是國內极少数可以提供PXIe插卡式源表、低漏电开关矩阵、高压源表、脉冲源等多产品矩阵的厂商。公司聚焦核心技术复用价值，积极布局电性能测试设备产品线，主要产品包括WAT测试机、晶圆级可靠性测试系统等，是國內少数具备精密源表等核心测试部件自主能力的厂商。公司在半导体集成电路领域的代表性客户包括客户二、集团一、比亚迪半导体、燕东微、士兰微、X-FAB等国内外知名企业。

公司积极响应国家重大战略需求号召，多次承担国家重点研发计划和国家重大专项，取得了国家级专精特新“小巨人”等多项荣誉，技术实力获得主管部门和业内广泛认可。公司将继续聚焦国家重大战略需求，把握人工智能、新能源、半导体行业发展机遇，致

力于成为国际高端测试仪器设备行业的领导者，为保障国家核心基础仪器设备的自主可控、提升全球竞争力注入强劲动能。

（二）主要经营模式概览

公司产品主要包括电子测量仪器和半导体测试设备，以及配套的测试部件及服务。

采购方面，公司主要实行“以产定购”的采购模式，采购内容主要包括通用类采购、定制类采购与外协采购。其中，通用类采购主要包括电子元器件、标准件、电气类、仪器设备等，公司根据产品技术需求对原材料的规格型号进行选型、验证及批量采购；定制类采购主要包括专用芯片、机加钣金件等，由公司向供应商提供版图、图纸或技术参数定制产品专用零部件；外协采购主要系生产工序中的外协生产，主要包括设备基础装配、PCBA 贴片、夹具加工等，公司向外协厂商提供部分原材料及技术规格，由外协厂商组装或加工完成后，发往公司进行采购验收。公司重要供应商包括苏州苏汀达自动化科技有限公司、PANGAEA、苏州康巨富自动化设备有限公司、安徽恩玛尼科技有限公司、艾睿电子等，具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、发行人采购情况和主要供应商”。

生产方面，公司采用“以销定产，适当备货”的生产模式，具备完备的生产加工体系和适应业务需求的生产组织方式。公司将核心资源集中于产品开发和技术创新，基于专业化分工与成本效益的考量，公司采用自主生产与外协生产相结合的生产模式，核心部件组装、软件烧录、整机调试、性能测试和检验等核心环节由公司自主生产；设备基础装配、PCBA 贴片、夹具加工等非核心环节采取外协方式进行生产。公司质量部门对生产完成后的成品进行检验，检验合格后成品入库。

销售方面，公司已建立专业化、国际化的销售团队及完善的销售体系，在美国、日本、韩国、新加坡、泰国、马来西亚等国家设立销售办公室，形成了覆盖全球的专业化营销网络。公司销售团队基于产业特性、产品应用及区域市场等维度进行精细化市场开发，凭借深厚的行业经验和背景，基于公司强大的技术实力，服务全球高速通信和半导体等科技领域知名用户，助力公司触达各领域前沿技术，引领公司创新发展。公司采用“直销为主，经销为辅”的销售模式，公司经销模式均为买断式销售。

（三）发行人行业竞争地位

1、电子测量仪器行业

公司电子测量仪器包括通信测试仪器和电性能测试仪器。

通信测试仪器领域，公司产品主要面向光通信测试，为光模块等光通信网络基础设施提供完整的测试解决方案。公司是目前全球少数、国内极少数量产供货 400G、800G、1.6T 高速光模块核心测试仪器的厂商，全球第二家推出 1.6T 光模块全部核心测试仪器的厂商。根据 Frost&Sullivan 数据，Keysight、Anritsu 等为代表的海外企业占据了 2024 年中国光通信测试仪器市场约 84% 的份额，行业集中度较高，本土企业市场份额占比约 16%。公司作为国内头部企业，贡献了中国光通信测试仪器市场 9.9% 的市场份额，位列市场第三，也是前五中唯一的本土企业。

电性能测试仪器领域，公司主要产品为精密源表和低漏电开关矩阵。公司是国内极少数可提供 PXIe 插卡式源表、低漏电开关矩阵、高压源表、脉冲源等多产品矩阵的电性能测试仪器厂商。根据 Frost&Sullivan 数据，2024 年中国精密源表大部分的市场份额被 Tektronix、NI、Keysight 等海外企业占据，三家合计占据超 80% 的市场份额；公司在国内市场位列本土企业第一。

2、半导体测试设备行业

公司半导体测试设备包括主要面向光通信测试的光电子器件测试设备、主要面向功率器件测试的功率器件测试设备以及主要面向半导体集成电路测试的电性能测试设备。

光电子器件测试设备领域，公司产品全面覆盖封装级光芯片、裸 Die 级光芯片、晶圆级硅光芯片等光通信产业链上游核心环节测试需求，且主要聚焦在硅光晶圆、芯片（裸 Die/CoC）等产业链上游更前端工序。根据 Frost&Sullivan 数据，2024 年中国光电子器件测试设备市场中，公司市场份额位列第一。

功率器件测试设备领域，公司是目前国内极少数同时实现晶圆级老化系统、功率芯片 KGD 分选测试系统产业化应用的厂商。根据 Frost&Sullivan 数据，2024 年中国碳化硅功率器件测试设备市场中，公司贡献 21.7% 的市场份额，位列国内市场第一；2024 年中国碳化硅功率器件晶圆级老化系统市场中，公司贡献 43.6% 的市场份额，位列国内市场第一；2023-2024 年中国碳化硅功率芯片 KGD 分选测试系统市场中，SPEA、Pentamaster 等海外企业占据多数市场份额，公司贡献 12.1% 的市场份额，位列国内市场第三、本土企业第一。

电性能测试设备领域，公司主要产品包括 WAT 测试机、晶圆级可靠性测试系统等，是国内少数具备精密源表等核心测试部件自主能力的电性能测试设备厂商。根据 Frost&Sullivan 数据，2024 年中国 WAT 测试机和晶圆级可靠性测试系统的市场份额大部分被 Keysight、QualiTau 等海外企业所占据；随着公司电性能测试设备产品持续市场拓展，公司的市场份额有望持续提升。

五、发行人符合科创板定位情况

（一）公司符合科创板行业领域要求

公司所属行业领域	☒ 新一代信息技术	公司所处行业符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》规定的“新一代信息技术领域”，属于《战略性新兴产业分类（2018）》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》中规定的国家重点鼓励、发展的战略性新兴产业，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》规定的对经济社会发展有重要促进作用的鼓励类产业； 公司符合国家科技创新战略相关要求，符合科创板行业领域定位
	☐ 高端装备	
	☐ 新材料	
	☐ 新能源	
	☐ 节能环保	
	☐ 生物医药	
	☐ 符合科创板定位的其他领域	

（二）公司符合科创属性相关指标要求

科创属性相关指标	是否符合	指标情况
最近 3 年累计研发投入占最近 3 年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近 3 年累计研发投入金额 $\geq 8,000$ 万元	☒ 是 ☐ 否	公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的研发投入分别为 5,357.28 万元、10,471.57 万元和 19,143.44 万元，累计研发投入 34,972.30 万元
研发人员占当年员工总数的比例 $\geq 10\%$	☒ 是 ☐ 否	截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员 348 人，占公司员工总数的 40.32%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 ≥ 7 项	☒ 是 ☐ 否	截至 2025 年 9 月 30 日，公司取得应用于主营业务并能够产业化的已授权发明专利 113 项
最近三年营业收入复合增长率 $\geq 25\%$ ，或最近一年营业收入金额 ≥ 3 亿元	☒ 是 ☐ 否	公司 2024 年度的营业收入为 78,862.99 万元

六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

报告期内，公司主要财务数据和财务指标如下：

项目	2025.9.30/ 2025 年 1-9 月	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度
资产总额（万元）	161,025.30	129,607.36	83,753.83	52,087.87
归属于母公司所有者权益（万元）	80,869.52	67,888.99	49,431.37	38,128.51

项目	2025.9.30/ 2025 年 1-9 月	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度
资产负债率（合并）	49.74%	47.66%	41.08%	26.71%
资产负债率（母公司）	47.28%	46.76%	40.85%	26.72%
营业收入（万元）	80,562.15	78,862.99	27,579.31	21,439.06
净利润（万元）	9,768.70	14,088.30	-5,670.31	-3,788.88
归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,664.30	14,049.48	-5,539.38	-3,807.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	9,293.49	13,209.65	-6,270.36	-2,745.79
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（扣除股份支付影响）（万元）	12,583.47	17,495.49	-1,752.02	-109.53
基本每股收益（元）	1.26	1.82	-0.73	-1.95
稀释每股收益（元）	1.26	1.82	-0.73	-1.95
加权平均净资产收益率	13.29%	24.89%	-12.44%	-23.73%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,548.27	8,078.58	-525.90	698.05
现金分红（万元）	-	-	-	2,106.41
研发投入占营业收入的比例	24.89%	24.27%	37.97%	24.99%

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

（一）财务报告审计截止日后的主要经营状况

本招股说明书已披露的财务报告的审计基准日为 2025 年 9 月 30 日。财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日之间，公司经营情况良好，公司产业政策、税收政策、行业市场环境、主要经营模式、主要客户及供应商的构成、经营管理层及核心技术人员未发生重大不利变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

（二）2025 年度审阅数据

容诚会计师对发行人 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表，2025 年度的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚阅字[2026]230Z0008 号）。

公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，详见本招股说明书“第六节财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况”。

公司 2025 年度经审阅的主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动比例
营业收入	119,406.84	78,862.99	51.41%
归属于母公司股东的净利润	17,365.16	14,049.48	23.60%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	16,979.92	13,209.65	28.54%
项目	2025 年 10-12 月	2024 年 10-12 月	变动比例
营业收入	38,844.69	26,945.46	44.16%
归属于母公司股东的净利润	7,700.85	5,238.14	47.02%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7,686.43	5,103.30	50.62%

2025 年度，公司实现营业收入 119,406.84 万元，较去年同期增长 51.41%，其中 2025 年 10-12 月实现营业收入 38,844.69 万元，较去年同期增长 44.16%，2025 年度及 2025 年 10-12 月公司营业收入、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期均有所增长，主要系公司所处行业发展趋势良好，公司下游客户需求保持高速增长，收入与利润水平较同期上升。

（三）2026 年 1-3 月业绩预计情况

基于公司目前的经营状况和市场环境，公司预计 2026 年 1-3 月主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月（预计）	2025 年 1-3 月	变动比例
营业收入	40,000 至 43,000	20,110.50	98.90%至 113.82%
归属于母公司股东的净利润	4,300 至 5,100	1,932.87	122.47%至 163.86%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4,100 至 4,900	1,751.45	134.09%至 179.77%

注：2025 年 1-3 月数据已经审计。

2026 年 1-3 月，公司预计可实现营业收入约 40,000 万元至 43,000 万元，同比增幅约 98.90%至 113.82%；公司预计可实现扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润同比增幅约为 122.47%至 163.86%和 134.09%至 179.77%，主要系公司所处行业市场的需求快速增长，主要客户业务发展势头良好，公司持续满足客户需求，经营规模持续增长，盈利能力稳步提升。

公司未编制和披露盈利预测信息，上述 2026 年 1-3 月业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计，未经注册会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

八、发行人选择的具体上市标准

发行人 2024 年度营业收入为 78,862.99 万元，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为 13,209.65 万元；结合发行人最近一次增资对应的估值情况，预计发行人发行后总市值不低于 10 亿元。发行人符合《科创板上市规则》中“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 1 亿元”的上市标准。

九、发行人公司治理特殊安排

截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排。

十、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用概况

根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，并经 2025 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，公司决定调整部分募投项目并取消“补充流动资金”项目，相应调整募集资金总额。

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，投向科技创新领域。本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目	51,279.22	51,279.22
2	车规芯片测试设备研发及产业化建设项目	19,885.27	19,885.27
3	存储测试设备研发及产业化建设项目	38,547.37	38,547.37
4	数字测试仪器研发及产业化建设项目	30,400.53	30,400.53
5	下一代测试仪表设备研发中心建设项目	31,031.89	31,031.89
合计		171,144.28	171,144.28

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将通过自筹资金解决；若本次发行实际募集资金高于募集资金投资项目投资额，剩余部分公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用。

本次募集资金投资项目的实施不会新增构成重大不利影响的同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

（二）未来发展规划

高端科学仪器设备的研发是推动科学技术发展的重要力量，公司将坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求开展技术研究，并依托强大的平台级核心技术体系，持续实现高端测试仪器设备的突破，提高我国高端科学仪器设备的自主可控水平，助力全球人工智能、新能源、半导体等前沿科技行业提升产品开发和量产效率。

电子测量仪器方面，公司是全球少数、国内极少数量产供货400G、800G、1.6T高速光模块核心测试仪器的厂商，全球第二家推出目前业内最高水平1.6T光模块全部核心测试仪器的厂商，国内极少数可以提供PXIe插卡式源表、低漏电开关矩阵、高压源表、脉冲源等多产品矩阵的厂商。未来，公司将持续关注与把握技术发展的前沿动态，一方面，持续向更高速率、更大带宽等性能指标迭代，向高集成度、高灵活度的发展方向创新；另一方面，持续挖掘精密源表作为底层硬件的技术潜力，不断拓宽产品线，以满足下游领域复杂度更高、精度更高、范围更广的测试需求。

半导体测试设备方面，公司是国内极少数覆盖芯片、晶圆等光通信产业链上游核心环节测试需求的厂商，极少数同时实现晶圆级老化系统、功率芯片 KGD 分选测试系统产业化应用的厂商，少数具备精密源表等核心测试部件自主能力的厂商。未来，公司将持续关注半导体前沿技术应用与测试需求，一方面，不断巩固和深化在光电子器件测试、功率器件测试与半导体集成电路测试领域的纵向竞争力；另一方面拓宽下游应用领域，加速推进在存储器件测试等领域的横向拓展。

公司将持续投入资金和人力资源，加强研发技术团队建设，完善内部管理，不断提升产业化运营能力，并有效发挥资本市场助力功能，不断巩固竞争优势和提升市场地位，力争成为国际高端测试仪器设备行业的领导者。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，不存在其他对公司有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、与发行人相关的风险

（一）技术风险

1、产品研发与技术开发风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“1、产品研发与技术开发风险”。

2、技术人才流失风险

公司所处的行业属于技术密集型、人才密集型产业。随着行业技术水平的不断发展，优秀和高端研发人才的需求缺口将日益扩大。未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势或人力资源政策及内部晋升制度得不到有效执行，公司将无法引进更多的高端技术人才，甚至可能出现现有骨干技术人员流失的情形，从而导致公司无法保持持续创新能力。

3、知识产权保护相关的风险

公司所处行业为知识与技术密集的行业，知识产权至关重要。公司在产品研发过程中，涉及到的专利及非专利技术等知识产权众多，需通过申请专利等方式保护自身核心技术并避免侵犯他人知识产权。但不能排除与竞争对手等相关方产生知识产权争议的可能，亦不能排除公司的知识产权被竞争对手等相关方侵权的可能，此类知识产权争议将有可能对公司的正常经营活动产生不利影响。

（二）经营风险

1、客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大客户实现营业收入分别为 9,140.96 万元、14,565.14 万元、34,868.28 万元和 29,760.94 万元，占当期营业收入的比重分别为 42.64%、52.81%、44.21% 和 36.94%，集中度相对较高。因公司的经营业绩与主要客户经营情况相关性较高，若

未来公司主要客户经营情况发生重大问题或公司与客户合作关系发生变化,公司将面临客户订单减少或流失等风险,进而影响公司生产经营,对公司的经营业绩造成不利影响。

2、产品质量风险

公司下游客户对公司产品的质量要求较高,而公司产品的质量和性能受到原材料、设计、制造、售后服务等多种因素的影响,无法完全排除因不可控因素导致出现产品质量问题。如果公司在产品生产过程中出现性能不稳定或质量问题,可能影响客户的满意度甚至产生质量纠纷、客户流失,将对公司的经营业绩造成不利影响。

3、税收优惠政策变动的风险

公司享受的税收优惠政策主要包括高新技术企业所得税优惠、先进制造业企业增值税加计抵减政策、研究开发费用加计扣除、小微企业税收优惠等。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整,或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠,将对公司的经营业绩造成不利影响。

4、经营场所租赁的风险

报告期内,公司部分生产经营场所通过租赁方式取得。虽然公司对经营场所的租赁行为一直处于持续稳定状态,但不排除出现租赁合同不能继续履行、到期无法续租或租金大幅上涨、租赁过程中发生出租方违约等情形。如果发生上述情形,则公司可能因需要搬迁而产生额外费用,在短期内亦可能会影响公司正常经营。

5、诉讼风险

截至本招股说明书签署日,公司与 Aehr 之间存在两起专利侵权纠纷诉讼。Aehr 以公司侵犯其在中国申请的两项专利权向人民法院提起诉讼,目前 Aehr 持有的涉案专利已经被国家知识产权局宣告部分无效,相关侵害发明专利权纠纷诉讼一审法院已作出《民事判决书》,判决驳回原告的全部诉讼请求。Aehr 和发行人均已就一审判决提起上诉,二审人民法院已立案。鉴于相关诉讼事项尚未取得生效判决,现有未决诉讼为公司所面临的风险之一,可能对公司的经营产生一定影响。

（三）财务风险

1、毛利率波动风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“2、毛利率波动风险”。

2、应收账款坏账损失的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“3、应收账款坏账损失的风险”。

3、存货跌价的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“4、存货跌价的风险”。

4、经营业绩下滑风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“6、经营业绩下滑风险”。

二、与行业相关的风险

（一）贸易环境变化及境外收入和采购波动风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“5、贸易环境变化及境外收入和采购波动风险”。

（二）市场竞争加剧风险

公司主营业务为电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务，具备电子测试仪器和半导体测试设备的自主研发及产业化能力。但是和国际龙头企业相比，公司在市场占有率、产品成熟度、多应用领域经验等方面仍然存在诸多差距；同时，随着行业内其他厂商在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，也不排除出现部分国内厂商抢占市场份额，公司所处行业市场竞争将日趋激烈。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则公司可能无法有效应对激烈的市场竞争，公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

（三）宏观经济及行业周期性波动风险

公司产品和服务目前主要面向光通信及半导体领域。其中，光通信领域主要取决于电信市场、数据中心等基础设施建设的景气程度；半导体行业与宏观经济形势密切相关，其需求直接受到芯片制造及终端应用市场的影响。尽管光通信、半导体行业面临全球化竞争与合作，并属于国家政策大力支持的战略新兴行业，但其受到国内外宏观经济、行业发展规律、行业法规和产业政策等因素的影响，存在一定的周期性。如果未来国内外宏观经济增长放缓或产业政策支持力度减弱使得行业发生周期性波动，可能导致公司产品的市场需求未来短期内有所下降，从而对公司的业务发展和经营业绩产生一定的不利影响。

三、其他风险

（一）募投项目实施的风险

本次募投项目基于现有的业务情况、行业发展趋势、国家经济环境、产业政策和未来技术发展方向制定。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精准预测，项目实施过程中可能出现投资额变动、无法按期投产等问题，将可能导致募投项目实施效果无法达到预期的效益水平，甚至对公司的经营成果造成一定程度的不利影响。

（二）募投项目新增折旧及研发人员薪酬影响公司盈利能力的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“7、募投项目新增折旧及研发人员薪酬影响公司盈利能力的风险”。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	苏州联讯仪器股份有限公司
英文名称	Semight Instruments Co., Ltd.
注册资本	7,700.0000 万元
法定代表人	胡海洋
有限公司成立日期	2017 年 3 月 15 日
股份公司成立日期	2022 年 10 月 31 日
注册地址	苏州高新区湘江路 1508 号 5 幢
主要生产经营地址	苏州高新区泰山路 315 号
邮政编码	215011
电话	0512-68780583
传真	0512-68780583
互联网网址	https://www.semight.com
电子信箱	ir@semight.com
信息披露和投资者关系的负责部门	董事会秘书办公室
信息披露和投资者关系的负责人	廖金
信息披露和投资者关系的电话号码	0512-68780583

二、发行人设立情况

（一）有限公司设立情况

2017年3月15日，杨建、潘易鹏共同签署《苏州联讯仪器有限公司章程》，约定共同以货币方式出资设立联讯有限。联讯有限设立时，潘易鹏系为胡海洋代持其股权，相关方于2018年1月解除了代持，具体代持原因及解除过程详见本节“二、发行人设立情况”之“（三）历史上股权代持及代持解除情况”。

2017年3月15日，联讯有限取得苏州市虎丘区市场监督管理局核发的《营业执照》。

联讯有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨建	135.0000	45.00
2	潘易鹏	165.0000	55.00

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
	合计	300.0000	100.00

（二）股份公司设立情况

公司系由联讯有限整体变更设立。2022年9月22日，容诚会计师出具《审计报告》（容诚审字[2022]230Z4085号），截至审计基准日2022年7月31日，联讯有限净资产账面价值为21,960.89万元。2022年9月23日，江苏中企华出具《苏州联讯仪器有限公司拟改制设立股份有限公司涉及的该公司净资产价值资产评估报告》（苏中资评报（2022）第2085号），截至评估基准日2022年7月31日，联讯有限净资产市场价值为23,346.36万元。

2022年9月24日，联讯有限召开关于整体变更为股份有限公司的股东会，全体股东一致同意：公司整体变更设立为股份有限公司，股份有限公司的名称为“苏州联讯仪器股份有限公司”，以经容诚会计师审计的净资产为基础折股，净资产大于股本总额的部分计入资本公积，即拟设立的股份公司的股份总数为7,000.00万股，每股面值人民币1元，均为普通股，股份公司股本总额为人民币7,000.00万元，股份公司注册资本为人民币7,000.00万元；有限公司股东在股份公司中的股本比例保持不变。

2022年9月24日，联讯有限全体发起人股东签署《关于苏州联讯仪器有限公司变更为苏州联讯仪器股份有限公司之发起人协议书》。

2022年10月10日，联讯仪器召开股份公司创立大会暨2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于苏州联讯仪器股份有限公司筹办情况的报告》等议案。

根据容诚会计师出具的《苏州联讯仪器股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0316号），截至2022年9月24日，公司已收到全体股东以其拥有的联讯有限净资产折合的实收资本7,000.00万元。

2022年10月31日，联讯仪器取得苏州市行政审批局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91320505MA1NK4RYXT，完成整体变更的工商变更登记。公司整体变更设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	胡海洋	1,582.0140	22.60
2	联睿光通	574.3780	8.21

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
3	黄建军	553.4200	7.91
4	博睿光通	534.1980	7.63
5	博恒睿哲	525.8400	7.51
6	鑫瑞集诚	499.4570	7.14
7	杨建	448.9030	6.41
8	中小企业发展基金	430.7870	6.15
9	芯未来一期	378.3780	5.41
10	南山架桥	331.6390	4.74
11	廉哲	242.7110	3.47
12	金镖	194.4740	2.78
13	华峰测控	189.1890	2.70
14	聚源创投	126.1260	1.80
15	硅星创投	124.8660	1.78
16	高新枫桥	86.1560	1.23
17	永鑫开拓	79.4010	1.13
18	金谷汇枫	63.0630	0.90
19	凯烁安明	24.9970	0.36
20	凯烁邦盛	10.0030	0.14
合计		7,000.0000	100.00

（三）历史上股权代持及代持解除情况

公司历史上曾存在股权代持情形。截至本招股说明书签署日，公司历史上股权代持均已经解除，公司股权清晰，不存在纠纷或潜在纠纷的情形。具体情况如下：

1、公司直接股东代持及清理情况

（1）股权代持形成的原因

2017年3月，公司前身联讯有限设立时，胡海洋尚未离开上海前往苏州定居，出于工商登记便利性的考虑，胡海洋委托其熟悉苏州本地工商登记流程的朋友潘易鹏代其持有联讯有限的股权。

联讯有限设立时的股权结构具体如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨建	135.0000	45.00
2	潘易鹏	165.0000	55.00
合计		300.0000	100.00

（2）股权代持演变情况及解除情况

2018 年 1 月，联讯有限通过股权转让方式解除了上述代持：杨建将其持有的联讯有限 45.00%股权转让予胡海洋，潘易鹏将其持有的联讯有限 45.00%的股权转让予杨建、10.00%的股权转让予胡海洋。

上述股权转让完成后，联讯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨建	135.0000	45.00
2	胡海洋	165.0000	55.00
合计		300.0000	100.00

至此，公司历史上曾存在的直接股东股权代持情况已经解除完毕。

2、公司员工持股平台中代持及清理情况

持股平台	股权激励份额代持人	股权激励份额实际合伙人	代持财产份额（万元）	对应公司持股比例	代持形成情况	代持清理情况
联睿光通	朱红	唐仁伟（朱红配偶）	25.0000	0.37%	2020 年 11 月，公司开展股权激励，彼时唐仁伟尚未正式入职，且出于家庭内部安排，由其配偶朱红（公司员工）代持股权激励份额	2025 年 5 月朱红将持有的全部联睿光通财产份额转让予唐仁伟，代持关系解除
博恒睿哲	江芳	林甲威（江芳配偶）、李甲福（与林甲威同一前单位）	133.2004	0.91%	2022 年 2 月，林甲威、李甲福拟加入公司并参与股权激励，但彼时二人尚未正式入职，因此由林甲威配偶江芳（公司员工）为二人代持股权激励份额	2025 年 5 月江芳将持有的全部博恒睿哲财产份额转让予林甲威、李甲福，代持关系解除

至此，公司历史上曾存在的员工持股平台中股权代持情况已经解除完毕。

三、发行人报告期内股本和股东变化情况

2022 年 1 月 1 日，联讯有限为有限责任公司，注册资本为 948.8337 万元，股权结

构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	胡海洋	309.7935	32.65
2	杨建	130.2092	13.72
3	联睿光通	86.4200	9.11
4	黄建军	85.8992	9.05
5	鑫瑞集诚	75.1476	7.92
6	中小企业发展基金	64.8148	6.83
7	南山架桥	49.8979	5.26
8	廉哲	41.7833	4.40
9	马耀文	34.3700	3.62
10	金镖	29.2600	3.08
11	硅星创投	18.7869	1.98
12	高新枫桥	12.9630	1.37
13	金谷汇枫	9.4883	1.00
合计		948.8337	100.00

公司报告期内股本和股东变化情况如下：

时间	工商变动事项	股东变化情况	变动后注册资本/ 股本（万元）
2022 年 2 月	股权转让	马耀文将其持有的 34.3700 万元注册资本转让给博睿光通；杨建将其持有的 46.0042 万元注册资本转让给博睿光通、将其持有的 14.8739 万元注册资本转让给博恒睿哲；胡海洋将其持有的 32.6472 万元注册资本转让给博恒睿哲	948.8337
2022 年 3 月	增资	联讯有限注册资本增加 104.3717 万元，其中，芯未来一期认缴 56.9300 万元，华峰测控认缴 28.4650 万元，聚源创投认缴 18.9767 万元	1,053.2054
2022 年 6 月	股权转让	胡海洋将其持有的 31.5962 万元注册资本转让给博恒睿哲	1,053.2054
2022 年 7 月	股权转让	胡海洋将其持有的 7.5229 万元注册资本转让给永鑫开拓；黄建军将其持有的 2.6330 万元注册资本转让给永鑫开拓；杨建将其持有的 1.7904 万元注册资本转让给永鑫开拓；廉哲将其持有的 3.7614 万元注册资本转让给凯烁安明；廉哲将其持有的 1.5046 万元注册资本转让给凯烁邦盛	1,053.2054
2022 年 10 月	股改	公司整体变更设立为股份有限公司	7,000.0000

时间	工商变动事项	股东变化情况	变动后注册资本/ 股本（万元）
2022 年 12 月	增资	联讯仪器注册资本增加 443.3333 万元，其中，永鑫融耀认缴 116.6667 万元，海通创新认缴 105.0000 万元，架桥富凯认缴 70.0000 万元，恒奕泰二期认缴 58.3333 万元，武汉光创认缴 46.6667 万元，茵联启芯认缴 23.3333 万元，柯桥长枫认缴 23.3333 万元	7,443.3333
2023 年 3 月	增资	联讯仪器注册资本增加 256.6667 万元，其中，国风投认缴 210.0000 万元，金谷汇枫认缴 46.6667 万元	7,700.0000

四、发行人成立以来重要事件（含报告期内的重大资产重组）

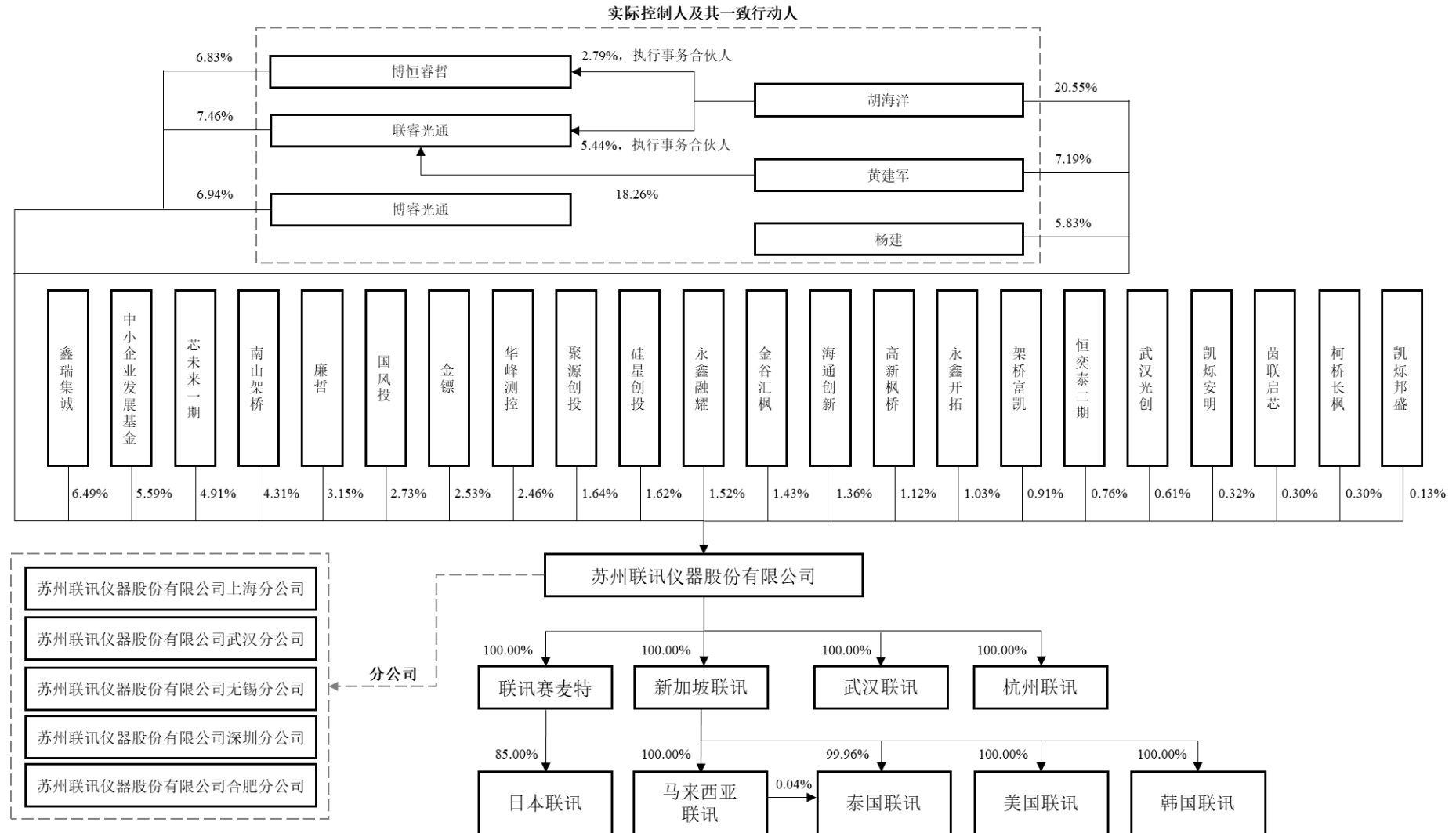
成立以来，公司未曾发生重大资产重组等重要事件。

五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况

截至本招股说明书签署日，公司未在其他证券市场上市或挂牌。

六、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构图如下：



七、发行人分公司、子公司及参股公司情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有 9 家控股子公司、2 家参股公司、5 家分公司，具体情况如下：

（一）控股子公司

截至本招股说明书签署日，公司控股子公司的基本情况如下：

1、联讯赛麦特

名称：	苏州联讯赛麦特半导体有限公司		
成立时间：	2022 年 11 月 18 日		
注册资本：	1,000.0000 万元		
实收资本：	500.0000 万元		
股东构成：	公司持股 100.00%		
注册地址：	苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢		
主要生产经营地：	江苏省苏州市		
主营业务及其与发行人主营业务的关系：	联讯赛麦特无实际经营业务		
主要财务数据（万元）：	科目	2025.9.30/ 2025 年 1-9 月	2024.12.31/ 2024 年度
	总资产	499.51	499.51
	净资产	499.51	499.51
	营业收入	-	-
	净利润	-0.002	-0.26
	审计情况	上述数据均已经容诚会计师在合并范围内审计	

2、武汉联讯

名称：	武汉联讯仪器有限公司		
成立时间：	2025 年 7 月 10 日		
注册资本：	2,000.0000 万元		
实收资本：	1,700.0000 万元		
股东构成：	公司持股 100.00%		
注册地址：	湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰一路 1 号生物创新园二期 I 期（全部自用）A4#厂房		
主要生产经营地：	湖北省武汉市		
主营业务及其与发行人主营业务的关系：	定位为产品研发，属于公司主营业务范围		

主要财务数据（万元）：	科目	2025.9.30/ 2025 年 1-9 月	2024.12.31/ 2024 年度
	总资产	2,687.82	尚未设立，无对应期间 财务数据
	净资产	656.79	
	营业收入	-	
	净利润	-43.21	
	审计情况	上述数据均已经容诚 会计师在合并范围内 审计	

3、杭州联讯

名称：	杭州联讯仪器有限公司		
成立时间：	2025 年 7 月 15 日		
注册资本：	2,000.0000 万元		
实收资本：	1,300.0000 万元		
股东构成：	公司持股 100.00%		
注册地址：	浙江省杭州市西湖区翠苑街道学院路 77 号 1 幢 1001 室		
主要生产经营地：	浙江省杭州市		
主营业务及其与发行人主营业务的关系：	定位为产品研发，属于公司主营业务范围		
主要财务数据（万元）：	科目	2025.9.30/ 2025 年 1-9 月	2024.12.31/ 2024 年度
	总资产	695.74	尚未设立，无对应期间 财务数据
	净资产	37.36	
	营业收入	-	
	净利润	-112.64	
	审计情况	上述数据均已经容诚 会计师在合并范围内 审计	

4、日本联讯

名称：	Semi next 株式会社		
成立时间：	2022 年 8 月 8 日		
注册资本：	9,800.0000 万日元		
实收资本：	9,800.0000 万日元		
股东构成：	联讯赛麦特持股 85.00%，福泽健持股 15.00%		
注册地址：	东京都江东区有明三丁目 7 番 18 号		
主要生产经营地：	日本		

主营业务及其与发行人主营业务的关系：	定位为海外分销主体，主要负责日本当地的产品销售及售后支持，属于公司主营业务范围		
主要财务数据（万元）：	科目	2025.9.30/ 2025 年 1-9 月	2024.12.31/ 2024 年度
	总资产	4,741.45	3,674.00
	净资产	1,108.44	403.79
	营业收入	4,553.82	3,532.33
	净利润	696.00	258.75
	审计情况	上述数据均已经容诚会计师在合并范围内审计	

5、新加坡联讯

名称：	NEXUSTEST PTE. LTD.		
成立时间：	2023 年 10 月 27 日		
注册资本：	49.0000 万新加坡元		
实收资本：	49.0000 万新加坡元		
股东构成：	公司持股 100.00%		
注册地址：	10 Science Park Road, #02-11, The Alpha, Singapore 117684		
主要生产经营地：	新加坡		
主营业务及其与发行人主营业务的关系：	定位为海外业务总部，主要负责海外产品销售等，属于公司主营业务范围		
主要财务数据（万元）：	科目	2025.9.30/ 2025 年 1-9 月	2024.12.31/ 2024 年度
	总资产	9,681.47	2,197.16
	净资产	5,369.52	2,060.58
	营业收入	706.23	-
	净利润	-251.92	-422.35
	审计情况	上述数据均已经容诚会计师在合并范围内审计	

6、马来西亚联讯

名称：	NEXUSTEST TECHNOLOGY SDN.BHD.		
成立时间：	2024 年 2 月 6 日		
注册资本：	250.0000 万林吉特		
实收资本：	250.0000 万林吉特		
股东构成：	新加坡联讯持股 100.00%		
注册地址：	35, 1st Floor, Jalan Kelisa Emas 1, Taman Kelisa Emas, Seberang Jaya, 13700 Pulau Pinang		
主要生产经营地：	马来西亚		
主营业务及其与发行人主营	定位为海外生产基地/海外售后服务基地，主要负责海外产品生产及售		

业务的关系：	后服务，属于公司主营业务范围		
主要财务数据（万元）：	科目	2025.9.30/ 2025 年 1-9 月	2024.12.31/ 2024 年度
	总资产	7,185.37	1,728.50
	净资产	2,502.10	635.95
	营业收入	812.77	2.85
	净利润	-1,031.31	-786.50
	审计情况	上述数据均已经容诚会计师在合并范围内审计	

7、泰国联讯

名称：	NEXUSTEST (THAILAND) CO., LTD.		
成立时间：	2024 年 11 月 6 日		
注册资本：	1,300.0000 万泰铢		
实收资本：	1,300.0000 万泰铢		
股东构成：	新加坡联讯持股 99.96%，马来西亚联讯持股 0.04%		
注册地址：	60/125, Moo 9 (A13-A14), Khlong Nueng Subdistrict, Khlong Luang District, Pathum Thani Province, Thailand.		
主要生产经营地：	泰国		
主营业务及其与发行人主营业务的关系：	定位为海外售后服务基地，主要负责海外产品售后服务，属于公司主营业务范围		
主要财务数据（万元）：	科目	2025.9.30/ 2025 年 1-9 月	2024.12.31/ 2024 年度
	总资产	115.16	0.02
	净资产	85.29	0.000006
	营业收入	-	-
	净利润	-111.75	0.000005
	审计情况	上述数据均已经容诚会计师在合并范围内审计	

8、美国联讯

名称：	NEXUSTEST TECHNOLOGIES INC.		
成立时间：	2025 年 2 月 11 日		
注册资本：	80.0000 万美元		
实收资本：	80.0000 万美元		
股东构成：	新加坡联讯持股 100.00%		
注册地址：	47787 FREMONT BLVD FREMONT, CA 94538		
主要生产经营地：	美国		
主营业务及其与发行人主营业务的关系：	定位为海外分销主体，主要负责美国当地的产品销售及售后支持，属于公司主营业务范围		

主要财务数据:	报告期内美国联讯尚未投入实际生产经营，无对应期间财务数据

9、韩国联讯

名称：	NEXUSTEST KOREA CO., LTD.		
成立时间：	2025 年 2 月 26 日		
注册资本：	19,970.0000 万韩元		
实收资本：	19,970.0000 万韩元		
股东构成：	新加坡联讯持股 100.00%		
注册地址：	314 Bucheon-ro, Wonmi-gu,Bucheon-si, Gyeonggi-do, South Korea, Unit 101 (Dodang-ro)		
主要生产经营地：	韩国		
主营业务及其与发行人主营业务的关系：	定位为海外分销主体，主要负责韩国当地的产品销售及售后支持，属于发行人主营业务范围		
主要财务数据（万元）：	科目	2025.9.30/ 2025 年 1-9 月	2024.12.31/ 2024 年度
	总资产	503.12	尚未设立，无对应期间财务数据
	净资产	447.59	
	营业收入	-	
	净利润	-108.22	
	审计情况	上述数据均已经容诚会计师在合并范围内审计	

（二）参股公司

截至本招股说明书签署日，公司参股公司的基本情况如下：

1、思诺威

名称:	思诺威科技（无锡）有限公司
成立时间:	2019 年 9 月 2 日
注册资本:	1,153.8462 万元
实收资本:	492.5921 万元
出资金额:	2,000.0000 万元
入股时间:	2023 年 10 月 16 日
股东构成:	王镇持股 26.44%，无锡中领微集成电路合伙企业（有限合伙）持股 26.01%，无锡指北针集成电路合伙企业（有限合伙）持股 22.53%，公司持股 6.67%，东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业（有限合伙）持股 5.00%，以及其他 4 位持股 5%以下股东
注册地址:	无锡市新吴区弘毅路 8 号金帛座 602 室
主营业务:	高性能芯片设计

2、合晶诺

名称:	苏州合晶诺科技有限公司
成立时间:	2025 年 6 月 21 日
注册资本:	1,000.0000 万元
实收资本:	620.0000 万元
出资金额:	400.0000 万元
入股时间:	2025 年 6 月 21 日
股东构成:	王永持股 60.00%，公司持股 40.00%
注册地址:	苏州高新区金枫路 655 号 3 幢一楼
主营业务:	精密零部件制造

(三) 分公司情况

截至本招股说明书签署日，公司分公司的基本情况如下：

序号	公司名称	成立时间	主营业务情况
1	苏州联讯仪器股份有限公司武汉分公司	2022 年 6 月 7 日	研发
2	苏州联讯仪器股份有限公司上海分公司	2022 年 11 月 10 日	未开展实际业务，仅作为公司员工的社保及公积金缴纳主体
3	苏州联讯仪器股份有限公司无锡分公司	2022 年 6 月 23 日	
4	苏州联讯仪器股份有限公司深圳分公司	2023 年 10 月 23 日	
5	苏州联讯仪器股份有限公司合肥分公司	2025 年 11 月 7 日	

八、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况

(一) 控股股东和实际控制人基本情况

截至本招股说明书签署日，胡海洋直接持有公司 20.55%的股份，并通过其担任执行事务合伙人的员工持股平台联睿光通、博恒睿哲分别间接控制公司 7.46%、6.83%的股份，合计控制公司 34.83%的股份，系发行人控股股东。

胡海洋、黄建军、杨建三人于 2019 年 12 月 5 日签署《一致行动人协议》，约定各方拟在公司董事会以及股东会中采取一致行动，《一致行动人协议》自生效之日起至首次公开发行股票并上市五年内持续有效；各方在行使股东权利或者董事权利前应充分协商和沟通，直至达成一致意见，如无法达成一致意见，则以胡海洋表决意见为准。为进一步保障公司持续稳定发展，提高公司经营决策效率，胡海洋、黄建军、杨建、联睿光通、博睿光通和博恒睿哲签署了《一致行动人协议补充协议》，协议约定联睿光通、博

睿光通和博恒睿哲在行使股东权利等重大事项决策过程中与胡海洋、黄建军、杨建三人采取一致行动，发生意见分歧或纠纷时以胡海洋表决意见为准。截至本招股说明书签署日，胡海洋、黄建军、杨建三人分别直接持有公司 20.55%、7.19%、5.83%的股份，合计直接持有公司 33.56%的股份；通过员工持股平台联睿光通、博睿光通和博恒睿哲分别间接控制公司 7.46%、6.94%、6.83%的股份，合计间接控制公司 21.23%的股份；直接和间接合计控制公司 54.79%的股份。胡海洋、黄建军、杨建三人控制的股份足以对发行人股东会、董事会的决议产生重大影响，能够实际支配发行人的决策和行为，系发行人实际控制人。

公司实际控制人胡海洋、黄建军和杨建的基本情况如下：

胡海洋，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，身份证号：610104197309*****。2001 年 7 月毕业于中国科学院上海精密光学机械研究所光学工程专业；2001 年 7 月至 2016 年 8 月历任安捷伦科技软件有限公司（期间更名为是德科技（中国）有限公司）应用工程师、实验室主任、资深技术顾问；2016 年 8 月至 2017 年 5 月任上海乘讯信息科技有限公司市场总监；2017 年 6 月至 2022 年 10 月历任联讯有限执行董事、董事长；2022 年 10 月至今任公司董事长。现兼任联讯赛麦特执行董事、武汉联讯执行董事、杭州联讯执行董事、思诺威董事。

黄建军，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，身份证号：320124198101*****。2006 年 6 月毕业于北京工业大学光学工程专业；2001 年 7 月至 2002 年 7 月任光炬科技（深圳）有限公司（后更名为新美亚科技（深圳）有限公司）助理工程师；2006 年 7 月至 2006 年 9 月任昂纳信息技术（深圳）有限公司工程师；2006 年 10 月至 2008 年 9 月任捷迪讯光电（深圳）有限公司高级工程师；2008 年 10 月至 2017 年 12 月历任菲尼萨光电通讯（上海）有限公司高级工程师、工程经理、工程总监；2018 年 1 月至 2022 年 10 月任联讯有限董事、总经理；2022 年 10 月至今任公司董事、总经理。现兼任新加坡联讯董事、马来西亚联讯董事、泰国联讯董事、美国联讯董事。

杨建，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，身份证号：370105198004*****。2006 年 7 月毕业于华中科技大学通信工程专业；2006 年 7 月至 2010 年 12 月任青岛朗讯科技通讯设备有限公司技术支持；2011 年 1 月至 2017

年2月任安捷伦科技软件有限公司（期间更名为是德科技（中国）有限公司）销售经理；2017年3月至2022年10月任联讯有限副总经理，历任联讯有限执行董事、董事；2022年10月至今任公司董事、副总经理。现兼任日本联讯执行董事、新加坡联讯董事、马来西亚联讯董事、泰国联讯董事、美国联讯董事、韩国联讯董事。

（二）实际控制人的一致行动人

截至本招股说明书签署日，公司员工持股平台联睿光通、博睿光通和博恒睿哲为实际控制人的一致行动人，基本情况如下：

1、联睿光通

名称：	苏州联睿光通企业管理中心（有限合伙）
成立时间：	2019年11月29日
出资额：	500.0000万元
实收资本：	500.0000万元
执行事务合伙人：	胡海洋
住所：	苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢
经营范围：	一般项目：企业管理；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务：	员工持股平台，仅持有发行人股份，未从事其他经营活动

截至本招股说明书签署日，联睿光通的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	胡海洋	普通合伙人	27.2072	5.44
2	黄建军	普通合伙人	91.2752	18.26
3	邓寒	有限合伙人	60.9355	12.19
4	张纪	有限合伙人	35.0000	7.00
5	潘朝松	有限合伙人	32.0000	6.40
6	梁仕帮	有限合伙人	30.4677	6.09
7	郭孝明	有限合伙人	25.0000	5.00
8	赵山	有限合伙人	25.0000	5.00
9	吴永红	有限合伙人	25.0000	5.00
10	唐仁伟	有限合伙人	25.0000	5.00
11	徐鹏嵩	有限合伙人	25.0000	5.00
12	魏雷	有限合伙人	23.1555	4.63

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
13	周立东	有限合伙人	12.5000	2.50
14	项加平	有限合伙人	4.3525	0.87
15	张盼盼	有限合伙人	4.2655	0.85
16	黄芳	有限合伙人	4.2655	0.85
17	华强	有限合伙人	4.0624	0.81
18	程妍	有限合伙人	3.6561	0.73
19	张杰	有限合伙人	3.5546	0.71
20	姚慧	有限合伙人	3.3515	0.67
21	张婷婷	有限合伙人	2.7421	0.55
22	廖金	有限合伙人	2.6115	0.52
23	张金萍	有限合伙人	2.0312	0.41
24	朱叶霞	有限合伙人	2.0312	0.41
25	张学增	有限合伙人	1.9296	0.39
26	程亮	有限合伙人	1.8861	0.38
27	高瑞刚	有限合伙人	1.8861	0.38
28	秦昊	有限合伙人	1.7410	0.35
29	郑金梅	有限合伙人	1.7265	0.35
30	张旭	有限合伙人	1.5234	0.30
31	马文娟	有限合伙人	1.5234	0.30
32	李娜	有限合伙人	1.4509	0.29
33	江超	有限合伙人	1.4218	0.28
34	朱良	有限合伙人	1.2187	0.24
35	屠若宇	有限合伙人	1.2187	0.24
36	顾巧云	有限合伙人	1.0156	0.20
37	王镜栋	有限合伙人	1.0156	0.20
38	柳艳君	有限合伙人	1.0156	0.20
39	丁毅华	有限合伙人	0.9140	0.18
40	杜玫	有限合伙人	0.8705	0.17
41	徐国伟	有限合伙人	0.8125	0.16
42	李永国	有限合伙人	0.5368	0.11
43	杨东阳	有限合伙人	0.5078	0.10
44	邹冬	有限合伙人	0.5078	0.10
45	周春美	有限合伙人	0.4062	0.08

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
46	刘珊珊	有限合伙人	0.2031	0.04
47	王辉	有限合伙人	0.2031	0.04
合计			500.0000	100.00

2、博睿光通

名称：	苏州博睿光通企业管理中心（有限合伙）
成立时间：	2022 年 1 月 18 日
出资额：	1,016.5000 万元
实收资本：	1,016.5000 万元
执行事务合伙人：	周晓峰
住所：	苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢
经营范围：	一般项目：企业管理；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务：	员工持股平台，仅持有发行人股份，未从事其他经营活动

截至本招股说明书签署日，博睿光通的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	周晓峰	普通合伙人	274.5000	27.00
2	陈晓东	有限合伙人	243.0000	23.91
3	马耀文	有限合伙人	217.0000	21.35
4	罗跃浩	有限合伙人	133.0000	13.08
5	彭兴贵	有限合伙人	89.0000	8.76
6	廖金	有限合伙人	60.0000	5.90
合计			1,016.5000	100.00

3、博恒睿哲

名称：	苏州博恒睿哲企业管理中心（有限合伙）
成立时间：	2022 年 1 月 19 日
出资额：	1,000.5971 万元
实收资本：	1,000.5971 万元
执行事务合伙人：	胡海洋
住所：	苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢
经营范围：	一般项目：企业管理；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务：	员工持股平台，仅持有发行人股份，未从事其他经营活动

截至本招股说明书签署日，博恒睿哲的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	胡海洋	普通合伙人	27.9070	2.79
2	邵毅男	有限合伙人	274.5000	27.43
3	邓寒	有限合伙人	266.3997	26.62
4	林甲威	有限合伙人	110.3661	11.03
5	张来阳	有限合伙人	53.2801	5.32
6	丁浩	有限合伙人	38.1840	3.82
7	李甲福	有限合伙人	22.8343	2.28
8	生兆东	有限合伙人	21.5341	2.15
9	赵凤丽	有限合伙人	14.4300	1.44
10	施志虎	有限合伙人	13.3199	1.33
11	金鹏	有限合伙人	13.3199	1.33
12	王茂庆	有限合伙人	9.3239	0.93
13	闫亚超	有限合伙人	9.3239	0.93
14	贺江云	有限合伙人	8.8800	0.89
15	杜佳伟	有限合伙人	5.9940	0.60
16	朱晶	有限合伙人	5.9940	0.60
17	唐念	有限合伙人	5.7720	0.58
18	徐立	有限合伙人	5.7720	0.58
19	刘珊珊	有限合伙人	5.3280	0.53
20	曹勋	有限合伙人	5.3280	0.53
21	谢智寅	有限合伙人	5.3280	0.53
22	范学斌	有限合伙人	4.8840	0.49
23	陈煌娟	有限合伙人	4.6620	0.47
24	蔡超	有限合伙人	4.2180	0.42
25	赵子闯	有限合伙人	4.2180	0.42
26	刘玉龙	有限合伙人	4.2180	0.42
27	刘军	有限合伙人	4.2180	0.42
28	蒋国家	有限合伙人	4.2180	0.42
29	张爱林	有限合伙人	4.2180	0.42
30	李永国	有限合伙人	3.6156	0.36
31	李英	有限合伙人	3.3300	0.33
32	蔡春海	有限合伙人	3.1080	0.31

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
33	熊国宝	有限合伙人	3.1080	0.31
34	李同林	有限合伙人	3.1080	0.31
35	薛腾	有限合伙人	3.1080	0.31
36	王飞	有限合伙人	3.1080	0.31
37	邓仁辉	有限合伙人	3.1080	0.31
38	杨帆	有限合伙人	3.1080	0.31
39	杨志明	有限合伙人	3.1080	0.31
40	周春美	有限合伙人	2.8543	0.29
41	薛黎明	有限合伙人	2.8543	0.29
42	王勇	有限合伙人	1.9980	0.20
43	张文刚	有限合伙人	1.1100	0.11
44	许昌平	有限合伙人	1.1100	0.11
45	王玉春	有限合伙人	0.8880	0.09
合计			1,000.5971	100.00

（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在被质押、冻结、发生诉讼纠纷或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人持有的公司股份不存在被质押、冻结、发生诉讼纠纷或其他有争议的情况。

（四）控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

（五）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东

截至本招股说明书签署日，除公司控股股东、实际控制人及其一致行动人外，其他持有公司 5%以上股份的股东为鑫瑞集诚、中小企业发展基金和南山架桥（及架桥富凯），其基本情况如下：

1、鑫瑞集诚

截至本招股说明书签署日，鑫瑞集诚持有公司 499.4570 万股，持股比例为 6.49%。
鑫瑞集诚的基本情况如下：

名称：	鑫瑞集诚（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：	2019 年 12 月 6 日
出资额：	30,800.0000 万元
执行事务合伙人：	厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司
统一社会信用代码：	91350200MA33F0MY5X
住所：	厦门市集美区杏林湾路 492 号 2101 单元 B32
经营范围：	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；创业投资咨询业务；未涉及外商投资准入特别管理措施范围内及审批许可的其他一般经营项目
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关

截至本招股说明书签署日，鑫瑞集诚的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司	普通合伙人	369.6000	1.20
2	王育贤	有限合伙人	22,176.0000	72.00
3	胡育琛	有限合伙人	7,022.4000	22.80
4	吴亚宏	有限合伙人	1,232.0000	4.00
合计			30,800.0000	100.00

2、中小企业发展基金

截至本招股说明书签署日，中小企业发展基金持有公司 430.7870 万股，持股比例为 5.59%。中小企业发展基金的基本情况如下：

名称：	江苏中小企业发展基金（有限合伙）
成立时间：	2016 年 11 月 4 日
出资额：	450,000.0000 万元
执行事务合伙人：	江苏毅达股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：	91320000MA1MYEW57N
住所：	南京市浦口区慧成街 3 号
经营范围：	以对中小企业开展创业投资业务为主，进行股权投资及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关

截至本招股说明书签署日，中小企业发展基金的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	4,500.0000	1.00
2	江苏毅达中小企业发展基金（有限合伙）	有限合伙人	244,000.0000	54.22
3	国家中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	110,000.0000	24.44
4	江苏省政府投资基金（有限合伙）	有限合伙人	67,500.0000	15.00
5	太平财产保险有限公司	有限合伙人	24,000.0000	5.33
合计			450,000.0000	100.00

3、南山架桥及架桥富凯

截至本招股说明书签署日，南山架桥与架桥富凯同为深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司控制的主体，南山架桥持有公司 331.6390 万股，持股比例为 4.31%；架桥富凯持有公司 70.0000 万股，持股比例为 0.91%；南山架桥与架桥富凯合计持有公司 401.6390 万股，持股比例为 5.22%。南山架桥和架桥富凯的基本情况如下：

（1）南山架桥

名称：	深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：	2016 年 5 月 11 日
出资额：	68,300.0000 万元
执行事务合伙人：	深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：	91440300MA5DCE9A0H
住所：	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路 6 号港之龙科技园科技孵化中心 2 层 D 区发现创客空间 5D
经营范围：	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）
主营业务及与发行人主营业务关系：	股权投资，与发行人主营业务无关

截至本招股说明书签署日，南山架桥的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司	普通合伙人	1,000.0000	1.46
2	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	12,500.0000	18.30
3	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	有限合伙人	12,000.0000	17.57

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
4	宁波保税区优备股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,050.0000	8.86
5	宁波保税区优智股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,050.0000	8.86
6	森霸传感科技股份有限公司	有限合伙人	3,000.0000	4.39
7	远海明晟（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000.0000	4.39
8	赣州利荣投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,600.0000	3.81
9	深圳市架桥资本管理股份有限公司	有限合伙人	2,134.0000	3.12
10	深圳前海鑫辰投资管理有限公司	有限合伙人	2,000.0000	2.93
11	珠海横琴架桥企业管理咨询有限公司	有限合伙人	1,500.0000	2.20
12	中美联泰大都会人寿保险有限公司	有限合伙人	1,500.0000	2.20
13	深圳市架桥资产管理有限公司	有限合伙人	1,500.0000	2.20
14	沈福根	有限合伙人	1,400.0000	2.05
15	横琴志合行远股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,366.0000	2.00
16	陆曙光	有限合伙人	1,200.0000	1.76
17	顾友花	有限合伙人	1,100.0000	1.61
18	上海乐黎商务服务中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000.0000	1.46
19	苏州恒润进出口有限公司	有限合伙人	1,000.0000	1.46
20	王嘉莉	有限合伙人	1,000.0000	1.46
21	万峰	有限合伙人	1,000.0000	1.46
22	徐彦辉	有限合伙人	1,000.0000	1.46
23	青岛乾沛投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.0000	1.46
24	利得资本管理有限公司	有限合伙人	900.0000	1.32
25	苏州市鼎立包装有限公司	有限合伙人	500.0000	0.73
26	仲兆兵	有限合伙人	500.0000	0.73
27	深圳神策维新信息科技有限公司	有限合伙人	500.0000	0.73
合计			68,300.0000	100.00

(2) 架桥富凯

名称:	深圳市架桥富凯二十五号投资合伙企业（有限合伙）
成立时间:	2021 年 12 月 21 日

出资额:	4,000.0000 万元
执行事务合伙人:	深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司
统一社会信用代码:	91440300MA5H5NQN5G
住所:	深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 2403
经营范围:	创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务关系:	股权投资，与发行人主营业务无关

截至本招股说明书签署日，架桥富凯的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司	普通合伙人	40.0000	1.00
2	深圳市架桥资本管理股份有限公司	有限合伙人	1,320.0000	33.00
3	秦大乾	有限合伙人	2,112.0000	52.80
4	张萍	有限合伙人	528.0000	13.20
合计			4,000.0000	100.00

九、发行人特别表决权股份或类似安排的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

十、发行人协议控制架构的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构。

十一、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

本次发行前公司总股本为 7,700.0000 万股，本次公开发行 2,566.6667 万股的人民币普通股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及老股东公开发售股份的情形。本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

序号	股东名称/姓名	发行前		发行后	
		持股数量 （万股）	持股比例（%）	持股数量 （万股）	持股比例（%）
1	胡海洋	1,582.0140	20.55	1,582.0140	15.41
2	联睿光通	574.3780	7.46	574.3780	5.59

序号	股东名称/姓名	发行前		发行后	
		持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
3	黄建军	553.4200	7.19	553.4200	5.39
4	博睿光通	534.1980	6.94	534.1980	5.20
5	博恒睿哲	525.8400	6.83	525.8400	5.12
6	鑫瑞集诚	499.4570	6.49	499.4570	4.86
7	杨建	448.9030	5.83	448.9030	4.37
8	中小企业发展基金	430.7870	5.59	430.7870	4.20
9	芯未来一期	378.3780	4.91	378.3780	3.69
10	南山架桥	331.6390	4.31	331.6390	3.23
11	廉哲	242.7110	3.15	242.7110	2.36
12	国风投	210.0000	2.73	210.0000	2.05
13	金镖	194.4740	2.53	194.4740	1.89
14	华峰测控	189.1890	2.46	189.1890	1.84
15	聚源创投	126.1260	1.64	126.1260	1.23
16	硅星创投	124.8660	1.62	124.8660	1.22
17	永鑫融耀	116.6667	1.52	116.6667	1.14
18	金谷汇枫	109.7297	1.43	109.7297	1.07
19	海通创新 (CS)	105.0000	1.36	105.0000	1.02
20	高新枫桥 (CS)	86.1560	1.12	86.1560	0.84
21	永鑫开拓	79.4010	1.03	79.4010	0.77
22	架桥富凯	70.0000	0.91	70.0000	0.68
23	恒奕泰二期	58.3333	0.76	58.3333	0.57
24	武汉光创	46.6667	0.61	46.6667	0.45
25	凯烁安明	24.9970	0.32	24.9970	0.24
26	茵联启芯	23.3333	0.30	23.3333	0.23
27	柯桥长枫	23.3333	0.30	23.3333	0.23
28	凯烁邦盛	10.0030	0.13	10.0030	0.10
本次公开发行的股份		-	-	2,566.6667	25.00
合计		7,700.0000	100.00	10,266.6667	100.00

(二) 本次发行前公司前十名股东持股情况

截至本招股说明书签署日，公司前十名股东及其直接持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	直接持股数量（万股）	直接持股比例（%）
1	胡海洋	1,582.0140	20.55
2	联睿光通	574.3780	7.46
3	黄建军	553.4200	7.19
4	博睿光通	534.1980	6.94
5	博恒睿哲	525.8400	6.83
6	鑫瑞集诚	499.4570	6.49
7	杨建	448.9030	5.83
8	中小企业发展基金	430.7870	5.59
9	芯未来一期	378.3780	4.91
10	南山架桥	331.6390	4.31

（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在发行人处任职情况

截至本招股说明书签署日，公司自然人股东及其在公司担任职务的情况如下：

序号	姓名	直接持股数量（万股）	直接持股比例（%）	公司任职情况
1	胡海洋	1,582.0140	20.55	董事长
2	黄建军	553.4200	7.19	董事、总经理
3	杨建	448.9030	5.83	董事、副总经理
4	廉哲	242.7110	3.15	董事、副总经理
5	金鏢	194.4740	2.53	曾担任公司研发经理，因个人原因于 2022 年离职

（四）发行人股本中的国有股份及外资股份情况

截至本招股说明书签署日，公司股东海通创新、高新枫桥属于国有实际控制股东（标识为“CS”）。根据上海市国有资产监督管理委员会 2025 年 4 月 8 日出具的《市国资委关于苏州联讯仪器股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复》（沪国资委产权〔2025〕87 号），如公司在境内发行股票并上市，海通创新和高新枫桥的证券账户应标注“CS”标识。相关国有股东具体情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	股东性质
海通创新	105.0000	1.36%	CS
高新枫桥	86.1560	1.12%	CS

截至本招股说明书签署日，公司不存在外资股东。

（五）发行人申报前十二个月新增股东情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在申报前十二个月新增股东。

（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及各自持股比例

截至本招股说明书签署日，公司直接股东之间的关联关系、一致行动关系及持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量 (万股)	直接持股比例 (%)	关联关系及一致行动关系
1	胡海洋	1,582.0140	20.55	胡海洋任联睿光通执行事务合伙人并持有 5.44% 的财产份额，黄建军持有联睿光通 18.26% 的财产份额
	黄建军	553.4200	7.19	
	联睿光通	574.3780	7.46	
2	胡海洋	1,582.0140	20.55	胡海洋任博恒睿哲执行事务合伙人并持有 2.79% 的财产份额
	博恒睿哲	525.8400	6.83	
3	胡海洋	1,582.0140	20.55	实际控制人胡海洋、黄建军、杨建与员工持股平台联睿光通、博睿光通、博恒睿哲存在一致行动关系
	黄建军	553.4200	7.19	
	杨建	448.9030	5.83	
	联睿光通	574.3780	7.46	
	博睿光通	534.1980	6.94	
	博恒睿哲	525.8400	6.83	
4	南山架桥	331.6390	4.31	南山架桥与架桥富凯同为深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司控制的主体
	架桥富凯	70.0000	0.91	
5	永鑫融耀	116.6667	1.52	永鑫开拓与永鑫融耀同为苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙）控制的主体
	永鑫开拓	79.4010	1.03	
6	凯烁安明	24.9970	0.32	凯烁安明与凯烁邦盛同为上海凯烁投资管理有限公司控制的主体
	凯烁邦盛	10.0030	0.13	
7	金谷汇枫	109.7297	1.43	金谷汇枫和高新枫桥已于 2025 年 11 月签署《一致行动协议》，存在一致行动关系
	高新枫桥	86.1560	1.12	

除上述情况外，公司其他直接股东之间不存在关联关系。

（七）现有股东私募投资基金备案情况

截至本招股说明书签署日，公司共有机构股东 23 名，其中 17 名为私募投资基金，均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等规定在中国证券投资基金业协会进行登记或备案，具体情况如下：

序号	股东名称	私募基金备案情况	管理人登记情况
1	鑫瑞集诚	基金编号为 SJL824	基金管理人为厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司，登记编号为 P1062803
2	中小企业发展基金	基金编号为 SR1700	基金管理人为江苏毅达股权投资基金管理有限公司，登记编号为 P1001459
3	芯未来一期	基金编号为 SSQ525	基金管理人为上海兴橙投资管理有限公司，登记编号为 P1028590
4	南山架桥	基金编号为 SL3328	基金管理人为深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司，登记编号为 P1015157
5	国风投	基金编号为 SZA004	基金管理人为国风投创新私募基金管理有限公司，登记编号为 P1074169
6	聚源创投	基金编号为 SNN898	基金管理人为中芯聚源私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙），登记编号为 P1030872
7	硅星创投	基金编号为 SJL970	基金管理人为上海硅港私募基金管理有限公司，登记编号为 P1070148
8	永鑫融耀	基金编号为 SZQ879	基金管理人为苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙），登记编号为 P1017017
9	金谷汇枫	基金编号为 SNJ227	基金管理人为苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司，登记编号为 P1032059
10	永鑫开拓	基金编号为 STD538	基金管理人为苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙），登记编号为 P1017017
11	架桥富凯	基金编号为 SXY942	基金管理人为深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司，登记编号为 P1015157
12	恒奕泰二期	基金编号为 SXU857	基金管理人为广东恒奕泰私募基金管理有限公司，登记编号为 P1072563
13	武汉光创	基金编号为 SQS902	基金管理人为武汉光谷产业投资基金管理有限公司，登记编号为 P1064746
14	凯烁安明	基金编号为 SVS971	基金管理人为上海凯烁投资管理有限公司，登记编号为 P1070638
15	茵联启芯	基金编号为 SXZ466	基金管理人为茵联创新投资基金管理（北京）有限公司，登记编号为 P1062631
16	柯桥长枫	基金编号为 SZA146	基金管理人为国科西子（上海）私募基金管理有限公司，登记编号为 P1073612
17	凯烁邦盛	基金编号为 SQN488	基金管理人为上海凯烁投资管理有限公司，登记编号为 P1070638

（八）发行人股东公开发售股份的情况

公司本次发行不涉及股东公开发售股份的情况。

（九）股东特殊权利条款及其解除情况

在历次融资中，公司及部分原始股东曾与外部投资人存在特殊权利安排协议，具体情况如下：

序号	特殊权利条款签署时间	协议名称	签署方	主要特殊权利条款
1	2019-03	《增资协议之补充协议》	中小企业发展基金、高新枫桥、发行人、胡海洋、杨建、黄建军、廉哲	优先认购权、优先购买权、共同出售权、反稀释权、最优惠待遇等
2	2019-05	《股权转让协议补充协议》	南山架桥、发行人、胡海洋、杨建、黄建军、廉哲、马耀文、金镖	
3	2020-11	《增资协议之补充协议》	鑫瑞集诚、胡海洋、杨建、黄建军、廉哲、联睿光通	
4	2021-01	《股权转让协议》	南山架桥、发行人、胡海洋、杨建、黄建军、廉哲	
5	2021-01	《股权转让协议补充协议》	南山架桥、发行人、胡海洋、杨建、黄建军、廉哲	
6	2021-03	《股权转让协议》	硅星创投、发行人、胡海洋、杨建、黄建军	
7	2021-08	《增资协议之补充协议》	金谷汇枫、发行人、胡海洋、杨建、黄建军、廉哲	
8	2022-02	《补充合作协议》	芯未来一期、发行人、胡海洋、杨建、黄建军、廉哲	
9	2022-02	《股东协议》	芯未来一期、华峰测控、聚源创投、发行人、胡海洋、杨建、黄建军、廉哲、金镖、联睿光通、博恒睿哲、博睿光通、中小企业发展基金、南山架桥、高新枫桥、鑫瑞集诚、硅星创投、金谷汇枫	
10	2022-05	《股权转让协议之补充协议》	永鑫开拓、发行人、胡海洋、杨建、黄建军、廉哲	
11	2022-05	《股权转让协议之补充协议》	凯烁安明、凯烁邦盛、发行人、胡海洋、杨建、黄建军、廉哲	
12	2023-03	《承诺函》	国风投、胡海洋、杨建、黄建军	

截至本招股说明书签署日，公司与外部投资人曾存在的特殊权利安排协议解除情况如下：

享有股东特殊权利的主体	特殊权利解除情况
中小企业发展基金、高新枫桥、鑫瑞集诚、硅星创投、永鑫开拓、芯未来一期、南山架桥、华峰测控、聚源创投、凯烁安明、凯烁邦盛、金谷汇枫	确认上述特殊权利未曾实际触发、执行，且上述特殊权利已不可撤销地彻底终止，且自始无效、不得恢复

截至本招股说明书签署日，公司上述涉及签署特殊权利安排协议的原始股东与外部投资人曾存在的特殊权利安排协议解除情况如下：

享有股东特殊权利的主体	特殊权利解除情况
中小企业发展基金、高新枫桥、鑫瑞集诚、硅星创投、永鑫开拓、金谷汇枫、凯烁安明、凯烁邦盛、南山架桥	确认上述特殊权利未曾实际触发、执行，且上述特殊权利已自解除协议签署之日起不可撤销地彻底终止，且自始无效、不得恢复

享有股东特殊权利的主体	特殊权利解除情况
芯未来一期、华峰测控、聚源创投、国风投	确认上述特殊权利未曾实际触发、执行，且上述特殊权利已自联讯仪器完成 IPO 辅导验收之日起不可撤销地彻底终止，且自始无效、不得恢复

据此，截至本招股说明书签署日，各方已签订协议确认上述特殊权利未曾实际触发、执行，且上述特殊权利已不可撤销地彻底终止，且自始无效、不得恢复。

综上，截至本招股说明书签署日，公司已清理完毕相关股东特殊权利条款。公司不作为对赌协议的当事人，股东之间的特殊权利义务安排不存在可能导致公司控制权发生变化的约定，不与市值挂钩，不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，符合《监管规则适用指引——发行类第 4 号》“4-3 对赌协议”的相关要求。

十二、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况

1、董事会成员

截至本招股说明书签署日，公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，具体职务及任期情况如下：

姓名	职务	提名人	本届任职期间
胡海洋	董事长	胡海洋	2025 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日
黄建军	董事、总经理	黄建军	2025 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日
杨建	董事、副总经理	杨建	2025 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日
廉哲	董事、副总经理	胡海洋	2025 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日
陈晓东	董事、研发总监	职工代表大会	2025 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日
刘晋	董事	中小企业发展基金	2025 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日
路国平	独立董事	董事会	2025 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日
徐秀法	独立董事	董事会	2025 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日
高玉标	独立董事	董事会	2025 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日

公司现任董事简历如下：

胡海洋的基本情况详见本节“八、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情

况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”。

黄建军的基本情况详见本节“八、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”。

杨建的基本情况详见本节“八、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”。

廉哲，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业；2008 年 7 月至 2010 年 7 月任中兴通讯股份有限公司硬件工程师；2010 年 8 月至 2017 年 3 月任菲尼萨光电通讯（上海）有限公司高级硬件工程师；2017 年 3 月至 2017 年 8 月任上海厚力电子科技有限公司监事，2017 年 8 月至 2019 年 7 月任上海厚力电子科技有限公司执行董事；2017 年 11 月至 2022 年 10 月任联讯有限董事、副总经理；2022 年 10 月至今任公司董事、副总经理。

陈晓东，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 6 月毕业于复旦大学电路与系统专业；2003 年 7 月至 2006 年 8 月任中国雷华电子技术研究所（期间更名为中航雷达与电子设备研究院）硬件工程师；2009 年 6 月至 2014 年 7 月任上海炬力集成电路设计有限公司高级系统设计工程师；2014 年 8 月至 2017 年 12 月任菲尼萨光电通讯科技（无锡）有限公司高级硬件测试工程师；2018 年 1 月至 2022 年 10 月任联讯有限研发经理；2022 年 10 月至今任公司董事，历任公司研发经理、研发总监。

刘晋，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年至 2013 年任中国移动通信集团江苏有限公司区域校园市场总监；2013 年至 2014 年任江苏高投创业投资管理有限公司投资经理；2014 年至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司业务合伙人；2019 年 5 月至 2022 年 10 月任联讯有限董事，2022 年 10 月至今任公司董事。

路国平，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，教授。1981 年 7 月至 1985 年 12 月任江苏省南京农业机械化学校财务科会计；1985 年 12 月至 2005 年 5 月历任南京农业大学工学院管理系讲师、副教授、教研室主任；2005 年 6 月至 2016 年 5 月历任南京审计大学会计学院副教授、会计系副主任；2016 年 6 月至 2020 年 3 月历任南京审计大学瑞华学院副教授、教授、副院长；2020 年 3 月

至 2023 年 3 月任南京审计大学中审学院教授、副院长；2023 年 4 月至 2025 年 6 月任南京审计大学中审学院教授；2022 年 12 月至今任公司独立董事。

徐秀法，男，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工程师。1968 年 6 月毕业于上海无线电工业学校无线电元件专业；1968 年 8 月至 1992 年 6 月历任上海元件五厂仪表室技术员、仪表室主任；1992 年 6 月至 1998 年 12 月任上海元件五厂厂部厂长；1998 年 12 月至 1999 年 9 月任上海华虹集成电路有限责任公司副总经理；1999 年 9 月至 2002 年 6 月任上海华虹（集团）有限公司市场部部长；2002 年 6 月至 2007 年 2 月任上海华杰芯片技术服务有限公司董事长；2007 年 2 月至 2026 年 1 月任上海市集成电路行业协会副秘书长、高级顾问；2015 年至今任中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长；2022 年 10 月至今任公司独立董事。

高玉标，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏石油化工学院教师，申银万国证券股份有限公司项目经理，苏州固锔电子股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，苏州天沃科技股份有限公司董事会秘书、副总经理，苏州工业园区洽道投资管理有限公司风险控制部门负责人，江苏海晨物流股份有限公司董事会秘书。高玉标现任苏州宏裕睿辰管理咨询有限公司总监，2025 年 9 月至今任公司独立董事。

2、监事会（已取消）成员

截至取消监事会前，公司监事会由彭兴贵、赵山、郭孝明组成。公司取消监事会前在任监事简历如下：

彭兴贵，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月毕业于华中理工大学通信工程专业；1998 年 9 月至 2002 年 4 月任巨龙信息技术有限责任公司工程师；2002 年 5 月至 2018 年 6 月历任上海博为光电科技有限公司工程师、项目经理、技术总监；2020 年 12 月至 2022 年 10 月任联讯有限监事，2018 年 7 月至 2022 年 10 月任联讯有限主任工程师；2022 年 10 月至 2025 年 9 月任公司监事会主席（职工代表监事），2022 年 10 月至今任公司主任工程师。现兼任联讯赛麦特监事。

赵山，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 6 月毕业于江南大学控制工程专业；2014 年 7 月至 2018 年 3 月任菲尼萨光电通讯科技（无锡）有限公司高级软件工程师；2018 年 3 月至 2022 年 10 月历任联讯有限资深

软件工程师、研发经理、研发总监；2022 年 10 月至 2025 年 9 月任公司监事，2022 年 10 月至今历任公司研发总监、研发副总。

郭孝明，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月毕业于苏州大学电气工程及自动化专业；2007 年 7 月至 2012 年 12 月任旭电（苏州）科技有限公司（期间更名为伟创力电子技术（苏州）有限公司）软件开发技术员；2012 年 12 月至 2016 年 4 月任威泰能源（苏州）有限公司软件工程师；2016 年 4 月至 2017 年 7 月任苏州海光芯创光电科技有限公司软件开发主管；2017 年 7 月至 2018 年 1 月任上海市共进通信技术有限公司高级软件工程师；2018 年 1 月至 2022 年 10 月任联讯有限高级研发经理；2022 年 10 月至 2025 年 9 月任公司监事，2022 年 10 月至今历任公司高级研发经理、高级研发总监。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，2025 年 9 月 27 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会，决议调整公司内部监督机构，由董事会审计委员会承接原监事会的法定职权，不设监事会或者监事。

截至本招股说明书签署日，审计委员会成员包括路国平、徐秀法、胡海洋，由路国平担任召集人。审计委员会成员的简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况”之“1、董事会成员”。

3、高级管理人员

截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员共 4 名，具体职务及任期情况如下：

姓名	职务	本届任职期间
黄建军	董事、总经理	2025 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日
杨建	董事、副总经理	2025 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日
廉哲	董事、副总经理	2025 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日
廖金	董事会秘书、财务负责人、副总经理	2025 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日

公司现任高级管理人员简历如下：

黄建军的基本情况详见本节“八、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情

况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”。

杨建的基本情况详见本节“八、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”。

廉哲的基本情况详见本节“十二、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况”之“1、董事会成员”。

廖金，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月毕业于东南大学物流管理专业；2011年7月至2016年2月历任深圳创维数字技术股份有限公司（期间更名为深圳创维数字技术有限公司）供应链管理中心采购经理等职位；2016年5月至2017年4月任浪潮金融信息技术有限公司采购；2017年6月至2021年10月历任苏州天孚光通信股份有限公司总监等职位；2021年11月至2022年10月任联讯有限董事会秘书、副总经理，2022年10月至今任公司董事会秘书、财务负责人、副总经理。现兼任新加坡联讯董事、马来西亚联讯董事、泰国联讯董事、美国联讯董事。

4、核心技术人员

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员共有9名，具体职务情况如下：

姓名	职务
胡海洋	董事长
黄建军	董事、总经理
廉哲	董事、副总经理
陈晓东	董事、研发总监
赵山	研发副总
郭孝明	高级研发总监
彭兴贵	主任工程师
邵毅男	研发总监
潘朝松	高级研发总监

（1）核心技术人员认定依据

根据生产经营的需要和对企业生产经营发挥的实际作用，公司核心技术人员的确定标准主要参考员工与公司业务匹配的学历背景、专业背景、工作经历、工作职责、所负责的具体研发方向、所取得的研发成果、所获取的发明及专利情况、对公司产品研发的

具体技术贡献以及对公司发展做出的贡献等情况综合认定。

（2）核心技术人员基本情况

公司核心技术人员的简历如下：

胡海洋的基本情况详见本节“八、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”。

黄建军的基本情况详见本节“八、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”。

廉哲的基本情况详见本节“十二、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况”之“1、董事会成员”。

陈晓东的基本情况详见本节“十二、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况”之“1、董事会成员”。

赵山的基本情况详见本节“十二、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况”之“2、监事会（已取消）成员”。

郭孝明的基本情况详见本节“十二、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况”之“2、监事会（已取消）成员”。

彭兴贵的基本情况详见本节“十二、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况”之“2、监事会（已取消）成员”。

邵毅男，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月毕业于复旦大学电子信息专业；2005年10月至2010年10月任艾维思通讯技术（上海）有限公司高级嵌入式软件工程师；2010年10月至2013年12月任英格索兰（上海）贸易有限公司嵌入式软件工程师；2014年1月至2015年12月任无锡易锐迅光电科技

有限公司高级固件工程师；2015年8月至今任上海圆马信息科技有限公司监事；2015年12月至2017年3月任上海乘讯信息科技有限公司研发经理；2019年4月至2020年12月任联讯有限监事，2017年3月至2022年10月任联讯有限研发总监；2022年10月至今任公司研发总监。

潘朝松，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年1月毕业于中国地质大学电气工程及其自动化专业；2002年11月至2004年5月任康舒电子（东莞）有限公司产品工程师；2004年6月至2005年5月任深圳核达中远通电源技术有限公司开发工程师；2005年6月至2007年6月任冠捷科技（北京）有限公司电源开发工程师；2007年8月至2007年11月，担任奇胜工业（惠州）有限公司深圳办事处电子工程师；2007年12月至2008年1月任北京动力源科技股份有限公司原理工程师；2008年3月至2011年5月任鼎桥通信技术有限公司通信电源工程师；2011年6月至2011年8月，担任安伏（苏州）电子有限公司硬件工程师；2011年9月至2019年3月任泰克科技（中国）有限公司硬件设计工程师；2019年8月至2022年10月历任联讯有限研发经理、研发总监；2022年10月至今历任公司研发总监、高级研发总监。

5、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况（除公司及公司控股子公司外）如下：

姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职企业与发行人的关联关系
胡海洋	董事长	联睿光通	执行事务合伙人	员工持股平台，公司实际控制人的一致行动人
		博恒睿哲	执行事务合伙人	员工持股平台，公司实际控制人的一致行动人
		思诺威	非独立董事	发行人参股企业、发行人关联方
刘晋	董事	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	业务合伙人	发行人关联方
		江苏万邦微电子有限公司	非独立董事	发行人关联方
		北京恒达时讯科技股份有限公司	非独立董事	发行人关联方
		凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司	非独立董事	发行人关联方
		南京创芯慧联技术有限公司	非独立董事	发行人关联方
		斯润天朗（北京）科技有限公司	非独立董事	发行人关联方

姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职企业与发行人的关联关系
		江苏京创先进电子科技有限公司	非独立董事	发行人关联方
		江苏数智毅达私募基金管理有限公司	非独立董事、经理	发行人关联方
		成都迈科科技有限公司	非独立董事	发行人关联方
		江苏阳晓电子科技有限公司	非独立董事	发行人关联方
		苏州赛迈测控技术有限公司	非独立董事	发行人关联方
		太景科技(南京)有限公司	非独立董事	发行人关联方
		上海合利微半导体有限责任公司	非独立董事	发行人关联方
		深圳市迈特芯科技有限公司	非独立董事	发行人关联方
		南京芯岩光半导体有限公司	非独立董事	发行人关联方
		半影光学(南京)有限公司	监事	无关联关系
		江苏铤奥光电科技有限公司	监事	无关联关系
		苏州锐杰微科技集团有限公司	监事	无关联关系
		扬州万方科技股份有限公司	监事	无关联关系
徐秀法	独立董事	中国半导体行业协会集成电路设计分会	副秘书长	无关联关系
		南京宏泰半导体科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
		上海南麟电子股份有限公司	独立董事	无关联关系
		上海灿瑞科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
路国平	独立董事	江苏洋河酒厂股份有限公司	独立董事	无关联关系
		安徽神剑新材料股份有限公司	独立董事	无关联关系
高玉标	独立董事	苏州明皜传感科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
		内蒙古和光新材料股份有限公司	独立董事	无关联关系
		苏州宏裕睿辰管理咨询有限公司	总监	无关联关系

6、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核

心技术人员之间不存在亲属关系。

7、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员合法合规情况

截至本招股说明书签署日，除独立董事路国平由于宝胜科技创新股份有限公司（股票代码：600973）违规而受到上海证券交易所通报批评外，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。独立董事路国平因其他 A 股上市公司的违法违规行为受到证券交易所的纪律处分不影响独立董事的任职资格和独立性，不影响发行人本次发行上市条件。

（二）发行人与董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况

截至本招股说明书签署日，除外派董事及独立董事外的董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签署了《劳动合同》《保密及禁止竞业协议》，独立董事与发行人签订了《独立董事聘用协议》。自前述协议签订以来，相关董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行合同约定的义务和职责，遵守相关承诺，未发生违反合同义务、责任或承诺的情形。

除上述协议外，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和核心技术人员未与公司签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的其他协议。

（三）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

1、公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员直接持股情况

姓名	职务	持股数（万股）	持股比例（%）
胡海洋	董事长	1,582.0140	20.55
黄建军	董事、总经理	553.4200	7.19
杨建	董事、副总经理	448.9030	5.83
廉哲	董事、副总经理	242.7110	3.15

2、公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员间接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事（外部董事除外）、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员通过联睿光通、博睿光通、博恒睿哲等员工持股平台间接持有公司股份，具体如下：

姓名	职务	持股平台名称	员工持股平台 出资额 (万元)	员工持股平台 出资比例 (%)	间接持有公司 股份比例 (%)
胡海洋	董事长、核心技术人员	联睿光通	27.2072	5.44	0.41
		博恒睿哲	27.9070	2.79	0.19
黄建军	董事、总经理、核心技术人员	联睿光通	91.2752	18.26	1.36
陈晓东	董事、核心技术人员	博睿光通	243.0000	23.91	1.66
彭兴贵	取消监事会前在任监事会主席、核心技术人员	博睿光通	89.0000	8.76	0.61
赵山	取消监事会前在任监事、核心技术人员	联睿光通	25.0000	5.00	0.37
郭孝明	取消监事会前在任监事、核心技术人员	联睿光通	25.0000	5.00	0.37
廖金	董事会秘书、财务负责人、副总经理	联睿光通	2.6115	0.52	0.04
		博睿光通	60.0000	5.90	0.41
邵毅男	核心技术人员	博恒睿哲	274.5000	27.43	1.87
潘朝松	核心技术人员	联睿光通	32.0000	6.40	0.48

3、公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员近亲属持有公司股份的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事（外部董事除外）、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属未直接或间接持有公司股份。

4、公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

（四）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内的变动情况

最近两年内，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变化，具体变动情况如下：

1、董事变动情况

2023 年初，公司董事会由 9 名董事组成，分别为胡海洋、黄建军、杨建、廉哲、陈晓东、刘晋、路国平、徐秀法和庄松林。最近两年内，公司董事具体变动情况如下：

变动时间	变动情况及性质	变动后董事会成员
2025 年 9 月	原独立董事庄松林任期届满，因个人原因不再担任独立董事，公司股东会选举新的独立董事高玉标	胡海洋、黄建军、杨建、廉哲、陈晓东、刘晋、路国平、徐秀法和高玉标

2、取消监事会前在任监事变动情况

2023 年初，公司监事会由 3 名监事组成，分别为彭兴贵、赵山和郭孝明。最近两年内，公司监事具体变动情况如下：

变动时间	变动情况及性质	变动后监事会成员
2025 年 9 月	公司股东会决议取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使	无

（五）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员不存在与公司及公司业务相关的对外投资。

（六）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

1、薪酬组成和确定依据

在公司担任具体生产经营职务的董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成包括工资、奖金及补贴。

工资主要由基本工资、岗位津贴、管理津贴等部分构成，系根据人员的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬；奖金系根据年度表现、绩效考核及公司经营情况予以发放；补贴主要由加班补贴、餐补等部分构成，系根据人员工作具体情况确定，属于不固定的工资报酬。

独立董事在公司领取津贴。独立董事津贴由公司参照资本市场中独立董事津贴的一

般水平予以确定。

2、履行的程序

报告期内，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员的薪酬方案已经由第一届董事会第九次会议、2023 年度股东大会审议批准。

3、薪酬占利润总额的比例

报告期内，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占当期公司利润总额的比重分别为-12.91%、-12.09%、5.98%和 5.12%。

4、最近一年从发行人及其关联企业领取薪酬的情况

公司董事刘晋不在公司领薪，独立董事在本公司只领取独立董事津贴，不享有其他福利待遇。

除上述人员外的董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和核心技术人员在公司领取薪酬，2024 年度从公司处领取薪酬合计为 798.34 万元，具体薪酬情况如下表所示：

序号	姓名	职务	2024 年度薪酬 (万元)	2024 年是否在实际控制人控制的其他企业领薪
1	胡海洋	董事长、核心技术人员	41.10	否
2	黄建军	董事、总经理、核心技术人员	110.94	否
3	杨建	董事、副总经理	113.26	否
4	廉哲	董事、副总经理、核心技术人员	82.34	否
5	陈晓东	董事、研发总监、核心技术人员	55.25	否
6	彭兴贵	取消监事会前在任监事会主席、主任工程师、核心技术人员	49.81	否
7	赵山	取消监事会前在任监事、研发副总、核心技术人员	87.73	否
8	郭孝明	取消监事会前在任监事、高级研发总监、核心技术人员	59.99	否
9	廖金	董事会秘书、财务负责人、副总经理	77.50	否
10	邵毅男	研发总监、核心技术人员	56.22	否
11	潘朝松	高级研发总监、核心技术人员	64.18	否

除上述薪酬待遇外，公司现任董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和核心技术人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。

十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排

（一）股权激励安排的基本情况

本次公开发行申报前，公司通过联睿光通、博睿光通、博恒睿哲三个员工持股平台实施了多轮股权激励，股权激励对象均为公司员工，该等股权激励均已实施完毕，具体情况如下：

1、员工持股平台基本情况

联睿光通、博睿光通、博恒睿哲的基本情况详见本节“八、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（二）实际控制人的一致行动人”。

2、员工持股平台股份锁定期

截至本招股说明书签署日，联睿光通、博睿光通、博恒睿哲作为公司员工持股平台及直接股东，已根据相关要求，承诺自公司上市后 36 个月内不转让其持有的公司股份；激励对象为公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员或者其他特殊情况的则按照相关法律法规的规定承诺相应锁定期，具体详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”之“（一）关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

根据历次员工股权激励计划书的相关约定，在激励计划约定的服务期（指激励对象应自按照激励计划的规定在获得被授予的公司股权之日（即激励对象通过合伙企业间接取得公司股权之日）起持续在公司至少全职工作 5 年（即 60 个月））内，除合伙企业执行事务合伙人同意外，激励对象不得以任何形式直接或间接向任何第三方转让（其中包括以质押、抵押或设置其他权利负担等形式间接转让财产份额权益的情况）其持有的合伙企业的全部或部分财产份额，亦不得要求合伙企业转让其通过合伙企业间接持有的公司股权。

3、人员离职后的股份处理

当激励对象发生离职、退休、死亡等情形后，激励对象或其法定继承人应根据合伙企业执行事务合伙人指令将所持有的激励股权转让至指定第三方。转让价格=激励对象认购转让份额的原始出资金额（即激励对象原始投资成本）+激励对象认购转让份额的原始出资金额×8%×N÷365，其中 N 为激励对象取得财产份额的对应价款支付之日至转让日之间的天数；且不低于公司上一年度经审计的净资产对应的股权价格。

（二）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权安排

公司上述股权激励有利于充分调动员工的工作积极性、进一步提高骨干团队和人才队伍的稳定性，为公司持续、稳定、快速地发展提供重要保障。

公司依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》确认股份支付费用，相应调整资本公积。报告期内，股权激励相关的股份支付金额如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
股份支付金额	3,289.98	4,436.67	4,845.42	3,943.74
占当期归属于母公司股东的净利润的比例	34.04%	31.58%	-87.47%	-103.59%

截至本招股说明书签署日，公司员工持股平台联睿光通、博睿光通和博恒睿哲均系公司实际控制人的一致行动人，实际控制人及其一致行动人合计控制公司 54.79%的股份。上述股权激励对公司控制权不存在重大不利影响。

除上述已实施完毕的股权激励外，公司不存在尚未实施完毕的股权激励，亦不存在上市后的行权安排。

十四、发行人员工情况

（一）员工人数

报告期各期末，公司员工人数如下：

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
员工总人数（人）	1,095	863	485	253

（二）员工结构

1、专业结构

截至 2025 年 9 月 30 日，公司员工的专业结构情况如下：

项目	人数（人）	占比
管理人员	184	16.80%
研发人员	440	40.18%
生产及技术支持人员	413	37.72%
销售人员	58	5.30%
合计	1,095	100.00%

2、学历结构

截至 2025 年 9 月 30 日，公司员工的学历结构情况如下：

项目	人数（人）	占比
本科及以上	775	70.78%
大专	215	19.63%
大专以下	105	9.59%
合计	1,095	100.00%

3、年龄结构

截至 2025 年 9 月 30 日，公司员工的年龄结构情况如下：

项目	人数（人）	占比
40 岁及以上	115	10.50%
30-39 岁	563	51.42%
30 岁以下	417	38.08%
合计	1,095	100.00%

（三）社会保险及住房公积金情况

报告期各期末，公司及公司境内子公司为员工缴纳社会保险的基本情况如下：

单位：人

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
境内员工总人数	1,035	834	484	253
实缴人数	1,027	818	471	250
未缴人数	8	16	13	3

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
未缴人数占比	0.77%	1.92%	2.69%	1.19%

注：报告期内，公司及公司境内子公司未为全部员工缴纳社会保险的原因主要为：（1）当月新入职员工原工作单位未完成社保减员，无法缴纳社会保险；（2）当月社会保险扣缴日后入职的新入职员工，入职后次月才能缴纳社会保险。

报告期各期末，公司及公司境内子公司为员工缴纳住房公积金的基本情况如下：

单位：人

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
境内员工总人数	1,035	834	484	253
实缴人数	1,026	819	471	253
未缴人数	9	15	13	0
未缴人数占比	0.87%	1.80%	2.69%	0.00%

注：报告期内，公司及公司境内子公司未为全部员工缴纳住房公积金的原因主要为：（1）当月新入职员工原工作单位未完成住房公积金减员，无法缴纳住房公积金；（2）当月住房公积金扣缴日后入职的新入职员工，入职后次月才能缴纳住房公积金。

公司及境内子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规规定与员工签订劳动合同，并按照国家 and 地方有关社会保障的法律、法规规定，为员工缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险，缴存住房公积金。报告期内，公司及境内子公司不存在因社会保险、住房公积金缴纳问题而引发的纠纷或诉讼。根据发行人及其境内主体所在地的社会保险、住房公积金管理部门出具的证明及公开信息，发行人及其境内主体不存在欠缴社会保险、住房公积金的情形，也未因违反社会保险和住房公积金相关法律法规而受到行政处罚。同时，公司已为境外员工按当地的要求缴纳社会保险和住房公积金。

（四）劳务派遣及境外劳动用工情况

报告期内，公司存在劳务派遣及境外劳动用工的情形。报告期各期末，公司及控股子公司劳务派遣员工人数分别为 0 人、7 人、11 人和 8 人，劳务派遣用工人数未超过用工总量 10%。

报告期内，公司存在境外劳动用工，主要为境外子公司员工和部分劳务派遣用工，公司境外子公司按照所在地的法律法规的规定，与境外员工签署雇佣合同并执行当地的劳动保障制度。

公司劳务派遣及境外劳动用工相关情形合法合规，不存在因劳务派遣及境外劳动用

工而受到重大行政处罚的情形。

第五节 业务与技术

一、发行人主营业务及主要产品情况

（一）主营业务概况

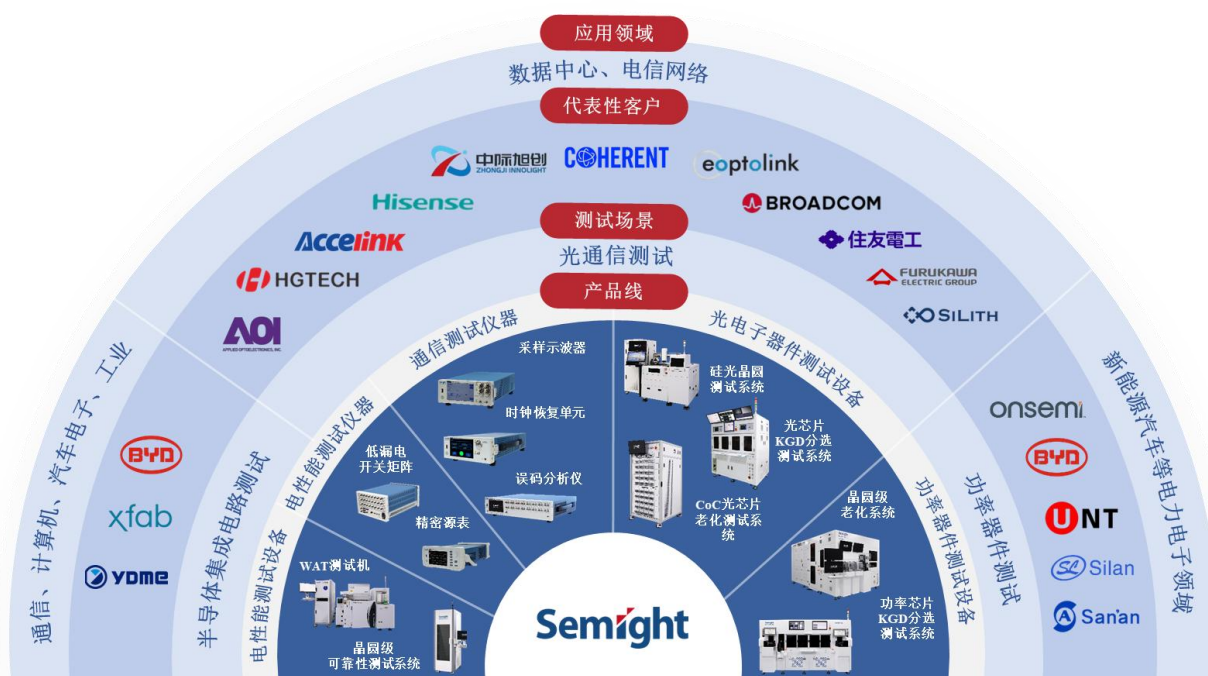
联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设备企业，主营业务为电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务，专业为全球高速通信和半导体等领域用户提供高速率、高精度、高效率的核心测试仪器设备，助力人工智能、新能源、半导体等前沿科技行业提升产品开发和量产效率，是国家重大战略需求领域实现核心基础仪器设备国产化攻坚与自主可控的重要力量。

公司电子测量仪器包括通信测试仪器和电性能测试仪器，通信测试仪器主要面向光通信测试，包括采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪等核心测试仪器；电性能测试仪器主要包括精密源表和低漏电开关矩阵，广泛应用于通信和半导体等领域的高精度电学测试。公司半导体测试设备包括主要面向光通信测试的光电子器件测试设备（CoC光芯片老化测试系统、光芯片KGD分选测试系统、硅光晶圆测试系统等），主要面向功率器件测试的功率器件测试设备（晶圆级老化系统、功率芯片KGD分选测试系统等），以及主要面向半导体集成电路测试的电性能测试设备（WAT测试机和晶圆级可靠性测试系统）。公司是业内极少数覆盖光通信产业链中模块、芯片、晶圆等核心环节测试需求的厂商，全球少数、国内极少数量产供货400G、800G、1.6T高速光模块核心测试仪器的厂商，全球第二家推出目前业内最高水平1.6T光模块全部核心测试仪器的厂商；国内极少数可提供PXIe插卡式源表、低漏电开关矩阵、高压源表、脉冲源等多产品矩阵的电性能测试仪器厂商；国内极少数同时实现晶圆级老化测试设备、裸芯片级分选测试设备产业化应用的厂商，国内少数具备精密源表等核心测试部件自主能力的半导体测试设备厂商，产品核心性能指标业内领先。

成立至今，公司凭借在光通信领域核心测试仪器设备的技术研发和产业化应用的成功实践，逐步掌握了自主知识产权核心芯片及自研核心算法、硬件板卡、超精密运动系统等测试行业关键前沿技术能力，形成了以高速信号处理、微弱信号处理和超精密运动控制为核心的平台级核心技术体系。依托强大的平台级核心技术体系，公司一方面不断

巩固和深化在光通信领域的纵向竞争力，另一方面也成功实现在功率器件、半导体集成电路等领域的横向拓展，形成了丰富的产品矩阵，在上述各领域里构筑起显著竞争优势。

图：公司“主要产品—产品线—测试场景—应用领域”关系图



在光通信领域，公司主要为用户提供通信测试仪器、光电子器件测试设备和电性能测试仪器，是业内极少数覆盖光通信全产业链核心测试环节的企业。其中，通信测试仪器市场长期被Keysight、Anritsu等美日企业垄断，近年来，随着人工智能等下游应用领域对数据传输速度要求日益提升，光通信产品速率迭代随之加快，测试仪器带宽与速率等核心性能指标迭代相应提速，进一步加大了国内测试仪器企业的追赶难度；公司是目前全球少数、国内极少数量产供货400G、800G、1.6T高速光模块核心测试仪器的厂商，面向400G、800G高速光模块测试需求的50GHz采样示波器、56GBaud时钟恢复单元、800Gbps误码分析仪等核心产品报告期内实现大规模量产供货；公司已推出满足目前业内最高水平1.6T光模块测试需求的65GHz采样示波器、120GBaud时钟恢复单元、1.6Tbps误码分析仪，是全球第二家推出1.6T光模块全部核心测试仪器的厂商，三款产品均已实现量产供货；根据Frost&Sullivan数据，2024年公司在中国光通信测试仪器市场份额排名第三，也是前五中唯一的本土企业。除通信测试仪器外，公司面向光通信领域用户提供CoC光芯片老化测试系统、光芯片KGD分选测试系统、硅光晶圆测试系统等光电子器件测试设备，全面覆盖封装级光芯片、裸Die级光芯片、晶圆级硅光芯片等光通信产业链上游核心环节测试需求，硅光晶圆测试系统于2024年度实现收入；根据Frost&Sullivan

数据，2024年公司在中國光電子器件測試設備市場份額中排名第一。公司在光通信領域已覆蓋集團一、中際旭創、新易盛、光迅科技、海信集團、華工正源、賽麗科技、Lumentum、Coherent、Broadcom、環球广电、日本住友、日本古河等國內外主流光通信產業鏈客戶。

在功率器件領域，公司面向車規級應用場景下功率器件日益嚴苛的可靠性要求，依托在光電子器件測試設備領域底層核心技術的深度積累和延伸應用，進一步拓展了主要面向車規級應用場景的功率器件測試設備產品線，兩款核心產品晶圓級老化系統、功率芯片KGD分選測試系統均已實現產業化應用。根據Frost&Sullivan數據，2024年中國碳化硅功率器件晶圓級老化系統市場中，公司市場份額排名第一；2023-2024年中國功率芯片KGD分選測試系統市場中，公司市場份額排名第三、本土企業第一。公司在功率器件領域已覆蓋比亞迪半導體、芯聯集成、士蘭微、三安光电、芯聚能、長飛先進、株洲中車、瞻芯電子、ONSEMI、Power Master等國內外主流功率芯片廠商。

在半導體集成電路領域，公司主要為用戶提供電性能測試儀器及設備。電性能測試儀器方面，公司核心產品精密源表最小電流分辨率已突破至0.1fA，與國際最高水平的差距持續縮小，且公司是國內極少數可以提供PXIe插卡式源表、低漏電開關矩陣、高壓源表、脈沖源等多產品矩陣的廠商。公司聚焦核心技術复用價值，積極布局電性能測試設備產品線，主要產品包括WAT測試機、晶圓級可靠性測試系統等，是國內少數具備精密源表等核心測試部件自主能力的廠商。公司在半導體集成電路領域的代表性客戶包括客戶二、集團一、比亞迪半導體、燕東微、士蘭微、X-FAB等國內外知名企業。

公司積極響應國家重大戰略需求號召，多次承擔國家重點研發計劃和國家重大專項，取得了國家級專精特新“小巨人”等多項榮譽，技術實力獲得主管部門和業內廣泛認可。公司將繼續聚焦國家重大戰略需求，把握人工智能、新能源、半導體行業發展機遇，致力於成為國際高端測試儀器設備行業的領導者，為保障國家核心基礎儀器設備的自主可控、提升全球競爭力注入強勁動能。

（二）主要产品概况、主营业务收入及毛利构成

1、主要产品概况

（1）按照产品形态分类

按照产品形态分类，公司产品主要包括通信测试仪器、电性能测试仪器等电子测量仪器，光电子器件测试设备、功率器件测试设备、电性能测试设备等半导体测试设备，以及配套的测试部件及服务。

1) 电子测量仪器

公司电子测量仪器主要包括通信测试仪器和电性能测试仪器，其中：

通信测试仪器主要面向光通信测试，包括采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪、突发误码分析仪、快速波长计等产品，覆盖眼图测试、时钟信号提取、误码率测试、突发数据误码测试、波长测量等测试项目，可为光模块等光通信网络基础设施提供完整的测试解决方案。公司是目前全球少数、国内极少数量产供货 400G、800G、1.6T 高速光模块核心测试仪器的厂商，面向 400G、800G 高速光模块测试需求的 50GHz 采样示波器、56GBaud 时钟恢复单元、800Gbps 误码分析仪等核心产品报告期内实现大规模量产供货；公司已推出满足目前业内最高水平 1.6T 光模块测试需求的 65GHz 采样示波器、120GBaud 时钟恢复单元、1.6Tbps 误码分析仪，是全球第二家推出 1.6T 光模块全部核心测试仪器的厂商，三款产品均已实现量产供货。

电性能测试仪器广泛应用于通信和半导体等领域的高精度电学测试，包括精密源表和低漏电开关矩阵等产品，产品参数和产品矩阵覆盖范围广泛，可满足不同类型的电性测试需求。公司是国内极少数可以提供 PXIe 插卡式源表、低漏电开关矩阵、高压源表、脉冲源等多产品矩阵的厂商，精密源表最小电流分辨率已突破至 0.1fA，与国际最高水平的差距持续缩小。

公司电子测量仪器产品的概况如下：

产品线	产品名称	产品功能	主要测试对象	下游典型应用领域
通信测试仪器	采样示波器	眼图测试	100G/400G/800G/1.6T 光模块、光收发器件	数据中心、电信网络
	时钟恢复单元	时钟信号提取		
	误码分析仪	误码率测试		

产品线	产品名称	产品功能	主要测试对象	下游典型应用领域
	突发误码分析仪	突发数据误码测试	10G-50G PON 光模块	
	快速波长计	波长测量	可调激光器、光模块	
电性能测试仪器	精密源表	电学参数测试	半导体、通信器件	通信、计算机、汽车电子、工业
	低漏电开关矩阵	电学参数测试	半导体	

2) 半导体测试设备

公司半导体测试设备包括光电子器件测试设备、功率器件测试设备和电性能测试设备，其中：

光电子器件测试设备主要面向光通信测试，主要包括 CoC 光芯片老化测试系统、光芯片 KGD 分选测试系统、硅光晶圆测试系统等产品，分别用于 CoC 封装级光芯片老化测试、裸 Die 级光芯片分选测试、晶圆级硅光芯片功能测试，全面覆盖封装级光芯片、裸 Die 级光芯片、晶圆级硅光芯片等光通信产业链上游核心环节测试需求。

功率器件测试设备主要面向碳化硅功率器件测试，主要包括晶圆级老化系统、功率芯片 KGD 分选测试系统等产品，分别用于晶圆级功率芯片老化测试、裸 Die 级功率芯片分选测试，公司是国内极少数同时实现晶圆级老化系统、功率芯片 KGD 分选测试系统产业化应用的厂商。

电性能测试设备主要面向半导体集成电路电性能测试，主要包括WAT测试机、晶圆级可靠性测试系统等产品，分别用于晶圆允收测试、晶圆可靠性测试，公司是国内少数具备精密源表等核心测试部件自主能力的厂商。公司半导体测试设备产品的概况如下：

产品线	产品名称	产品功能	主要测试对象	下游典型应用领域
光电子器件测试设备	CoC 光芯片老化测试系统	老化测试	CoC 光芯片	数据中心、电信网络
	光芯片 KGD 分选测试系统	分选测试	光芯片裸 Die	
	硅光晶圆测试系统	功能测试	硅光晶圆	
功率器件测试设备	晶圆级老化系统	老化测试	碳化硅晶圆	新能源汽车等电力电子领域
	功率芯片 KGD 分选测试系统	分选测试	碳化硅功率芯片裸 Die	
电性能测试设备	WAT 测试机	电性参数测试	晶圆	通信、计算机、汽车

产品线	产品名称	产品功能	主要测试对象	下游典型应用领域
	晶圆级可靠性测试系统	可靠性抽样测试	晶圆	电子、工业

（2）按照应用领域分类

按照应用领域分类，公司产品主要应用于光通信、碳化硅功率器件、半导体集成电路等领域，各应用领域与公司主要产品的对应关系如下：

应用领域	产品线	产品形态	主要产品构成	下游典型应用领域
光通信	通信测试仪器	电子测量仪器	采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪、突发误码分析仪、快速波长计	数据中心、电信网络
	光电子器件测试设备	半导体测试设备	CoC 光芯片老化测试系统、光芯片 KGD 分选测试系统、硅光晶圆测试系统	
	电性能测试仪器	电子测量仪器	精密源表	
碳化硅功率器件	功率器件测试设备	半导体测试设备	晶圆级老化系统、功率芯片 KGD 分选测试系统	新能源汽车等电力电子领域
半导体集成电路	电性能测试设备	半导体测试设备	WAT 测试机、晶圆级可靠性测试系统	通信、计算机、汽车电子、工业
	电性能测试仪器	电子测量仪器	精密源表、低漏电开关矩阵	

注：电性能测试仪器在光通信、半导体集成电路领域均有应用，按客户实际使用场景分类。

2、主营业务收入及毛利构成

按照产品形态分类，公司产品主要包括电子测量仪器和半导体测试设备，以及配套的测试部件及服务。报告期内，公司主营业务收入按业务类别列示如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子测量仪器	34,304.88	43.06%	37,759.06	48.21%	15,410.89	57.25%	6,807.50	32.08%
半导体测试设备	39,847.44	50.02%	35,377.66	45.17%	9,582.66	35.60%	12,329.10	58.10%
测试部件	4,979.37	6.25%	4,786.46	6.11%	1,631.53	6.06%	1,621.97	7.64%
其他	533.86	0.67%	401.88	0.51%	294.87	1.10%	462.02	2.18%
合计	79,665.55	100.00%	78,325.06	100.00%	26,919.95	100.00%	21,220.59	100.00%

按照应用领域分类，公司产品主要应用于光通信、碳化硅功率器件、半导体集成电路等领域。报告期内，公司主营业务收入按应用领域列示如下：

单位：万元

应用领域	产品线	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
光通信	通信测试仪器	33,086.83	41.53%	36,566.42	46.69%	14,510.66	53.90%	6,365.97	30.00%
	光电子器件测试设备	25,736.56	32.31%	14,887.45	19.01%	4,040.47	15.01%	12,228.22	57.62%
	电性能测试仪器	680.94	0.85%	526.60	0.67%	226.35	0.84%	111.41	0.53%
	测试部件及其他	3,387.11	4.25%	3,809.47	4.86%	1,439.77	5.35%	2,083.98	9.82%
	小计	62,891.43	78.94%	55,789.93	71.23%	20,217.24	75.10%	20,789.59	97.97%
碳化硅功率器件	功率器件测试设备	13,066.64	16.40%	19,317.65	24.66%	5,378.48	19.98%	-	-
	测试部件及其他	2,099.53	2.64%	1,367.09	1.75%	479.48	1.78%	-	-
	小计	15,166.17	19.04%	20,684.74	26.41%	5,857.95	21.76%	-	-
半导体集成电路	电性能测试设备	1,044.25	1.31%	1,172.57	1.50%	163.72	0.61%	100.88	0.48%
	电性能测试仪器	537.11	0.67%	666.04	0.85%	673.88	2.50%	330.11	1.56%
	测试部件及其他	26.59	0.03%	11.78	0.02%	7.15	0.03%	-	-
	小计	1,607.95	2.02%	1,850.39	2.36%	844.75	3.14%	431.00	2.03%
主营业务收入合计		79,665.55	100.00%	78,325.06	100.00%	26,919.95	100.00%	21,220.59	100.00%

注：电性能测试仪器在光通信、半导体集成电路领域均有应用，按客户实际使用场景分类，下同。

报告期内，公司主营业务毛利按业务类别列示如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子测量仪器	26,198.43	55.32%	27,899.70	55.73%	10,329.28	62.53%	4,316.82	46.37%
半导体测试设备	18,284.14	38.61%	19,751.43	39.46%	5,244.74	31.75%	3,854.73	41.41%
测试部件	2,481.89	5.24%	2,277.37	4.55%	828.34	5.01%	744.67	8.00%
其他	393.46	0.83%	131.54	0.26%	117.78	0.71%	392.96	4.22%
合计	47,357.93	100.00%	50,060.04	100.00%	16,520.14	100.00%	9,309.17	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利按应用领域列示如下：

单位：万元

应用领域	产品线	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
光通信	通信测试仪器	25,391.77	53.62%	27,149.99	54.23%	9,840.80	59.57%	4,227.67	45.41%
	光电子器件测试设备	9,829.25	20.76%	5,983.83	11.95%	1,486.97	9.00%	3,819.97	41.03%
	电性能测试仪器	441.82	0.93%	325.51	0.65%	116.60	0.71%	22.26	0.24%

应用领域	产品线	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
	测试部件及其他	1,673.66	3.53%	1,516.92	3.03%	598.38	3.62%	1,137.62	12.22%
	小计	37,336.50	78.84%	34,976.25	69.87%	12,042.75	72.90%	9,207.52	98.91%
碳化硅功率器件	功率器件测试设备	7,918.93	16.72%	13,118.72	26.21%	3,651.55	22.10%	-	-
	测试部件及其他	1,177.66	2.49%	880.56	1.76%	340.83	2.06%	-	-
	小计	9,096.59	19.21%	13,999.28	27.96%	3,992.38	24.17%	-	-
半导体集成电路	电性能测试设备	535.96	1.13%	648.89	1.30%	106.23	0.64%	34.76	0.37%
	电性能测试仪器	364.84	0.77%	424.20	0.85%	371.89	2.25%	66.89	0.72%
	测试部件及其他	24.04	0.05%	11.43	0.02%	6.91	0.04%	-	-
	小计	924.84	1.95%	1,084.51	2.17%	485.02	2.94%	101.65	1.09%
主营业务毛利合计		47,357.93	100.00%	50,060.04	100.00%	16,520.14	100.00%	9,309.17	100.00%

（三）主要产品的基本情况

1、电子测量仪器

公司电子测量仪器包括通信测试仪器和电性能测试仪器，主要产品的基本情况如下：

（1）通信测试仪器

1) 采样示波器

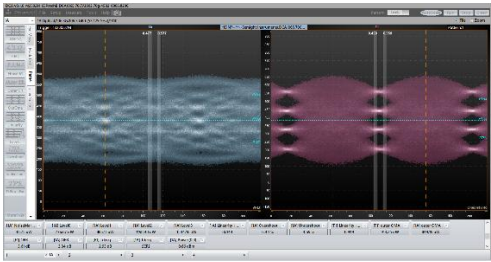
示波器用于将抽象、细微的信号变化转化为可视的波形，以便于信息的观测、分析和存储，是电子测量仪器信号处理能力的结晶，被誉为电子测量领域“皇冠上的明珠”。

采样示波器是示波器的一类，是高速测试领域的核心测试仪器，主要用于对周期信号进行等效、重复采样，其基于等效时间采样原理触发与信号周期相关的特定信号，在信号完成首次触发后即开始采样，并对该信号重复采样直至获取完整的眼图波形数据，完成多次采样后对信号进行分析与测量。

相较于实时示波器侧重捕捉显示信号的瞬态变化，采样示波器在极低的采样率下可实现极高的带宽，获得更高的垂直分辨率和更低的噪声，适用于周期信号的测量与分析。

图：采样示波器

图：PAM4 信号经采样示波器均衡前后的眼图对比



采样示波器的核心性能指标为通道带宽，带宽越高，示波器所能检测到的信号速率范围越广。

公司成立以来不断突破采样示波器通道带宽的既有上限，是目前国内极少数有能力提供采样示波器的企业。公司采样示波器产品的发展历程如下：

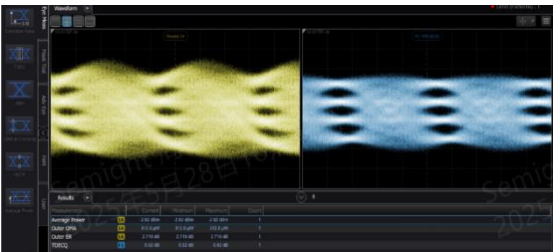
推出时间	产品型号	通道带宽	主要应用场景
2018 年	DCA4201	10GHz	10G 及以下速率光模块测试（10GBaud 单通道）
2020 年	DCA6201-B30	30GHz	400G 光模块测试（28GBaud 八通道）
2022 年	DCA6201-B50	50GHz	400G 光模块测试（53GBaud 四通道） 800G 光模块测试（53GBaud 八通道）
2024 年	DCA1065	65GHz	800G 光模块测试（112GBaud 四通道） 1.6T 光模块测试（112GBaud 八通道）

2）时钟恢复单元

时钟恢复单元可用于从数据信号中提取出对应频率的时钟信号，从而为采样示波器提供所需的同步触发时钟信号，有效提升数据信号的波形恢复质量，进而评估高速信号的波形质量及测量指标参数，是高速串行信号测试中的重要测试仪器，可应用于光模块测试。

图：时钟恢复单元

图：时钟信号经时钟恢复单元提取前后的眼图对比



时钟恢复单元的核心性能指标为最高恢复速率，决定了能提取时钟信号的数据信号的速率上限，恢复速率越高，能覆盖的数据信号速率范围越广。

公司成立以来不断突破时钟恢复单元最高恢复速率的既有上限，公司时钟恢复单元产品的发展历程如下：

推出时间	产品型号	最高恢复速率	主要应用场景
2019 年	CR4201	10GBaud	10G 及以下速率光模块测试（10GBaud 单通道）
2019 年	CR6201	28GBaud	400G 光模块测试（28GBaud 八通道）
2022 年	CR6256	56GBaud	400G 光模块测试（53GBaud 四通道） 800G 光模块测试（53GBaud 八通道）
2025 年	CR3302	120GBaud	800G 光模块测试（112GBaud 四通道） 1.6T 光模块测试（112GBaud 八通道）

3）误码分析仪

误码分析仪是一种常用的传输链路信号分析仪器，可根据不同协议标准产生指定要求的信号源，并对接收端返回的数据流进行采样锁定与逐位判定，最终完成误码统计分析、FEC 纠错分析及信噪比等指标测量并评估信号传输的质量，主要用于光模块、光收发器件测试。

图：误码分析仪

图：误码分析仪实时监控示意图



误码分析仪的核心性能指标为单通道最高传输速率，传输速率越高，可覆盖的测试链路速率范围越广。

公司自成立起即致力于误码分析仪的开发，是国内首批推出可应用于 100G 及以上光模块测试的高速率误码分析仪的企业之一，产品具有信号质量优、信号完整性高、测试链路稳定、测试精准、功能丰富的特点。公司不断突破误码分析仪的单通道最高传输速率既有上限，产品的发展历程如下：

推出时间	产品型号	单通道最高传输速率	主要应用场景
2017 年	PBT8425/PBT8825	25GBaud	100G/200G 及以下光模块测试
2018 年	PBT8856	30GBaud	400G 光模块测试
2020 年	PBT8812	59.37GBaud	800G 光模块测试

推出时间	产品型号	单通道最高传输速率	主要应用场景
2025 年	PBT3058	113.44GBaud	1.6T 光模块测试

4) 突发误码分析仪

突发误码分析仪是一种特殊的误码分析仪，主要应用于无源光网络(PON)的测试。在无源光网络中，光线路终端(OLT)会持续不断地向所有用户发送数据，所有用户终端都能同时接收到这些信息。用户端设备(ONU)向光线路终端(OLT)上传数据时，为了避免信号冲突，每个用户需要在不同的时间段发送自己的数据，这种快速、间歇性的数据传输方式被称为“突发模式”。

为了准确测试光线路终端(OLT)接收这些分散数据的能力，必须使用支持突发模式的专用测试工具，才能模拟真实场景下的性能表现。

图：突发误码分析仪

图：突发误码分析仪实时监控示意图



突发误码分析仪的核心性能指标为单通道最高突发速率，决定了产品能覆盖的突发传输链路的单通道速率上限，指标越高，能覆盖的突发传输链路速率范围越广。

公司自成立起即致力于突发误码分析仪的开发，公司突发误码分析仪产品的发展历程如下：

推出时间	产品型号	单通道最高突发速率	主要应用场景
2020 年	rBT1250	10GBaud	EPON、GPON、XGPON、XGSPON 等产品的 OLT 光模块测试
2022 年	rBT2250	25GBaud	25G PON 技术应用的 OLT 光模块测试
2024 年	rBT3250	51.56GBaud	25G、50G PON 技术应用的 OLT 光模块测试

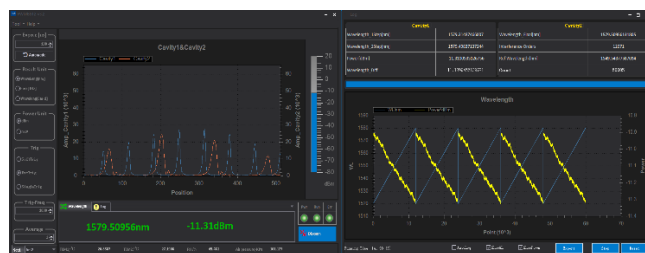
5) 快速波长计

快速波长计是一种用于测量传输线路中电磁波波长的测量仪器，应用于可调激光器、光模块的生产、测试及校准，以及 DBR、DFB 等激光器的波长测量及验证。

图：快速波长计



图：快速波长计实时测试光信号波长和输出功率



快速波长计的核心性能指标为波长测量精度，用于衡量测量波长与真实波长的偏差范围，波长精度越高，能覆盖的高精度测试场景越广泛。

公司型号为 FWM8612 的快速波长计产品覆盖 1250nm-1650nm 通讯波段，波长测量精度达 0.5pm，通过全固态无机械运动部件的光学结构设计在实现高精度测量的同时可实现高速、同步采样，其内置触发时钟信号可满足最高 1kHz 速率，在外部信号触发下同步实现对可调激光器的波长测量及校准。

（2）电性能测试仪器

1）精密源表

精密源表是可同时输出并测量电压和电流的测量仪器，具有高精度和高准确度的特点，广泛应用于光通信、半导体、新能源等领域。精密源表的技术难度体现在通过精密硬件电路设计与控制算法的深度融合，构建动态负载下的自适应调节系统，实现超微弱信号源的精准输出与可靠捕捉。衡量精密源表性能的主要指标包括最小电流分辨率、最小电压分辨率等，其中最小电流分辨率是精密源表的代表性指标，最小电流分辨率数值越低，分辨率越高，信号输出与测量的准确度越高，可覆盖的应用场景越广。

公司自 2019 年发布首款台式精密源表以来，陆续发布分辨率更高、精度更优、量程更广的源表产品，以型号 S2036H 为代表的台式精密源表的最小电流分辨率突破 1fA，综合技术水平业界领先。公司在台式源表的基础上持续丰富精密源表的产品形态和应用场景，并于 2022 年推出首款 PXIe 插卡式源表，通过可集成的、大规模的测试系统，并灵活扩展与调整配置，可满足集成电路、分立器件等半导体器件严苛的电性能测试需求，型号 S2017C 的 PXIe 插卡式源表最小电流分辨率突破 0.1fA。

图：台式精密源表



图：PXIe 插卡式源表



2) 低漏电开关矩阵

半导体晶圆制造过程中需进行电性能参数测量以控制工艺流程，通过将精密源表、LCR 表、数字万用表等多种精密仪器组成自动化测试系统，可实现对半导体器件各类参数的测量，而测试系统中的失调电流将影响测试结果的准确性。为了有效抑制电路中的失调电流，低漏电开关矩阵应运而生，其基于特殊的电路设计和元器件选择，能够有效抑制电路中的漏电流，提供更高的分辨率和准确度，满足半导体元器件的研发生产、半导体晶圆封测等过程中更高级别的测试需求，通过配置多重保护功能有效防止过载、短路等情况，保护测试仪器和被测件。衡量低漏电开关矩阵性能的主要指标包括失调电流、电流稳定时间和耐压范围等，其中失调电流是低漏电开关矩阵的代表性指标，系两个差分输入端偏置电流的误差，失调电流越低，产品性能越高。

公司低漏电开关矩阵采用模块化设计，支持多种开关矩阵卡，用户可以通过上位机应用软件方便地切换不同的测试通道，快速搭建测试系统。同时，其支持传统的 SCPI 命令，使得测试代码的迁移变得轻松快捷。此外，其还支持多机并联，便于组建大规模的测试系统，提高测试效率并降低成本。

公司型号为 RM1010-LLC 的低漏电开关矩阵产品的失调电流达到 100fA，产品在半导体测试领域有着广泛应用。

图：低漏电开关矩阵



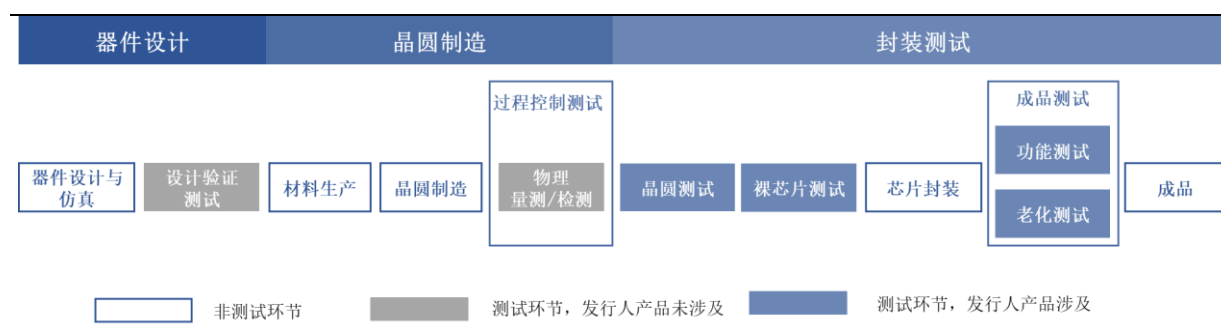
2、半导体测试设备

公司半导体测试设备包括光电子器件测试设备、功率器件测试设备和电性能测试设备，主要产品的基本情况如下：

（1）光电子器件测试设备

公司面向光通信领域的光电子器件测试需求，自主研发包括 CoC 光芯片老化测试系统、光芯片 KGD 分选测试系统、硅光晶圆测试系统在内的光电子器件测试设备，主要面向 CoC 封装级光芯片老化测试、裸 Die 级光芯片分选测试、晶圆级硅光芯片功能测试。

图：光电子器件测试环节



1) CoC 光芯片老化测试系统

光芯片用于通信领域往往面临高温、低温、高湿等极端环境，对器件的可靠性要求极高，而光芯片制造过程中引入的晶格缺陷会导致器件在高温、高强度电流的环境下加速劣化进而失效，需在器件投入使用前通过老化和测试筛出失效产品，以保证其使用寿命和可靠性。

CoC（Chip-on-Carrier，载体上芯片）是一种常见的光芯片封装形式，通过将裸芯片直接贴装到基板上，然后金线键合进行电气连接，最后在芯片顶部加盖板或者点胶保护实现封装。相较于 CoB（Chip-on Board）、TO（Transistor Outline）等封装形式，CoC 封装的光芯片体积小、集成度高，更为适合光模块等对信号传输速度要求较高的应用场景。公司针对 CoC 芯片测试需求，推出了 CoC 光芯片老化系统、CoC 光芯片测试系统和 CoC 光芯片上下料系统。

公司 CoC 光芯片老化系统 BI620X 系列产品用于光芯片的老化测试，通过将 CoC 光芯片固定在特制夹具中并通过老化抽屉与驱动电源相连，在设定高温环境下对光芯片

驱动偏置电流或偏置电压来加速芯片内电子流动以加速芯片衰减,实现对芯片老化寿命验证。BI620X 具备参数实时监控与分析功能,拥有优异的测试精度和良好的重复测试结果一致性;采用模块化架构设计,具备优良的兼容性,测试系统由老化抽屉、老化单层和机架组成,老化单层包含 4 组老化抽屉,单个机架可容纳多套老化单层,可执行对单套或同时多套单层的老化测试,最高支持 4,224 路并行测试,兼顾测试的高精度与高效率。

公司 CoC 光芯片测试系统 CT620X 系列产品与 CoC 光芯片老化系统协同作业,用于芯片老化前、老化后对 CoC 光芯片的光学和电学性能测试。CT620X 适配 BI620X 同型号夹具,简化芯片的上下料过程并消除了潜在的静电释放风险;依托领先的光功率耦合系统架构,可确保光学耦合与光谱测量效果的一致性,独特的双测试载台架构可实现载台的独立温控,并通过双通并行测试提高测试效率。

公司 CoC 光芯片上下料系统 AL620X 系列产品配套 CoC 光芯片老化系统与 CoC 光芯片测试系统使用,通过模块式设计实现快速安装、拆卸、维护和切换不同类型的 CoC 芯片,有效提高 CoC 芯片的全流程的自动化水平与测试效率。

图: CoC 光芯片老化系统

图: CoC 光芯片测试系统

图: CoC 光芯片上下料系统



2) 光芯片 KGD 分选测试系统

光芯片在出厂前必须对各项参数进行测试,以确保产品的可靠性及使用寿命,以 DFB 光芯片和 EML 光芯片为代表的激光器芯片类型受限于侧发光的结构特征,加之裸 Die 体积小、在晶圆上排列密度高,难以在晶圆层面进行 CP 测试,因此业界普遍在晶圆裂片后对未封装的裸 Die 进行 KGD 分选测试。

图：光芯片 KGD 分选测试系统



公司光芯片 KGD 分选测试系统 CT820X 系列以及 CT830X 系列产品由晶圆供给区、芯片搬运区、芯片位置校正区、芯片 OCR 提取区、芯片光电测试区、芯片收纳区共六部分组成，集成了晶圆环上料、运输、DUT ID 扫描、测试、下料、分拣归类等功能，可灵活满足不同类型的激光器芯片裸 Die 分选测试需求。精密源表作为光芯片 KGD 分选测试系统的核心测试部件对光芯片执行 LIV 等电性能测试，其性能直接影响测试能力与测试精度。

测试效率方面，光芯片 KGD 分选测试系统通过高效的精密运动架构实现裸芯片的精确对准，可在 6 秒内完成裸芯片上下料以及双温区全流程测试，实现对裸芯片的高速测试；通过自主设计的探针与压力控制机构，实现裸芯片的无痕精准测试。测试能力方面，光芯片 KGD 分选测试系统采用窄脉冲精密电流源实现 $1\mu\text{s}$ 脉宽的快速测试，提高了大功率光芯片散热能力以及测试精度。可靠性方面，光芯片 KGD 分选测试系统通过独特的工艺提高测试载台的导热效率与耐磨性，极大提升了设备核心部件的使用寿命与可靠性。可拓展性方面，光芯片 KGD 分选测试系统支持多测试工位独立控温功能，温度范围覆盖低温、常温与高温测试环境，温度稳定性控制在 0.2°C 以内，可满足光芯片裸 Die 规模化生产条件下的测试需求；CT830X 系列集成了芯片外观 AOI 检测功能，在芯片完成光电测试流程后对芯片的外观进行自动检测并筛选，实现了对芯片光电性能与外观瑕疵的全功能检测。

3）硅光晶圆测试系统

硅光芯片一般指采用硅基材料的光电子元件，属于新一代光通信器件，它通过集成激光器、光调制器、光探测器、复用器、光波导、光栅耦合器等光电子器件功能，可在

微小硅片上实现光信号的高速传输和处理。相较于传统的光器件组合封装，硅光芯片可在同等的带宽下大幅降低光模块的制造成本和单位能耗，进而促进数据中心和通信网络的发展。

公司面向硅基光电子测试需求，开发了硅光晶圆测试系统 sCT900X 系列产品，可在晶圆层面对硅光芯片进行检测，精准测量电光、光电转换效率、信号调制质量、接收灵敏度等关键参数，实现对硅光芯片的测试与筛选。

图：硅光晶圆测试系统



sCT900X 系统采用模块化设计，由测试机、耦合测试模组、探针台、晶圆上下料机部件组成。其中，测试机内置精密源表、可调光源、偏振控制器等测试部件和 PC 控制器，用于测试系统的整体控制；耦合测试模组包含耦合光探针、DC 直流探针与 RF 射频探针等测试部件，支持垂直耦合与边缘耦合方式，并通过并行测试架构大幅缩短测试时间；探针台则用于晶圆的承载和位移，实现待测器件的精准定位；上下料机用于晶圆的搬运，可根据测试需求选配全自动或半自动模式。

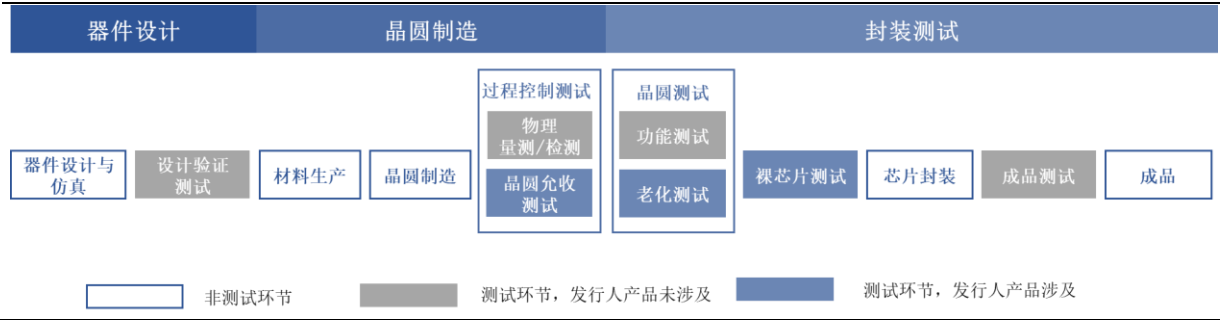
公司自主研发的耦合测试模组作为硅光晶圆测试系统的核心部件，对系统的耦合重复性与运行效率至关重要。公司持续优化硅光晶圆测试系统的核心性能指标，相关产品的发展历程如下：

推出时间	产品型号	光耦合重复性	光耦合速度	支持晶圆尺寸
2024 年	sCT9001	<0.2dB	<2s	6/8 寸
2024 年	sCT9002	<0.2dB	<1.5s	8/12 寸

（2）功率器件测试设备

公司面向功率器件测试需求，开发了包括晶圆级老化系统与功率芯片 KGD 分选测试系统在内的功率器件测试设备，主要面向晶圆级功率芯片老化测试、裸 Die 级功率芯片分选测试。

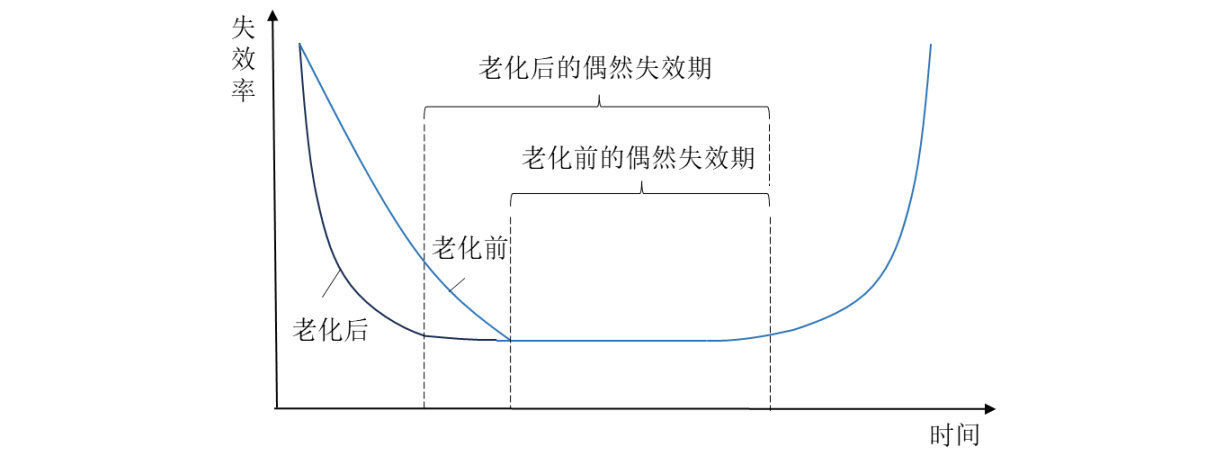
图：功率器件测试环节



1) 晶圆级老化系统

功率器件在生命周期中的失效率的变化呈现出类似浴缸的形状，在早期失效期，受制造工艺中的微粒污染、晶格缺陷等影响，器件的初始失效率处于较高水平；随着时间的推移，工艺缺陷逐步暴露，失效率也逐步下降。器件进入偶然失效期后，工艺缺陷基本暴露完毕，器件保持在稳定的低失效率区间。器件进入耗损期后，功率器件因老化磨损导致失效率再次上升。

图：老化测试与器件寿命的关系



根据功率器件的失效特征，器件制造完成后立即使用将面临较高的失效风险，为了适应车规级应用场景下日益严苛的可靠性要求，通过晶圆老化测试（WLBI）筛选出有隐患的芯片已成为行业通行标准。在常规条件下，功率器件一般需要 1,000 小时才能度过早期失效阶段，在高温高压条件下对碳化硅等功率器件进行老化测试可大幅加快工艺缺陷的暴露速度，使功率器件提前进入偶然失效期，进而提升测试效率。

公司晶圆级老化系统可对待测晶圆执行高温栅极偏压（HTGB）和高温反向偏压（HTRB）等老化测试项目，支持 6/8 寸晶圆老化测试，并对每个 Die 的阈值电压（Vth）进行高精度检测，确保测试数据的准确性；每个测试通道均配备了独立的过电流保护功能，有效保障待测器件的安全性。此外，测试系统可生成详细的 Map 数据，为用户提供全面的性能分析和质量控制依据。

图：晶圆级老化系统



公司持续优化晶圆级老化系统的核心性能指标，相关产品的发展历程如下：

推出时间	产品型号	单工位最大并行测试数量（颗）	工位数（个）	支持晶圆尺寸
2022 年	WLR3500	720	6	6 寸
2024 年	WLBI3800	2,112	3	6/8 寸
2024 年	WLBI370A	1,500	20	6/8 寸
2025 年	WLBI3810	2,560	9	6/8 寸

注：截至本招股说明书签署日，产品型号 WLBI3810 正在送样验证中。

2）功率芯片 KGD 分选测试系统

碳化硅和氮化镓等第三代半导体材料因其优异的物理特性被广泛应用于功率器件制作，但由于其材料脆性，裂片后损耗率较普通硅基芯片更高，而功率模组可由数十颗裸芯片封装而成，单个芯片的工艺缺陷将造成整个模组的失效，进而导致成本损失。因此，在晶圆裂片后对裸芯片 KGD 测试并分选出瑕疵品，已成为提高功率器件综合良率并降低成本的有效途径。

公司功率芯片 KGD 分选测试系统采用模块化架构，支持晶圆环（Frame Ring）、卷带（Tape&Reel）以及芯片托盘（Tray）等多种芯片来料方式；通过精密吸嘴搬运模块，测试系统能够精准控制探针定位精度，实现与待测器件的精准接触，确保测试信号

的完整性；系统采用自适应柔性芯片测试结构，可精确控制与芯片的接触压力，实现对裸芯片无损伤、高精度的取放和搬运；芯片测试座（Socket）采用特殊的设计与高压保护结构，可有效抑制高电压、高电流测试环境下的电弧，保障裸芯片测试的低回路电感，提高测试的稳定性。新一代产品采用“平移式+转塔式”组合方式，实现芯片在取放料以及不同测试工站间的快速与稳定搬运，大幅提高测试系统的测试效率。

图：功率芯片 KGD 分选测试系统



公司持续提升功率芯片 KGD 分选测试系统的核心性能指标，相关产品的发展历程如下：

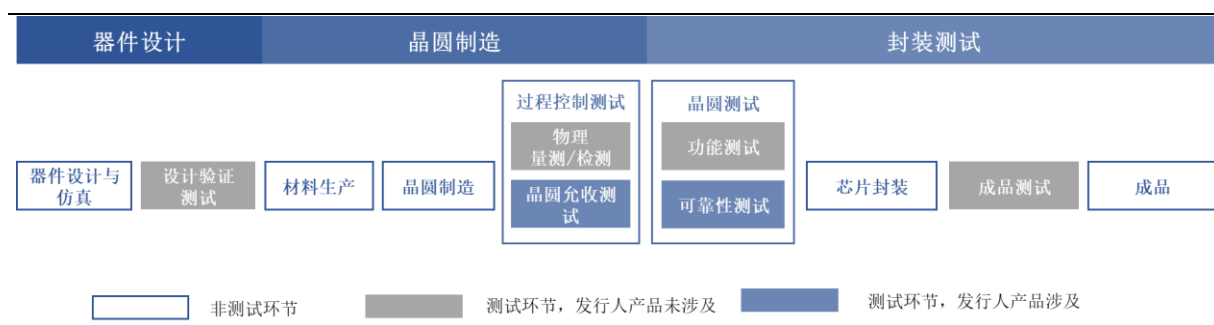
推出时间	产品型号	UPH（单位小时测试的裸芯片数量）（个）	工位数（个）
2023 年	PB6400	>900	4
2024 年	PB6600	>1,400	6
2025 年	PB6800	>4,000	6

注：截至本招股说明书签署日，产品型号 PB6800 正在送样验证中。

（3）电性能测试设备

公司电性能测试设备应用于半导体集成电路产品生产过程中的电性测试，主要产品包括 WAT 测试机和晶圆级可靠性测试系统，面向晶圆允收测试（WAT）和晶圆可靠性测试（WLR）。

图：半导体器件测试环节



1) WAT 测试机

WAT 测试机通过读取晶圆特定测试结构的电性参数从而监控各工艺步骤是否正常，进而实现优化晶圆制造工艺、提高各工序良品率的目的。

图：WAT 测试机



WAT 测试机由测试头、测试机柜、探针台和上下料机组成，测试头包含精密源表、开关矩阵、脉冲产生器等测试部件，用于电信号的接收和传递；测试机柜内置高精度数字万用表、电容测量单元等部件和 PC 控制器，用于测试系统的校准、测量和整体控制；探针台则用于晶圆的承载和位移，实现待测器件的精准定位；上下料机用于晶圆的搬运，可根据测试需求选配全自动或半自动模式。WAT 测试机的核心指标包括电流分辨率、电压分辨率、电流精度、电压精度、测试量程等，测试性能主要取决于测试头和测试机柜内置的测试部件。公司自主研发的精密源表和低漏电开关矩阵作为 WAT 测试机的核心部件，其性能直接影响测试系统的电流和电压的分辨率、测试精度、失调电流等核心性能指标，对测试系统的精度与运行效率至关重要。

公司 WAT 测试机涵盖串行和并行两种机型。WAT6200 系列为串行测试机，可满足多数半导体产品制造中的 WAT 电性测试需求，最小电流测量分辨率 1fA；WAT6300 系列为串行高压测试机，可满足功率半导体器件测试需求；WAT6600 系列为并行测试

机，适用于工艺更先进、测试结构更复杂的半导体集成电路工艺流程中的电性能测试需求，最高支持 48 路并行测试，在串行测试机性能基础上，失调电流水平进一步突破 0.2pA 以下，综合性能国内领先。

公司持续优化 WAT 测试机的主要性能指标，相关产品的发展历程如下：

推出时间	产品型号	测试能力	最小电流分辨率	最小电压分辨率
2022 年	WAT6200 系列	串行测试	1fA	100nV
2024 年	WAT6300 系列	高压串行测试	1fA	100nV
2024 年	WAT6600 系列	48 路并行测试	1fA	100nV

注：截至本招股说明书签署日，产品型号 WAT6300 系列、WAT6600 系列正在送样验证中。

2）晶圆级可靠性测试系统

随着对半导体器件应用场景的持续丰富与可靠性要求的不断提升，越来越多的厂商在常规 CP 测试的基础上引入晶圆可靠性测试（Wafer Level Reliability），通过施加极端测试环境对半导体制造工艺进行评估，最终实现提升器件可靠性的目的。

晶圆级可靠性测试系统与晶圆级老化系统具有相似性，均通过对器件施加极端测试条件加速器件性能的退化，不同的是，晶圆级可靠性测试系统有着更为丰富的电性能测试功能，主要用于半导体器件的抽检。根据联合电子设备工程委员会（JEDEC）的标准，可靠性测试主要包括经时绝缘击穿测试（TDDDB）、可靠性热载流子注入效应测试（HCI）、负偏置温度不稳定性（NBTI）、可靠性电子迁移老化测试（EM）及栅极电压稳定性老化测试（Vths）等内容。

图：WLR 系列



图：PLR 系列



公司面向晶圆裂片前和裂片后的可靠性测试需求，分别推出了 WLR 系列产品和 PLR 系列产品，支持多站点（Multi-site）测试及相关数据分析，可快速反馈器件的可靠

性和工艺缺陷，通过更换探针卡和测试座可支持测试不同型号的器件，满足主流半导体器件的可靠性测试需求。

公司持续优化晶圆级可靠性测试系统的主要性能指标，主要产品的发展历程如下：

推出时间	产品型号	测试能力	系统测试温度
2023 年	WLR0200	串行测试	300℃
2024 年	WLR0100	并行测试	300℃
2024 年	PLR0010	并行测试	250℃

注：截至本招股说明书签署日，产品型号 PLR0010 正在送样验证中。

3、测试部件

配套电子测量仪器和半导体测试设备使用，公司向用户提供自主研发设计的夹具、探针卡、夹具板等测试部件。

（四）主要经营模式

1、研发模式

公司主要采取自主研发的模式，掌握核心技术的自主知识产权。公司以行业需求为导向确定产品开发方向，结合上下游产业技术趋势，不断迭代提高自身技术水平并拓展核心技术的应用边界。公司已形成完善的研发体系，核心技术团队具有多年专业经验积累，形成了一支专业自主的研发团队。公司研发部门包括各事业部下设的研发部，围绕产品线布局以项目形式开展研发活动，确保研发活动规范有序开展。

公司的研发流程主要包括立项阶段、架构设计阶段、工程验证阶段（EVT）、设计验证阶段（DVT）和转产阶段（MVT）。

（1）立项阶段

公司根据市场调研情况，评估研发项目的市场潜力与市场前景，研发部门结合研发经验、介入时机、技术壁垒、项目预算与市场情况等因素综合评估项目的可行性，经立项评审通过后，研发项目立项并启动。

（2）架构设计阶段

研发项目团队对研发项目新产品的方案架构等进行设计，对新产品的可靠性、成本、开发风险等进行分析，明确研发项目产品方向及关键技术，降低项目研发失败风险。

（3）工程验证阶段（EVT）

研发项目团队进行结构、软件、硬件等模块的详细设计和验证，并根据设计方案组装研发样机并验证设计方案的完整性，包括电气功能测试、信号完整性测试和电源测试等测试项目。此阶段的研发样机测试结果通过审议后，研发项目工程验证阶段（EVT）结束并进入设计验证阶段（DVT）。

（4）设计验证阶段（DVT）

研发项目团队针对研发样机制定更详细的测试方案并进行产品优化迭代，可按需进行客户及潜在客户研发样机试用测试、第三方检测机构测试等，根据客户及检测机构的验证测试反馈结果，对研发样机进行设计、性能、可靠性上的改良优化。此阶段的研发样机测试结果通过审议后，研发项目设计验证阶段（DVT）结束并进入转产阶段（MVT）。

（5）转产阶段（MVT）

通过批量试制评估新产品的工艺稳定性、产品良率等关键要素，并将技术资料移交生产部门等做好交接工作，确保产品达到可量产状态。研发项目通过 MVT 转产审核后，研发项目团队编制结项报告，研发项目正式结项。

2、采购模式

公司的采购内容主要包括通用类采购、定制类采购与外协采购。其中，通用类采购主要包括电子元器件、标准件、电气类、仪器设备等，公司根据产品技术需求对原材料的规格型号进行选型、验证及批量采购；定制类采购主要包括专用芯片、机加钣金件等，由公司向供应商提供版图、图纸或技术参数定制产品专用零部件；外协采购主要系生产工序中的外协生产，主要包括设备基础装配、PCBA 贴片、夹具加工等，公司向外协厂商提供部分原材料及技术规格，由外协厂商组装或加工完成后，发往公司进行采购验收。

公司主要实行“以产定购”的采购模式，依据生产计划，结合物料库存情况及采购交付周期较长物料的安全库存情况，编制物料需求计划及物料采购计划；依据采购计划安排，结合行业供应变化情况、使用部门与计划部门采购需求，下达采购订单，完成物料采购。采购物资送达后，质量部门进行到货检验，检验合格后完成入库。公司定期分析物料采购与交付情况，识别与预防物料供应风险。

公司采购部门负责采购计划制定、供应商管理、采购价格管理、采购作业实施及物料交付保障等物料采购相关工作。公司采购部门对供应商的资质信誉、产品技术与质量、交货及时性、供货价格、售后服务等方面综合评估，选择合格的供应商，并定期对供应商进行分级考核管理。公司已与主要供应商建立了稳定的长期合作关系，稳定的供应商管理体系支持着日常交付的达成、新产品的快速发布及公司未来的发展。

3、生产模式

公司采用“以销定产，适当备货”的生产模式，具备完备的生产加工体系和适应业务需求的生产组织方式。生产计划部门根据销售订单及预测情况，结合存货库存等制定生产计划，生产部门负责生产计划的安排、生产物料领取、生产执行等，并定期跟踪生产计划执行情况，识别与解决生产风险。

公司将核心资源集中于产品开发和技术创新，基于专业化分工与成本效益的考量，公司采用自主生产与外协生产相结合的生产模式，核心部件组装、软件烧录、整机调试、性能测试和检验等核心环节由公司自主生产；设备基础装配、PCBA贴片、夹具加工等非核心环节采取外协方式进行生产。公司质量部门对生产完成后的成品进行检验，检验合格后成品入库。

4、销售模式

公司已建立专业化、国际化的销售团队及完善的销售体系，在美国、日本、韩国、新加坡、泰国、马来西亚等国家设立销售办公室，形成了覆盖全球的专业化营销网络。公司销售团队基于产业特性、产品应用及区域市场等维度进行精细化市场开发，凭借深厚的行业经验和背景，基于公司强大的技术实力，服务全球高速通信和半导体等科技领域知名用户，助力公司触达各领域前沿技术，引领公司创新发展。同时，公司已建立健全的销售管理制度，做到从市场推广、客户开发、需求挖掘、商务谈判、合同签订、协调生产交付、售后服务全销售流程的高效规范运行。

公司采用“直销为主，经销为辅”的销售模式，具体如下：公司以直销模式为主，独立掌握核心客户资源，通过展会交流、客户拜访、招投标、客户主动询价等多方式获取客户订单；公司以经销模式为辅，利用经销商的区位和渠道优势，提高对终端客户的响应速度和服务能力，加速终端客户的开发周期与导入进度，有利于公司品牌和产品的快速推广。公司经销模式均为买断式销售。

报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	70,949.50	89.06%	71,280.34	91.01%	24,923.05	92.58%	17,747.81	83.63%
经销	8,716.05	10.94%	7,044.72	8.99%	1,996.90	7.42%	3,472.77	16.37%
合计	79,665.55	100.00%	78,325.06	100.00%	26,919.95	100.00%	21,220.59	100.00%

5、发行人采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及其在报告期内及未来的变化趋势

公司经营模式是经过多年深耕发展而不断积累和完善所形成的，能够满足公司经营发展的需求，符合公司自身业务特征和行业惯例。影响公司经营模式的关键因素主要包括宏观经济环境、国家产业政策、行业发展趋势、上下游市场供需情况、公司自身产品及技术特征和业务水平等因素。报告期内，公司经营模式未发生重大变化，影响公司经营模式的关键因素未出现重大变化，在可预见的未来一定期间内公司经营模式亦不会发生重大变化。

（五）设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

公司主营业务为电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务，专业为全球高速通信和半导体等领域用户提供高速率、高精度、高效率的核心测试仪器设备。自成立以来，公司主营业务、主要产品以及主要经营模式均未发生重大变化。

成立至今，公司凭借在光通信领域核心测试仪器设备的技术研发和产业化应用的成功实践，逐步掌握了自主知识产权核心芯片及自研核心算法、硬件板卡、超精密运动系统等测试行业关键前沿技术能力，形成了以高速信号处理、微弱信号处理和超精密运动控制为核心的平台级核心技术体系。依托强大的平台级核心技术体系，公司一方面不断巩固和深化在光通信领域的纵向竞争力，另一方面也成功实现在功率器件、半导体集成电路等领域的横向拓展，形成了丰富的产品矩阵，在上述各领域里构筑起显著竞争优势。

未来公司将依托核心技术复用价值，一方面持续丰富现在行业领域产品矩阵，拓展实时示波器、光模块测试一体机、硅光晶圆老化系统、硅光芯片测试系统、CPO芯片测试系统、半导体综合参数分析仪等产品；另一方面拓宽下游应用领域，持续加大存储器

件测试等领域的战略布局。

公司成立以来业务、产品及经营的演变情况如下：

1、聚焦光模块测试主航道，铸就高速信号处理技术硬实力

2017年，公司创始团队敏锐洞察5G浪潮下新一代光通信市场的增长潜力，聚焦光模块测试需求，以误码分析仪作为突破口，持续推进通信测试仪器的研发与产业化。公司研发团队凭借丰富的技术经验与深刻的行业理解，逐步掌握了以“低损耗低噪声高速信号电路设计”为代表的高速信号处理领域核心技术，为采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪等通信测试仪器的持续迭代奠定了底层技术支撑。

公司围绕光通信提速需求，保持持续高强度研发投入，推动芯片、算法、硬件、软件能力的代际跨越，不断突破高速信号处理技术的上限，努力缩小与全球最高水平的技术代差，采样示波器通道带宽从10GHz提升至65GHz，时钟恢复单元最高恢复速率从10GBaud提升至120GBaud，误码分析仪单通道最高传输速率从25GBaud提升至113GBaud，深度覆盖100G至1.6T光模块核心测试需求。

同时，公司正面向行业高速率、高集成度的测试需求持续拓展产品矩阵，加快推进实时示波器、光模块测试一体机等产品的研发与产业化应用。

2、拓展光芯片测试，实现光通信全产业链核心测试环节全覆盖

光芯片是光模块的核心器件，光模块厂商出于工艺良率、交付效率与成本控制的需要，普遍自主完成光芯片的封装工序，部分厂商进一步覆盖光芯片的制造业务。

公司凭借在光通信领域的客户资源优势，逐步向上游的光芯片测试环节延伸业务版图，逐步掌握了“高集成度四象限源测量技术”等微弱信号处理领域核心技术，以及以“KGD裸芯片级测试分选技术”、“硅基光子芯片光电混合信号高精度耦合和测量技术”为代表的超精密运动控制领域核心技术，2018年以来推出CoC光芯片老化测试系统、光芯片KGD分选测试系统、硅光晶圆测试系统等光电子器件测试设备，满足封装级光芯片、裸Die级光芯片、晶圆级硅光芯片测试需求，实现光通信全产业链核心测试环节覆盖。

同时，公司正面向新一代通信器件及高速率光电混合测试需求持续拓展产品矩阵，加快推进硅光晶圆老化系统、硅光芯片测试系统、CPO芯片测试系统等产品的研发与产

业化应用。

3、补强微弱信号处理技术，布局半导体集成电路测试应用领域

公司始终高度重视仪器设备核心部件与核心器件的自主能力，针对光芯片电学性能测试精度的技术瓶颈，重点攻坚核心测试部件精密源表的研究开发，依托硬件电路设计领域的技术积淀，进一步掌握“超微弱信号产生与测量技术”等微弱信号处理领域核心技术，并于2019年成功推出公司首款精密源表。

在光通信测试领域产业化应用的基础上，公司重点围绕半导体集成电路测试需求开展精密源表科研攻坚，产品技术水平不断提升，最小电流分辨率从100pA逐步突破至0.1fA，同国际最高水平的差距持续缩小。公司持续丰富电性能测试仪器产品线，拓展出PXIe插卡式源表、低漏电开关矩阵、高压源表、脉冲源等多款产品，并正在大力推进半导体综合参数分析仪的研发及产业化应用，以不断满足客户多元测试需求。公司聚焦微弱信号处理技术的复用价值，进一步布局电性能测试设备产品线，陆续开发出WAT测试机、晶圆级可靠性测试系统等，是国内少数具备精密源表等核心测试部件自主能力的厂商。

4、深度挖掘微弱信号处理、超精密运动控制技术复用价值，拓展功率器件测试设备业务版图

依托光电子器件测试领域的技术沉淀，公司面向车规级应用场景下功率器件与日俱增的可靠性、安全性、稳定性的严苛要求，深度挖掘微弱信号处理、超精密运动控制等核心技术复用价值，成功拓展功率器件测试设备业务版图。

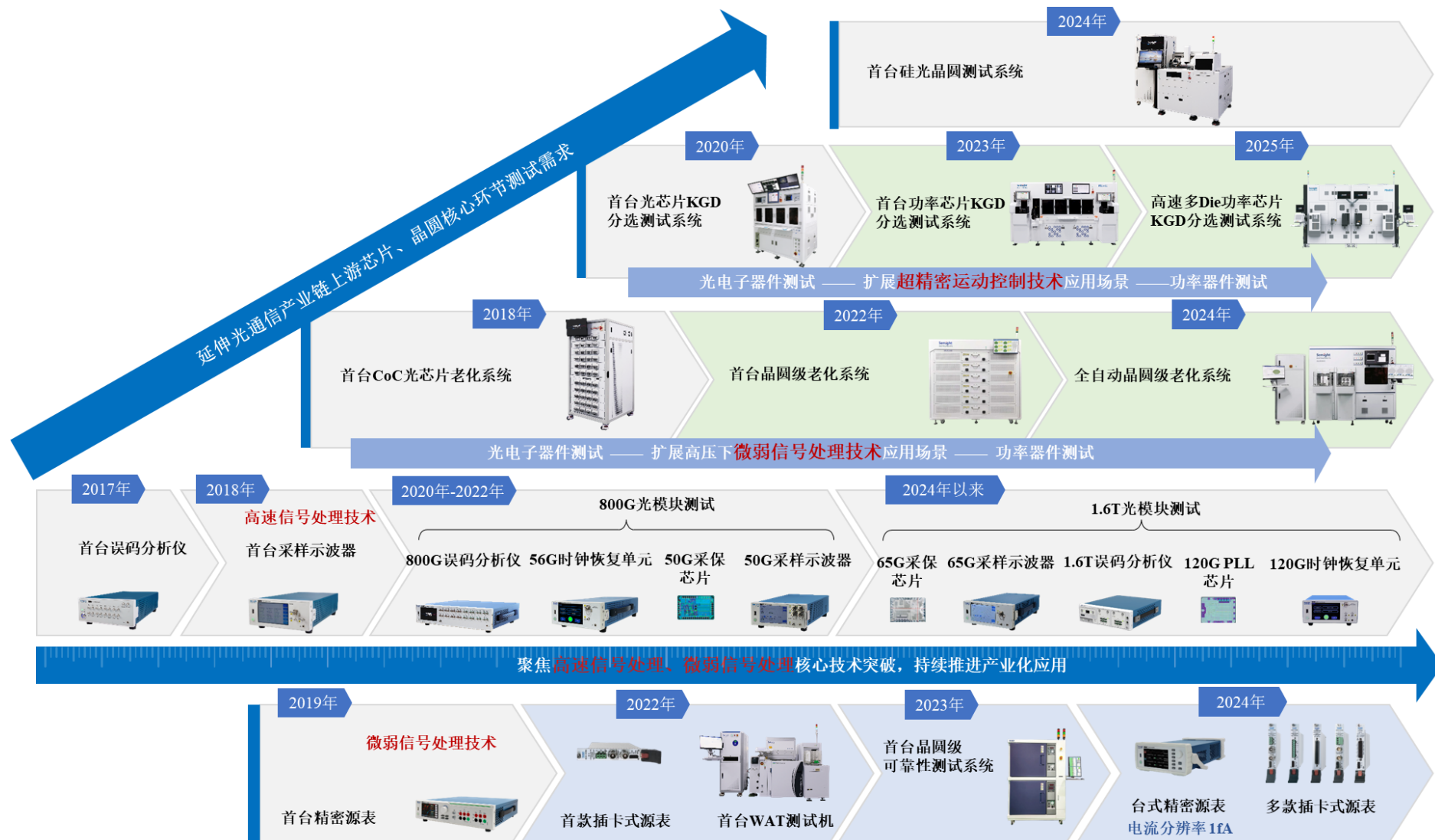
公司依托在CoC光芯片老化测试系统研发过程中积累的微弱信号处理技术，针对功率器件高压场景的测试特点，重点提升测试通道数量与耐压能力，成功推出晶圆级老化系统；依托光芯片KGD分选测试系统研发过程中积累的超精密运动控制技术，面向功率器件量产测试需求持续提升测试效率，成功推出功率芯片KGD分选测试系统。上述两款产品均于2023年实现产业化应用，公司是目前国内极少数同时实现晶圆级老化系统、功率芯片KGD分选测试系统产业化应用的厂商，并在此基础上成功出海参与全球竞争。

5、依托平台级核心技术体系，拓宽存储器件测试等下游应用场景

目前全球存储器件测试设备市场主要被Advantest、Teradyne等美日企业垄断，国内存储器件测试设备厂商多处于研发或产业化初期阶段，产品性能与国际领先企业存在较大差距，高速产品更是处于空白阶段。随着国产存储芯片厂商的产能扩张，解决存储器件测试设备的“卡脖子”问题迫在眉睫。

依托以高速信号处理、微弱信号处理和超精密运动控制为核心的平台级核心技术体系，公司持续加大存储芯片测试设备等领域的战略布局和投入，大力推进高速存储芯片测试系统、HBM芯片KGD分选测试系统、DRAM芯片老化系统等产品的研发及产业化应用，有望打开公司下一个增长曲线。

公司主要产品的发展历程如下：

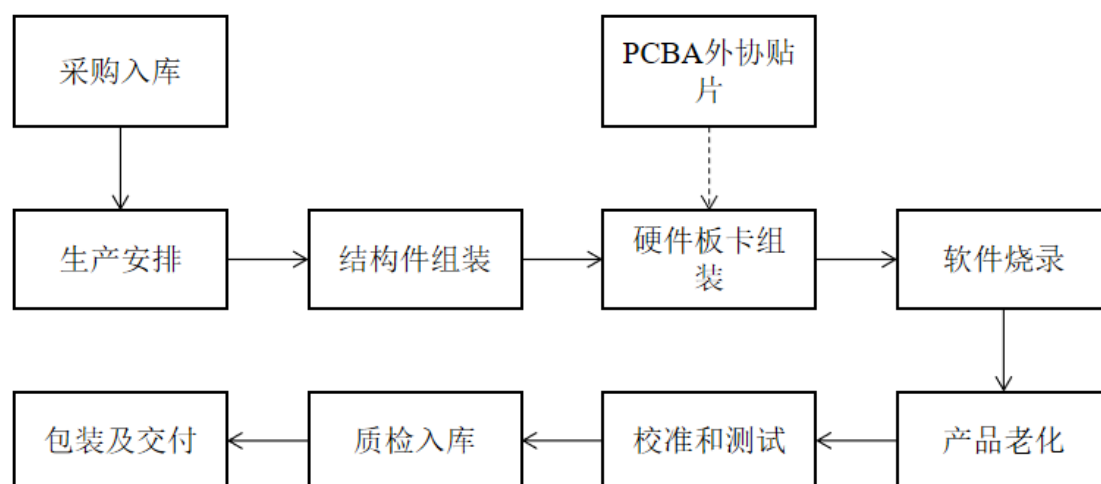


（六）主要业务经营情况和核心技术产业化情况

成立至今，公司凭借多年的技术积累和产业化实践，逐步掌握了自主知识产权核心芯片及自研核心算法、硬件板卡、超精密运动系统等测试行业关键前沿技术能力，形成了以高速信号处理、微弱信号处理和超精密运动控制为核心的平台级核心技术体系，并深度融入并应用于主营业务。报告期内，公司核心技术产品的收入贡献分别为 21,220.59 万元、26,919.95 万元、78,325.06 万元和 79,665.55 万元，占营业收入的比例分别 98.98%、97.61%、99.32%和 98.89%。

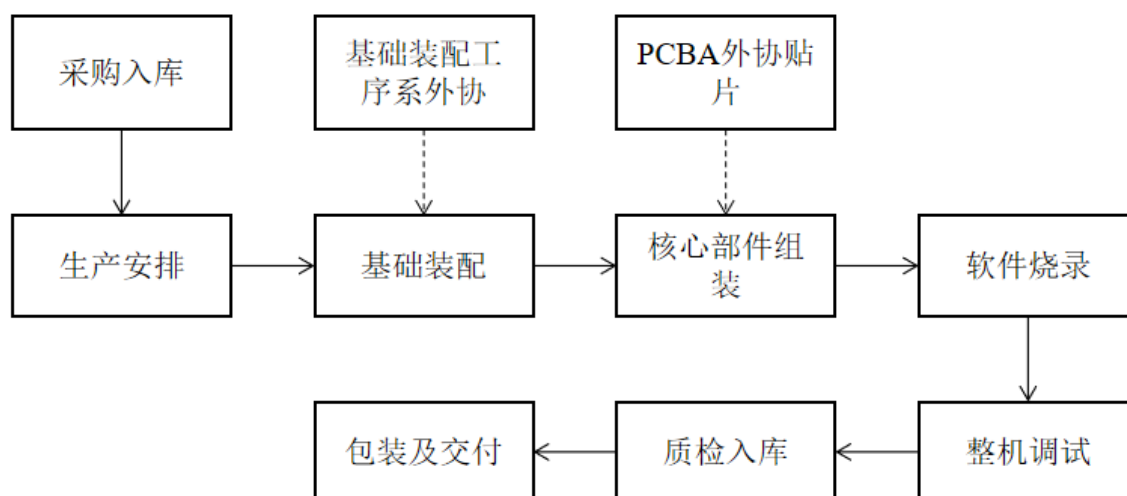
（七）主要产品的工艺流程图

1、电子测量仪器



电子测量仪器主要生产工序包括结构件组装、硬件板卡组、软件烧录、产品老化、仪器校准和测试等。其中，公司掌握的自主知识产权核心芯片（贴装至硬件板卡）及自研核心算法软件、硬件板卡等是产品先进性的集中体现，融合了公司高速信号处理、微弱信号处理等多项核心技术，直接决定了仪器的性能边界。电子测量仪器的校准和测试环节需对产品进行技术指标的测试、对比与校准，确保出厂性能符合设计要求。

2、半导体测试设备



半导体测试设备主要生产工序包括基础装配、硬件板卡等核心部件组装、软件烧录、整机调试等。公司将不涉及核心技术的基础机构件与电气组件的装配环节交由外协厂商执行，完成设备的基础装配并检测合格后，由生产部门执行核心部件组装和软件烧录工序；其中，核心部件（硬件板卡、精密运动部件、探针部件）和算法软件融合了微弱信号处理、超精密运动控制等多项核心技术，是产品技术先进性的集中体现。半导体测试设备完成生产组装后进入整机调试环节，该环节主要涉及影响设备性能与工艺指标的多项调试工作（例如电气点位测试、各类元器件校准等），需要应用机械设计、电子工程、电气工程、计算机软件等多个学科，调试复杂性高，是生产环节技术难点的集中体现。

公司核心技术主要应用于各主要产品的研发设计、核心部件组装、整机调试、校准和测试等环节，是公司主要产品升级迭代、生产交付的技术支撑。公司核心技术的具体使用情况和效果详见本招股说明书之“第五节 业务与技术”之“六、发行人核心技术与技术看研情况”之“（一）主要产品的核心技术情况”。

（八）公司具有代表性的业务指标及其变动情况

报告期内，公司具有代表性的业务指标包括营业收入、毛利率、研发投入以及产品技术指标，营业收入、毛利率、研发投入体现公司整体业务规模、盈利能力以及研发投入水平，产品技术指标体现公司产品技术水平。

报告期内，公司收入变动情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。报告期内，公司主要产品

和服务的毛利率变动情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“（四）毛利及毛利率分析”。报告期内，公司研发投入变动情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“（五）期间费用分析”之“3 研发费用”。公司产品技术指标情况详见本节“二、发行人所处行业的基本情况”之“（四）发行人所处行业竞争格局及主要企业”。

（九）符合产业政策和国家经济发展战略的情况

公司是国内领先的高端测试仪器设备企业，主营业务为电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务，是国家重大战略需求领域实现核心基础仪器设备国产化攻坚与自主可控的重要力量。根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司所处行业为“二十八、信息产业”之“3.通信设备”，属于鼓励类行业；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.2 电子专用设备仪器制造”，属于国家重点鼓励、发展的战略性新兴产业。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）所属行业及确认所属行业的依据

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业为“C 制造业”之“C40 仪器仪表制造业”下属的“C4028 电子测量仪器制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020—2024），公司所处行业为“C 制造业”之“CI 仪器、仪表”之“CH40 仪器仪表制造业”下属的“CH402 专用仪器仪表制造”。

根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司所处行业为“二十八、信息产业”之“3.通信设备”，属于鼓励类行业；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.2 电子专用设备仪器制造”，属于国家重点鼓励、发展的战略性新兴产业。

（二）所属行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策

1、所属行业主管部门、监管体制

公司所属行业的主管部门为工信部、科技部，行业自律组织为中国电子仪器行业协会和中国半导体行业协会。

工信部主要职责为研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资等项目等。

科技部主要负责拟定国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；牵头建立统一的国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机构；拟定国家基础研究规划、政策和标准并组织实施；编制国家重大科技项目规划并监督实施；牵头国家技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施等。

中国电子仪器行业协会是国家一级行业协会，主管部门为工信部。主要承担行业调研、信息咨询、推荐和制定标准、技术交流、协助企业参加展会、开拓国内外市场、进行国际交流合作等职能。

中国半导体行业协会是由从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的相关的企、事业单位自愿结成的行业性、全国性、非营利性的社会组织，是中国集成电路的行业自律管理机构。行业协会在工业和信息化部指导和管理下，负责产业及市场研究，对会员企业提供行业引导、咨询服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。协会下设集成电路分会、封装测试分会、设计分会等。

2、所属行业主要法律法规政策

为加强基础研究领域，2023年2月，习近平总书记在中共中央政治局集体学习中强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。

电子测量仪器和半导体测试设备属于国家战略新兴产业，全方位应用于我国国民经济的多个领域，包括光通信、半导体、消费电子、汽车、医疗、能源、教育科研等，是

支撑经济社会发展的战略性、基础性行业。近年来，国家相继出台了一系列支持性政策，主要包括：

序号	行业政策	发布时间	发布单位	相关政策内容
1	《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》	2024 年	工信部等	构建 5G-A 产业链,持续推进上下行超宽带、通感一体、无源物联、高精度低功耗定位、网络智能等关键技术研发试验,加快推进基站、核心网、终端、芯片和 仪器仪表 等设备研发及产业化
2	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	2024 年	工信部等	提升 精密测量仪器 、高端试验设备、设计仿真软件等供给能力,为关键技术验证提供试用环境,加快新技术向现实生产力转化
3	《制造业卓越质量工程实施意见》	2023 年	工信部等	支持企业加强计量、标准、认证认可、试验验证、检验检测等能力建设,持续采用新技术、新产品对 计量检测仪器 、试验设备等设施升级改造,提升质量控制水平,加大对标准研制与推广、检验检测认证等无形资产的投资,拉升质量“高线”
4	《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》	2023 年	工信部等	面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G 通信、智能网联汽车等重点领域,推动电子材料、电子专用设备和 电子测量仪器 技术攻关
5	《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025 年）》	2023 年	工信部等	到 2025 年,智能检测技术基本满足用户对制造工艺的需求,核心零部件、专用软件和整机装备供给能力显著提升,重点领域智能检测装备示范带动和规模应用成效明显,产业生态初步形成,基本满足智能制造发展需求
6	《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》	2022 年	国务院办公厅	加大基础电子产业研发创新支持力度。统筹有关政策资源,加大对基础电子产业（电子材料、电子元器件、电子专用设备、 电子测量仪器 等制造业）升级及关键技术突破的支持力度
7	《“十四五”数字经济发展规划》	2021 年	国务院	着力提升基础软硬件、核心电子元器件、 关键基础材料和生产装备 的供给水平,强化关键产品自给保障能力
8	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	2021 年	十三届全国人大四次会议	依托行业龙头企业,加大重要产品和关键核心技术攻关力度,加快工程化产业化突破;加强 高端科研仪器设备 研发制造;实施重大技术装备攻关工程,完善激励和风险补偿机制,推动 首台（套）装备 、首批次材料、首版次软件示范应用
9	《新时期促进集成电路产业和软	2020 年	国务院	国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业,自获利年度起,

序号	行业政策	发布时间	发布单位	相关政策内容
	件产业高质量发展的若干政策》			第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税
10	《加强“从 0 到 1”基础研究工作方案》	2020 年	科技部等	加强重大科技基础设施和高端通用科学仪器的设计研发，聚焦 高端通用和专业重大科学仪器设备 研发、工程化和产业化研究，推动高端科学仪器设备产业快速发展

（三）所属行业发展情况

1、电子测量仪器行业基本情况

（1）电子测量仪器行业概况

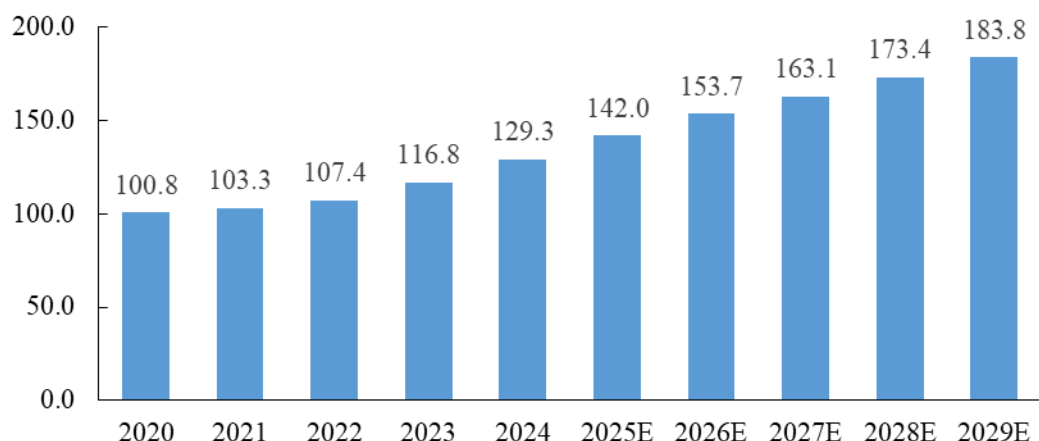
电子测量仪器以电子技术为基础，融合电子测量技术、射频微波设计技术、数字信号处理技术、微电子技术、计算机技术、通信技术、软件技术等多领域技术，广泛应用于我国国民经济的各个方面，包括光通信、半导体、消费电子、汽车、医疗、能源、教育科研等多个领域，对提升我国科学技术能力、发展新兴产业、促进传统工业智能化转型，以及提高国民日常生活水平起到关键的作用，其发展水平已成为一个国家科技水平、综合国力和国际竞争力的标志。

1) 电子测量仪器市场规模

①全球市场规模

受益于电信、数据中心、医疗电子等下游行业需求增长，以及电子测量产业技术水平不断进步，全球电子测量仪器市场快速发展。根据 Frost&Sullivan 数据，全球电子测量仪器市场规模从 2020 年的 100.8 亿美元增长至 2024 年的 129.3 亿美元，预计于 2029 年进一步增长至 183.8 亿美元。

图：全球电子测量仪器市场规模（亿美元）



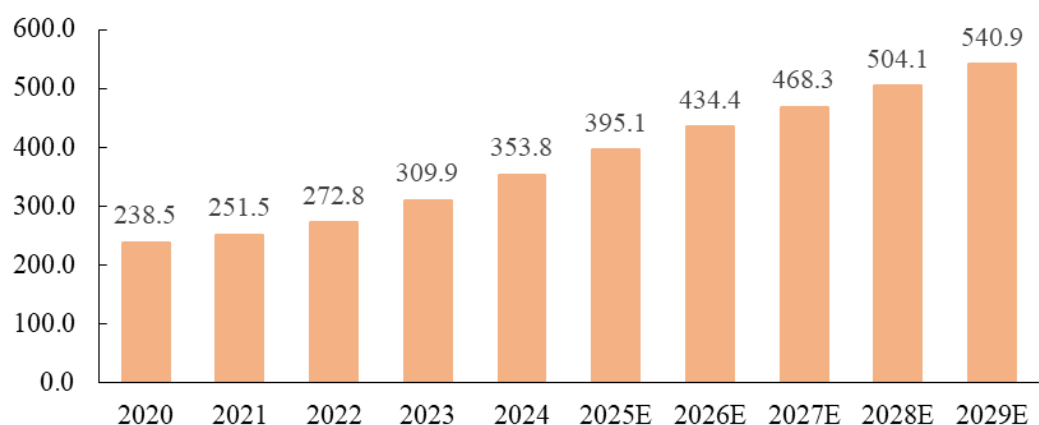
数据来源：Frost&Sullivan。

②中国市场规模

中国是全球电子测量仪器市场中增速最快的市场之一。国家政策从财政、税收、技术、人才、知识产权等多方面为电子测量仪器行业提供全方位的支持。在中国制造业迎来数字化、网络化、智能化的变革浪潮下，半导体、通信、新材料、新能源汽车、消费电子等下游行业蓬勃发展，催生了对电子测量仪器设备的大量需求。

根据 Frost&Sullivan 数据，中国电子测量仪器市场规模将由 2020 年的 238.5 亿元增长至 2024 年的 353.8 亿元，期间的年复合增长率将达 10.4%。预计 2029 年进一步增长至 540.9 亿元。

图：中国电子测量仪器市场规模（亿元）



数据来源：Frost&Sullivan。

2) 电子测量仪器的分类及公司产品的覆盖情况

①按照下游应用分类

按下游应用领域分类，电子测量仪器可分为光通信测试仪器、半导体测试仪器、消费电子测试仪器、汽车电子测试仪器、教育科研测试仪器等。公司采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪、突发误码分析仪、快速波长计等通信测试仪器目前主要面向光通信测试需求，按下游应用领域分类，属于光通信测试仪器。

②按照测量功能分类

按测试功能分类，电子测量仪器可分为数据采集仪器、高速数字测试仪器、电气及环境测试仪器、射频测试仪器等。目前，公司电性能测试仪器产品线的主要产品是精密源表，属于电气及环境测试仪器范畴。

3) 电子测量仪器行业发展趋势

随着测试复杂程度不断提升，测试场景逐渐多元化，技术快速迭代，单一测试功能很难满足客户需求，因此对电子测量仪器提出更高的模块化、平台化需求。插卡式仪表等集成化测试仪器产品逐渐成熟，设备集成多种仪器仪表的测试功能，配合可二次开发以及可替换的测试模块，在满足客户灵活的测试需求、提高测试系统的稳定性以及提升客户的测试效率的同时，降低技术迭代导致的设备更换成本。未来，电子测量仪器模块化、平台化的发展趋势将进一步延续。

(2) 光通信测试仪器行业概况

1) 光通信行业概况

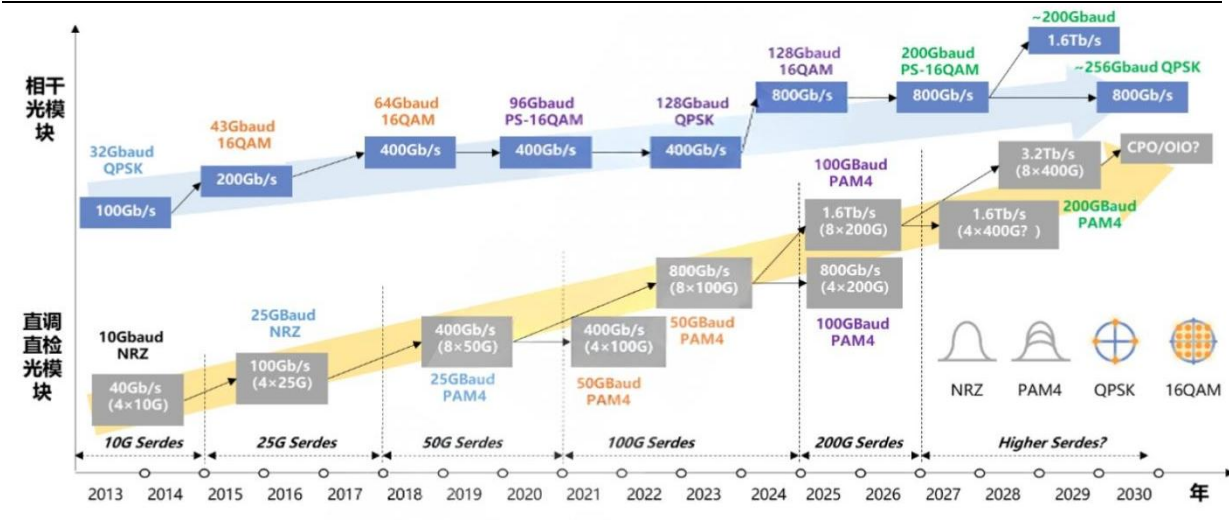
光通信以光波作为信息传输的载体，以光纤作为信息传输媒介，具有高速率、大容量、抗干扰能力强等优势，在无线通信、光纤宽带、数据中心和消费电子等领域广泛应用。

光模块是光通信系统的核心组件，用于光通信系统的发射端与接收端进行光电信号的转换。早期，光通信的提速需求主要由城域网络和干线电信网络驱动，但更新迭代速度较为缓慢，约5年更新一代。近年来，人工智能大模型快速发展，需要高性能计算的支持训练，而采用分布式架构通过多个节点进行并行训练已成为通用做法。分布式的计

算架构下，不同节点之间需要频繁同步模型参数，因此对光收发模块大带宽、低延时等性能提出了更高要求，推动高速光模块在数据中心快速落地应用。

目前，数据中心已成为光模块的主要应用场景，占整个光模块市场的比例超 60%。应用于数据中心的光模块早期约 3-4 年更新一代，2023 年以来在 AI 影响下迭代周期进一步缩短至 2 年左右。目前，800G 光模块已成为全球范围内数据中心领域的主流产品，1.6T 光模块也进入商业化阶段。根据 LightCounting 测算，2023 年全球数通光模块市场规模达 62.5 亿美元，2024-2029 年预计将以 27% 的 CAGR 增长，2029 年有望达 258 亿美元。

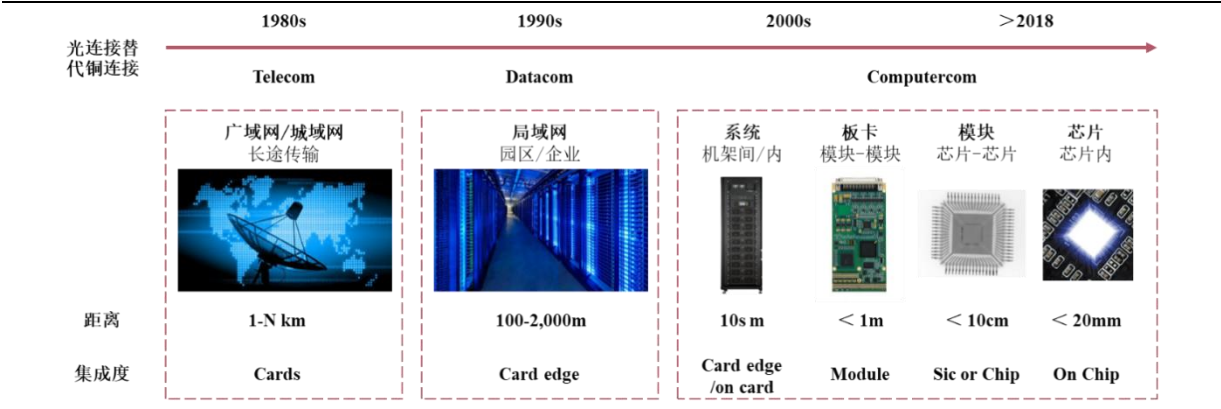
图：光模块发展趋势



数据来源：中国信息通信研究院《信息光子技术发展与应用研究报告（2024 年）》

为应对全球数据量指数式增长对通信容量的挑战，光通信技术的应用正从通信网络逐步延伸至系统芯片，未来将逐步实现板卡级、模块级、芯片级的高速光信号传输。

图：光通信变革历程



在此背景下，通过硅光技术实现激光器、光调制器、光探测器等光电子器件的单芯

片集成，相比传统光模块采用的分立式结构具有低功耗、高速率等优势，将逐步取代传统的可插拔光模块，进一步提升光互连效率。根据 LightCounting 预测，基于硅光技术的光模块市场占比将由 2025 年 30%增长至 2030 年的 60%。

2）光通信测试仪器在产业链中发挥的关键作用

光模块作为光通信系统的关键器件，其性能直接决定通信传输的效率和稳定性。为确保光模块在光通信系统中的可靠性，IEEE（电气与电子工程师协会）、ITU-T（国际电信联盟的电信标准化部门）、OIF（光网络论坛）等行业协会对于各类光模块参数制定了详细的标准。光模块在研发与生产制造过程中需经过严格的测试环节，以确保符合行业要求。

典型的光模块测试包括光模块发射端/光发射器件（TOSA）、光模块接收端/光接收器件（ROSA）测试，需使用采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪、波长计等多样化的通信测试仪器，具体如下：

测试内容	测试仪器	测试流程
光模块发射端/ 光发射器件 （TOSA）	采样示波器、时钟恢复单元、波长计等	采样示波器将光信号转化为可视的眼图，进行眼图测试并测量噪声、抖动、消光比、TDECQ（发射机色散眼图闭合代价）等参数；时钟恢复单元搭配采样示波器使用，其在提取光模块发射端/光发射器件（TOSA）发出信号中的时钟信号后，向采样示波器提供触发信号。波长计则可用于测量光模块发射端/光发射器件（TOSA）发出光信号的波长、频率、功率等参数
光模块接收端/ 光接收器件 （ROSA）	误码分析仪、突发误码分析仪、网络测试仪等	误码测试核心功能是对比接收端信息与其发出的误码信息的差异，进而判断光模块接收端/光接收器件（ROSA）的信号接收质量：1）误码分析仪用于常规的连续信号误码测试；2）突发误码分析仪用于 PON 网络的突发信号误码测试；3）网络测试仪则用于以太网环境下的跑流测试

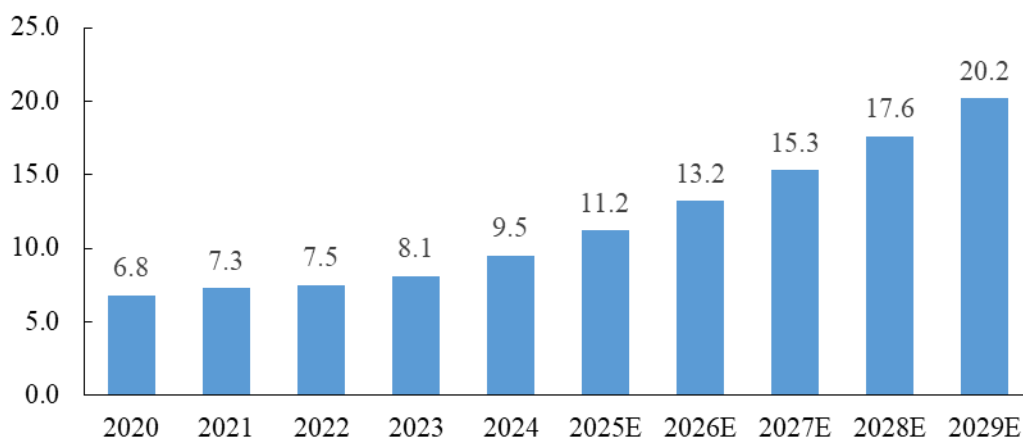
随着数据量、数据传输速率、传输距离和传输效率等要求不断提升，光模块技术持续迭代升级，光模块的测试项目愈加丰富、测试范围要求更广、测试精度要求更高、测试集成度提升，光通信测试仪器迎来更大的技术挑战和发展机遇。

3）光通信测试仪器行业发展趋势

随着 AI、物联网等技术的蓬勃发展，对信号的传输速度和数据处理能力提出了更高要求，光模块传输速率已经历从 40G 到 800G 的迭代，1.6T 光模块的商业化进程也不断推进，光通信测试仪器向着高速率、大带宽的方向发展，以适应高速测试需求。

全球范围内，得益于 AI 新兴技术逐步投入应用所带动的数据流量需求增长，用于数据通信的光模块市场规模持续扩张，相应拉动了全球光通信测试仪器市场需求增长，市场规模于 2024 年达到 9.5 亿美元，预计 2029 年达到 20.2 亿美元。

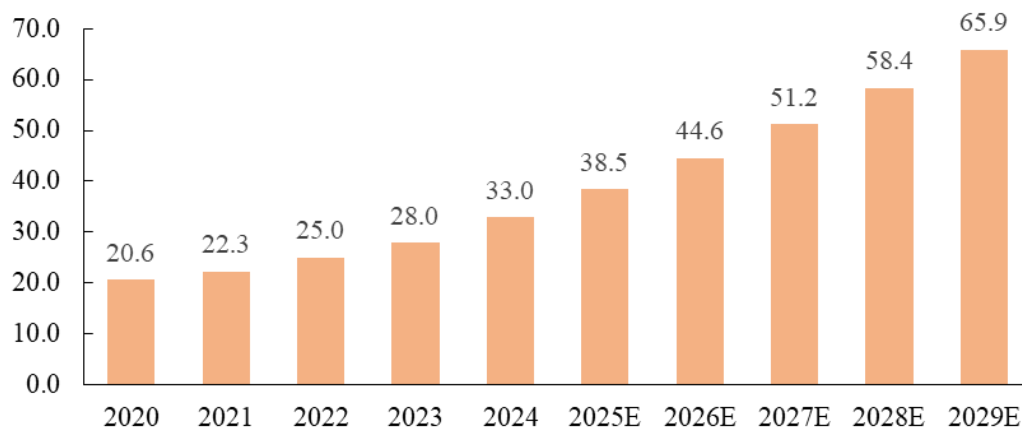
图：全球光通信测试仪器市场规模（亿美元）



数据来源：Frost&Sullivan。

根据 Frost&Sullivan 数据，中国光通信测试仪器市场 2024 年市场规模达 33.0 亿元，随着下游光模块市场需求的持续增长和光通信测试技术的升级，2029 年市场规模将达到 65.9 亿元。

图：中国光通信测试仪器市场规模（亿元）



数据来源：Frost&Sullivan。

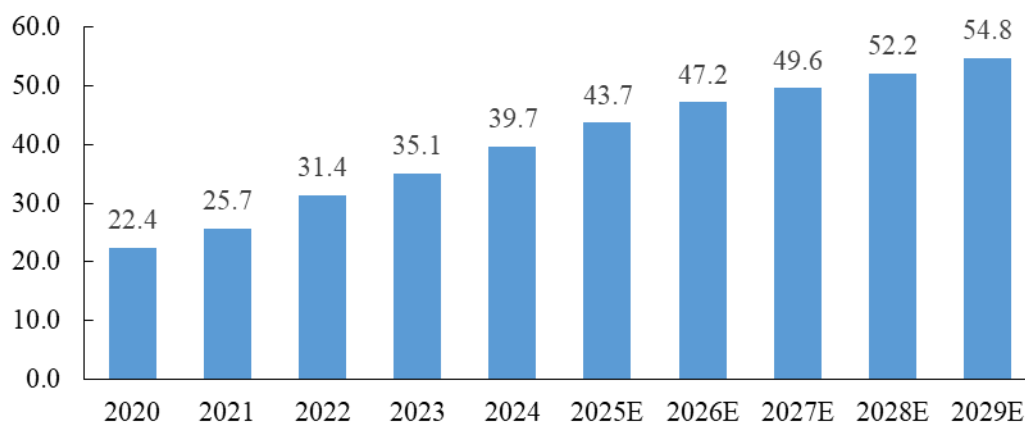
（3）电气及环境测试仪器行业概况

1）电气及环境测试仪器行业概况

电气及环境测试仪器主要用于电性参数测试，包括精密源表、开关矩阵、数字万用表、阻抗测试仪等产品，广泛应用于半导体、新能源、医疗、科学研究等多个领域。

随着测试技术进步、仪器自动化和智能化趋势的不断加速，电气及环境测试仪器持续拓展应用场景，根据 Frost&Sullivan 数据，全球市场规模由 2020 年的 22.4 亿美元增长到 2024 年的 39.7 亿美元，预计 2029 年可达 54.8 亿美元。

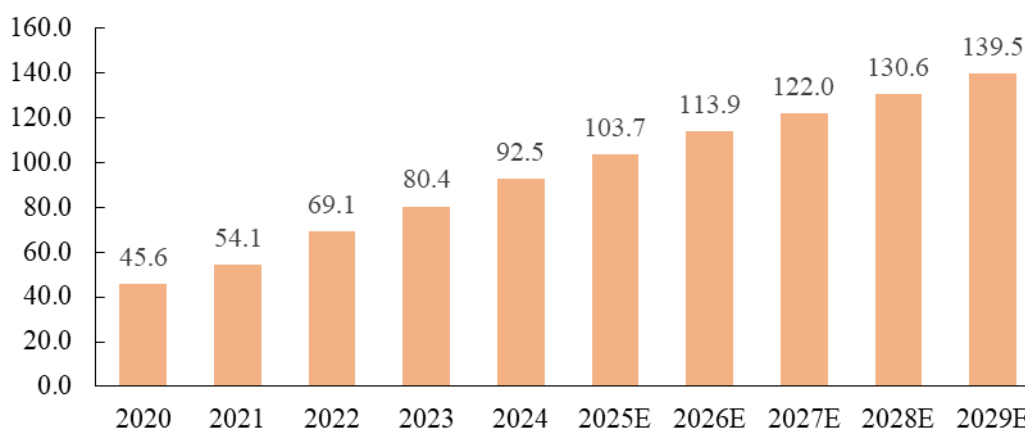
图：全球电气及环境测试仪器市场规模（亿美元）



数据来源：Frost&Sullivan。

中国电气及环境测试仪器市场规模从 2020 年的 45.6 亿元增至 2024 年 92.5 亿元，预计 2029 年市场规模将达到 139.5 亿元。

图：中国电气及环境测试仪器市场规模（亿元）



数据来源：Frost&Sullivan。

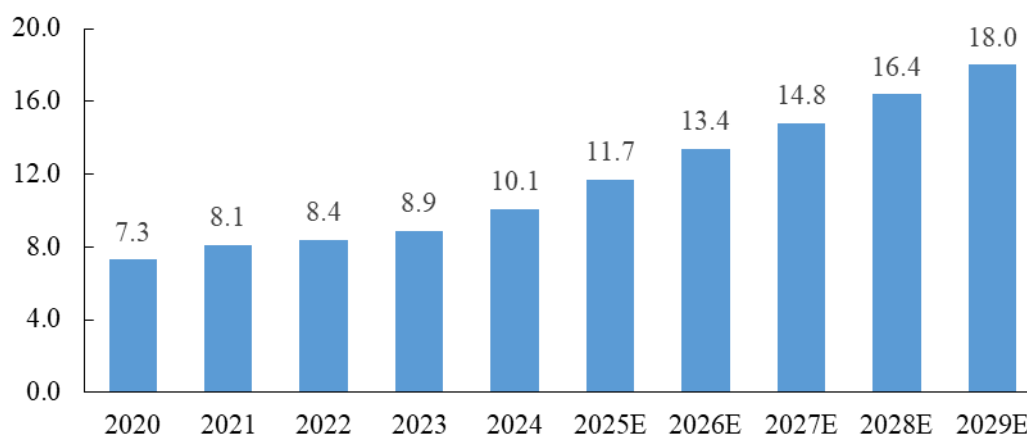
2) 精密源表行业发展态势

精密源表集电压源、电流源、电流表、电压表及负载功能于一体，在半导体器件、新能源等多个领域拥有广泛应用场景，是电气及环境测试仪器中的重要细分品类之一。随着下游行业对可靠性要求的提升，精密源表正朝着高精度、宽量程、高响应速度的方向演进；而随着下游应用场景的多样化，精密源表也从单一功能产品向系统化解决方案转型。

半导体制造领域，随着芯片制程步入 5nm 阶段，芯片内部晶体管密度提升，要求精密源表的漏电流检测精度达到 pA 级水平；而 DRAM 存储芯片的测试方面，对存储单元的良率检测需在 1 μ s 内完成数十次读写操作验证，对源表的响应速度与信号稳定性提出更高要求。新能源汽车领域，车规级功率器件模块测试则需覆盖 2,000V 以上高压场景，精密源表通过融合多通道切换矩阵及自适应量程技术，可实现 μ V-10kV、fA-100A 的全范围覆盖，大幅提高测试效率。消费电子领域，快充芯片需在 -40°C~125°C 温区内完成上百次充放电循环测试。工业物联网领域，传感器微电流检测精度达到 0.01% $\pm$ 5nA 水平，丰富多样的测试需求对精密源表的可拓展性提出了更高要求，精密源表也从单一功能产品向系统化解决方案转型。

根据 Frost&Sullivan 数据，精密源表的全球市场规模从 2020 年的 7.3 亿美元增长至 2024 年的 10.1 亿美元，预计 2029 年进一步增长至 18.0 亿美元。

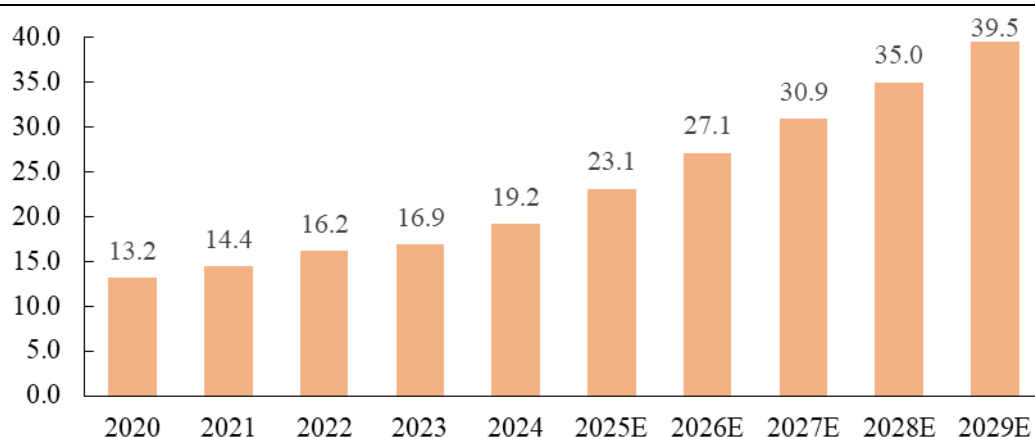
图：全球精密源表市场规模（亿美元）



数据来源：Frost&Sullivan。

得益于半导体、光通信等领域的需求扩张，中国精密源表市场正处于高速发展阶段，增速引领全球，市场规模由 2020 年的 13.2 亿元增长至 2024 年的 19.2 亿元，预计 2029 年市场规模将达 39.5 亿元。

图：中国精密源表市场规模（亿元）



数据来源：Frost&Sullivan。

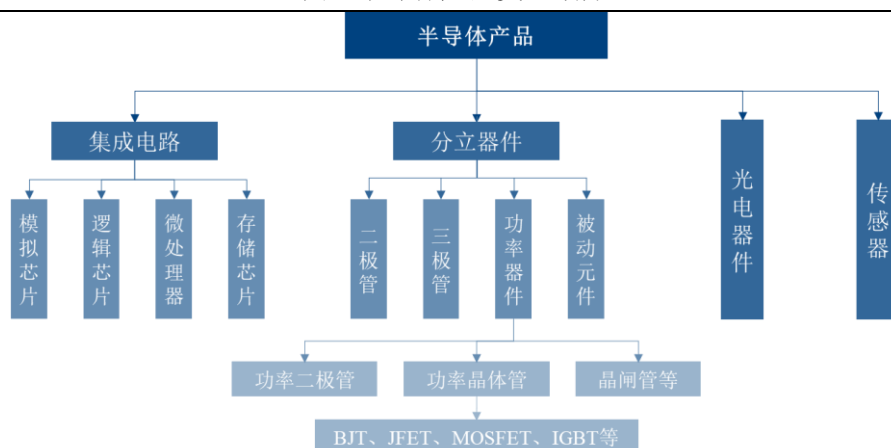
2、半导体测试设备行业基本情况

（1）半导体及其测试设备行业概况

1）半导体行业概况

半导体是指在常温下导电性能介于导体与绝缘体之间，且导电性能可控的材料，半导体器件可分为集成电路、分立器件、光电子器件以及传感器四大类，广泛应用于网络通讯、汽车电子、消费电子、工业控制等领域。

图：半导体产品类型细分



半导体行业作为现代信息技术产业的基础和核心，在推动国家经济发展、提高人民生活水平和保障国家安全等方面发挥着重要的作用，是当今国际竞争的焦点和衡量一个国家现代化程度以及综合国力的重要标志之一。

2）半导体测试设备在产业链中发挥的关键作用

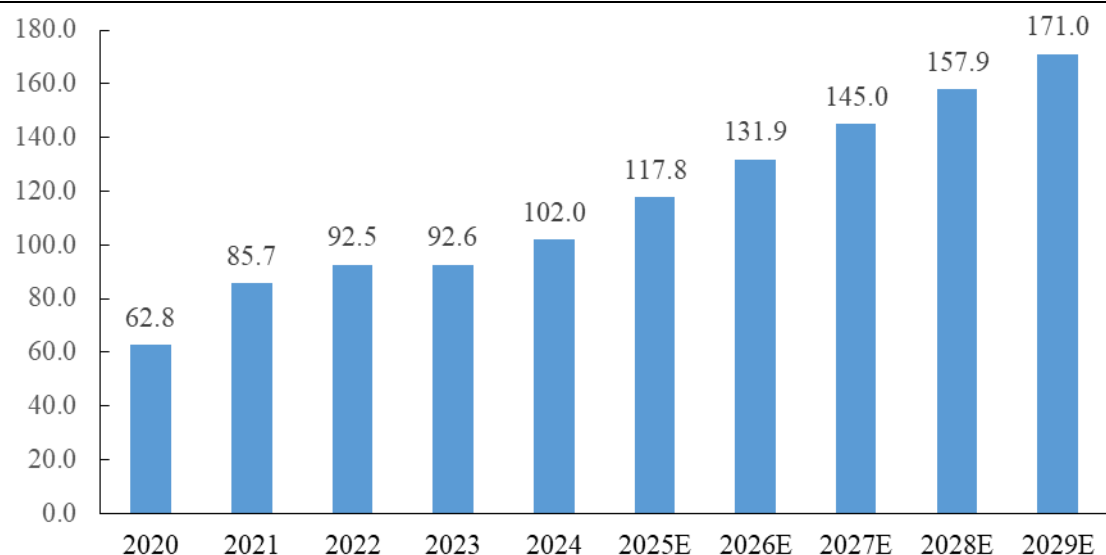
半导体制造过程中存在颗粒、互联、静电损伤等工艺缺陷，随着半导体前道制程步骤增多，缺陷数量也随之增加，根据电子系统故障检测中的“十倍法则”，若芯片厂商未能及时发现芯片故障，则需在下一阶段耗费十倍的成本以排查和处理故障。因此，随着芯片生产成本的提升，半导体测试的重要性也日渐凸显。当前，随着半导体制造工艺难度提升，Chiplet 等先进封装技术快速发展，为确保芯片的良率与可靠性，测试环节的专业性和复杂度明显提升。

半导体测试设备贯穿于半导体制造过程，以监测与优化半导体制造工艺、提高最终良品率为目的，是保障器件良品率的关键设备。随着芯片制程的提升、化合物半导体材料的引入，半导体器件制造工序逐渐复杂，对半导体测试设备要求愈加提高。

3) 半导体测试设备行业发展趋势

2022 年至 2023 年，受全球消费电子等终端市场需求萎靡及半导体产业整体资本性支出增长不及预期等因素影响，全球半导体测试设备增速明显放缓。2024 年，在人工智能、高性能计算（HPC）的高速发展、汽车电子及消费电子回暖等因素的驱动下，半导体市场整体呈现复苏态势，拉动半导体测试设备增速回升，同比增长 10.15%，发展仍呈现长期向好的趋势。

图：2020-2029 年全球半导体测试设备市场规模（亿美元）



注：半导体测试设备市场规模中包含了集成电路、分立器件、光电器件测试设备，以及包括 WAT 测试设备、WLBI 测试设备、KGD 测试设备在内的新兴应用领域的市场规模。

数据来源：Frost&Sullivan。

4) 半导体测试设备的分类及公司产品的覆盖情况

①半导体测试设备的分类

A.按照测试对象分类

按测试领域分类，半导体测试设备的测试对象包括集成电路、分立器件、光电子芯片、传感器，其中：集成电路包括模拟芯片、逻辑芯片、微处理器、存储芯片等，分立器件包括功率器件等。

B.按照测试类别分类

按照半导体器件制造过程中接受的测试类别分类，半导体测试设备可以分为功能测试设备、参数测试设备和可靠性测试设备。

C.按照测试环节分类

按测试环节分类，半导体测试设备可以分为晶圆级测试设备、裸芯片级测试设备和封装级芯片测试设备等。

②公司半导体测试设备的覆盖情况

公司主要产品	测试领域	测试类别	测试环节
CoC 光芯片老化测试系统	光电子器件	可靠性（老化）测试、功能测试	封装级芯片
光芯片 KGD 分选测试系统	光电子器件	功能测试	裸芯片
硅光晶圆测试系统	光电子器件	功能测试	晶圆
晶圆级老化系统	功率器件	可靠性（老化）测试	晶圆
功率芯片 KGD 分选测试系统	功率器件	功能测试	裸芯片
WAT 测试机	半导体集成电路	参数测试	晶圆
晶圆级可靠性测试系统	半导体集成电路	可靠性测试	晶圆

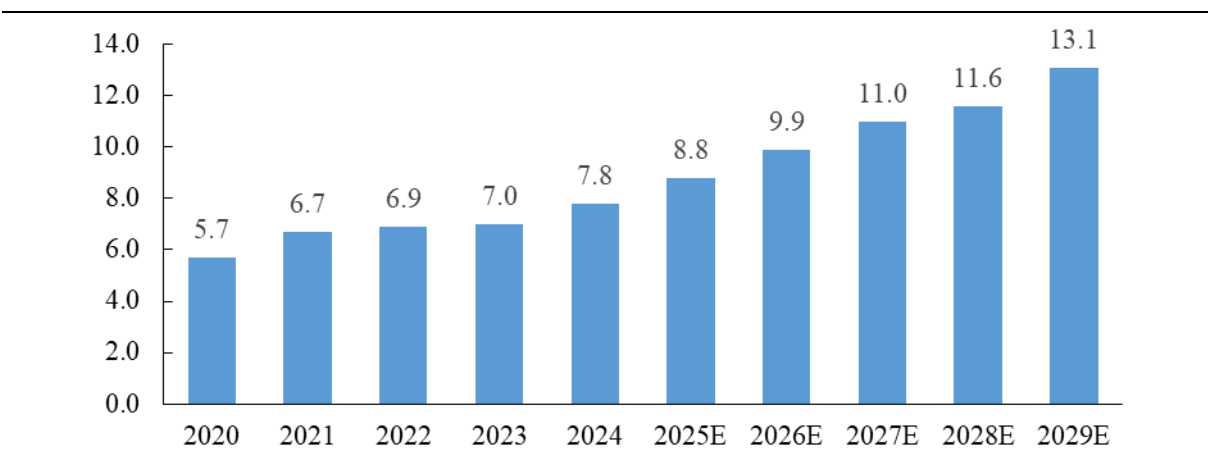
（2）光电子器件测试设备行业发展现状及趋势

光芯片技术迭代带来测试需求的持续增长。一方面，新技术的发展、迭代与应用带来新增的测试需求，例如硅光芯片有望在 FMCW 激光雷达、光子计算等领域进一步延拓，全新的光芯片技术对测试设备精度、测试范围等指标提出新增的要求；另一方面，在全球电信、数据中心等通信系统向更快传输速率升级背景下，对光芯片速率提出更高需求，生产工艺流程复杂程度提高，带来测试效率与精度要求的提升。

随着 5G、物联网和人工智能等新兴应用领域对光电子器件的精度和可靠性提出更

高的要求，测试要求随着增加，全球半导体光电器件测试设备市场在 2020 年至 2024 年间经历了快速上升，从 2020 年的 5.7 亿美元增至 2024 年的 7.8 亿美元，期间年复合增长率为 8.0%，预计 2029 年达到 13.1 亿美元。

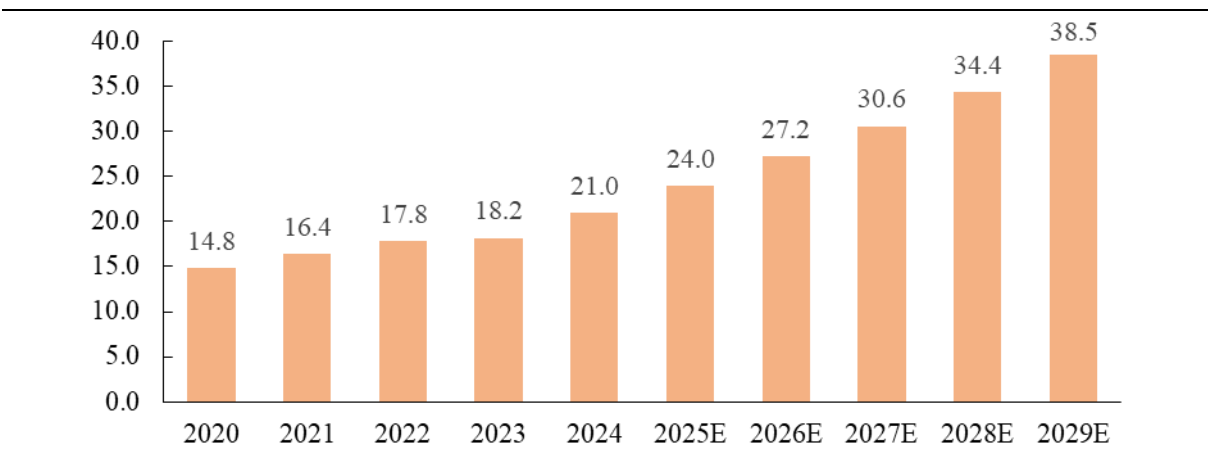
图：全球半导体光电器件测试设备市场规模（亿美元）



数据来源：Frost&Sullivan。

中国半导体光电器件测试设备市场的走势与全球市场基本一致，其规模从 2020 年的 14.8 亿元增至 2024 年的 21.0 亿元，预计 2029 年达 38.5 亿元。

图：中国半导体光电器件测试设备市场规模（亿元）



数据来源：Frost&Sullivan。

（3）功率器件测试设备行业发展现状及趋势

功率器件是半导体分立器件中的主要产品类别，涵盖功率二极管、功率晶体管（MOSFET、IGBT 等）、功率晶闸管等。根据 Frost&Sullivan 数据，2024 年中国分立器件测试设备市场规模为 18.4 亿元，预计 2029 年市场规模将达 43.6 亿元，2024-2029 年的年均复合增速为 18.8%。在分立器件测试设备市场中，功率器件是其最主要应用方

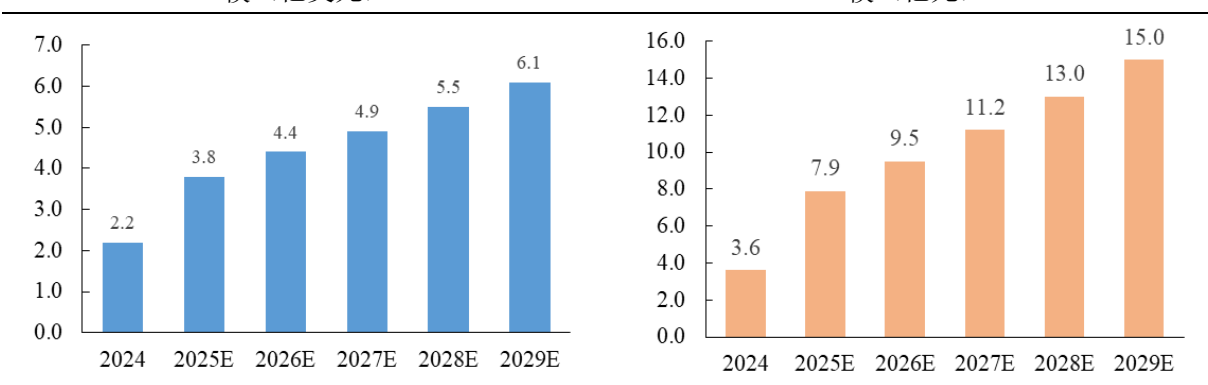
向，而其中碳化硅功率器件测试需求的快速增长，正成为驱动整个分立器件测试设备市场扩张的关键动力。

伴随全球新能源汽车普及加速，碳化硅功率器件产业化进程提速，根据 Frost&Sullivan 数据，2024 年中国碳化硅功率器件测试设备市场规模为 7.4 亿元，预计 2029 年中国碳化硅功率器件测试设备市场规模达 33.5 亿元，2024-2029 年的年均复合增速为 35.3%。其中，碳化硅功率器件 WLBI 测试设备与碳化硅功率器件 KGD 测试设备直接关系到碳化硅器件的最终可靠性、生产成本与良率，已成为碳化硅功率器件测试所需的主要设备。

1) 碳化硅功率器件 WLBI 测试设备行业发展现状及趋势

WLBI 测试设备能够在晶圆级别对裸芯片进行并行测试，相较于传统的测试方法，具有更低的成本和更高的效率。随着半导体产业对成本和效率的关注度不断提高，主要面向车规级测试需求的碳化硅功率器件 WLBI 测试设备的市场需求也随之增长。

图：全球碳化硅功率器件 WLBI 测试设备市场规模（亿美元） 图：中国碳化硅功率器件 WLBI 测试设备市场规模（亿元）



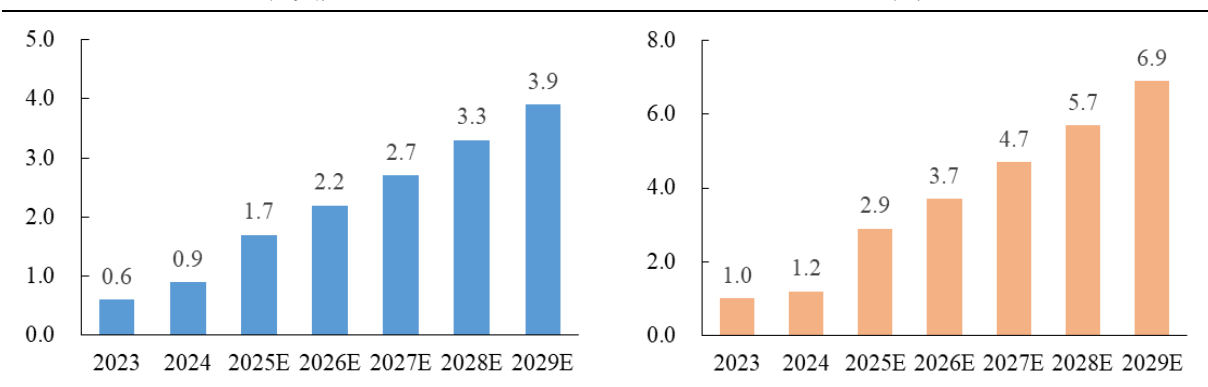
数据来源：Frost&Sullivan。

全球碳化硅功率器件 WLBI 测试设备市场规模在 2024 年达到 2.2 亿美元，预计 2029 年增至 6.1 亿美元；中国碳化硅功率器件 WLBI 测试设备市场在 2024 年的市场规模为 3.6 亿元，预计 2029 年增至 15.0 亿元。

2) 碳化硅功率器件 KGD 测试设备行业发展现状及趋势

功率器件在驱动电机、调节电压和控制电流等方面发挥关键作用，因此对其可靠性和性能的测试需求也在增加，KGD 测试可减少芯片封装后因可靠性问题导致的良率损失，测试设备的市场需求也随之增长。

图：全球碳化硅功率器件 KGD 测试设备市场规模（亿美元） 图：中国碳化硅功率器件 KGD 测试设备市场规模（亿元）



数据来源：Frost&Sullivan。

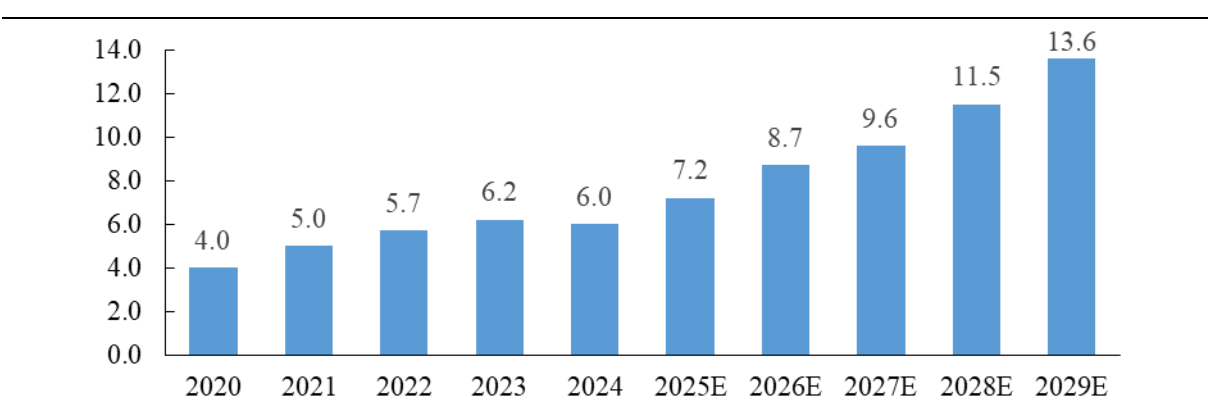
全球碳化硅功率器件 KGD 测试设备市场规模在 2024 年达到 0.9 亿美元，预计 2029 年增至 3.9 亿美元；中国碳化硅功率器件 KGD 测试设备市场在 2024 年的市场规模为 1.2 亿元，预计 2029 年增至 6.9 亿元。

（4）电性能测试设备行业发展现状及趋势

1）WAT 测试设备行业发展现状及趋势

全球半导体 WAT 测试设备市场在 2020 至 2023 年间经历了较快发展。2024 年，受晶圆厂新建产能不足影响，半导体 WAT 测试设备市场规模略有下滑。总体而言，全球半导体 WAT 测试设备市场规模以 10.9% 的年复合增长率，从 2020 年的 4.0 亿美元增至 2024 年的 6.0 亿美元，预计 2029 年增至 13.6 亿美元。

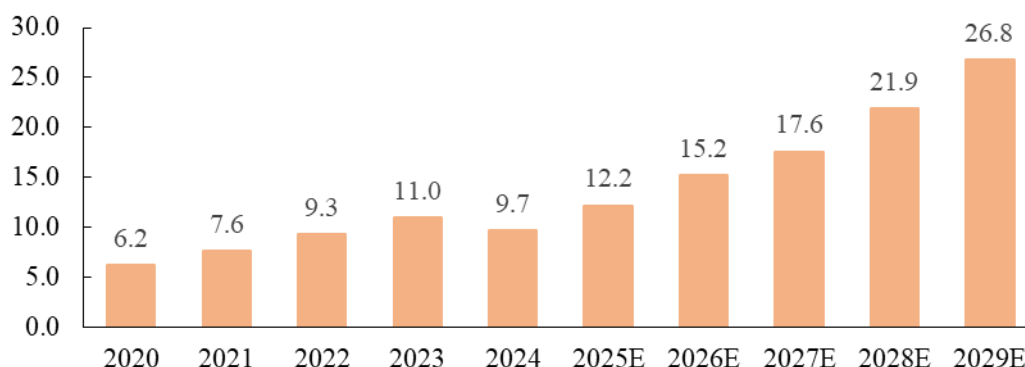
图：全球半导体 WAT 测试设备市场规模（亿美元）



数据来源：Frost&Sullivan。

中国半导体 WAT 测试设备市场由 2020 年的 6.2 亿元增至 2024 年的 9.7 亿元，期间年复合增长率为 11.7%，预计 2029 年增至 26.8 亿元。

图：中国半导体 WAT 测试设备市场规模（亿元）

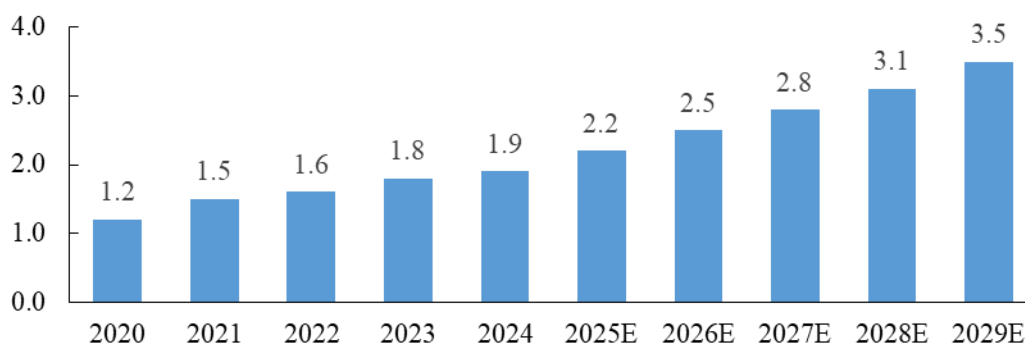


数据来源：Frost&Sullivan。

2) WLR 测试设备行业发展现状及趋势

WLR 测试设备可以在晶圆级别对器件进行批量可靠性测试，相较于传统的封装级测试，具有更低的成本和更高的效率。全球半导体 WLR 测试设备市场从 2020 年的 1.2 亿美元增至 2024 年的 1.9 亿美元，预计 2029 年增至 3.5 亿美元。

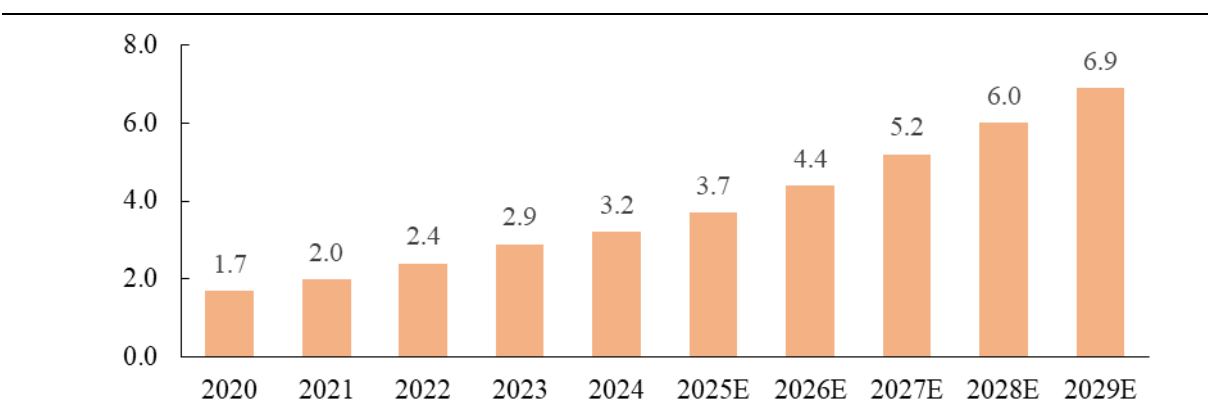
图：全球半导体 WLR 测试设备市场规模（亿美元）



数据来源：Frost&Sullivan。

中国半导体 WLR 测试设备市场由 2020 年的 1.7 亿元增至 2024 年的 3.2 亿元，期间年复合增长率为 17.6%，预计 2029 年增至 6.9 亿元。

图：中国半导体 WLR 测试设备市场规模（亿元）



数据来源：Frost&Sullivan。

3、行业技术水平及特点

（1）电子测量仪器

1) 产品技术含量高，产品对新技术融合快

电子测量仪器属于技术密集型行业，其发展是多学科、多领域共同进步的成果。电子测量仪器以电子技术为基础，融合电子测量、射频微波设计、数字信号处理、微电子、计算机、通信等多领域技术，产品技术含量高。随着人工智能、精密制造等新兴技术的快速发展，相关新技术快速融入测量仪器产品，数字测试、电气测试、半导体测试等电子测量仪器性能不断提升，传统仪器形态和测量模式也在变化。

2) 国内起步较晚，相较海外龙头存在技术差距

早在 1946 年，泰克创始人发明了世界上第一款触发示波器，而中国电子测量仪器市场于 21 世纪初方才步入虚拟仪器阶段。近年来，我国电子测量仪器的产业化水平已取得较大进步，根据 Frost&Sullivan 数据，国产品牌市场份额由 2020 年 8.4% 上升至 2024 年的 16.8%，但总体水平仍落后于海外先进水平，国内企业普遍技术积累时间尚短，在品牌知名度、产品线丰富程度、行业整体解决方案的能力及业务规模等方面与是德科技等行业龙头存在较大差距。

（2）半导体测试设备

我国半导体行业整体起步时间较晚，产业链整体存在较大的进步空间，半导体第三次产业转移以来，我国半导体制造产业蓬勃发展，在多因素共同作用下，国产半导体测试设备供应商销售规模快速增长，行业整体技术水平显著提升，多种类型产品已在业界

领先的半导体产线成功实现产业化应用；但在存储芯片测试、SoC 芯片测试等细分市场，仍被 Advantest、Teradyne 等海外龙头主导竞争格局，我国相关企业的技术实力与国际领先水准存在一定差距。

4、所属行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性

（1）电子测量仪器

图：电子测量仪器行业产业链



1) 上游行业与本行业的关联

电子测量仪器行业的上游行业主要为电子元器件行业，包括 IC 芯片、PCBA、线缆、电容、电阻、电感等。电子测量仪器对信号处理的速度和精度具有较高的要求，随着电子测量仪器行业数字化、智能化推进，对产业链上游的电子元器件提出更高的性能要求。上游电子元器件性能的发展以及各国对电子元器件的贸易政策可能会对电子测量仪器行业发展产生影响。

2) 下游行业与本行业的关联

电子测量仪器行业作为国家基础性、战略性行业，该领域的技术设备已深度融入包括通信、半导体、消费电子、汽车、教育科研等重要国民经济领域，为下游行业的研发和生产环节优化工艺流程、保障产品质量起到关键作用，而下游行业的资本开支与技术更新迭代情况也直接影响电子测量仪器行业的发展。

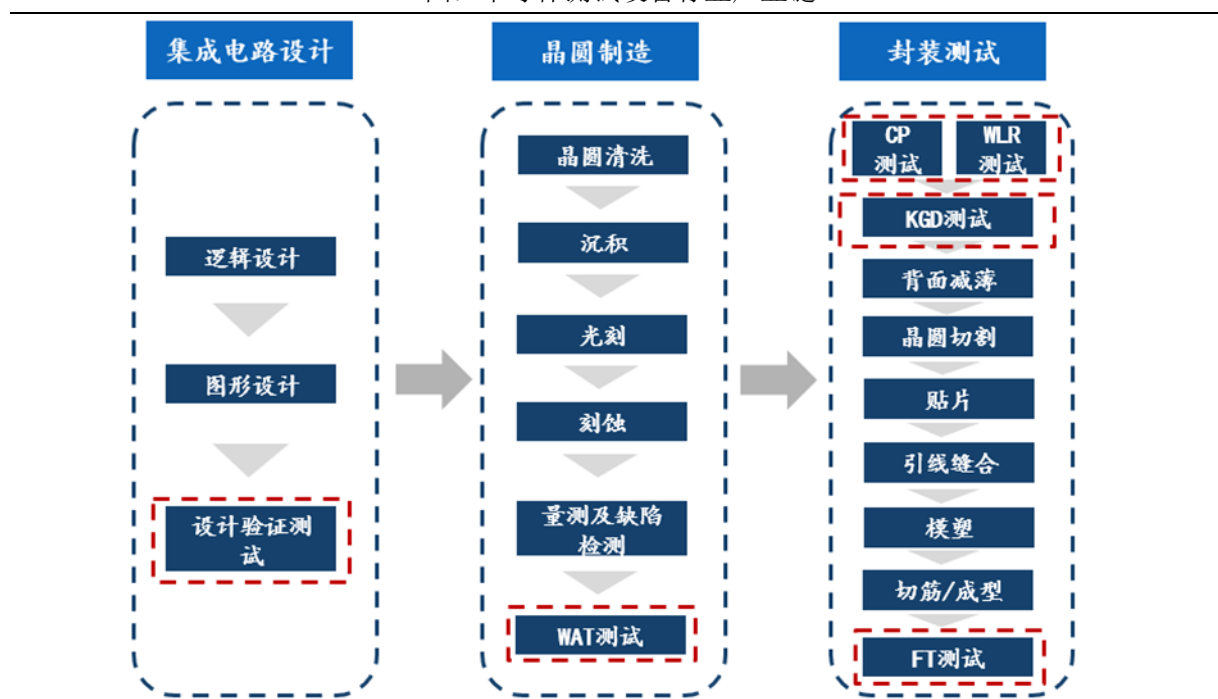
在通信领域，相关测试仪器支撑 5G 标准制定与产品研发量产，并助力 6G 前瞻性研究，同时为数据中心等数字基础设施建设提供技术保障。在半导体制造环节，从晶圆

加工到封装测试的全流程都需借助电子测量仪器完成参数检测，确保器件良率并有效筛选缺陷产品。在消费电子领域，微型化可穿戴设备的普及催生了更严苛的产品性能标准，推动了对高端测试仪器技术创新需求。在汽车工业领域，新能源技术革命与智能驾驶的发展促使电池系统、充电设施及车载电子等环节的测量需求激增，拓宽了电子测量仪器的应用维度。在教育与科研领域，作为理工科教学与科研的基础设备，电子测量仪器伴随高等教育投入的持续增长迎来更广阔的市场空间。

（2）半导体测试设备

半导体测试是监测与优化半导体制造的工艺，以提高半导体器件良品率为目的，贯穿于半导体器件从设计到制造的全过程。

图：半导体测试设备行业产业链



在集成电路设计环节，测试机、分选机、探针台等半导体测试设备用于对晶圆样品进行验证测试，从而保证样品符合设计要求。

在晶圆制造环节中，测试机、探针台用于晶圆的电性参数及功能测试。其中，探针台将晶圆传送到指定测试位置后，测试机对芯片施加输入信号，通过对比输出信号与预期值来判断芯片是否符合要求。

在封装测试环节中，首先需要对芯片进行 CP 测试、WLR 测试以及 KGD 测试等，通过测试的芯片则可进入封装流程。在封装环节结束后，测试机和分选机对成品进行

FT 测试。分选机将封装后的芯片传送到指定位置后，测试机对其施加输入信号，通过对比输出信号与预期值来判断芯片是否符合要求，并由分选机对不符合要求的芯片进行标记和筛除。

5、行业进入壁垒

（1）技术壁垒

电子测量仪器行业与半导体测试设备行业属于技术密集和知识密集的高科技行业，涵盖多门学科的技术，包括电子信息工程、机械自动化、材料科学、软件工程等领域，用户对于测试设备的可靠性与稳定性有较高的要求。龙头企业普遍在业内耕耘多年，已积累了一定的技术实力以及市场经验，而新进入者难以在短期内完成技术积累以及产品线的搭建，因此其在前期无法与已具备技术优势的企业抗衡，往往需要经历较长时间的技术积累与摸索。此外，由于业内相关技术及产品更新迭代速度极快，新进入者还需要具备强大的持续研发及创新能力，以适应不断变化的市场需求。

（2）资金投入和生产规模壁垒

电子测量仪器行业与半导体测试设备行业属于重资金投入的行业，为保持技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力，本行业需要投入大量资金以进行人才团队的建设、技术的研发、产线的拓展、设备的更新等。尤其是电子测量仪器产品类别众多，参数性能不尽相同，下游客户对配套专用仪器设备的技术和性能要求也会有所不同。同时，要获得大型优质客户的订单必须经过严格的认证，成为合格供应商，而认证的先决条件也要求具有一定的生产规模。因此，以上各类支出也将在企业经营过程中持续投入，持续性的高额资金投入成为其他企业进入该行业的壁垒之一。

（3）人才壁垒

电子测量仪器行业与半导体测试设备行业同样也是人才密集型行业。在以技术水平为主要驱动的行业，优质的人才团队往往是企业实现可持续发展的有力保障。本行业从研发到生产都需要一定的专业技能，而这些专业技能的培养需要较长的时间，需要积累丰富的实践经验，但目前该行业中具备丰富的测试产品应用开发经验和市场经验的人才在业内尚属于稀缺资源。优质的技术、管理和销售人才通常集中于行业领先企业，其中人才的争夺非常激烈，而相关人才的培养需要企业投入大量时间与资金。随着技术不

断更新迭代，企业对于高端人才的需求只会越来越大，因此，人才的聚集和储备是新进入企业的重要壁垒。

（4）客户认证壁垒

在电子测量仪器行业与半导体测试设备行业，客户数量和客户质量对企业的长期发展具有较大影响，下游客户特别是国际知名企业认证的周期较长，设备替换意愿度低，行业头部企业拥有显著的客户资源壁垒。该行业客户资源的积累以及客户关系的建立往往需要较长时间，部分国际大型客户的认证审核周期可能长达 1-2 年，下游客户一旦选定则不会轻易更改。因此，客户认证难度将对新进入企业的前期发展造成较大的不利影响。

6、行业发展面临的机遇和挑战

（1）面临的机遇

1) 国家政策支持

电子测量仪器与半导体测试设备是基础性和战略性新兴产业，其发展水平已成为一个国家科技水平、综合国力和国际竞争力的标志。仪器的自主研发在创新型国家得到重视，欧美日等国家和地区都把“发展一流的科学仪器”作为国家战略，对科学仪器的装备和创新给予重点扶持。

近年来，我国同样不断推出关于高端测量仪器的利好政策，2021 年 3 月，十三届全国人大四次会议授权发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，指出：“依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破；加强高端科研仪器设备研发制造”。

国家支持将推动电子测量仪器行业的迅速发展。

2) 下游应用行业景气度上升推动行业需求持续稳定增长

电子测量仪器是基础类设备，广泛应用于国民经济的各个领域。随着下游主要应用领域如光通信、新能源、智能网联汽车、消费电子等产业的持续发展，电子测量仪器的需求也将持续增长。

（2）面临的挑战

1) 行业发展基础相对薄弱

电子测量仪器行业和半导体测试设备行业具有投资周期长、研发投入大等特点，属于典型的资本密集型和技术密集型行业。从全球范围来看，电子测量仪器长期被以 Keysight、Tektronix、Anritsu 等海外龙头主导，半导体测试设备市场长期被 Advantest、Teradyne 等国际巨头占据主要份额，且其在经营规模、技术认知、运营时间、客户资源等方面都存在较大的先发优势，国产厂商在规模、产品线覆盖、研发投入、技术先进度等方面存在一定差距，在竞争过程中面临较大的压力和挑战。

近年来，国家对电子测量仪器行业与半导体行业给予鼓励和支持，但受制于技术密集型产业特性与产业基础建设规律，技术演进存在非线性特征。对比国外先进厂商，我国相关行业发展历程相对较短，人才和技术水平难以满足产业需求，这是造成研发及制造技术相对薄弱的主要原因之一。未来，随着国家政策的支持、产业的不断发展，我国电子测量仪器行业与半导体产业在人才、产品等方面逐步积累，将能与国外一流设备厂商形成有力竞争。

2) 各国贸易政策变化带来的影响

近年来全球化进程遭遇逆流，技术壁垒升高与贸易保护主义抬头构成的复合挑战，对电子测量仪器行业和半导体测试行业的全球化布局形成多维冲击。中美贸易摩擦中，海外对华高端技术出口限制及加征关税措施，对产业升级构成直接冲击；与此同时，我国加速推进高端测量仪器自主化战略，对全球电子测量仪器产业链的原有生态产生了显著影响。

7、行业周期性特征

电子测量仪器主要应用于电子信息及关联行业的生产与研发过程，下游应用领域众多，如光通信、半导体、消费电子、汽车工业等。电子信息行业存在着明显的升级周期，电子测量仪器行业周期与电子行业发展周期具有相关性。

半导体专用设备制造属于半导体产业链上游。长期看，作为国民经济支柱产业的半导体行业在国家战略竞争格局中地位日益凸显，国家层面持续加大政策扶持与资源投入力度，推动行业整体步入长周期上升通道。短期来看，半导体设备制造业与下游半导体制造及终端消费电子等领域景气度高度关联，存在一定的周期性。

（四）发行人所处行业竞争格局及主要企业

1、行业内主要企业

公司电子测量仪器包括通信测试仪器和电性能测试仪器，通信测试仪器主要面向光通信测试，包括采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪等核心测试仪器；电性能测试仪器主要包括精密源表和低漏电开关矩阵，广泛应用于通信和半导体等领域的高精度电学测试。公司半导体测试设备包括主要面向光通信测试的光电子器件测试设备（CoC 光芯片老化测试系统、光芯片 KGD 分选测试系统、硅光晶圆测试系统等），主要面向功率器件测试的功率器件测试设备（晶圆级老化系统、功率芯片 KGD 分选测试系统等），以及主要面向半导体集成电路测试的电性能测试设备（WAT 测试机和晶圆级可靠性测试系统）。

与公司从事同类业务的同行业公司包括 Keysight、Tektronix、Anritsu、EXFO、HighFinesse、NI、Advantest、Teradyne、致茂电子、Alphax、圣昊光电、镭神技术、FormFactor、旺矽科技、SPEA、Pentamaster、Aehr、QualiTau、广立微，公司产品线、主要产品与同类业务竞争对手的对应关系详见下表：

类别	产品线	主要产品	国内外主要竞争对手
电子测量仪器	通信测试仪器	采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪等	Keysight (KEYS.N)、Tektronix、Anritsu (6754.T)、EXFO (EXFO.O, 已退市)、HighFinesse
	电性能测试仪器	精密源表、低漏电开关矩阵	Tektronix、NI (NATI.O, 已退市)、Keysight (KEYS.N)
半导体测试设备	光电子器件测试设备	CoC 光芯片老化与测试系统、光芯片 KGD 分选测试系统、硅光晶圆测试系统等	致茂电子 (2360.TW)、Alphax、圣昊光电、镭神技术、FormFactor (FORM.O)、旺矽科技 (6223.TWO)
	功率器件测试设备	晶圆级老化系统、功率芯片 KGD 分选测试系统等	SPEA、Pentamaster (1665.HK, 已退市)、Aehr (AEHR.O)
	电性能测试设备	WAT 测试机和晶圆级可靠性测试设备	Keysight (KEYS.N)、QualiTau (QLTU.TA)、广立微 (301095.SZ)

注：Advantest (6857.T)、Teradyne (TER.O) 系半导体测试设备行业公司，处于行业领先地位，其主要产品与发行人细分领域存在一定差异，故未在上表中体现。

上述竞争对手中，Keysight (KEYS.N)、Anritsu (6754.T)、致茂电子 (2360.TW)、Advantest (6857.T)、Teradyne (TER.O)、FormFactor (FORM.O)、旺矽科技 (6223.TWO)、Aehr (AEHR.O)、QualiTau (QLTU.TA) 系中国境外上市公司，EXFO、NI、Pentamaster

目前已退市，仅广立微（301095.SZ）系 A 股上市公司，其余竞争对手均非上市公司。考虑到境外上市公司会计处理差异、未上市公司的公开信息有限等，为更好地向投资者展现公司的财务状况、盈利能力，因此在 A 股中选取普源精电（688337.SH）、鼎阳科技（688112.SH）另外作为电子测量仪器同行业可比公司；选取长川科技（300604.SZ）、华峰测控（688200.SH）、联动科技（301369.SZ）另外作为半导体测试设备同行业可比公司。上述企业的情况详见下表：

公司简称	股票代码	基本情况	主要产品
电子测量仪器行业			
Keysight	KEYS.N	起源于 1939 年成立的美国惠普公司，1999 年惠普公司重组成为安捷伦科技和惠普，2014 年再次拆分成为 Keysight 并在纽约证券交易所上市。Keysight 是全球领先的测量仪器公司，该公司提供电子测量仪器、系统以及相关软件工具和用于设计、开发、安装以及操作电子设备的相关服务，目前公司在美国、欧洲和亚太地区均设有工厂和研发中心	主要产品包括示波器和分析仪、万用表、发生器、信号源与电源、无线网络仿真器、模块化仪器和网络测试仪器等
Tektronix	未上市	成立于 1946 年，总部位于美国比弗顿，2016 年并入福迪威集团并成为该集团测试测量业务板块的重要组成部分。Tektronix 是一家全球领先的测试、测量和监测解决方案提供商。公司除了销售电子测量仪器还衍生出了其他产品线和服务的收入，包括校准和维修服务，视频测试设备，以及电源类产品。目前 Tektronix 在全球 21 个国家和地区设有办事处	主要产品有示波器、任意波形发生器、电源、逻辑分析仪、频谱分析仪和误码率分析仪等
Anritsu	6754.T	成立于 1895 年，是一家超过 110 年历史的创新电子测量解决方案的全球供应商，提供现有及下一代有线和无线通信系统和运营商的解决方案。1990 年与美国微冲公司的合并，成功实现了从低频、射频、到微波，从光通信到移动通信的多领域发展；公司总部在日本，在美国、日本、法国、英国、丹麦等国家设立有研发中心和生产基地，销售遍布全球	用于数字通信和互联网协议(IP)网络，光通信和移动通信的测量设备，射频(RF)，微波频段和毫米波段的通用测量设备
EXFO	未上市	1985 年成立，总部位于加拿大魁北克，是致力于光纤测试、测量、监测和自动化解决方案研制和开发的国际知名公司；其凭借设计和制造先进的创新型测试和测量解决方案，居于全球光通信领域前列。EXFO 于 2020 年收购光创科技，拥有了光收发器、器件和网络设备制造商提供采样示波器、误码率测试仪等产品能力	产品覆盖光纤网络、无线（5G/4G）、云和 IP 网络等领域，包括光纤检测探头、采样示波器、误码率测试仪等

公司简称	股票代码	基本情况	主要产品
HighFinesse	未上市	成立于 2000 年 7 月，总部位于德国，是全球第一家使用斐索干涉仪技术的波长计厂商，致力于为科学应用和工业研发提供创新的激光系统、精密电子设备和高精度光学测量设备	主要包括波长计、光谱仪等
NI	未上市	成立于 1976 年，总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀市，是全球领先的测量仪器公司，是移动和无线通信领域的市场领先供应商，提供全面的测试与测量仪器和系统。该公司在近 50 多个国家中设有分支机构，产品主要应用领域包括电子、机械、通信、汽车制造、生物、医药、化工、科研、教育等多个行业领域。该公司提供的模块化硬件、软件服务和系统	主要包括 PXI/PXIe 模块化仪器系统等
普源精电	688337.SH	成立于 1998 年，总部位于苏州，在美国、德国、日本和中国台湾等地设有分支机构。其产品主要包括数字示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、万用表及数据采集器等通用电子测量仪器产品，下游客户包括光通信与光模块测试、新能源汽车与储能、SiC/GaN 功率器件、半导体 ATE 测试等领域行业客户	主要包括数字示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、万用表及数据采集器等通用电子测量仪器产品
鼎阳科技	688112.SH	成立于 2007 年，总部位于深圳市，公司产品主要销售区域为北美、欧洲和亚洲等地区。其主要产品包括数字示波器、频谱分析仪、信号发生器、矢量网络分析仪等通用电子测试测量行业四大主力产品，以及可编程直流电源/源表、数字万用表和电子负载	主要产品包括数字示波器、频谱分析仪、信号发生器、矢量网络分析仪等通用电子测试测量行业四大主力产品，以及可编程直流电源/源表、数字万用表和电子负载
半导体测试设备行业			
Advantest	6857.T	存储器测试龙头企业，总部位于日本东京，于 1954 年创立，提供半导体和组件测试系统，机电一体化系统，服务，支持和其他产品。该公司向工业，设计和制造公司，晶圆厂半导体公司，铸造厂和测试厂提供其产品	主要包括存储器测试机、数字测试机、混合信号测试机等

公司简称	股票代码	基本情况	主要产品
Teradyne	TER.O	目前是全球最大的半导体测试设备公司，总部位于美国马萨诸塞州，于 1960 年成立。Teradyne 能够提供模拟、混合信号、存储器及超大规模集成电路测试设备的厂商，下游客户遍布整个半导体产业链	主要产品包含半导体测试系统、国防/航空存储测试系统、无线测试系统以及协作机器人业务，其中半导体测试系统涵盖逻辑、射频、模拟、电源管理、混合信号和存储设备等多个方向
致茂电子	2360.TW	成立于 1984 年，总部位于中国台湾，中国台湾证券交易所上市公司。以自有品牌“Chroma”成为全球电子量测仪器及系统的领导品牌供应商，提供量测仪器、自动化测试设备及制造资讯管理系统的 Turnkey 整合解决方案。凭借着 30 多年来在量测仪器的经验，持续在新能源相关产业提出测试方案，包括电动汽车、太阳能及微网储能等，尤其在电动车关键零部件的检测，陆续提供了车载充电器、DC/DC 变换器及整车控制器等测试方案，已获得国内外车厂及知名检验实验室采用	提供量测仪器、自动化测试设备及制造资讯管理系统的 Turnkey 整合解决方案
Alphax	未上市	成立于 1979 年，总部位于日本。该公司主要提供雷射二极管（LD）批量生产用检查设备与 LED 批量生产用检查及照明设备等产品	LD 检查装置、LED 检查装置等
圣昊光电	未上市	河北圣昊光电科技有限公司位于石家庄市，成立于 2017 年，专业致力于光通信芯片生产及关键设备研发制造	主要业务包括：光通信芯片测试设备、划片设备、裂片设备的研发制造；激光器、探测器、双抛片的分割、外观检测、电性能测试等芯片加工服务
镭神技术	未上市	镭神技术（深圳）有限公司成立于 2017 年，是一家致力于向光通讯、工业激光、芯片制造等行业提供专业的生产加工、组装、测试技术成套解决方案及定制化设备的企业	包括测试老化类、光路组装类、半导体封装类、芯片测试类等
FormFactor	FORM.O	FormFactor 成立于 1993 年，是一家领先的测试和测量技术提供商，覆盖整个半导体产品生命周期，从特性分析、建模、可靠性和设计调试到资格认证和生产测试，主要客户为英特尔、海力士、台积电以及三星等。总部位于美国，在德国、意大利、中国台湾、韩国、新加坡、日本等国家或地区设有分支机构	探针卡、探针台、工程探针以及计量设备等

公司简称	股票代码	基本情况	主要产品
旺矽科技	6223.TWO	旺矽科技股份有限公司成立于 1995 年，总部位于中国台湾，是一家专注于半导体测试与精密探针技术的全球领先企业，业务覆盖半导体制造、光电、微机电（MEMS）等领域	包括晶圆探针卡、光电半导体自动化设备（包括晶圆测试与分选设备、光电半导体晶圆与元件之测试、分选与光学检查设备等）
SPEA	未上市	成立于 1976 年，总部位于意大利，是半导体测试设备供应商，产品广泛应用于汽车、服务器控件、工业、医疗、国防等领域	ATE 制造商，涵盖从半导体晶片测试到封装微芯片和微机电系统传感器测试，从组装 PCB 的电路和飞针测试到最终的功能测试
Pentamaster	未上市	成立于 2017 年，是一家自动化制造和技术解决方案提供商，提供集成和定制解决方案。该公司的解决方案包括半导体和微机电系统(MEMS)传感器、光学和光子传感器、工厂自动化传感器以及医疗行业解决方案。该公司经营两个部门：自动化测试设备和工厂自动化解决方案	包括半导体和微机电系统(MEMS)传感器、光学和光子传感器、工厂自动化传感器和医疗行业解决方案
Aehr	AEHR.O	成立于 1977 年，总部位于美国，提供用于各种测试和可靠性筛选（老化）应用的交钥匙解决方案，适用于电动汽车和电动汽车充电基础设施、汽车应用、移动设备、计算、固态存储器、网络和数据存储以及包括 5G 基础设施在内的半导体可靠性测试	为晶圆级、单独的芯片和封装部件形式的半导体设备提供测试、烧录和稳定性测试的解决方案
QualiTau	QLTU.TA	成立于 1991 年，自成功推出第一套系统以来已成为半导体行业可靠性测试设备的领先供应商，提供全面的交钥匙解决方案，满足半导体行业质量、可靠性和技术开发团队当前和未来的需求	产品主要应用于集成电路（IC）、功率器件、先进封装等领域的失效分析与质量评估
广立微	301095.SZ	成立于 2003 年，是一家专为半导体业界提供芯片成品率提升和电性测试方案的领先供应商，向客户提供基于测试芯片的软、硬件系统产品以及整体解决方案。利用高效测试芯片自动设计、高速电学测试和智能数据分析的全流程平台与技术方法，为集成电路制造与设计企业实现芯片性能、成品率、稳定性的提升并加快产品上市速度	提供 EDA 软件、电路 IP、WAT 测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案
长川科技	300604.SZ	成立于 2008 年，总部位于中国杭州市，主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，是一家致力于提升我国集成电路专用测试技术水平、积极推动集成电路装备业升级的国家高新技术企业和软件企业	主要产品包括测试机、分选机及自动化生产线

公司简称	股票代码	基本情况	主要产品
华峰测控	688200.SH	成立于 1993 年，主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售，产品主要用于模拟及混合信号类集成电路的测试，产品销售区域覆盖中国大陆、中国台湾、美国、欧洲、日本、韩国等全球半导体产业发达的国家和地区。自成立以来，公司始终专注于半导体自动化测试系统领域	向集成电路设计、IDM、晶圆制造、封装测试等领域客户提供半导体自动化测试系统及配件
联动科技	301369.SZ	成立于 1998 年，是一家专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备研发、生产和销售的高新技术企业，其业务涉及封装设备、测试设备和智能制造三大板块	主要包括数模混合测试设备、分立器件测试设备、视像检测系统及其他分选系统等

注：上述股票代码系截至本招股说明书签署日仍在上市状态企业的股票代码，下同。

2、行业竞争格局

（1）电子测量仪器行业竞争格局

1）通信测试仪器

公司通信测试仪器主要面向光通信测试，为光模块等光通信网络基础设施提供完整的测试解决方案。国内光通信测试仪器厂商的技术水平在过去几年间经历了快速发展，采样示波器等测试仪器的带宽等各项参数逐渐向国外产品靠拢，国产品牌市场份额持续提升。

根据 Frost&Sullivan 数据，Keysight、Anritsu 等为代表的海外企业占据了 2024 年中国光通信测试仪器市场约 84%的份额，行业集中度较高，本土企业市场份额占比约 16%。公司作为国内头部企业，贡献了中国光通信测试仪器市场 9.9%的市场份额，位列市场第三，也是前五中唯一的本土企业。

排名	公司简称	2024 年市场份额
1	Keysight	30.8%
2	Anritsu	22.5%
3	联讯仪器	9.9%
4	Tektronix	8.2%
5	EXFO	4.8%

数据来源：Frost&Sullivan。

2）电气及环境测试仪器

电气及环境测试仪器领域，公司主要产品为精密源表和低漏电开关矩阵。根据 Frost&Sullivan 数据，2024 年中国精密源表市场规模为 19.2 亿元，大部分市场份额被 Tektronix、NI、Keysight 等海外企业占据，三者合计占据 80%以上的市场份额；公司在国内市场位列本土企业第一。

（2）半导体测试设备行业竞争格局

公司半导体测试设备包括主要面向光通信测试的光电子器件测试设备（CoC 光芯片老化测试系统、光芯片 KGD 分选测试系统、硅光晶圆测试系统等）、主要面向功率器件的功率器件测试设备（晶圆级老化系统、功率芯片 KGD 分选测试系统等）以及主要面向半导体集成电路的电性能测试设备（WAT 测试机、晶圆级可靠性测试系统等）。

1）光电子器件测试设备

光电子器件测试设备领域，公司产品全面覆盖封装级光芯片、裸 Die 级光芯片、晶圆级硅光芯片等光通信产业链上游核心环节测试需求，且主要聚焦在硅光晶圆、芯片（裸 Die/CoC）等产业链上游更前端工序。根据 Frost&Sullivan 数据，2024 年中国光电子器件测试设备市场规模为 21.0 亿元，公司贡献 5.2%的市场份额，位列国内市场第一。

2）功率器件测试设备

在碳化硅功率器件测试设备领域，公司产品主要面向技术壁垒更高且价值量更大的晶圆级老化测试（WLBI）和裸 Die 分选测试（KGD）需求。根据 Frost&Sullivan 数据，2024 年中国碳化硅功率器件测试设备市场规模达 7.4 亿元，公司贡献 21.7%的市场份额，位列国内市场第一；2024 年中国碳化硅功率器件晶圆级老化系统市场规模为 3.6 亿元（2024-2029 年预计将以 33%的 CAGR 增长，2029 年有望达 15.0 亿元），公司贡献 43.6%的市场份额，位列国内市场第一；2023-2024 年中国碳化硅功率芯片 KGD 分选测试系统累计市场规模为 2.2 亿元（2024-2029 年预计将以 42%的 CAGR 增长，2029 年有望达 6.9 亿元），SPEA、Pentamaster 等海外企业占据多数份额，公司贡献 12.1%的市场份额，位列国内市场第三、本土企业第一。

3）电性能测试设备

根据 Frost&Sullivan 数据，2024 年中国 WAT 测试机和晶圆级可靠性测试系统的市场份额大部分被 Keysight、QualiTau 等海外企业所占据；随着公司电性能测试设备产品持续市场拓展，公司的市场份额有望持续提升。

3、公司与行业主要企业的比较情况

（1）经营情况

最新披露财年，公司与同行业公司的经营情况对比如下：

公司简称	股票代码	财年截止日	单位	营业收入	净利润	研发投入	研发投入占营业收入的比重
电子测量仪器行业							
Keysight	KEYS.N	2025-10-31	亿美元	53.75	8.50	10.07	18.73%
Tektronix	未上市	/	/	/	/	/	/
Anritsu	6754.T	2025-3-31	亿日元	1,129.79	92.57	92.49	8.19%
EXFO	未上市	/	/	/	/	/	/
HighFinesse	未上市	/	/	/	/	/	/
NI	未上市	/	/	/	/	/	/
普源精电	688337.SH	2024-12-31	亿元	7.76	0.92	2.07	26.64%
鼎阳科技	688112.SH	2024-12-31	亿元	4.97	1.12	1.08	21.81%
半导体测试设备行业							
Advantest	6857.T	2025-3-31	亿日元	7,797.07	1,611.77	未披露	未披露
Teradyne	TER.O	2024-12-31	亿美元	28.20	5.42	4.61	16.35%
致茂电子	2360.TW	2024-12-31	亿新台币	216.04	52.64	21.99	10.18%
Alphax	未上市	/	/	/	/	/	/
圣昊光电	未上市	/	/	/	/	/	/
镭神技术	未上市	/	/	/	/	/	/
FormFactor	FORM.O	2024-12-28	亿美元	7.64	0.70	1.22	15.97%
旺矽科技	6223.TWO	2024-12-31	亿新台币	103.23	23.01	10.89	10.55%
SPEA	未上市	/	/	/	/	/	/
Pentamaster	未上市	2024-12-31	亿马来西亚林吉特	6.22	1.07	未披露	未披露
Aehr	AEHR.O	2024-5-31	亿美元	0.66	0.33	0.09	13.64%
QualiTau	QLTU.TA	2024-12-31	亿美元	0.46	0.14	0.05	10.87%
广立微	301095.SZ	2024-12-31	亿元	5.47	0.84	2.77	50.57%

公司简称	股票代码	财年截止日	单位	营业收入	净利润	研发投入	研发投入占营业收入的比重
长川科技	300604.SZ	2024-12-31	亿元	36.42	4.67	10.25	28.14%
华峰测控	688200.SH	2024-12-31	亿元	9.05	3.34	1.72	19.04%
联动科技	301369.SZ	2024-12-31	亿元	3.11	0.18	1.18	37.77%
发行人		2024-12-31	亿元	7.89	1.41	1.91	24.27%

数据来源：各公司年度报告。

（2）市场地位

公司与同行业公司市场地位的对比情况详见本节“二、发行人所处行业的基本情况”之“（四）发行人所处行业竞争格局及主要企业”之“2、行业竞争格局”。

（3）技术实力

1）电子测量仪器

公司电子测量仪器主要产品的核心指标与行业最高水平的对比情况如下：

产品	核心指标	指标含义	公司最高水平		行业最高水平	
			型号	指标	型号	指标
采样示波器	通道带宽	测试的光信号频率范围，数值越高，性能越高	DCA1065	65GHz	Keysight, N1032	120GHz
时钟恢复单元	最高恢复速率	可恢复的输入信号最高波特率，数值越高，性能越高	CR3302	120GBaud	Keysight, N1093B	120GBaud
误码分析仪	单通道最高传输速率	单通道能够支持的最高波特率，数值越高，性能越高	PBT3058	113.44GBaud	Keysight, M8050A	120GBaud
突发误码分析仪	单通道最高突发速率	单通道能够支持的最高波特率，数值越高，性能越高	rBT3250	51.56GBaud	Anritsu, MP1900A	64GBaud
快速波长计	波长测量精度	光波长测量结果与实际波长值之间的最大偏差，数值越低，性能越高	FWM8612	0.5pm	HighFinesse, WS8-10	8MHz（≈0.064pm）
精密源表	最小电流分辨率	最小量程下可识别的最小电流变化量，数值越低，性能越高	S2017C	0.1fA	Tektronix, 6430	10aA
	最小电压分辨率	最小量程下可识别的最小电压变化量，数值越低，性能越高	S2017C	100nV	Tektronix, 2450	10nV

产品	核心指标	指标含义	公司最高水平		行业最高水平	
			型号	指标	型号	指标
低漏电开关矩阵	失调电流	两个差分输入端偏置电流的误差，数值越低，性能越高	RM1010-LLC	100fA	Keysight, B2200A	10fA

资料来源：相关公司官网、产品手册。

如上所示，公司电子测量仪器主要产品所对比的行业最高水平厂商均为国际厂商，公司多数产品打破国际垄断，是目前极少数具备供货能力的本土企业，主要产品的技术水平与行业最高水平的差距持续缩小，部分产品核心指标已达到行业领先水平。

2) 半导体测试设备

公司半导体测试设备主要产品的核心指标与行业领先水平的对比情况如下：

产品	核心指标	指标含义	公司最高水平		行业领先水平	
			型号	指标	型号	指标
光芯片 KGD 分选测试系统	UPH	单位小时测试的裸芯片数量，数值越高，性能越高	CT8302	655	Alphax, LD2900 系列	无公开信息
	电流脉冲宽度	电流脉冲信号从其上升沿开始到下降沿结束的时间间隔，数值越低，性能越高	CT8302	1 μ s	Alphax, LD2900 系列	无公开信息
	AOI 检测功能	基于机器视觉与 AI 技术的光学检测能力，实现对 DUT 外观缺陷的识别	CT8302	支持	Alphax, LD2900 系列	无公开信息
CoC 光芯片老化系统	系统并行测试数量	整个系统可同时测试 DUT 的最大数量，数值越高，性能越高	BI6203	4,224	镭神技术，EML/DML CoC 老化机	5,120
					致茂电子，58604-HD	2,688
	温度一致性	DUT 的温度一致性，数值越低，性能越高	BI6203	$\pm 2^{\circ}\text{C}$	镭神技术，EML/DML CoC 老化机	$\pm 2^{\circ}\text{C}$
					致茂电子，58604-HD	$\pm(1^{\circ}\text{C}+1.2\%\Delta T)$ ($\approx \pm 2^{\circ}\text{C}$)
硅光晶圆测试系统	光耦合重复性	多次耦合峰值结果的极差，数值越低，性能越高	sCT9002	<0.2dB	FormFactor, CM300xi-SiPh	<0.2dB
	光耦合速	达到全局最大值所	sCT9002	<1.5s	旺矽科技，TS3000 系列	无公开信息
					FormFactor, CM300xi-SiPh	<1s

产品	核心指标	指标含义	公司最高水平		行业领先水平	
			型号	指标	型号	指标
	度	需的时间，数值越低，性能越高			旺矽科技，TS3000 系列	<1s
晶圆级老化系统	单工位并行测试数量	单个老化单层可同时测试 DUT 的最大数量，数值越高，性能越高	WLBI3810	2,560	Aehr, Fox-XP	2,048
	工位数量	整个系统老化单层数量，数值越高，性能越高	WLBI370A	20	Aehr, Fox-XP	18
功率芯片 KGD 分选测试系统	UPH	单位小时测试的裸芯片数量，数值越高，性能越高	PB6800	>4,000	SPEA, KGD Test Cells	无公开信息
					Pentamaster, PM52X-KGD	无公开信息
	最大工位数量	系统最多支持的工位数量，数值越高，性能越高	PB6800	6	SPEA, KGD Test Cells	无公开信息
					Pentamaster, PM52X-KGD	4
WAT 测试机	并行测试数量	同步激励与测量的通道数量，数值越高，性能越高	WAT6600	48	广立微, T4100S	48
					Keysight, P9002A	100
	最小电流分辨率	最小量程下可识别的最小电流变化量，数值越低，性能越高	WAT6600	1fA	广立微, T4100S	10fA/0.1fA
					Keysight, P9002A	0.1fA
	最小电压分辨率	最小量程下可识别的最小电压变化量，数值越低，性能越高	WAT6600	100nV	广立微, T4100S	100nV
					Keysight, P9002A	2μV
晶圆级可靠性测试系统	系统并行测试数量	整个系统可同时测试 DUT 的最大数量，数值越高，性能越高	PLR0010	480	QualiTau, Infinity	384
	系统测试温度	系统可支持的最高测试温度，数值越高，性能越高	PLR0010	250°C	QualiTau, Infinity	350°C

注：与电子测量仪器相比，半导体测试设备应用场景更加多元，同一产品主要性能指标更多，较难准确定义行业最高水平竞品，公司基于对同行业可比公司及产品理解，以及信息可获取性，选择代表性竞品型号作为行业领先水平进行对比。

资料来源：相关公司官网、产品手册。

如上所示，公司半导体测试设备主要产品的核心指标整体处于行业领先水平或接近行业领先水平。

（五）发行人竞争优势与竞争劣势

1、主要竞争优势

（1）技术优势与平台化能力

公司以技术创新为根基，保持高强度研发投入，在光通信测试、功率器件测试与半导体集成电路测试等领域实现了关键技术的自主研发与突破，通过算法、软件、板卡、芯片与架构设计的深度融合不断突破技术上限并驱动研发成果的快速转化，多款主力产品的核心指标已达业内领先水平，成功打破国际垄断并填补国内相关领域空白。

公司在电子测量仪器和半导体测试设备领域深耕多年并取得了大量原创性的研究成果，建立了以高速信号处理、微弱信号处理、超精密运动控制为核心的具有高复用性的平台级核心技术体系，通过将底层技术与自主研发的软件、硬件及模块化设计架构相结合，组成可同时满足多方面需求的核心功能模块，并通过功能模块的累积，搭建起可高效响应新产品开发需求的技术平台，支持公司快速对产品线进行纵向升级和横向拓展。

（2）产品矩阵优势

自2017年成立以来，公司聚焦光模块测试需求相继推出了误码分析仪、采样示波器、时钟恢复单元等核心测试仪器，凭借在光模块测试领域的经验积累，公司逐步向上游的光电子器件测试领域拓展业务版图，推出CoC光芯片老化测试系统、光芯片KGD分选测试系统、硅光晶圆测试系统等光电子器件测试设备，逐步实现光通信产业链中模块、芯片、晶圆等核心环节测试需求的覆盖。公司依托于光电子器件测试领域的技术沉淀，针对功率器件在车规级应用场景下日益严苛的可靠性要求相继推出晶圆级老化系统、功率芯片KGD分选测试系统等测试设备，并在国内实现产业化应用的基础上成功实现品牌出海。

与此同时，公司高度重视核心部件的自研能力，重点攻关精密源表等电性能测试仪器的研发，成功实现精密源表在光通信领域的商业化应用，并重点围绕半导体测试需求，突破精密源表的指标上限并拓宽电性能测试产品线的覆盖面，相继实现WAT测试机、晶圆级可靠性测试设备等领域的产业化应用。

（3）客户优势

基于强大的产品与技术实力，公司深度服务全球高速通信和半导体等科技领域知名

用户。光通信测试领域，公司已覆盖集团一、中际旭创、新易盛、光迅科技、海信集团、华工正源、赛丽科技、Lumentum、Coherent、Broadcom、环球广电、日本住友、日本古河等国内外主流光通信产业链客户。功率器件测试领域，公司已覆盖比亚迪半导体、芯联集成、士兰微、三安光电、芯聚能、长飞先进、株洲中车、瞻芯电子、ONSEMI、Power Master 等国内外主流功率芯片厂商。半导体集成电路测试领域，公司代表性客户包括客户二、集团一、比亚迪半导体、燕东微、士兰微、X-FAB 等国内外知名企业。上述行业知名用户助力公司各行业领域前沿技术突破，引领公司创新发展。

（4）人才与管理优势

电子测量仪器行业和半导体测试设备行业属于技术密集型行业，行业“Know-How”往往由资深人员掌握，保持核心技术、管理和销售人员稳定的重要性不言而喻，对企业的持续发展至关重要。公司注重人员内部培养和外部人才引进，建立了一支拥有行业领先技术和专业能力、高度认同公司企业文化的核心管理和员工团队。公司核心技术团队稳定，截至 2025 年 9 月末公司研发人员 440 人，并规划持续充实优化研发团队。公司核心技术人员深耕行业多年，拥有扎实的专业能力和丰富的管理经验，能够准确把握行业和公司发展方向，并制定符合公司实际的发展战略，在公司技术研发的演进、市场开拓、企业文化的塑造和推动等方面起到了关键作用。

（5）品牌优势

公司已建立起了健全且优质的研发、采购、生产、销售体系，并持续为客户提供优质的售前、售中及售后服务，成功在业内积累起了良好的口碑，有助于公司保持稳定的客户合作关系并开拓优质的下游客户。

自设立以来，公司已获得多项荣誉，塑造了良好的品牌形象，取得“国家级专精特新‘小巨人’企业”、“江苏省瞪羚企业”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省潜在独角兽企业”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省企业工程技术研究中心”、“苏州市‘独角兽’培育企业”等多项荣誉。

（6）全球化业务布局优势

公司依靠突出的产品性能、交付效率和技术服务优势，在全球业务布局上取得了突出成就。公司全球化战略以境外销售业务为重心，从技术支持、售后服务以及供应链各方面全方位实现出海，大幅提升响应速度与本地化支持能力。

公司于 2022 年进军日本市场，逐步实现产品出海并积累宝贵的在地化服务经验；2023 年以来，公司在东南亚地区相继设立新加坡办公室、马来西亚制造中心、泰国技术服务中心，在紧随国内头部客户出海步伐的同时，加快导入国际顶尖客户群体，努力提升本土化交付能力与服务水平；2025 年以来，在已经具备一定国际市场规模的基础上，公司于美国、韩国设立子公司，持续提升全球化交付能力。通过输出核心产品、技术与服务优势，公司全方位赋能境外市场，并聚焦国际顶级用户需求不断进行技术创新与产品优化。

2、主要竞争劣势

（1）公司规模及技术水平与国际领先企业存在一定差距

公司经过数年发展，已成为国内电子测量仪器行业和半导体测试设备行业的领先企业，但和国际领先企业相比，公司规模仍较小，产品线的丰富程度、技术水平存在一定差距，不利于公司参与国际竞争。

（2）融资渠道单一

公司早期主要通过自身积累和引进外部投资者获得了一定的发展资金，但总体而言融资渠道相对单一，为进一步缩小与国际厂商的差距，能否获取扩大经营规模所需的资金仍然是制约公司高速增长的重要因素。

三、发行人销售情况和主要客户

（一）报告期内主要产品的产销情况

公司产品主要包括电子测量仪器和半导体测试设备，其工艺流程主要包括组装、调试、测试等生产环节，不存在标准化的生产线。公司产品因性能指标、规格型号、装配工艺等因素的区别，生产所需工时与场地存在差异，各期产能无法量化，产能可随市场需求变化而灵活扩展。

报告期内，公司电子测量仪器和半导体测试设备的产量、出货量、销量以及出货率、产销率情况具体如下：

单位：台

主要产品	项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
电子测量仪器	产量	3,563	4,684	1,705	1,195
	出货量	3,111	3,699	1,539	954
	销量	3,033	3,344	1,455	957
	出货率	87.31%	78.97%	90.26%	79.83%
	产销率	85.12%	71.39%	85.34%	80.08%
半导体测试设备	产量	358	454	128	201
	出货量	353	446	139	197
	销量	359	273	91	197
	出货率	98.65%	98.30%	108.58%	97.92%
	产销率	100.08%	60.11%	71.32%	97.70%

注 1：出货率根据出货量除以产量计算，产销率根据销量除以产量计算；

注 2：电子测量仪器销量包括半导体测试设备配套部件的销量；

注 3：CoC 光芯片老化系统及晶圆级老化系统的数量按照单层折算。

报告期内，公司电子测量仪器的出货率及产销率变动趋势整体一致，其中 2024 年度的出货率及产销率有所下降，主要原因系公司为保障订单交付，期末备有一定库存；公司半导体测试设备的出货率保持较高水平，2022-2024 年度的产销率呈下降态势，主要原因系半导体测试设备产品出货后至验收完成存在一定周期，产量与确认收入的销量之间存在周期错配所致。

（二）报告期内主要产品的销售情况

1、公司产品的主要客户群体

公司电子测量仪器包括通信测试仪器和电性能测试仪器，通信测试仪器主要面向光通信测试；电性能测试仪器广泛应用于通信和半导体等领域的高精度电学测试。公司半导体测试设备包括主要面向光通信测试的光电子器件测试设备，主要面向功率器件测试的功率器件测试设备，以及主要面向半导体集成电路测试的电性能测试设备。

光通信测试领域，公司已覆盖集团一、中际旭创、新易盛、光迅科技、海信集团、华工正源、赛丽科技、Lumentum、Coherent、Broadcom、环球广电、日本住友、日本古河等国内外主流光通信产业链客户。功率器件测试领域，公司已覆盖比亚迪半导体、

芯联集成、士兰微、三安光电、芯聚能、长飞先进、株洲中车、瞻芯电子、ONSEMI、Power Master 等国内外主流功率芯片厂商。半导体集成电路测试领域，公司代表性客户包括客户二、集团一、比亚迪半导体、燕东微、士兰微、X-FAB 等国内外知名企业。上述行业知名用户助力公司各行业领域前沿技术突破，引领公司创新发展。

2、公司营业收入构成情况及主要产品销售单价变动分析

报告期内，公司营业收入的构成情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”之“1、营业收入构成情况”。

公司主营业务收入以采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪、CoC 光芯片老化系统、光芯片 KGD 分选测试系统、硅光晶圆测试系统、晶圆级老化系统、功率芯片 KGD 分选测试系统等细分产品为主，该等细分产品单价如下表所示：

单位：万元/台、万元/层

细分产品	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
采样示波器	28.00	24.84	18.94	11.56
时钟恢复单元	7.77	10.81	16.33	10.27
误码分析仪	6.86	7.14	6.83	8.04
CoC 光芯片老化系统	10.92	9.06	14.18	10.76
光芯片 KGD 分选测试系统	201.52	238.77	138.05	120.44
硅光晶圆测试系统	199.89	168.14	-	-
晶圆级老化系统	127.50	130.44	150.56	-
功率芯片 KGD 分选测试系统	348.91	408.05	358.36	-

上述细分产品单价变动分析详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”之“2、主营业务收入构成及变动分析”。

(三) 报告期内前五大客户情况

报告期内，公司向前五大客户的销售情况具体如下：

单位：万元

序号	客户名称	销售模式	销售金额	占销售总额比例	主要销售产品
2025 年 1-9 月					
1	集团一	直销	10,093.39	12.53%	通信测试仪器、光电子器件测试设备
2	中际旭创	直销	5,776.56	7.17%	通信测试仪器、光电子器件测试设备
3	新易盛	直销	5,077.54	6.30%	光电子器件测试设备
4	赛丽科技	直销	4,597.16	5.71%	光电子器件测试设备
5	Lumentum	直销	4,216.29	5.23%	通信测试仪器、光电子器件测试设备
合计			29,760.94	36.94%	/
2024 年度					
1	集团一	直销	13,342.41	16.92%	通信测试仪器、光电子器件测试设备
2	光迅科技	直销	5,969.32	7.57%	通信测试仪器、光电子器件测试设备
3	士兰微	直销	5,459.38	6.92%	功率器件测试设备
4	海信集团	直销	5,159.92	6.54%	通信测试仪器、光电子器件测试设备
5	中际旭创	直销	4,937.25	6.26%	通信测试仪器
合计			34,868.28	44.21%	/
2023 年度					
1	海信集团	直销	4,227.19	15.33%	通信测试仪器、光电子器件测试设备
2	中际旭创	直销	4,068.26	14.75%	通信测试仪器
3	集团一	直销	2,730.72	9.90%	通信测试仪器、功率器件测试设备
4	三安光电	直销	1,876.87	6.81%	功率器件测试设备、电性能测试设备
5	集团二	直销	1,662.10	6.03%	功率器件测试设备
合计			14,565.14	52.81%	/
2022 年度					
1	海信集团	直销	3,005.18	14.02%	光电子器件测试设备、通信测试仪器
2	光迅科技	直销	2,471.91	11.53%	光电子器件测试设备、通信测试仪器
3	Broadcom	直销	1,310.23	6.11%	光电子器件测试设备
4	讯速信远	经销	1,269.58	5.92%	通信测试仪器、光电子器件测试设备
5	三安光电	直销	1,084.04	5.06%	光电子器件测试设备、电性能测试设备
合计			9,140.96	42.64%	/

注：同一控制下主体的销售金额已合并披露。

报告期内，公司向前五大客户合计销售金额占当期销售总额的比例分别为 42.64%、52.81%、44.21%和 36.94%，不存在向单个客户销售比例超过公司当年销售总额 50%或严重依赖少数客户的情况。

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员与公司前五大客户不存在关联关系。

四、发行人采购情况和主要供应商

（一）报告期内主要原材料采购情况

报告期内，公司主要原材料包括电子元器件、标准件、电气类、外协组装、机加钣金件、仪器设备、夹治具等，各类别原材料的主要采购内容如下：

序号	类别	主要采购内容
1	电子元器件	IC、光电探测器、PCBA/PCB、继电器等
2	标准件	探针、弹簧针、滑台、位移台、运动模组等
3	电气类	射频线、电机、电机驱动器、电源等
4	外协组装	设备基础装配等
5	机加钣金件	单层、抽屉、机架、热沉等
6	仪器设备	探针台、测试机、光谱仪等
7	夹治具	夹具、夹具配件等
8	其他	光学模组、相机、镜头等

报告期内，公司原材料采购的构成情况如下：

单位：万元

类别	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子元器件	12,753.04	28.60%	15,868.05	34.60%	9,567.48	41.38%	5,870.48	40.71%
标准件	6,091.90	13.66%	5,378.62	11.73%	2,660.66	11.51%	1,356.23	9.40%
电气类	4,802.12	10.77%	5,077.42	11.07%	2,292.26	9.91%	1,333.49	9.25%
外协组装	5,563.54	12.48%	5,144.45	11.22%	2,020.40	8.74%	1,271.32	8.82%
机加钣金件	4,214.03	9.45%	4,538.01	9.89%	1,838.46	7.95%	1,054.08	7.31%
仪器设备	5,431.94	12.18%	3,551.22	7.74%	2,018.96	8.73%	1,214.50	8.42%
夹治具	1,706.24	3.83%	2,768.33	6.04%	776.18	3.36%	999.16	6.93%
其他	4,034.29	9.05%	3,536.02	7.71%	1,947.45	8.42%	1,321.33	9.16%

类别	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	44,597.09	100.00%	45,862.11	100.00%	23,121.85	100.00%	14,420.59	100.00%

报告期内，公司主要原材料采购规模均呈现快速增长态势，与公司经营规模变动保持一致，不同类别原材料的采购占比情况相对稳定，其中 2024 年度电子元器件采购占比较往期有所下降，主要系当期半导体测试设备的新增订单和生产计划大幅增长，带动外协组装、机加钣金件以及夹治具等物料需求增长，该等类别原材料的采购占比有所提升所致。

报告期内，公司产品线丰富，且产品性能复杂，涉及原材料种类繁多，不同规格型号的原材料数量高达上万种，并且不同规格型号的原材料之间存在差异，相应的采购价格亦存在较大差异。为准确体现公司主要原材料价格变动情况，选取主要原材料中部分代表性细分物料进行单价分析，具体情况如下表所示：

类别	细分物料名称	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
电子元器件	光电探测器	103.03	103.30	103.01	100.00
电子元器件	继电器	69.38	74.59	81.10	100.00
标准件	位移台	92.50	100.00	-	-
电气类	六轴控制器	92.12	100.00	-	-
外协组装	CoC 光芯片上下料系统基础装配	93.42	92.22	93.79	100.00
外协组装	CoC 光芯片测试系统基础装配	98.75	98.76	99.65	100.00
机加钣金件	机架	97.75	97.89	99.42	100.00
仪器设备	探针台	87.89	94.64	-	100.00
夹治具	夹具加工	93.93	93.93	94.98	100.00
其他	光学模组	97.27	91.58	94.35	100.00

注：假设 2022 年价格指数为 100，2023 年、2024 年、2025 年 1-9 月价格指数均以 2022 年采购价格为基数计算得出；对于 2022 年未发生采购的原材料，以首次发生采购所在期间的采购价格作为价格指数计算基数。

整体而言，随着采购规模扩大及合作关系深入，报告期内公司主要原材料采购价格呈现下降态势；其中光电探测器价格有所上涨，主要系汇率波动影响所致。

（二）报告期内主要能源采购情况

报告期内，公司采购的主要能源为电力，采购金额分别为 78.23 万元、145.01 万元、

357.22 万元和 561.73 万元，其供应充足、价格较为稳定。

（三）报告期内前五大供应商情况

报告期内，公司对前五大供应商的采购情况具体如下：

单位：万元

序号	供应商名称	供应商类别	采购金额	占采购总额比例	主要采购内容
2025 年 1-9 月					
1	苏州苏汀达自动化科技有限公司	生产商	3,483.53	7.81%	外协组装、机加钣金件
2	苏州康巨富自动化设备有限公司	生产商	2,908.67	6.52%	外协组装、机加钣金件
3	艾睿电子	贸易商	2,342.50	5.25%	电子元器件
4	苏州一诺兴精密机械有限公司	生产商	1,600.46	3.59%	机加钣金件
5	矽电股份	生产商	1,242.53	2.79%	仪器设备
合计			11,577.69	25.96%	/
2024 年度					
1	苏州苏汀达自动化科技有限公司	生产商	3,156.94	6.88%	外协组装、机加钣金件
2	PANGAEA	贸易商	2,778.71	6.06%	电子元器件
3	苏州康巨富自动化设备有限公司	生产商	2,482.66	5.41%	外协组装、机加钣金件
4	安徽恩玛尼科技有限公司	生产商	2,298.98	5.01%	夹治具
5	艾睿电子	贸易商	2,198.71	4.79%	电子元器件
合计			12,916.00	28.16%	/
2023 年度					
1	PANGAEA	贸易商	1,812.85	7.84%	电子元器件
2	苏州苏汀达自动化科技有限公司	生产商	1,224.64	5.30%	外协组装、机加钣金件
3	艾睿电子	贸易商	925.20	4.00%	电子元器件
4	苏州一诺兴精密机械有限公司	生产商	924.18	4.00%	机加钣金件
5	Advanced Science and Novel Technology Company, Inc.	生产商	893.19	3.86%	电子元器件
合计			5,780.07	25.00%	/
2022 年度					
1	南京汉立德信息科技有限公司	贸易商	1,503.43	10.43%	电子元器件
2	雅创睿芯（深圳）科技有限公司	贸易商	865.66	6.00%	电子元器件
3	安徽恩玛尼科技有限公司	生产商	857.04	5.94%	夹治具
4	PANGAEA	贸易商	757.45	5.25%	电子元器件
5	苏州策林智能科技有限公司	生产商	747.23	5.18%	外协组装

序号	供应商名称	供应商类别	采购金额	占采购总额比例	主要采购内容
合计			4,730.82	32.81%	/

注：同一控制下主体的采购金额已合并披露。

报告期内，公司向前五大供应商合计采购金额占当期采购总额的比例分别为32.81%、25.00%、28.16%和25.96%，不存在向单个供应商采购比例超过公司当年采购总额50%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员与公司前五大供应商不存在关联关系。

五、发行人与业务相关的主要资源要素情况

（一）固定资产

截至报告期末，公司固定资产账面原值为26,934.34万元，净值为24,148.78万元，具体情况如下：

单位：万元

类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
房屋建筑物	16,199.46	319.84	15,879.61
电子设备	6,471.37	1,432.54	5,038.83
器具、家具	2,448.38	596.97	1,851.41
机器设备	1,688.24	387.00	1,301.23
运输设备	126.89	49.20	77.69
合计	26,934.34	2,785.56	24,148.78

1、房屋及建筑物

截至本招股说明书签署日，公司及子公司拥有的房屋所有权具体情况如下：

序号	所有权人	权证号	地址	建筑面积(m ²)	用途	使用期限	他项权利
1	联讯仪器	苏(2025)苏州市不动产权第5012421号	泰山路315号	40,843.79	工业用地	国有建设用地使用权2053.03.14止	无

2、房屋租赁情况

截至本招股说明书签署日，公司及子公司主要房屋租赁具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件七：公司租赁情况”。

根据公司提供的房屋租赁合同、租赁不动产权属证书、租赁备案凭证、实地勘验照片，公司部分租赁不动产未办理租赁备案手续。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条和相关司法解释的规定，未办理租赁备案不影响租赁合同的效力。因此，租赁合同未办理登记备案手续不影响租赁合同的履行。

公司未办理租赁备案手续的主要租赁房产出租方已出具情况说明，解释未办理房屋租赁备案的客观原因，承诺出租方租赁房产未办理房屋租赁备案的情形不会影响双方之间租赁合同的合同效力及合同的正常履行，出租方与联讯仪器就租赁合同的履行及租赁房产的使用等事宜均不存在任何纠纷或潜在纠纷。

公司控股股东、实际控制人已出具关于租赁房产相关事项的相关承诺，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

（二）无形资产

截至2025年9月30日，公司无形资产主要包括土地使用权、商标、专利、软件及其他等，具体情况如下：

1、土地使用权

截至2025年9月30日，公司拥有1处土地使用权，具体情况如下：

序号	使用人	权证号	地址	面积（m ² ）	取得方式	用途	使用期限	他项权利
1	联讯仪器	苏（2025）苏州市不动产权第5012421号	泰山路315号	土地使用权面积15,000.00/房屋建筑面积40,843.79	出让	工业用地	国有建设用地使用权2053.03.14止	无

2、商标

（1）境内商标

截至2025年9月30日，公司共拥有18项境内注册商标，具体情况如下：

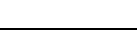
序号	商标权人	商标标识	注册号	类别	有效期	取得方式	他项权利
1	联讯仪器	联讯睿哲	40870543	9	2020.5.14-2030.5.13	原始取得	无
2	联讯仪器	联讯仪器	40891707	9	2020.7.21-2030.7.20	原始取得	无

序号	商标权人	商标标识	注册号	类别	有效期	取得方式	他项权利
3	联讯仪器		48315922	9	2021.5.21-2031.5.20	原始取得	无
4	联讯仪器		48307180	9	2021.5.21-2031.5.20	原始取得	无
5	联讯仪器		54380112	9	2021.10.7-2031.10.6	原始取得	无
6	联讯仪器	联讯仪器	54382109	9	2021.11.07-2031.11.06	原始取得	无
7	联讯仪器		65234337	9	2023.1.7-2033.1.6	原始取得	无
8	联讯仪器		65539867	42	2022.12.28-2032.12.27	原始取得	无
9	联讯仪器		65231707	9	2023.1.7-2033.1.6	原始取得	无
10	联讯仪器		65228694	9	2023.1.7-2033.1.6	原始取得	无
11	联讯仪器		65518056	9	2023.1.7-2033.1.6	原始取得	无
12	联讯仪器		65521293	9	2023.1.14-2033.1.13	原始取得	无
13	联讯仪器	Lianxuntest	65234979	9	2023.3.7-2033.3.6	原始取得	无
14	联讯仪器	联讯仪器	76545051	9	2024.8.21-2034.8.20	原始取得	无
15	联讯仪器	联讯仪器	76568658	42	2024.10.14-2034.10.13	原始取得	无
16	联讯仪器		48307590	9	2021.5.7-2031.5.6	原始取得	无
17	联讯仪器		76546558	42	2024.8.14-2034.8.13	原始取得	无
18	联讯仪器		82973229	9	2025.7.14-2035.7.13	原始取得	无

(2) 境外商标

截至 2025 年 9 月 30 日，公司共拥有 15 项境外注册商标，具体情况如下：

序号	商标权人	商标标识	注册号	尼斯分类	有效期	取得方式	注册国家/地区	他项权利
1	联讯仪器		7518439	9	2023.6.7-2033.6.7	原始取得	商标国际注册马德里体系（美国）	无

序号	商标权人	商标标识	注册号	尼斯分类	有效期	取得方式	注册国家/地区	他项权利
2	联讯仪器		1765552	9	2023.10.7-2033.10.7	原始取得	商标国际注册马德里体系（德国、日本、新加坡、越南、澳大利亚、马来西亚）	无
3	联讯仪器		TM2024003325	9	2024.2.1-2034.2.1	原始取得	马来西亚	无
4	联讯仪器		40202402706T	9	2024.2.7-2034.2.7	原始取得	新加坡	无
5	联讯仪器		40202402705U	9	2024.2.7-2034.2.7	原始取得	新加坡	无
6	联讯仪器		7610171	9	2024.12.17-2034.12.17	原始取得	美国	无
7	联讯仪器		018994875	9	2024.3.5-2034.3.5	原始取得	欧盟	无
8	联讯仪器		018980947	9	2024.1.31-2034.1.31	原始取得	欧盟	无
9	联讯仪器		TM2024006813	9	2024.3.8-2034.3.8	原始取得	马来西亚	无
10	联讯仪器		02398127	9	2024.9.1-2034.8.31	原始取得	中国台湾	无
11	联讯仪器		6856805	9	2024.10.22-2034.10.22	原始取得	日本	无
12	联讯仪器		402329130	9	2025.3.12-2035.3.12	原始取得	韩国	无
13	联讯仪器		402365051	9	2025.5.27-2035.5.27	原始取得	韩国	无
14	联讯仪器		306468733	9	2024.2.2-2034.2.1	原始取得	中国香港特别行政区	无
15	联讯仪器		6847499	9	2024.9.25-2034.9.25	原始取得	日本	无

3、专利

截至 2025 年 9 月 30 日，公司已实际取得 339 项专利，其中境内专利 334 项（包含 3 项共有专利），境外专利 5 项。境内专利包括 115 项发明专利、208 项实用新型专利、

11 项外观设计专利。公司拥有的专利均取得国家知识产权局颁发的专利权证书，具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件五：公司专利具体情况”。

4、软件著作权

截至 2025 年 9 月 30 日，公司已实际取得 32 项软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	软件著作权名称	登记号	登记日期	取得方式	他项权利
1	联讯仪器	4×25g_8×25G 上位机软件 2.25	2018SR194236	2018.3.22	原始取得	无
2	联讯仪器	Pam4 上位机软件 V4.06	2019SR0905757	2019.8.30	原始取得	无
3	联讯仪器	8×56Gbps Pam4 误码仪下位机软件 V3.0	2019SR0905755	2019.8.30	原始取得	无
4	联讯仪器	SMU1601 上位机软件 V1.0	2019SR0926223	2019.9.5	原始取得	无
5	联讯仪器	SMU1202 上位机软件 V1.0	2020SR0214017	2020.3.5	原始取得	无
6	联讯仪器	8×112Gbps Pam4 误码仪下位机软件 V1.1.2	2020SR0214023	2020.3.5	原始取得	无
7	联讯仪器	PAM4 误码仪嵌入式软件 V1.0	2021SR0076996	2021.1.14	原始取得	无
8	联讯仪器	光模块老化系统上位机软件 V1.0	2021SR0076995	2021.1.14	原始取得	无
9	联讯仪器	TO 老化系统上位机软件 V1.0	2021SR0080404	2021.1.15	原始取得	无
10	联讯仪器	SMU 精密源表嵌入式软件 V1.1.0	2021SR0348636	2021.3.5	原始取得	无
11	联讯仪器	联讯高带宽采样示波器测试软件 V1.0	2023SR0339737	2023.3.14	原始取得	无
12	联讯仪器	联讯测试程序工程环境软件 V1.0	2023SR0339738	2023.3.14	原始取得	无
13	联讯仪器	联讯时钟恢复软件 V1.0	2023SR0382926	2023.3.22	原始取得	无
14	联讯仪器	联讯时钟恢复上位机控制软件 V1.0	2023SR0382925	2023.3.22	原始取得	无
15	联讯仪器	联讯芯片测试软件 V1.0	2023SR0382930	2023.3.22	原始取得	无
16	联讯仪器	联讯硅光晶圆光	2023SR0382931	2023.3.22	原始取得	无

序号	著作权人	软件著作权名称	登记号	登记日期	取得方式	他项权利
		电耦合测试软件 V1.0				
17	联讯仪器	联讯高精度温度 控制软件 V1.0	2023SR0382928	2023.3.22	原始取得	无
18	联讯仪器	联讯波长计软件 V1.0	2023SR0382929	2023.3.22	原始取得	无
19	联讯仪器	联讯突发误码测 试仪上位机软件 V1.0	2023SR0382927	2023.3.22	原始取得	无
20	联讯仪器	联讯参数测试及 程序工程环境测 试软件 V1.0	2023SR0443876	2023.4.6	原始取得	无
21	联讯仪器	联讯高速信号与 光电信号的混合 测试软件 V1.0	2023SR0651216	2023.6.14	原始取得	无
22	联讯仪器	联讯参数测试系 统应用程序编程 接口软件 V1.2.0	2023SR0896922	2023.8.4	原始取得	无
23	联讯仪器	联讯参数测试系 统探针台控制工 具软件 V1.2.0	2024SR0159886	2024.1.24	原始取得	无
24	联讯仪器	联讯参数测试系 统量产测试软件 V1.0	2024SR0155759	2024.1.24	原始取得	无
25	联讯仪器	联讯晶圆自动上 下料机上位机软 件 V1.0.0	2024SR0849646	2024.6.21	原始取得	无
26	联讯仪器	晶圆老化测试软 件 V1.2.0	2024SR0849338	2024.6.21	原始取得	无
27	联讯仪器	CR6256 56Gbaud 时钟恢复单元下 位机软件 V0.2.7	2024SR0848308	2024.6.21	原始取得	无
28	联讯仪器	低漏电开关矩阵 软件 V1.0	2024SR0923528	2024.7.3	原始取得	无
29	联讯仪器	PXIe 插卡式源表 软件 V2.0.3.4	2024SR1503600	2024.10.12	原始取得	无
30	联讯仪器	PXIe 插卡式源表 软件 V2.0.6	2024SR1931993	2024.11.28	原始取得	无
31	联讯仪器	Local Manual Panel 系统 V1.3.0	2025SR1295414	2025.7.18	原始取得	无
32	联讯仪器	ptSemight 机台校 准维护工具软件	2025SR1295337	2025.7.18	原始取得	无

序号	著作权人	软件著作权名称	登记号	登记日期	取得方式	他项权利
		V1.9.1				

5、域名

截至 2025 年 9 月 30 日，公司拥有的主要域名具体情况如下：

序号	权利人	域名名称	注册日期	到期日期
1	联讯仪器	联讯仪器.com	2022.6.6	2026.6.6
2	联讯仪器	lianxuntest.com	2022.6.7	2026.6.7
3	联讯仪器	lxinstrument.com	2022.6.6	2026.6.6
4	联讯仪器	semight.com	2022.6.8	2026.6.8
5	联讯仪器	联讯仪器.net	2022.8.25	2026.8.25
6	联讯仪器	semight.net	2022.6.20	2026.6.20
7	联讯仪器	semight.com.cn	2022.6.20	2026.6.20
8	联讯仪器	联讯仪器.cn	2022.8.25	2026.8.25
9	联讯仪器	semightinc.com	2022.6.30	2026.6.30
10	新加坡联讯	nexustest.sg	2024.2.22	2026.2.21

6、集成电路布图设计

序号	权利人	布图设计名称	布图设计登记号	布图设计申请日	布图设计颁证日
1	联讯仪器	一种采样保持芯片	BS.225011948	2022.8.19	2022.12.8
2	联讯仪器	THA65_V1	BS.245012362	2024.11.8	2025.2.14
3	联讯仪器	THA65_V2	BS.245012370	2024.11.8	2025.2.14

（三）业务资质或许可

截至本招股说明书签署日，公司及子公司与经营业务相关的主要资质情况如下：

序号	资质/认证名称	资质所有人	有效期	证书/文件编号
1	高新技术企业	联讯仪器	2025.12.19-2028.12.18	GR202532014953
2	对外贸易经营者备案登记	联讯仪器	长期	03319294
3	海关进出口货物收发货人备案	联讯仪器	长期	3205365879
4	安全生产标准化三级企业（机械）	联讯仪器	2023.12.12-2026.12.12	苏 AQB320505JXIII20210 0045

注：除上述经营业务资质外，公司存在使用压力容器、叉车、电梯等特种设备的情况，该等特种设备共计 4 类 23 项。公司已就前述 4 类 23 项特种设备取得主管市场监督管理部门核发的《特种设备使用登记证》。

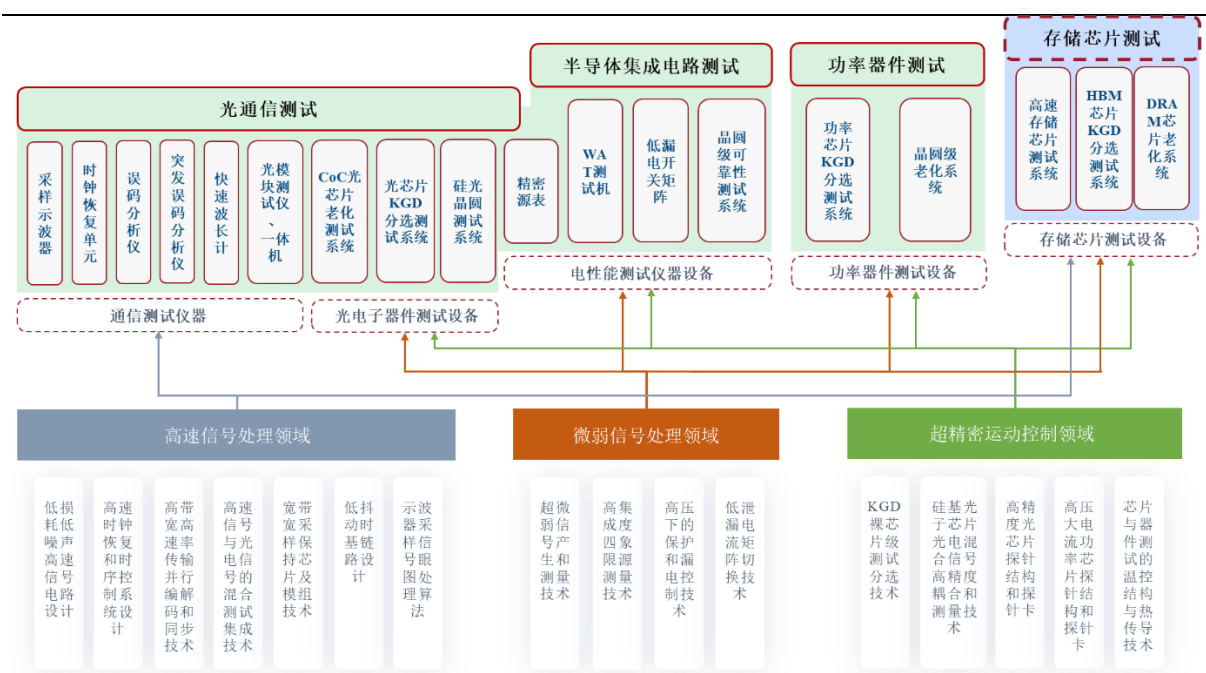
六、发行人核心技术与技术研发情况

（一）主要产品的核心技术情况

1、核心技术

公司重视技术研究和产品创新，紧跟行业技术与市场发展趋势，不断突破高端测试仪器设备的技术瓶颈与产业化空白，凭借多年的技术积累和产业化实践，公司逐步掌握了以“低损耗低噪声高速信号电路设计”“宽带宽采样保持芯片及模组技术”为代表的高速信号处理领域核心技术，以“超微弱信号产生与测量技术”“高集成度四象限源测量技术”为代表的微弱信号处理领域核心技术、以“KGD 裸芯片级测试分选技术”为代表的超精密运动控制领域核心技术，形成了具有高复用性的平台级核心技术体系，支持公司纵向与横向拓展，核心技术已深度融入并应用于主营业务，核心技术体系与产品线的对应关系如下：

图：公司核心技术体系与产品线的对应关系



公司自主开发的产品方案架构设计，以及公司掌握的自主知识产权专用芯片、自研硬件板卡、自研算法软件等，融合了高速信号处理、微弱信号处理和超精密运动控制等公司核心技术，直接决定了电子测量仪器和半导体测试设备的功能实现、性能边界与应用可能。

公司核心技术情况具体如下：

序号	技术名称	技术领域	主要内容	具体表征	技术来源	对应主要产品
1	低损耗低噪声高速信号电路设计	高速信号处理	1、通过设计高速信号的失调补偿电路，减小输出信号的失调，提升整体信号链路的动态响应范围和灵敏度；2、通过超低损耗 PCB 板材与叠层设计、全链路精准模型的高速仿真，降低高速信号传输损耗，提升链路信噪比；3、通过自研芯片，提升芯片性能指标，减少封装和 PCB 互联对性能的影响，提升链路信噪比；	系通信测试仪器产品开发的重要硬件技术基础，基于此技术实现单通道速率、发射机最大摆幅、抖动、灵敏度、噪声等关键指标的持续提升	自主研发	采样示波器、误码分析仪、时钟恢复单元、突发误码分析仪、快速波长计
2	高速时钟恢复和时序控制系统设计	高速信号处理	1、EQ 调理+限幅放大器的组合设计可应对更强的信号整形及恢复，可提升锁定数据信号的灵敏度、锁定的准确度及一致性；2、基于自研算法对 YTO/VCO 频率相位进行调制，实现锁定时间和精度的统一；3、基于自研快速锁定算法和复杂时序控制方法，实现通过突发数据包生成、门控信号输出技术及触发脉冲时序对准技术，实现多突发数据包的可编辑配置、接收与对齐	系通信测试仪器产品开发的重要技术基础，基于此技术实现最高恢复速率、输入信号最低光功率、恢复时钟最高输出频率、信号建立时间等重要指标的持续提升	自主研发	时钟恢复单元、突发误码分析仪
3	高带宽高速率传输并行编解码和同步技术	高速信号处理	1、通过 KP4 前向纠错码编解码技术及 MAC 成帧技术，实现高带宽、高并行度的误码实时纠正，以及大位宽以太网包提取和 CRC 校验；2、通过 alignment mark（AM 码）插入删除及锁定技术，实现超高吞吐率及高实时性大误码情况下的接收侧 AM 码锁定特殊字及字同步多通道数据对齐	系网络测试仪功能实现的重要技术能力，基于此技术持续突破相关算法开发及优化算法处理效率，满足 400G 及以上的高速以太网流量测试需求	自主研发	误码分析仪、突发误码分析仪
4	超微弱信号产生和测量技术	微弱信号处理	通过多级低噪电源变换方案、低噪滤波抗干扰技术及自适应高精度快速闭环控制算法，实现在复杂多变的负载情况下，高精度、超微弱信号源的产生及测量	系高端精密源表及半导体测试设备开发的核心硬件技术基础，基于此技术实现最小电流测量分辨率 0.1fA，测试精度 0.02%，直流信号范围覆盖 100pA 至 10A，噪声小于 1fA	自主研发	精密源表、WAT 测试机
5	高集成度四象限源测量技术	微弱信号处理	1、通过多通道切换技术，提升电流、电压的过冲保护，降低多通道电路之间的干扰，实现高集成度、高灵活度的测量；2、通过有源补偿技术，实现高稳定性的电压测量	系光芯片老化、晶圆老化效率提升的核心硬件技术基础，基于此技术实现：核心测试板卡多通道并行的高集成测试能力，控制电流电压过冲小于 3%，短路保护生效速度低于 1us	自主研发	CoC 光芯片老化测试系统、晶圆级老化系统

序号	技术名称	技术领域	主要内容	具体表征	技术来源	对应主要产品
6	高压下的保护和漏电控制技术	微弱信号处理	1、通过高压源限流技术，限压电路设计，快速检测和快速安全算法保障高压源到被测件的电路安全；2、通过安全保护算法和快速响应安全电路，在高压开尔文测试时避免电路开环时不可控高压的输出；3、自研超高阻抗继电器开关，实现超低漏电控制	系功率半导体测试的核心技术基础，基于此技术实现最高控制电压3,500V，控制漏电流小于100fA，短路保护生效速度小于1us 确保无电流过冲	自主研发	高压精密源表、晶圆级可靠性测试系统、晶圆级老化系统、功率芯片KGD 分选测试系统
7	硅基光子芯片光电混合信号高精度耦合和测量技术	超精密运动控制	1、通过高精度多自由度的运动轴及纳米级位移测量模组的设计，结合耦合算法，实现高集成度、高精度、高稳定性的光探针耦合；2、通过创新的多通道电探针卡及光探针模组，实现高密度、高精度、精准压力控制的探针压接及测量	系硅光产品测试的核心技术，基于此技术实现光探针的纳米级精准定位与秒级高速耦合，电探针的精准控制，创新开发适用于不同器件测量的多通道光电混合探针卡	自主研发	硅光晶圆测试系统
8	高速信号与光电信号的混合测试集成技术	高速信号处理	1、集成各类测试板卡，实现设备小型化、多通道化以及系统功能灵活配置和扩展，配合高效温度控制系统、光纤及射频件连接等技术集成为光电混合 ATE 测试系统；2、通过创新的板间高速射频对接设计，实现不同规格类型的待测件的便捷切换，降低耗材成本；3、通过自主开发光电混合 ATE 软件平台，实现图形化、模块化、扩展化的系统测试框架，满足多样的光模块协议测试规范需求，提高自动化程序实施部署的易操作性	系高速光模块测试机开发的重要技术基础，基于此技术实现高速光模块测试机最高单通道速率112Gbps，最高32通道并行测试，波长范围覆盖800-1,600nm，测试温度范围覆盖-20-85℃	自主研发	光模块测试仪、光模块测试一体机
9	宽带宽采样保持芯片及模组技术	高速信号处理	1、采用多级采样保持架构和版图布局优化，减小信号输入失配；2、通过模块化屏蔽方案提高芯片及模组集成度，实现50GHz以上高带宽信号的大增益、极小谐波失真、高线性度的采样与保持	系采样示波器自主研发的核心部件开发技术基础，基于此技术实现50G及以上更高带宽的采样示波器开发	自主研发	采样示波器
10	低抖动时基链路设计	高速信号处理	1、通过低抖动时钟生成电路、高分辨率延时控制电路和超低抖动互联技术，实现低抖动时基链路；2、通过时基采样电路和抖动处理算法，实现时基时钟的正交采样，根据正交距离回归计算获得准确的“时间戳”，3、通过特定的插值/互相关算法对时基进行估算与补偿，最后闭环反馈至硬件时基链路中进行补偿，极大降低时钟的抖动	系采样示波器核心性能指标突破的重要技术基础，基于此技术实现采样示波器的时基链路时钟RMS抖动小于200fs	自主研发	采样示波器

序号	技术名称	技术领域	主要内容	具体表征	技术来源	对应主要产品
11	示波器采样信号眼图处理算法	高速信号处理	通过延时交织同步采样技术提高码型锁定的采样效率,采用频带定向算法实现对已有频响的自定义修正,采用自适应多阶信号均衡算法满足测试的一致性要求,采用噪声分离和优化算法,降低系统本底噪声对测试的影响	系采样示波器核心性能指标提升的重要算法基础,基于此技术实现:采样示波器的数据处理效率提升,眼图测试效果优化(更加直观、清晰和准确)	自主研发	采样示波器
12	KGD 裸芯片级测试分选技术	超精密运动控制	1、通过创新设计的裸芯片剥离机构与吸嘴取放机构,实现对超小超薄裸芯片快速、稳定的取放与不同测试站的搬运;2、整机架构采用模块化设计,以适配多种芯片的测试来料与出料的要求;3、通过特殊设计的针卡模组与运动机构,降低针卡在快速测试过程中对芯片的压力冲击;4、通过多动子平移式设计搬运模组、结合转塔式搬运结构,实现芯片在多温区的并行测试,大幅提升设备的测试效率	系半导体测试设备的核心技术基础,基于此技术实现:裸芯片的高精度、高稳定性、高效搬运与测试全流程针痕外观不良率小于 0.02%,掉料率小于 0.03%。激光器裸芯片 UPH 达 650 颗,功率裸芯片 UPH 达 4,000 颗	自主研发	功率芯片 KGD 分选测试系统、光芯片 KGD 分选测试系统
13	高精度光芯片探针结构和探针卡	超精密运动控制	1、通过特殊设计的低摩擦滚动铰链搭配悬臂针卡,满足探针压力高准确性、高稳定性与高可靠性要求;2、通过一体式弹片结构,提高光芯片在测试夹具中的定位一致性,提升测试精度与稳定性;3、通过压力可调的夹具设计,提高夹具对不同大功率芯片的适配性;4、通过可调节伸缩弹片设计,实现高稳定性高效率的自动化上下料功能	系光芯片 KGD 分选测试系统、CoC 光芯片老化测试系统实现高精度、高可靠性测试的核心技术基础,基于此技术实现:激光器裸芯片扎针位置重复性小于 10um,扎针压力克重数长期稳定性小于 1g,创新开发 CoC 光芯片老化测试系统高集成探针卡	自主研发	光芯片 KGD 分选测试系统、CoC 光芯片老化测试系统
14	高压大电流功率芯片探针结构和探针卡	超精密运动控制	1、通过多功能层的高气压内腔体设计,避免晶圆测试过程高压打火击穿放电风险;2、通过无螺丝晶圆针卡设计,提升测试循环寿命;3、通过特种金属在芯片接触位置的镶嵌和研磨工艺,提升测试系统的稳定性;4、采用特殊设计的探针结构在微小滑移去除芯片表面氧化层,保证探针与芯片充分接触以提高 Kelvin 测试良率;5、通过独创的晶圆与测试载盘的配合,避免大尺寸超薄晶圆上下料过程中的碎片风险;6、通过在测试载盘集成温度检测、真空吸附、高压隔离等功能提前预警脏污,针痕异常情况,保证整个测试过程的自动化	系半导体老化及可靠性的核心技术基础,基于此技术实现:高温测试环境下高集成待测件的稳定接触与高精度并行测试	自主研发	晶圆级可靠性测试系统、晶圆级老化系统、功率芯片 KGD 分选测试系统

序号	技术名称	技术领域	主要内容	具体表征	技术来源	对应主要产品
15	芯片与器件测试的温控结构与热传导技术	超精密运动控制	1、通过复杂的芯片测试治具与温控模组设计，实现温度精准控制及高热传导能力，满足芯片对温度控制范围、精度以及均匀性的要求；2、针对低温测试要求，对主机腔体进行特殊密闭设计，提升高低温控制能力；3、针对多芯片并行测试，实现高功率负载下温度精准控制，确保多芯片并行测试的高精度与高稳定	系半导体产品可靠性测试的重要技术基础，基于此技术实现：可靠性测试中高效、稳定的温度控制与传导，保证长时间测试条件下的测试环境温度的高一致性	自主研发	CoC 光芯片老化测试系统、晶圆级可靠性测试系统、晶圆级老化系统
16	低泄漏电流矩阵切换技术	微弱信号处理	1、通过自研高绝缘创新的继电器来降低泄漏电流；2、采用保护环方案实现低寄生电容的 Layout 布局	系低漏电开关矩阵的重要技术基础，基于此技术实现多通道、低漏电的信号传输	自主研发	低漏电开关矩阵

2、核心技术产品占营业收入的比例

报告期内，公司核心技术广泛应用于主营业务中，核心技术收入保持快速增长，报告期各期核心技术收入占营业收入的比例均超过 97%，对营业收入的贡献突出，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
核心技术收入	79,665.55	78,325.06	26,919.95	21,220.59
营业收入	80,562.15	78,862.99	27,579.31	21,439.06
核心技术收入占比	98.89%	99.32%	97.61%	98.98%

3、核心技术的科研实力和成果情况

（1）专利情况

公司专利具体情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件五：公司专利具体情况”。

（2）获奖情况

截至本招股说明书签署日，公司获得的主要奖项情况如下：

序号	奖项名称	获奖时间	颁发机构
1	科技企业上市培育计划拟入库企业	2024 年	江苏省科学技术厅
2	瞪羚企业	2023 年	江苏省生产力促进中心
3	工业互联网与云平台企业	2023 年	江苏省工业和信息化厅
4	江苏省潜在独角兽企业	2023 年	江苏省生产力促进中心
5	江苏省民营科技企业	2023 年	江苏省民营科技企业协会
6	江苏省企业工程技术研究中心	2023 年	江苏省科学技术厅
7	企业技术中心	2023 年	苏州市人民政府
8	苏州民营企业创新 100 强	2023 年	苏州市工商联
9	苏州市“独角兽”培育企业	2023 年	苏州市科学技术局
10	苏州市“瞪羚企业”	2023 年	苏州市科学技术局
11	苏州市企业工程技术研究中心	2023 年	苏州市科学技术局
12	2022 年中国潜力独角兽-雏鹏企业 Top100	2022 年	中国大数据网
13	国家专精特新“小巨人”企业	2022 年	工业和信息化部
14	首届“金燧奖”中国光电仪器品牌—铜奖	2022 年	中国光学工程学会

序号	奖项名称	获奖时间	颁发机构
15	创新积分 500 企业	2022 年	科技部火炬中心
16	苏南国家自主创新示范区潜在独角兽企业	2022 年	苏南国家自主创新示范区 管理服务中心
17	苏州高新区博士后预备站	2022 年	苏州高新区人力资源和社 会保障局
18	优秀关键核心技术攻关企业	2022 年	苏州高新区管委会
19	创新型产业集群带动奖	2022 年	苏州高新区管委会
20	创新型中小企业	2022 年	苏州市工业和信息化局
21	中国潜在独角兽企业	2021 年	长城战略咨询、苏州工业园 区管委会
22	全国颠覆性技术创新大赛优胜项目	2021 年	科技部火炬中心
23	江苏省专精特新中小企业	2021 年	江苏省工业和信息化厅
24	苏州市光通信产业 20 强	2021 年	苏州市光通信产业联盟
25	苏州高新区“瞪羚企业”	2020 年	江苏省苏州市高新区

(3) 承担的重大科研项目

截至报告期末，公司已承接国家级、省级重大科研项目如下表所示：

序号	项目名称	项目类型	主管部门	项目级别	项目状态
1	宽频带取样示波器项目	国家重点研发计划 “基础科研条件与重大科学仪器设备研发”专项	中华人民共和国科学技术部	国家级	进行中
2	半导体器件动态伏安特性参数综合测试仪	国家重点研发计划 “基础科研条件与重大科学仪器设备研发”专项	中华人民共和国科学技术部	国家级	进行中
3	项目一		某部委	国家级	进行中
4	集成化激光器阵列芯片测试装备关键技术研发	2022 年省科技计划专项资金（重点研发计划产业前瞻与关键核心技术）	江苏省科学技术厅	省级	进行中

4、核心技术的保护措施

公司为保护核心技术采取的具体措施如下：第一，通过申请专利对核心技术进行保护；第二，根据自身实际情况制定并执行了较为完善的研发保密制度，明确研发部门各岗位职责与义务，重视员工保密意识培训，严格执行技术保密管理措施。此外，公司与研发人员签订了劳动合同、保密与竞业限制合同，针对与技术秘密和商业秘密相关的保密内容及范围、对公司商业机密的保密义务以及与竞业限制、职务成果有关的事项等进

行了明确约定。

通过上述措施，公司可以有效保护核心技术，防止核心技术的泄露和流失。

（二）发行人研发情况

1、在研项目及进展情况

截至报告期末，公司主要在研项目的情况如下：

序号	领域	项目名称	拟达目标	进展情况
1	电子测量仪器	项目一		EVT 阶段
2	半导体测试设备	高速多 die KGD 测试分选系统项目	支持 Frame Ring、Tape&Reel 以及定制 Tray 多种芯片包装方式。系统测试温度范围大，支持常温到高温 200°C。支持多达六个测试站，不同测试站支持不同测试条件与测试项目。支持芯片外观六面视觉检查，检测精度 12um。设备 UPH>4500PCS（单测试站测试时间≤0.7s）	EVT 阶段
3	电子测量仪器	宽频带取样示波器项目	实现光口带宽 60GHz，电口带宽 65GHz，波长范围 800-1,600nm，光灵敏度不高于 -12dBm，抖动不高于 200fs，ADC 精度 16bit	MVT 阶段
4	半导体测试设备	HPB 测试分选系统项目	HPB 测试分选系统项目采用 64 分区独立控温的温控系统，总温控能力 ≥3000W@25°C，105°C，1500W@-40°C，温度均匀性 2000W±2°C，2000W 以上±3°C，64 个 Die 之间的摆片精度 ±5um，同时进行 64Die 并行测试	EVT 阶段
5	半导体测试设备	半导体器件动态伏安特性参数综合测试仪项目	1、完成 5 个核心硬件模块的产品化开发：高功率精密源表模组；高分辨率精密源表模组；高分辨率、多频点电容测量模组；高压高速脉冲产生模组；任意波信号产生及同步测量模组；2、建立 PCIe 总线架构主机平台，研制复杂应用场景半导体参数测量软件，包含预定义测试库、控制界面、自动图形显示、分析和参数提取等功能；3、建立数据库以及微弱电性能参数国家基准校准技术；4、对软硬件进行整机集成和工程化，推广仪器在半导体晶圆、集成电路芯片、分立器件等电性能参数特性测量等领域的应用示范，完成工程化和产业化	EVT 阶段
6	半导体测试设备	WAT6600 半导体参数测试系统项目	实现 48 通道的并行半导体电性能参数测试，每个通道的集成源表，电容表，脉冲源，频率计等相关测试资源，大幅度提高测试效率	EVT 阶段
7	半导体测试设备	晶圆级栅偏老化系统项目	设备可在 175°C 工作温度下同时完成 20 片晶圆的高温栅偏老化测试，单晶圆最高支持 1500 通道，每片晶圆独立加电老化，通	DVT 阶段

序号	领域	项目名称	拟达目标	进展情况
			过更换夹具板可灵活适配不同产品	
8	半导体测试设备	晶圆级8英寸9工位全自动老化系统项目	设备可在 175°C工作温度下同时完成 9 片晶圆的高温栅偏老化测试或者高温反偏老化测试，单晶圆最高支持 2112 通道，每片晶圆独立加电老化，通过更换探针卡可灵活适配不同产品	EVT 阶段
9	半导体测试设备	ATE FT 中速测试机项目	实现测试速率 1.2GHz/2.4Gbps，整机通道数 11264ch，FT 功能可以实现 512DUTs 的并测数，同时 DPS 实现 Gang 的功能，支持模块化拓展应用，满足 Memory 测试的相关标准	EVT 阶段
10	电子测量仪器	200V 高精密单通道 PXIe 源表项目	1、实现最大 $\pm 200V$ 、 $\pm 1A$ （直流）、 $\pm 3A$ （脉冲）、20W 恒功率输出的高集成度四象限高精密度源表，支持传统的 SMU SCPI 命令，支持主流的 PXIe 机箱，支持多卡同步，可大规模集成到生产测试系统中使用，以提高系统的测试效率并降低成本；2、完成以 200V 高精密单通道 PXIe 源表项目为主产品的系列化拓展，形成最少 3 个系列机型的多应用领域扩展	MVT 阶段

2、研发投入情况

公司始终鼓励创新，重视研发工作，通过技术创新与持续研发保持核心竞争力。报告期内，公司研发费用金额分别为 5,357.28 万元、10,471.57 万元、19,143.44 万元和 20,052.87 万元，占营业收入的比例分别为 24.99%、37.97%、24.27%和 24.89%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
研发投入	20,052.87	19,143.44	10,471.57	5,357.28
营业收入	80,562.15	78,862.99	27,579.31	21,439.06
研发投入占营业收入比例	24.89%	24.27%	37.97%	24.99%

3、合作研发情况

报告期内，公司合作研发主要系公司联合相关高校实验室和企业共同申报完成技术攻关重点项目。截至 2025 年 9 月末，公司正在开展的合作研发情况具体如下：

序号	合作项目	其他合作方	合作内容	知识产权归属	保密措施
1	宽频带示波器	单位一、企业一、单位三、北京工业大学、湖北九峰山实验室、材	公司作为牵头单位与合作方联合申报科技部项目，公司主要负责仪器整机集成、工程化和应	牵头单位与合作单位在申请本项目之前各自所获得的知识产权及相应权益均归各自所有；在各方的工作	已约定保密条款

序号	合作项目	其他合作方	合作内容	知识产权归属	保密措施
		料科学姑苏实验室、单位二、中国计量科学研究院、苏州旭创科技有限公司	用示范项目，旨在开发65GHz电取样器、60GHz光取样器与高精度波形采集与重构、精准时基、高速时钟恢复、超低抖动时钟产生与触发等模块的组装集成工艺	范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有；由各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有；共同完成的科技成果的精神权利，如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有	
2	半导体器件动态伏安特性参数综合测试仪	西安交通大学苏州研究院、上海理工大学、单位一、中国电子工业标准化研究院、客户二	公司作为牵头单位与合作方联合申报科技部项目，公司主要负责软件平台/校准溯源/标准化，和仪器整机集成、工程化和应用示范项目，旨在推动产品在半导体晶圆、集成电路芯片、分立器件等电性能参数特性测量领域的大规模应用	牵头单位与合作单位在申请本项目之前各自所获得的知识产权及相应权益均归各自所有；在各方的工作范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有；由各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有；由各方共同完成的技术成果，各方均有独自使用的权利等	已约定保密条款
3	低漏电流 Pin board 的研发与验证	客户二	本项目针对国内高端半导体研发制造的需求，旨在解决国内半导体研发测试，制造验证中低漏电开关矩阵的低漏电流和通道 10MHz 带宽的需求，积累高端测试仪表产业化核心关键共性技术基础	双方各自所有的背景知识产权仍然归双方各自所有；对于本合同项目所产生的技术成果及其前景知识产权，如由甲乙双方共同开发的，则该技术成果及其前景知识产权归属于甲乙双方共同所有；如由一方单独开发的，则该技术成果及其前景知识产权归属于开发的一方单独所有等	已约定保密条款
4	基于 AI 增强的多维视觉表面损伤关键技术研发	东南大学苏州研究院	实现基于 AI 增强表面受损的多维视觉感知与识别的损伤检测关键技术研究，公司电子产品识别与缺陷检测	各方独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有；由双方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归双方共有。各方对共有科技成果和技术实施许可、转让而获得的经济收益由双方共享。收益共享方式应在行为实施前另行约定	已约定保密条款

注：截至 2025 年 9 月末，低漏电流 Pin board 的研发与验证合作研发项目已顺利结束。

（三）发行人核心技术人员和研发人员情况

1、核心技术人员及研发人员基本情况

公司核心技术人员包括胡海洋、黄建军、廉哲等 9 人，其认定依据及基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况”之“4、核心技术人员”。

公司的研发人员认定标准为专职从事研发活动的人员，公司研发人员均为专职研发人员，全职从事研发活动，不存在非全时研发人员的情形。报告各期末公司研发人员分别为 110 人、233 人、348 人和 440 人，占员工总数比例分别为 43.48%、48.04%、40.32% 和 40.18%。报告期内，公司研发人员学历分布如下：

学历	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	人数	比例	人数	比例	人数	比例	人数	比例
本科及以上	404	91.82%	309	88.79%	192	82.40%	86	78.18%
大专	35	7.95%	36	10.34%	32	13.73%	21	19.09%
大专以下	1	0.23%	3	0.86%	9	3.86%	3	2.73%
合计	440	100.00%	348	100.00%	233	100.00%	110	100.00%

2、核心技术人员相关情况及对公司的贡献

公司核心技术人员对公司的具体贡献如下：

胡海洋，现任公司董事长。胡海洋在电子测量和半导体测试领域具有丰富的技术研究与产品开发经验，主要负责公司技术与产品研发战略规划，作为代表牵头承担科技部“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项项目之“宽频带取样示波器项目”，并作为研发评审小组成员参与公司研发项目的推进、评审。

黄建军，现任公司总经理。黄建军在电子测量和半导体测试领域具有丰富的技术研究与产品开发经验，主要负责公司技术与产品发展路线的制定与执行，全面主持公司技术创新与产品开发等研发工作，并作为研发评审小组成员参与公司研发项目的推进、评审。

廉哲，现任公司副总经理、仪器与测试机事业部负责人。廉哲主持并负责采样示波器、快速波长计、WAT 测试机等相关产品的多个研发项目，并作为研发评审小组成员

参与公司研发项目的推进、评审。

陈晓东，现任公司研发总监。陈晓东具有丰富的硬件研发工作经验，为公司低损耗低噪声高速信号电路设计、高速时钟恢复和时序控制系统设计、低抖动时基链路设计等核心技术创新、积累与转化作出了突出贡献，有力支撑了采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪等产品的开发与性能迭代。

赵山，现任公司研发副总、芯片测试装备事业部负责人。赵山主持并负责光芯片 KGD 分选测试系统、功率芯片 KGD 分选测试系统等相关产品的多个研发项目，在公司主导并完成了 KGD 裸芯片级测试分选技术、高精度光芯片探针结构和探针卡、芯片与器件测试的温控结构与热传导技术等核心技术的创新、积累与转化，有力支撑公司半导体测试设备的产品拓展与性能迭代。

郭孝明，现任公司高级研发总监、芯片老化装备事业部负责人。郭孝明主持并负责 CoC 光芯片老化系统、晶圆级老化系统等相关产品的多个研发项目，在公司主导并完成了高压大电流功率芯片探针结构和探针卡、芯片与器件测试的温控结构与热传导技术等核心技术的创新、积累与转化，有力支撑公司半导体测试设备的产品拓展与性能迭代。

彭兴贵，现任公司主任工程师。彭兴贵主持并负责突发误码分析仪、网络测试仪相关的多个研发项目，在公司主导并完成了高速时钟恢复和时序控制系统设计、高带宽高速率传输并行编解码和同步技术等核心技术的创新、积累与转化。

邵毅男，现任公司研发总监。邵毅男主持并负责误码分析仪、时钟恢复单元相关的多个研发项目，在公司主导并完成了低损耗低噪声高速信号电路设计、高速时钟恢复和时序控制系统设计、高速信号与光电信号的混合测试集成技术等核心技术的创新、积累与转化。

潘朝松，现任公司高级研发总监。潘朝松主持并负责精密源表、低漏电开关矩阵、WAT 测试机等电性能测试仪器及设备相关的多个研发项目，并为公司半导体测试设备的开发提供核心硬件技术支持，在公司主导并完成了超微弱信号产生和测量技术、高集成度四象限源测量技术等核心技术的创新、积累与转化。

报告期内，公司核心技术人员未发生变化。

3、研发人员激励约束措施

（1）激励措施

公司通过制定明确具体的激励措施，对研发团队形成了较好的正向激励作用：

1)构建基本工资与年度奖金相结合的长期激励制度，并建立完备的绩效考核机制。研发人员薪酬主要由基本工资与年度奖金组成，研发人员在该年度对公司的研发贡献与技术创新将由该研发人员所在部门的研发负责人以及所参与项目的项目负责人进行全面考核与评估。结合研发人员考核情况，公司每年将会对研发人员的基本工资与年度奖金进行动态调整，对于实现重大突破与突出贡献的研发人员，一个年度内具备多次调整薪酬的机会。

2)对实现重要产品开发、核心技术突破、关键工艺创新、科研项目承接以及专利文章发表等的研发人员进行专项奖励。

3)公司实施员工持股计划，将公司研发团队中的核心技术人员引入员工持股激励计划，充分调动研发团队的积极性、降低研发人员的流动性并吸引优秀的外部研发人才，为公司持续的研发创新工作提供基础，促进研发人员与公司共同开创未来发展前景，贡献公司可持续发展。

（2）约束措施

1)公司通过指标考核实现有效管理。公司基于自身总体战略目标和年度经营目标，将任务分解到各研发部门，并与相关负责人员签订业绩考核任务书，以确定考核目标。研发部门通过岗位月度绩效考核表将每月任务细分到具体岗位执行。研发人员的月度绩效与薪酬直接挂钩。工作绩效以岗位职责履行情况、工作目标任务完成情况、工作质量、工作效率等为考核重点，由人力资源部和研发部门对研发人员工作绩效的考核。

2)公司通过保密协议与竞业限制协议实现约束机制。根据岗位要求，公司与研发人员签订保密协议和竞业限制协议，明确保密范围和竞业限制要求。此外，公司根据离职员工的具体情况，内部商议决定是否签署竞业禁止合同。人力资源部严格核查新进入研发人员与原单位是否存在竞业禁止合同的情况。

3)公司通过实施员工持股计划实现合理约束。公司实施员工持股计划，参与员工持股计划的员工所持公司权益份额将遵循现行法规制度有关锁定期的规定，进一步保障

了公司对于核心技术人员与研发团队骨干人员的约束机制。

4、核心技术人员的主要变动情况及对发行人的影响

报告期内，公司核心技术人员稳定，均自报告期初已在公司任职。

（四）发行人保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新安排

1、以技术创新为驱动、以需求为导向的创新机制

公司以技术创新为驱动，坚持“储备一代、开发一代、应用一代”的研发理念，聚焦电子测量仪器与半导体测试设备领域关键技术的研发和产业化。一方面，公司不断完善内部合作机制，以研发项目形式推进技术创新与产品开发，实施动态资源调配与项目全周期管理，并积极推动与外部机构的技术合作及交流，保持研发投入强度与行业发展同步，不断提升核心技术的先进性水平与应用边界。另一方面，以行业 and 客户需求为导向确定产品开发方向，使创新技术具有明确的目标定位并实现产业化落地，从而提高公司的产品竞争力和市场地位，并有效提升研发投入的产出比。

2、高度重视人才培养，加强人才梯队建设

人才是创新的主体，公司一直重视技术人才团队建设，采用内部培养和外部引进相结合的机制，不断提升团队人才层次、优化人才梯队结构。在内部培养方面，公司通过制定人才培养方案，建立科学合理的晋升通道，激励员工主动参与创新，同时鼓励专业技术人才参加内外部培训、国内外展会和学术会议，不断提升专业技术人才的知识储备、专业技能和管理水平。

在外部引进方面，公司实施差异化的人才引进策略，针对不同层次、不同背景的专业人才制定优势条件，采用全职引进、技术顾问、项目合作等多种引进方式，集聚国内外的优秀人才资源以最大程度实现人才资源引进。同时，公司持续加强校园招聘力度，通过选拔一批综合素质较高、具备培养潜力的应届毕业生作为储备人才。

3、建立创新激励机制，巩固核心团队稳定性

公司管理部门针对部门人员工作成效，制定了系统的绩效考核方案，其中针对工作成果的创新性进行专门奖励，以激励员工在工作中提升创新意识，形成创新成果。在知识产权管理方面，制定知识产权奖励机制，对形成专利等知识产权的创新成果进行奖励，以此来激励员工攻坚克难，并主动形成创新成果的知识产权保护。公司核心技术人员和

主要研发人员通过员工持股平台间接持有公司股份，可以享受公司发展成果，促使研发团队保持稳定和持续的创新动力。

4、加强知识产权管理，打造自有知识产权体系

在持续技术创新的同时，公司通过不断完善知识产权全流程保护体系，推动“研发过程即时保护、创新成果系统布局”。通过制定专门的管理制度，配置专人跟踪行业动态、检索技术信息，对公司专利权、软件著作权等知识产权进行申请与管理，以专利申请与专有技术保密相结合的方式保护研发成果，打造自有核心技术与知识产权体系，为技术创新提供持续动能。

七、发行人安全生产及环境保护情况

公司主要从事高端测试仪器设备的研发、制造、服务及销售，主要生产工序包括组装、调试、测试等，公司生产过程不涉及重污染及高危险的情形。

（一）环境保护

公司生产经营过程中产生的主要污染物为废水、废气、固体废弃物和噪声，具体情况如下：

污染物类别	具体环节	主要污染物名称	主要处理措施/设施	处理能力
废水	-	生活污水	排入市政污水管网，由污水处理厂处理	充足
废气	清洁工序使用酒精挥发产生	乙醇	无组织排放	充足
固体废弃物	-	废包装材料	回收利用	充足
		报废零部件		充足
		边角料		充足
		生活垃圾	由环卫部门统一收集处理	充足
噪声	生产组装、仪表测试与设备调试环节中相关设备噪声	噪声	厂区平面布局，对噪声较高的设备，采取减震和消声等措施；草木植被种植	充足

公司所处行业不属于高危险、重污染行业，生产经营中仅产生少量的废气、废水、固体废弃物和噪声，报告期内环保费用支出和环保投入较少，符合行业基本情况。

截至本招股说明书签署日，公司取得的相关环保主管部门核发的排污登记回执情况如下：

序号	持证单位	登记编号	有效期至
1	联讯仪器	91320505MA1NK4RYXT004W	2030.11.17
2	联讯仪器	91320505MA1NK4RYXT002Z	2030.3.10
3	联讯仪器	91320505MA1NK4RYXT003W	2029.12.29
4	杭州联讯	91330106MAEP32LL27001Y	2030.7.16

（二）安全生产

公司对安全生产保持高度重视，目前已建立健全安全生产管理制度，形成了较为完善的制度体系、组织体系和应急预案措施。

报告期内，发行人遵守环保法律、法规，在生产经营中未发生环境污染事故，未发生因违反环保法律相关法规、安全生产相关法律法规而受到相关行政主管部门处罚的情形。

八、发行人境外经营情况

报告期内，公司境外销售收入分别为 2,872.86 万元、2,467.48 万元、11,660.79 万元和 25,963.44 万元，占同期主营业务收入的比例为 13.54%、9.17%、14.89%和 32.59%。公司积极推进国际化战略布局，目前已在日本、新加坡、马来西亚、泰国、美国和韩国布局下属公司，具体详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人分公司、子公司及参股公司情况”之“（一）控股子公司”。

第六节 财务会计信息与管理层分析

非经特别说明，本节所列公司财务数据，均依据经容诚会计师审计的财务会计资料，或根据其中相关数据计算得出；本节所列同行业可比公司财务数据，均依据其公开披露的定期报告等资料，或根据其中相关数据计算得出。公司提示投资者关注和阅读财务报告及审计报告全文，以获取全部的财务会计信息。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
流动资产：				
货币资金	256,762,320.29	190,621,502.59	172,976,029.64	319,557,055.87
交易性金融资产	-	180,560,630.30	160,357,863.18	544.12
应收票据	5,546,813.19	5,480,630.47	35,586,610.53	5,651,955.98
应收账款	367,062,997.95	230,994,960.64	118,685,456.96	82,456,986.66
应收款项融资	23,566,561.28	23,118,066.15	4,289,498.40	4,188,205.52
预付款项	23,822,389.32	8,666,434.39	5,308,065.77	2,272,779.28
其他应收款	15,491,836.90	8,879,768.83	3,977,922.46	1,531,216.85
存货	453,701,216.72	334,423,015.34	170,966,337.63	70,725,662.72
合同资产	30,863,187.83	26,732,836.03	7,117,696.98	6,888,818.13
一年内到期的非流动资产	55,125,415.22	901,285.09	-	-
其他流动资产	22,821,883.06	23,436,175.95	4,982,436.48	3,547,773.29
流动资产合计	1,254,764,621.76	1,033,815,305.78	684,247,918.03	496,820,998.42
非流动资产：				
债权投资	-	53,057,534.25	51,507,534.25	-
长期应收款	217,251.78	578,099.04	-	-
长期股权投资	24,414,366.02	19,876,536.69	19,698,544.35	-
固定资产	241,487,755.72	52,022,835.24	28,267,170.54	10,150,387.88
在建工程	12,189,038.79	100,102,027.97	29,787,143.42	1,180,711.68
使用权资产	42,789,661.26	12,584,628.79	5,600,020.26	4,757,645.56
无形资产	9,684,519.10	6,638,595.78	6,055,892.82	408,602.19
商誉	258,106.10	258,106.10	258,106.10	258,106.10

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
长期待摊费用	22,850,750.47	16,140,531.27	9,714,491.03	7,302,277.45
递延所得税资产	187,482.44	45,707.71	101,647.32	-
其他非流动资产	1,409,485.00	953,678.18	2,299,786.42	-
非流动资产合计	355,488,416.68	262,258,281.02	153,290,336.51	24,057,730.86
资产总计	1,610,253,038.44	1,296,073,586.80	837,538,254.54	520,878,729.28
流动负债：				
短期借款	-	13,733,529.51	-	-
应付票据	111,992,140.08	128,246,332.31	21,860,982.61	19,401,529.17
应付账款	270,490,202.83	185,995,961.30	134,010,415.91	52,865,552.50
合同负债	147,555,312.42	121,377,326.49	93,683,948.78	26,712,348.70
应付职工薪酬	40,790,841.61	37,401,227.75	22,706,754.84	10,997,001.11
应交税费	9,273,632.45	4,719,850.80	617,023.78	6,201,940.90
其他应付款	6,128,535.82	4,235,276.52	3,016,601.22	10,245,234.96
一年内到期的非流动负债	25,540,876.07	9,117,250.83	4,429,390.11	2,241,716.28
其他流动负债	26,626,573.56	10,482,456.55	21,842,110.69	2,528,144.52
流动负债合计	638,398,114.84	515,309,212.06	302,167,227.94	131,193,468.14
非流动负债：				
长期借款	76,142,695.13	49,211,757.47	-	-
租赁负债	31,277,004.93	5,378,217.32	1,533,651.35	2,588,368.53
预计负债	12,082,872.94	9,424,987.51	3,696,638.17	2,410,338.10
递延收益	42,940,000.00	38,244,100.00	36,610,100.00	2,900,000.00
递延所得税负债	171,308.63	113,538.08	54,911.16	30,116.96
非流动负债合计	162,613,881.63	102,372,600.38	41,895,300.68	7,928,823.59
负债合计	801,011,996.47	617,681,812.44	344,062,528.62	139,122,291.73
所有者权益：				
股本	77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00	74,200,000.00
资本公积	594,130,654.68	561,230,822.10	516,864,095.56	351,209,911.98
其他综合收益	-63,385.01	-325,812.10	-40,444.08	-8,677.72
盈余公积	5,121,028.63	5,121,028.63	-	-
未分配利润	132,506,883.28	35,863,869.36	-99,509,943.31	-44,116,140.03
归属于母公司所有者权益合计	808,695,181.58	678,889,907.99	494,313,708.17	381,285,094.23
少数股东权益	545,860.39	-498,133.63	-837,982.25	471,343.32
所有者权益合计	809,241,041.97	678,391,774.36	493,475,725.92	381,756,437.55

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
负债和所有者权益总计	1,610,253,038.44	1,296,073,586.80	837,538,254.54	520,878,729.28

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	805,621,511.07	788,629,907.12	275,793,140.52	214,390,600.94
其中：营业收入	805,621,511.07	788,629,907.12	275,793,140.52	214,390,600.94
二、营业总成本	692,497,107.57	639,418,226.54	327,281,191.21	248,653,558.48
其中：营业成本	329,142,507.95	286,814,560.66	108,948,792.79	120,898,707.51
税金及附加	4,890,471.49	4,672,005.80	1,159,592.05	1,455,061.83
销售费用	55,941,537.44	52,210,812.34	32,529,089.90	19,206,224.94
管理费用	105,902,991.40	104,740,637.43	80,125,235.44	54,381,489.31
研发费用	200,528,698.38	191,434,436.52	104,715,703.22	53,572,829.15
财务费用	-3,909,099.09	-454,226.21	-197,222.19	-860,754.26
其中：利息费用	1,398,000.79	392,623.60	204,143.73	201,493.54
利息收入	5,554,071.77	987,073.57	1,377,858.88	176,864.92
加：其他收益	2,615,303.67	6,859,938.92	4,585,323.13	3,003,805.69
投资收益（损失以“-”号填列）	2,930,784.78	6,195,453.05	4,869,896.39	518,772.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	202,767.12	357,319.06	544.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,870,495.07	-4,625,664.29	-11,668,847.16	-3,635,091.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,894,180.44	-16,137,561.79	-5,522,349.53	-2,425,167.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,905,816.44	141,706,613.59	-58,866,708.80	-36,800,094.54
加：营业外收入	423,527.55	611,258.74	2,579,742.17	22,486.34
减：营业外支出	695,110.43	1,326,609.63	493,292.68	1,117,593.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,634,233.56	140,991,262.70	-56,780,259.31	-37,895,202.00
减：所得税费用	-52,774.38	108,292.78	-77,130.46	-6,385.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,687,007.94	140,882,969.92	-56,703,128.85	-37,888,816.92
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,687,007.94	140,882,969.92	-56,703,128.85	-37,888,816.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	96,643,013.92	140,494,841.30	-55,393,803.28	-38,069,968.30
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,043,994.02	388,128.62	-1,309,325.57	181,151.38
六、其他综合收益的税后净额	169,322.83	-285,368.03	-31,766.35	-8,677.72
七、综合收益总额	97,856,330.77	140,597,601.89	-56,734,895.20	-37,897,494.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	96,812,336.75	140,209,473.27	-55,425,569.63	-38,078,646.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,043,994.02	388,128.62	-1,309,325.57	181,151.38
八、每股收益				
(一) 基本每股收益 (元/股)	1.26	1.82	-0.73	-1.95
(二) 稀释每股收益 (元/股)	1.26	1.82	-0.73	-1.95

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	683,983,682.94	716,797,414.72	289,390,414.50	204,249,512.45
收到的税费返还	8,191,298.79	1,342,247.20	1,069,527.30	538,513.96
收到其他与经营活动有关的现金	14,720,355.40	7,456,139.19	40,999,150.76	15,016,877.84
经营活动现金流入小计	706,895,337.13	725,595,801.11	331,459,092.56	219,804,904.25
购买商品、接受劳务支付的现金	409,129,676.30	340,528,453.12	187,302,606.34	136,155,546.68
支付给职工以及为职工支付的现金	216,215,402.84	189,755,067.82	87,375,426.74	49,881,512.86
支付的各项税费	25,986,247.07	30,701,639.59	17,042,821.74	7,276,154.12
支付其他与经营活动有关的现金	81,046,712.02	83,824,815.88	44,997,254.77	19,511,229.36
经营活动现金流出小计	732,378,038.23	644,809,976.41	336,718,109.59	212,824,443.02
经营活动产生的现金流量净额	-25,482,701.10	80,785,824.70	-5,259,017.03	6,980,461.23
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	1,791,085.75	4,467,460.71	3,663,817.79	699,227.12
收到其他与投资活动有关的现金	430,000,000.00	640,000,000.00	775,048,519.31	291,034,528.15
投资活动现金流入小计	431,791,085.75	644,467,460.71	778,712,337.10	291,733,755.27
购建固定资产、无形资产和其	98,024,116.68	112,011,001.85	30,628,636.83	2,526,207.97

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
他长期资产支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,000,000.00	-	20,000,000.00	587,106.97
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	660,000,000.00	985,000,000.00	277,408,087.50
投资活动现金流出小计	352,024,116.68	772,011,001.85	1,035,628,636.83	280,521,402.44
投资活动产生的现金流量净额	79,766,969.07	-127,543,541.14	-256,916,299.73	11,212,352.83
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	120,000,000.00	296,097,716.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	640,916.54
取得借款收到的现金	86,884,261.59	108,795,703.37	-	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	86,884,261.59	108,795,703.37	120,000,000.00	301,097,716.54
偿还债务支付的现金	61,186,853.44	45,850,416.39	-	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	860,641.86	-	-	21,066,838.55
支付其他与筹资活动有关的现金	10,453,285.99	14,339,088.26	3,470,064.51	2,277,217.88
筹资活动现金流出小计	72,500,781.29	60,189,504.65	3,470,064.51	28,344,056.43
筹资活动产生的现金流量净额	14,383,480.30	48,606,198.72	116,529,935.49	272,753,660.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	471,297.42	55,395.23	-865,976.39	1,088,210.23
五、现金及现金等价物净增加额	69,139,045.69	1,903,877.51	-146,511,357.66	292,034,684.40
加：期初现金及现金等价物余额	167,151,901.63	165,248,024.12	311,759,381.78	19,724,697.38
六、期末现金及现金等价物余额	236,290,947.32	167,151,901.63	165,248,024.12	311,759,381.78

二、审计意见、关键审计事项

（一）审计意见

容诚会计师审计了公司财务报表，包括 2025 年 9 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

容诚会计师认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联讯仪器 2025 年 9 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022

年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）关键审计事项

关键审计事项是容诚会计师根据职业判断，认为对 2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，容诚会计师不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认

（1）事项描述

联讯仪器主要从事电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务，2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度联讯仪器营业收入分别为 80,562.15 万元、78,862.99 万元、27,579.31 万元、21,439.06 万元。

由于收入是联讯仪器的关键业绩指标，从而存在联讯仪器管理层（以下简称“管理层”）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，容诚会计师将收入确认确定为关键审计事项。

（2）审计应对

容诚会计师对收入实施的相关审计程序主要包括：

- 1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- 2) 了解联讯仪器的业务模式，分析收入确认的关键条件；选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- 3) 执行分析性程序，并与同行业可比公司进行对比分析，判断收入、成本、毛利率波动的合理性；
- 4) 执行细节测试，获取销售明细，对记录的收入交易选取样本，核对和检查销售合同、销售发票、出库单据、物流运输单据、签收单、验收单和出口报关单等支持性文件，判断收入确认的真实性；
- 5) 对主要的客户实施函证程序，确认销售金额、应收账款余额以及回款金额的真

实性、准确性；

6) 执行走访程序，对主要客户执行走访等程序，了解联讯仪器与主要客户的业务合作模式等情况；

7) 执行截止性测试，在资产负债表日前后记录的收入交易中选取样本，核对出库单、物流运输单据、签收单、验收单和出口报关单等资料，确认收入是否被记录于恰当的会计期间。

2、研发费用

(1) 事项描述

2025年1-9月、2024年度、2023年度、2022年度，联讯仪器研发费用分别为20,052.87万元、19,143.44万元、10,471.57万元、5,357.28万元。

由于研发费用是联讯仪器的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵研发费用认定的固有风险，容诚会计师将研发费用确认为关键审计事项。

(2) 审计应对

容诚会计师对研发费用实施的相关审计程序主要包括：

1) 了解和测试管理层与研发相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

2) 获取研发项目台账及研发费用明细表，抽样获取领料单据、研发人员工时记录和相关费用合同，核对项目领料是否与台账信息一致，复核人工费用归集的准确性和合理性，核实相关费用发生的真实性、准确性；

3) 获取研发样机台账，评价销售研发样机是否适用收入准则、满足收入定义及确认条件，判断销售研发样机相关核算是否符合企业会计准则的要求，检查销售研发样机的支持性文件；

4) 检查研发费用中职工薪酬、材料费、折旧与摊销等费用的归集与分摊，核对研发费用的归集范围是否恰当，研发费用的发生是否真实，是否与相关研发活动切实相关；

5) 执行截止性测试，在资产负债表日前后记录的研发费用中选取样本，核对相关支持性单据，确认研发费用是否被记录于恰当的会计期间。

（三）重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上
重要的预付账款、应付账款、合同负债	单项账龄超过 1 年的预付账款/应付账款/合同负债占预付账款/应付账款/合同负债总额的 10%以上
重要在建工程	单项资产期末余额占在建工程期末余额 10%以上
重要的与投资活动相关的现金流量	单项投资活动现金流占投资活动现金流入或流出总额的比例超过 10%
重要销售退回	销售退回金额占当期营业收入的 5%以上
重要或有事项	单个事项金额超过 100.00 万元
重要的资产负债表日后调整事项	资产负债表日后调整事项金额占当期利润总额的 5%以上

三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况**（一）财务报表编制基础**

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础编制。公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响公司持续经营能力的事项。

（二）合并报表范围及变化情况

报告期内，公司合并财务报表范围内的合并主体具体如下：

1、报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司简称	持股比例（%）	
		直接	间接
1	联讯赛麦特	100.00	-
2	日本联讯	-	85.00
3	新加坡联讯	100.00	-
4	马来西亚联讯	-	100.00
5	泰国联讯	-	100.00

序号	子公司简称	持股比例（%）	
		直接	间接
6	韩国联讯	-	100.00
7	美国联讯	-	100.00
8	武汉联讯	100.00	-
9	杭州联讯	100.00	-

2、报告期内合并财务报表范围变化

（1）报告期内新增子公司：

序号	子公司简称	新增期间	纳入合并范围原因
1	联讯赛麦特	2022 年度	新设
2	日本联讯	2022 年度	收购
3	新加坡联讯	2023 年度	新设
4	马来西亚联讯	2024 年度	新设
5	泰国联讯	2024 年度	新设
6	韩国联讯	2025 年 1-9 月	新设
7	美国联讯	2025 年 1-9 月	新设
8	武汉联讯	2025 年 1-9 月	新设
9	杭州联讯	2025 年 1-9 月	新设

（2）报告期内减少子公司：

序号	子公司简称	减少期间	不纳入合并范围原因
1	联讯睿哲	2022 年度	注销
2	联讯众创	2022 年度	注销

四、分部信息

公司主营业务为电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务，公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。公司主营业务收入的构成和地区分布等情况详见本节“九、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

五、主要会计政策及会计估计

（一）收入

1、一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

（5）客户已接受该商品；

（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、具体方法

（1）商品销售

1）电子测量仪器、测试部件等无需安装调试的产品销售：对于内销业务，本公司将货物运送至客户或其指定的地点后，客户或其指定方确认收到货物时确认收入；对于外销业务，本公司在完成出口报关手续并取得报关单据时确认收入。

2）半导体测试设备等需要安装调试的产品销售：本公司将货物交付给客户并完成安装调试后，客户确认验收合格时确认收入。

（2）提供服务

对于延保等约定服务期限的服务，本公司在约定的服务期限内平均摊销确认收入；对于维修升级等未约定服务期限的服务，本公司在服务完成并经客户确认后确认收入。

（二）金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- （2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

- （1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此

类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

3、金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

（3）以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

4、衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确

认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

5、金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

（1）预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未

来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司评估承兑人为信用等级较高的 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制商业银行（以下简称“信用等级较高银行”）银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票和承兑人为非信用等级较高银行的银行承兑汇票预期信用损失的计提参

照应收账款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 合并范围内关联方客户

应收账款组合 2 其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2 其他方款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收票据

应收款项融资组合 2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 未到期质保金

合同资产组合 2 其他合同资产

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 未逾期长期应收款

长期应收款组合 2 已逾期长期应收款

对于划分为组合 1 的长期应收款，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对未逾期的长期应收款项计提坏账准备。对于划分为组合 2 的长期应收款，合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日，长期应收款应转入应收账款，按应收款项的减值方法计提坏账准备。

2) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 2) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

4) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

5) 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

6) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

8) 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

（4）已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（5）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得

计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（6）核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

6、金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：（1）将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；（2）将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

（1）终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

（2）继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

（3）继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

7、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债

进行抵销。

8、金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

（1）估值技术

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

（2）公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（三）合同资产及合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本小节“（二）金融工具”。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

（四）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

4、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过

程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

（3）存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

（4）资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

5、周转材料的摊销方法

（1）低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

（2）包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

（五）股份支付

1、股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

（1）对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整；

（2）对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

4、股份支付计划实施的会计处理

（1）以现金结算的股份支付

1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（2）以权益结算的股份支付

1) 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

5、股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

6、股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

（六）固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

1、确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	2-5	0/5	19-50
器具、家具	年限平均法	3-5	5	19-31.67

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

（七）在建工程

1、在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（八）无形资产

1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2、无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件及其他	3-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
土地使用权	30 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测

试。

（3）无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或计入相关资产的成本。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

3、研发支出归集范围

本公司将与开展研发活动相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、材料投入费用、委托外部研究开发等专业服务费用、租赁及物业费、折旧与待摊费用、差旅及其他费用等。

4、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（1）本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

（2）在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有

能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(九) 长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十) 政府补助

1、政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 本公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 本公司能够收到政府补助。

2、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、政府补助的会计处理

(1) 与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（3）政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（4）政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（十一）租赁

1、租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2、单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3、本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1) 租赁负债的初始计量金额；

2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3) 承租人发生的初始直接费用；

4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）
房屋及建筑物	年限平均法	租赁期限

（2）租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁

付款额包括以下五项内容：

- 1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 5) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

4、本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资

租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

5、租赁变更的会计处理

（1）租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B.增加的对价与租赁范围扩大部分单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

（2）租赁变更未作为一项单独租赁

1）本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

②其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

2）本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

（十二）报告期内重大会计政策和会计估计的变更

1、报告期内重大会计政策变更

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为 0，对 2023 年度、2022 年度合并比较财务报表的相关项目调整如下：

单位：万元

受影响的报表项目	2023.12.31/2023 年度		2022.12.31/2022 年度	
	调整前	调整后	调整前	调整后
营业成本	10,481.19	10,894.88	11,768.28	12,089.87
销售费用	3,666.60	3,252.91	2,242.21	1,920.62

2、报告期内重大会计估计变更

报告期内，公司不存在对财务状况和经营成果产生重大影响的重大会计估计变更。

六、非经常性损益情况

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的规定，经容诚会计师出具的《非经常性损益的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z2089 号）鉴证，报告期内公司非经常性损益的具体内容、金额以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-56.30	-71.56	-48.35	-19.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	86.03	416.59	287.66	280.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	271.11	622.02	552.87	51.93
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被	53.78	17.80	-30.15	-

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
债务重组损益	-31.81	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47.97	5.81	296.02	-66.80
因股份支付确认的费用	-	-150.83	-327.07	-1,307.48
非经常性损益总额	370.78	839.84	730.98	-1,061.21
减：非经常性损益的所得税影响数	-	-	-	-
非经常性损益净额	370.78	839.84	730.98	-1,061.21
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-0.03	0.0003	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	370.82	839.84	730.98	-1,061.21
归属于母公司股东的净利润	9,664.30	14,049.48	-5,539.38	-3,807.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9,293.49	13,209.65	-6,270.36	-2,745.79

报告期内，公司非经常性损益主要包括计入当期损益的政府补助、金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及因股份支付确认的费用等。2022-2023 年度公司未实现盈利，2024 年度、2025 年 1-9 月公司归属于公司普通股股东的非经常性损益净额占公司归属于母公司股东的净利润的比例为 5.98%、3.84%，占比相对较小，对公司经营成果不存在重大影响。

七、税项

（一）公司主要税种和税率

报告期内，公司合并范围内各纳税主体适用的主要税种和税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售过程或提供应税服务过程中的增值额	6%、10%、13%
消费税	以按税法规定计算的当期销售额为基础计算消费税额，扣除当期允许抵扣的进项消费税额后，差额部分为应交消费税	10%
城市维护建设税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育附加	流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	9%、15%、17%、20%、23.20%、24%、29.84%

注：韩国联讯适用10%增值税税率，日本联讯适用10%消费税税率。

报告期内，公司合并范围内各纳税主体适用的所得税税率明细如下：

纳税主体	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
联讯仪器	15%	15%	15%	15%
联讯赛麦特	20%	20%	20%	20%
联讯睿哲	已注销	已注销	已注销	20%
联讯众创	已注销	已注销	已注销	20%
武汉联讯	20%	尚未设立	尚未设立	尚未设立
杭州联讯	20%	尚未设立	尚未设立	尚未设立
日本联讯	15%	15%、23.20%	15%	15%
新加坡联讯	17%	17%	17%	尚未设立
马来西亚联讯	24%	24%	尚未设立	尚未设立
泰国联讯	-	-	尚未设立	尚未设立
韩国联讯	9%	尚未设立	尚未设立	尚未设立
美国联讯	29.84%	尚未设立	尚未设立	尚未设立

注 1：报告期内，日本联讯适用日本企业所得税政策：“应纳税所得额 800 万日元以内法人税率适用 15%，超过 800 万日元部分适用 23.20%”；

注 2：报告期内，泰国联讯尚未盈利，适用泰国中小型企业所得税政策：“年净利润不超过 300,000 泰铢，免征企业所得税”。

（二）税收优惠

1、高新技术企业所得税优惠

公司于 2022 年 12 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合换发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202232010067），并于 2025 年 12 月 19 日取得新换发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202532014953），自换发当年起继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据财政部、税务总局、科技部联合发布的《财政部、税务总局、科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部、税务总局、科技部公告 2022 年第 28 号）扩大高新技术企业所得税前扣除优惠政策，高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，允许在税前实行 100% 加计扣除。

2、先进制造业企业增值税加计抵减

根据财政部和税务总局联合发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公

告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

3、研究开发费用加计扣除

根据《财政部、税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年第 13 号），制造业企业在开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

根据财政部和税务总局联合发布的《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 7 号）为进一步激励企业加大研发投入，更好地支持科技创新，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

4、小微企业税收优惠

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年第 12 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司报告期内的子公司联讯睿哲、联讯众创、联讯赛麦特、武汉联讯和杭州联讯符合小型微

利企业的条件，享受上述所得税优惠政策。

八、主要财务指标

（一）基本财务指标

主要财务指标	2025.9.30 /2025 年 1-9 月	2024.12.31 /2024 年度	2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度
流动比率（倍）	1.97	2.01	2.26	3.79
速动比率（倍）	1.25	1.36	1.70	3.25
资产负债率（合并）	49.74%	47.66%	41.08%	26.71%
资产负债率（母公司）	47.28%	46.76%	40.85%	26.72%
应收账款周转率（次）	3.28	4.04	2.45	2.73
存货周转率（次）	1.07	1.09	0.87	1.78
息税折旧摊销前利润（万元）	13,062.44	16,612.24	-4,235.94	-2,893.21
归属于母公司股东的净利润（万元）	9,664.30	14,049.48	-5,539.38	-3,807.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	9,293.49	13,209.65	-6,270.36	-2,745.79
利息保障倍数（倍）	70.84	360.10	/	/
研发投入占营业收入比例	24.89%	24.27%	37.97%	24.99%
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.33	1.05	-0.07	0.09
每股净现金流量（元）	0.90	0.02	-1.90	3.94
归属于母公司股东的每股净资产（元）	10.50	8.82	6.42	5.14

注 1：流动比率=流动资产/流动负债；

注 2：速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

注 3：资产负债率=（总负债/总资产）×100%；

注 4：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，其中 2025 年 1-9 月已折算全年；

注 5：存货周转率=营业成本/存货平均余额，其中 2025 年 1-9 月已折算全年；

注 6：息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

注 7：利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用，2022 及 2023 年度利息保障倍数不适用，系息税前利润为负所致；

注 8：每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

注 9：每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；

注 10：归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末普通股股份总数。

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，报告期内，公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益具体如下：

项目	期间	加权平均 净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2025 年 1-9 月	13.29%	1.26	1.26
	2024 年度	24.89%	1.82	1.82
	2023 年度	-12.44%	-0.73	-0.73
	2022 年度	-23.73%	-1.95	-1.95
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2025 年 1-9 月	12.78%	1.21	1.21
	2024 年度	23.40%	1.72	1.72
	2023 年度	-14.08%	-0.82	-0.82
	2022 年度	-17.11%	-1.41	-1.41

九、经营成果分析

（一）经营成果概览

报告期内，公司经营成果的总体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	80,562.15	78,862.99	27,579.31	21,439.06
营业成本	32,914.25	28,681.46	10,894.88	12,089.87
毛利率	59.14%	63.63%	60.50%	43.61%
营业利润	9,790.58	14,170.66	-5,886.67	-3,680.01
利润总额	9,763.42	14,099.13	-5,678.03	-3,789.52
归属于母公司股东的净利润	9,664.30	14,049.48	-5,539.38	-3,807.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9,293.49	13,209.65	-6,270.36	-2,745.79
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（不考虑股份支付影响）	12,583.47	17,495.49	-1,752.02	-109.53

报告期内，公司营业收入分别为 21,439.06 万元、27,579.31 万元、78,862.99 万元和 80,562.15 万元，保持高速增长趋势，2022-2024 年度营业收入复合增长率为 91.79%，主要得益于光通信及半导体等下游应用领域市场需求持续强劲、高端测试仪器设备国产替代进程提速、公司核心产品性能持续突破并获得境内外优质客户广泛认可、产品线不断丰富并持续拓宽应用场景等因素。

2022 年、2023 年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为负，主要系公司期间费用较高所致：一方面，公司为充分调动员工积极性实施了多轮股权激励，

报告期内确认了较大规模的股份支付费用；另一方面，公司为不断缩小与国际头部厂商的差距，报告期内保持了持续高强度的研发投入，研发费用持续提升。

报告期内，公司所处行业市场需求呈现强劲增长态势，一方面，受益于人工智能技术发展及全球算力需求提升，数据中心建设进程加速，带动高速光通信产品需求持续高速增长，光模块及光芯片厂商扩产意愿强烈，进而推动公司通信测试仪器产品及光电子器件测试设备产品的市场需求快速增长；另一方面，伴随全球新能源汽车普及加速，碳化硅功率器件产业化进程提速，驱动公司功率器件测试设备产品的市场需求显著提升。面对市场机遇，公司依托多年持续的研发投入与技术积淀，成功完成相关产品线的战略布局，并在核心产品性能上实现关键突破，能够有效满足客户日益提升的测试需求。因此，公司营业收入实现大幅增长，2024 年度及 2025 年 1-9 月均实现盈利。

（二）营业收入分析

1、营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	79,665.55	98.89%	78,325.06	99.32%	26,919.95	97.61%	21,220.59	98.98%
其他业务	896.60	1.11%	537.93	0.68%	659.36	2.39%	218.47	1.02%
合计	80,562.15	100.00%	78,862.99	100.00%	27,579.31	100.00%	21,439.06	100.00%

单位：万元

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务，主营业务收入占营业收入的比例保持在 97%以上，主营业务突出。公司其他业务收入主要为原材料销售，占营业收入的比重较小。

2、主营业务收入构成及变动分析

报告期内，公司主营业务收入按业务类别列示如下：

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子测量仪器	34,304.88	43.06%	37,759.06	48.21%	15,410.89	57.25%	6,807.50	32.08%
半导体测试设备	39,847.44	50.02%	35,377.66	45.17%	9,582.66	35.60%	12,329.10	58.10%

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
测试部件	4,979.37	6.25%	4,786.46	6.11%	1,631.53	6.06%	1,621.97	7.64%
其他	533.86	0.67%	401.88	0.51%	294.87	1.10%	462.02	2.18%
合计	79,665.55	100.00%	78,325.06	100.00%	26,919.95	100.00%	21,220.59	100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要来源于电子测量仪器、半导体测试设备及配套测试部件的销售收入；其他主要系租赁、延保、维修升级等服务收入。

（1）电子测量仪器

报告期内，公司电子测量仪器收入按产品线列示如下：

单位：万元

电子测量仪器	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
通信测试仪器	33,086.83	96.45%	36,566.42	96.84%	14,510.66	94.16%	6,365.97	93.51%
电性能测试仪器	1,218.05	3.55%	1,192.64	3.16%	900.23	5.84%	441.53	6.49%
合计	34,304.88	100.00%	37,759.06	100.00%	15,410.89	100.00%	6,807.50	100.00%

1) 通信测试仪器

报告期内，公司通信测试仪器收入按细分产品列示如下：

单位：万元

通信测试仪器	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
采样示波器	20,689.35	62.53%	17,560.22	48.02%	2,254.25	15.54%	2,474.08	38.86%
时钟恢复单元	6,671.08	20.16%	10,560.18	28.88%	7,300.57	50.31%	965.67	15.17%
误码分析仪	3,064.98	9.26%	5,848.65	15.99%	2,518.95	17.36%	1,357.93	21.33%
其他	2,661.42	8.04%	2,597.38	7.10%	2,436.88	16.79%	1,568.29	24.64%
合计	33,086.83	100.00%	36,566.42	100.00%	14,510.66	100.00%	6,365.97	100.00%

细分产品来看，采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪作为光通信领域核心测试仪器，构成公司通信测试仪器收入的主要组成部分。报告期内，上述三款主要产品合计收入分别为 4,797.68 万元、12,073.77 万元、33,969.04 万元和 30,425.40 万元，呈现快速增长趋势，且占通信测试仪器收入的比例持续提高。

报告期内，公司通信测试仪器主要细分产品的销量、单价以及销售收入变动情况如

下：

产品名称	项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
采样示波器	销售收入（万元）	20,689.35	17,560.22	2,254.25	2,474.08
	销量（台）	739	707	119	214
	单价（万元/台）	28.00	24.84	18.94	11.56
时钟恢复单元	销售收入（万元）	6,671.08	10,560.18	7,300.57	965.67
	销量（台）	859	977	447	94
	单价（万元/台）	7.77	10.81	16.33	10.27
误码分析仪	销售收入（万元）	3,064.98	5,848.65	2,518.95	1,357.93
	销量（台）	447	819	369	169
	单价（万元/台）	6.86	7.14	6.83	8.04

整体而言，报告期内，公司通信测试仪器主要细分产品的销售收入均呈现快速增长态势，主要系 AI 算力资本支出拉动高速光通信产品需求持续高速增长，光模块厂商 400G、800G、1.6T 高速光模块的扩产需求旺盛；公司紧握行业发展机遇，加速突破核心产品性能，面向 400G、800G、1.6T 高速光模块测试需求的 800Gbps/1.6Tbps 误码分析仪、56GBaud/120GBaud 时钟恢复单元、50GHz/65GHz 采样示波器等高速测试仪器报告期内陆续通过行业各头部客户验证并获取批量订单，带动相关产品的销量和收入大幅增长。

①采样示波器

报告期内，公司采样示波器收入整体呈快速增长趋势，2023年略有波动主要受销量影响所致。

2023年度，公司采样示波器销量有所下降，主要原因系2023年AI算力资本支出拉动的需求集中于高速光模块上，低速市场需求疲软，产业内主要围绕400G、800G高速光模块扩产。因产品复杂程度较高，采样示波器产品的研发周期相对较长，公司50GHz采样示波器产品于2023年下半年起陆续通过大客户验证并获取批量订单，其销售收入贡献当期未能充分释放。2024年以来，大客户持续放量采购公司50GHz采样示波器产品，带动销量持续增长。

价格方面，报告期内，公司采样示波器单价持续增长，主要系细分产品结构变动，单价较高的50GHz产品的收入占比持续提升所致。

②时钟恢复单元

2022-2024年度，公司时钟恢复单元收入高速增长，主要系下游市场需求旺盛，公司56GBaud时钟恢复单元等高速产品销量大幅提升所致。

价格方面，2023年度，公司时钟恢复单元单价较上年同期有所增长，主要系细分产品结构变动，单价较高的56GBaud产品的收入占比持续提升。2024年度、2025年1-9月，公司时钟恢复单元单价有所下降，主要系为进一步助力下游客户降低测试成本、提高测试效率，公司通过优化方案架构、核心器件国产导入等方式开发了新版本产品，在持续提高产品性能的基础上进一步降低了产品成本，公司同步下调产品价格让利客户。

③误码分析仪

2022-2024年度，公司误码分析仪收入高速增长，主要系下游市场需求旺盛，公司800Gbps误码分析仪等高速产品销量大幅提升所致。

2) 电性能测试仪器

公司电性能测试仪器主要包括精密源表及低漏电开关矩阵，主要用于半导体、光通信、新能源等领域的高精度电学测试。报告期内，公司电性能测试仪器收入分别为 441.53 万元、900.23 万元、1,192.64 万元和 1,218.05 万元，保持持续增长，主要系公司持续扩宽产品型号并加大市场开拓力度，使得相关产品迅速打开市场。

(2) 半导体测试设备

报告期内，公司半导体测试设备收入按产品线列示如下：

半导体测试设备	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
光电子器件测试设备	25,736.56	64.59%	14,887.45	42.08%	4,040.47	42.16%	12,228.22	99.18%
功率器件测试设备	13,066.64	32.79%	19,317.65	54.60%	5,378.48	56.13%	-	-
电性能测试设备	1,044.25	2.62%	1,172.57	3.31%	163.72	1.71%	100.88	0.82%
合计	39,847.44	100.00%	35,377.66	100.00%	9,582.66	100.00%	12,329.10	100.00%

单位：万元

1) 光电子器件测试设备

报告期内，公司光电子器件测试设备收入按细分产品列示如下：

单位：万元

光电子器件测试设备	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
CoC 光芯片老化系统	9,410.32	36.56%	5,587.27	37.53%	2,311.70	57.21%	4,562.90	37.31%
光芯片 KGD 分选测试系统	7,053.03	27.40%	4,536.61	30.47%	138.05	3.42%	4,094.81	33.49%
硅光晶圆测试系统	4,597.45	17.86%	504.42	3.39%	-	-	-	-
其他	4,675.77	18.17%	4,259.14	28.61%	1,590.71	39.37%	3,570.51	29.20%
合计	25,736.56	100.00%	14,887.45	100.00%	4,040.47	100.00%	12,228.22	100.00%

细分产品来看，公司光电子器件测试设备主要包括 CoC 光芯片老化系统和光芯片 KGD 分选测试系统，分别用于光芯片的 CoC 封装级老化测试和裸芯片级分选测试，两款产品报告期各期在光电子器件测试设备中的收入占比均超过 60%；硅光晶圆测试系统主要面向新一代光通信技术硅光芯片的测试需求，用于在晶圆层面对硅光芯片进行测试与筛选，该产品已于 2024 年度实现收入；其他主要系配套 CoC 光芯片老化系统组合使用的 CoC 光芯片测试与上下料系统等。

报告期内，公司光电子器件测试设备主要细分产品的销量、单价以及销售收入的变动情况如下：

产品名称	项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
CoC 光芯片老化系统	销售收入（万元）	9,410.32	5,587.27	2,311.70	4,562.90
	销量（层）	862	617	163	424
	单价（万元/层）	10.92	9.06	14.18	10.76
光芯片 KGD 分选测试系统	销售收入（万元）	7,053.03	4,536.61	138.05	4,094.81
	销量（台）	35	19	1	34
	单价（万元/台）	201.52	238.77	138.05	120.44
硅光晶圆测试系统	销售收入（万元）	4,597.45	504.42	-	-
	销量（台）	23	3	-	-
	单价（万元/台）	199.89	168.14	-	-

报告期内，公司CoC光芯片老化系统、光芯片KGD分选测试系统等光电子器件测试设备收入存在一定波动，且两款产品变动趋势整体一致。公司光电子器件测试设备主要用于光芯片的各类光学和电学性能测试，暂不涉及信号测试，可兼容不同速率的光芯片测试需求，因此该等设备的销售情况主要受下游市场整体需求影响；2022年下半年至2023年上半年期间，受到电信市场疲软等因素的影响，光模块市场增速达到阶段低点，

市场需求出现结构分化，虽然高速光模块需求呈现增长趋势，但光通信行业整体需求较为低迷，业内企业整体扩产需求放缓，因此公司2023年度光电子器件测试设备的销量和收入大幅下滑。2024年度及2025年1-9月，随着高速光模块需求的持续增长，下游客户新增产能需求回暖，同时公司持续加大海外市场及新客户开拓力度，光电子器件测试设备销量和收入企稳回升。

价格方面，2023年度及2025年1-9月，公司CoC光芯片老化系统产品单价相对较高，主要系该产品当期境外销售比例相对较高，向境外客户销售的产品配置要求和单价更高；2024年度及2025年1-9月，光芯片KGD分选测试系统产品单价相对较高，主要系当期销售的产品以新升级迭代的型号为主；2025年1-9月，硅光晶圆测试系统单价有所增长，主要系产品迭代升级所致。

2) 功率器件测试设备

报告期内，公司功率器件测试设备收入按细分产品列示如下：

单位：万元

功率器件测试设备	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
晶圆级老化系统	8,542.42	65.38%	14,609.39	75.63%	3,312.33	61.58%	-	-
功率芯片 KGD 分选测试系统	4,186.93	32.04%	3,672.46	19.01%	1,791.81	33.31%	-	-
其他	337.29	2.58%	1,035.80	5.36%	274.34	5.10%	-	-
合计	13,066.64	100.00%	19,317.65	100.00%	5,378.48	100.00%	-	-

细分产品来看，公司功率器件测试设备主要包括晶圆级老化系统和功率芯片 KGD 分选测试系统，分别用于功率芯片裂片前的晶圆级老化测试和裂片后的裸芯片 KGD 分选测试，均系材料特性及终端应用场景高可靠性要求而新增的测试环节；其他主要系配套上述两款产品组合使用的晶圆和芯片上下料系统。

报告期内，公司功率器件测试设备主要细分产品的销量、单价以及销售收入的变动情况如下：

产品名称	项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
晶圆级老化系统	销售收入（万元）	8,542.42	14,609.39	3,312.33	-
	销量（层）	67	112	22	-
	单价（万元/层）	127.50	130.44	150.56	-

产品名称	项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
功率芯片 KGD 分选测试系统	销售收入（万元）	4,186.93	3,672.46	1,791.81	-
	销量（台）	12	9	5	-
	单价（万元/台）	348.91	408.05	358.36	-

公司依托在老化测试和裸芯片分选测试领域的技术积淀，面向车规级应用场景下功率芯片与日俱增的可靠性、安全性、稳定性的严苛要求，针对性地推出晶圆级老化系统、功率芯片KGD分选测试系统，拓展功率器件测试业务版图，两款产品均于2023年实现产业化应用。2024年以来，伴随全球新能源汽车普及加速，碳化硅功率器件产业化进程提速，下游客户加速扩产，进而带动公司功率器件测试设备产品的销量和收入大幅增长。

价格方面，2024年度及2025年1-9月，公司晶圆级老化系统单价较2023年度有所下降，主要系部分大客户批量采购单价相对较低所致；2024年度，公司功率芯片KGD分选测试系统单价相对较高，主要得益于公司国际化战略部署，公司不断加大海外市场及新客户开拓力度，成功导入境外大客户并实现批量订单销售所致。

3）电性能测试设备

公司电性能测试设备主要包括 WAT 测试机、晶圆级可靠性测试系统，主要用于晶圆级电性能测试和可靠性测试。报告期内，公司电性能测试设备收入分别为 100.88 万元、163.72 万元、1,172.57 万元和 1,044.25 万元，2024 年度及 2025 年 1-9 月均实现同比大幅增长，主要系公司持续扩宽产品型号并实现客户导入所致。

（3）测试部件

报告期内，公司测试部件收入分别为 1,621.97 万元、1,631.53 万元、4,786.46 万元和 4,979.37 万元，主要包括夹具、探针卡、夹具板等，均系测试仪器设备配套使用，其收入变动趋势与公司主营业务收入基本一致。

3、主营业务收入地区分布分析

报告期内，公司主营业务收入地区分布如下：

单位：万元

项目		2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	华南	16,451.14	20.65%	23,253.77	29.69%	7,542.47	28.02%	2,221.29	10.47%

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东	19,002.53	23.85%	19,963.59	25.49%	9,623.02	35.75%	8,729.17	41.14%
华中	8,659.16	10.87%	12,744.77	16.27%	4,188.64	15.56%	3,945.41	18.59%
西南	8,211.06	10.31%	8,747.18	11.17%	1,263.28	4.69%	1,679.40	7.91%
其他	1,378.23	1.73%	1,954.97	2.50%	1,835.07	6.82%	1,772.46	8.35%
小计	53,702.11	67.41%	66,664.27	85.11%	24,452.47	90.83%	18,347.73	86.46%
境外	25,963.44	32.59%	11,660.79	14.89%	2,467.48	9.17%	2,872.86	13.54%
合计	79,665.55	100.00%	78,325.06	100.00%	26,919.95	100.00%	21,220.59	100.00%

报告期内，公司主营业务收入以境内收入为主，报告期各期境内收入占主营业务收入比例分别为 86.46%、90.83%、85.11%和 67.41%。与此同时，公司持续推进国际化战略部署，不断加大全球市场开拓力度，成功导入 Lumentum、日本住友、ONSEMI、日本古河、Power Master 等全球知名客户并实现批量订单销售，2024 年度及 2025 年 1-9 月的境外收入均实现同比大幅增长。

4、主营业务收入销售模式分类分析

报告期内，公司主营业务收入按照不同销售模式构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	70,949.50	89.06%	71,280.34	91.01%	24,923.05	92.58%	17,747.81	83.63%
经销	8,716.05	10.94%	7,044.72	8.99%	1,996.90	7.42%	3,472.77	16.37%
合计	79,665.55	100.00%	78,325.06	100.00%	26,919.95	100.00%	21,220.59	100.00%

报告期内，公司主营业务收入以直销收入为主，经销收入占比相对较低。

5、主营业务收入季节波动分析

报告期内，公司主营业务收入按季节划分如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	19,972.53	25.07%	7,872.92	10.05%	2,857.66	10.62%	2,166.23	10.21%
第二季度	29,134.48	36.57%	19,768.25	25.24%	3,514.31	13.05%	6,537.04	30.81%

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第三季度	30,558.53	38.36%	23,972.90	30.61%	9,134.35	33.93%	3,674.79	17.32%
第四季度	-	-	26,710.99	34.10%	11,413.62	42.40%	8,842.53	41.67%
合计	79,665.55	100.00%	78,325.06	100.00%	26,919.95	100.00%	21,220.59	100.00%

报告期内，公司主营业务收入呈现出一定的季节性特征，主要系公司所处行业特点决定，公司下游客户通常于年初确定资本支出计划，之后陆续开展采购、收货、验收等工作，导致公司下半年收入占比较高。

报告期内，公司收入季节性特征符合行业惯例，同行业可比公司普遍存在下半年收入占比相对较高的情形。

（三）营业成本分析

1、营业成本构成情况

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	32,307.62	98.16%	28,265.02	98.55%	10,399.80	95.46%	11,911.42	98.52%
其他业务	606.63	1.84%	416.43	1.45%	495.07	4.54%	178.46	1.48%
合计	32,914.25	100.00%	28,681.46	100.00%	10,894.88	100.00%	12,089.87	100.00%

报告期内，公司营业成本主要来自主营业务，营业成本规模及构成与营业收入相匹配。

2、主营业务成本的产品构成及变动分析

报告期内，公司主营业务成本按业务类别列示如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子测量仪器	8,106.45	25.09%	9,859.36	34.88%	5,081.61	48.86%	2,490.68	20.91%
半导体测试设备	21,563.30	66.74%	15,626.23	55.28%	4,337.93	41.71%	8,474.38	71.14%
测试部件	2,497.47	7.73%	2,509.09	8.88%	803.19	7.72%	877.30	7.37%

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他	140.40	0.43%	270.35	0.96%	177.08	1.70%	69.06	0.58%
合计	32,307.62	100.00%	28,265.02	100.00%	10,399.80	100.00%	11,911.42	100.00%

报告期内，公司主营业务成本变动趋势与主营业务收入变动趋势整体匹配，各业务类别占主营业务成本的比例与主营业务收入存在差异，主要系不同业务类别的毛利率存在差异所致。

3、主营业务成本的项目构成及变动分析

报告期内，公司主营业务成本的项目构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	19,947.14	61.74%	17,092.16	60.47%	7,002.41	67.33%	7,582.53	63.66%
直接人工	583.88	1.81%	531.65	1.88%	178.77	1.72%	125.69	1.06%
制造费用	5,340.07	16.53%	3,848.12	13.61%	1,273.46	12.25%	1,241.33	10.42%
外协费用	5,202.11	16.10%	5,618.22	19.88%	1,541.36	14.82%	2,643.56	22.19%
售后服务费	1,234.41	3.82%	1,174.88	4.16%	403.80	3.88%	318.31	2.67%
合计	32,307.62	100.00%	28,265.02	100.00%	10,399.80	100.00%	11,911.42	100.00%

报告期内，公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用、外协费用和售后服务费构成。其中，直接材料主要为电子元器件、标准件、电气类、机加钣金件等材料采购，直接人工主要为生产人员的职工薪酬，制造费用包括交付人员与产线管理人员的职工薪酬、设备折旧费用等，外协费用主要为公司向外协厂商采购设备基础装配、PCBA贴片、夹具加工等服务费用，售后服务费主要为预提的保证类质保费用。

报告期内，公司主营业务成本项目构成变动与产品销售结构整体匹配，其中2023年主营业务成本构成中外协费用占比有所下降，主要原因系公司半导体测试设备包括设备基础装配和夹具加工等外协生产工序，其外协费用占比相对较高，2023年主营业务成本中半导体测试设备占比下降导致当期主营业务成本中外协费用占比下降；2025年1-9月主营业务成本构成中外协费用占比有所下降，主要系细分产品结构变动所致。

（四）毛利及毛利率分析

1、营业毛利构成情况

报告期内，公司营业毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	47,357.93	99.39%	50,060.04	99.76%	16,520.14	99.02%	9,309.17	99.57%
其他业务	289.97	0.61%	121.50	0.24%	164.29	0.98%	40.02	0.43%
合计	47,647.90	100.00%	50,181.53	100.00%	16,684.43	100.00%	9,349.19	100.00%

报告期内，公司的营业毛利主要来自于主营业务，营业毛利规模及构成与营业收入相匹配。

2、主营业务毛利的产品构成及变动分析

报告期内，公司主营业务毛利按业务类别列示如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子测量仪器	26,198.43	55.32%	27,899.70	55.73%	10,329.28	62.53%	4,316.82	46.37%
半导体测试设备	18,284.14	38.61%	19,751.43	39.46%	5,244.74	31.75%	3,854.73	41.41%
测试部件	2,481.89	5.24%	2,277.37	4.55%	828.34	5.01%	744.67	8.00%
其他	393.46	0.83%	131.54	0.26%	117.78	0.71%	392.96	4.22%
合计	47,357.93	100.00%	50,060.04	100.00%	16,520.14	100.00%	9,309.17	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利整体呈增长趋势，主营业务毛利变动趋势与主营业务收入具有一致性，各业务类别占主营业务毛利的比例与主营业务收入存在差异，主要系不同业务类别的毛利率存在差异所致。

3、综合毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率及变动情况如下：

单位：%

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率	变动
主营业务	59.45	-4.47	63.91	2.55	61.37	17.50	43.87	43.87
其他业务	32.34	9.76	22.59	-2.33	24.92	6.60	18.32	18.32
合计	59.14	-4.49	63.63	3.14	60.50	16.89	43.61	43.61

2022-2024年度，公司综合毛利率持续提升，2025年1-9月，公司综合毛利率有所下降，主要系主营业务毛利率变动所致。

4、主营业务毛利率的产品构成及变动分析

报告期内，公司主营业务分业务类别及产品线的毛利率情况如下：

单位：%

业务类别	产品线	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
		毛利率	主营业务收入占比	毛利率	主营业务收入占比	毛利率	主营业务收入占比	毛利率	主营业务收入占比
电子测量仪器	通信测试仪器	76.74	41.53	74.25	46.69	67.82	53.90	66.41	30.00
	电性能测试仪器	66.23	1.53	62.86	1.52	54.26	3.34	20.19	2.08
半导体测试设备	光电子器件测试设备	38.19	32.31	40.19	19.01	36.80	15.01	31.24	57.62
	功率器件测试设备	60.60	16.40	67.91	24.66	67.89	19.98	-	-
	电性能测试设备	51.32	1.31	55.34	1.50	64.88	0.61	34.45	0.48
测试部件		49.84	6.25	47.58	6.11	50.77	6.06	45.91	7.64
其他		73.70	0.67	32.73	0.51	39.94	1.10	85.05	2.18
合计		59.45	100.00	63.91	100.00	61.37	100.00	43.87	100.00

2022-2024年度，公司主营业务毛利率持续提升，2025年1-9月公司主营业务毛利率有所下降，主要系产品结构变动、细分产品毛利率变动等综合影响所致，具体分析如下：

（1）业务类别结构变动的影响

根据各业务类别及产品线毛利率变动以及产品结构变动两个因素的影响，2023年度、2024年度以及2025年1-9月，采用连环替代法对公司主营业务毛利率的波动分析如下：

单位：%

业务类别	产品线	2025 年 1-9 月			2024 年度			2023 年度		
		产品毛利率变动影响	产品结构变动影响	合计	产品毛利率变动影响	产品结构变动影响	合计	产品毛利率变动影响	产品结构变动影响	合计
电子测量仪器	通信测试仪器	1.16	-3.95	-2.79	3.47	-5.36	-1.89	0.42	16.21	16.63
	电性能测试仪器	0.05	0.00	0.06	0.29	-1.14	-0.86	0.71	0.69	1.39
半导体测试设备	光电子器件测试设备	-0.38	5.08	4.70	0.51	1.61	2.12	3.21	-15.68	-12.48
	功率器件测试设备	-1.80	-5.01	-6.81	0.004	3.18	3.18	-	13.56	13.56
	电性能测试设备	-0.06	-0.10	-0.16	-0.06	0.49	0.43	0.14	0.09	0.23
测试部件		0.14	0.07	0.21	-0.19	0.02	-0.17	0.37	-0.80	-0.43
其他		0.21	0.12	0.33	-0.08	-0.19	-0.27	-0.98	-0.43	-1.41
合计		-0.68	-3.79	-4.47	3.94	-1.39	2.55	3.87	13.63	17.50

注：产品毛利率变动影响=（本期毛利率-上期毛利率）×上期收入占比；产品结构变动影响=（本期收入占比-上期收入占比）×本期毛利率。

2023 年度，公司主营业务毛利率大幅增长，主要系毛利率较高的通信测试仪器及功率器件测试设备的收入占比大幅提升所致；2024 年度，公司主营业务毛利率小幅增长，主要系通信测试仪器毛利率增长及功率器件测试设备的收入占比提升所致；2025 年 1-9 月，公司主营业务毛利率有所下降，主要系通信测试仪器及功率器件测试设备的收入占比下降所致。

（2）主要细分产品毛利率变动情况分析

报告期内，公司主营业务以采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪、CoC 光芯片老化系统、光芯片 KGD 分选测试系统、硅光晶圆测试系统、晶圆级老化系统及功率芯片 KGD 分选测试系统等核心产品为主，上述核心产品毛利贡献情况具体如下表所示：

单位：万元

产品线	细分产品	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
通信测量仪器	采样示波器	16,278.65	13,730.14	1,692.89	1,498.38
	时钟恢复单元	5,702.59	8,400.74	5,256.10	680.40
	误码分析仪	1,825.24	3,586.38	1,558.68	817.61
光电子器件测试设备	CoC 光芯片老化系统	2,990.54	1,668.75	1,004.38	1,645.82
	光芯片 KGD 分选测试系统	3,875.94	2,817.15	66.31	1,342.66
	硅光晶圆测试系统	1,705.24	213.72	-	-
功率器件测	晶圆级老化系统	5,391.56	10,404.22	2,375.25	-

产品线	细分产品	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
试设备	功率芯片 KGD 分选测试系统	2,443.70	2,370.55	1,205.85	-
核心产品合计		40,213.46	43,191.65	13,159.47	5,984.87
其他		7,144.47	6,868.39	3,360.67	3,324.30
主营业务毛利		47,357.93	50,060.04	16,520.14	9,309.17

报告期内，公司上述核心产品毛利率波动具体分析如下：

1) 采样示波器

报告期内，公司采样示波器产品的单价、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
单价（万元/台）	28.00	24.84	18.94	11.56
单位成本（万元/台）	5.97	5.42	4.72	4.56
毛利率	78.68%	78.19%	75.10%	60.56%

报告期内，公司采样示波器产品毛利率持续增长，主要原因系面向高速光模块测试需求的 50GHz 采样示波器和 65GHz 采样示波器产品的销售占比持续提升，拉动采样示波器产品毛利率快速增长。

2) 时钟恢复单元

报告期内，公司时钟恢复单元产品的单价、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
单价（万元/台）	7.77	10.81	16.33	10.27
单位成本（万元/台）	1.13	2.21	4.57	3.03
毛利率	85.48%	79.55%	72.00%	70.46%

报告期内，公司时钟恢复单元产品毛利率持续增长。其中，2023 年度毛利率同比增长主要原因系面向高速光模块测试需求的 56GBaud 时钟恢复单元产品的销售占比提升，拉动整体毛利率增长所致；2024 年度及 2025 年 1-9 月毛利率持续增长主要系公司通过优化方案架构、核心器件国产导入等方式开发了新版本产品，在持续提高产品性能的基础上进一步降低了产品成本，并且新版本产品占比持续提升所致。

3) 误码分析仪

报告期内，公司误码分析仪产品的单价、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
单价（万元/台）	6.86	7.14	6.83	8.04
单位成本（万元/台）	2.77	2.76	2.60	3.20
毛利率	59.55%	61.32%	61.88%	60.21%

报告期内，公司误码分析仪产品毛利率整体相对稳定，单价与单位成本的变动主要系产品型号结构变动所致。

4) CoC 光芯片老化系统

报告期内，公司 CoC 光芯片老化系统产品的单价、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
单价（万元/台）	10.92	9.06	14.18	10.76
单位成本（万元/台）	7.45	6.35	8.02	6.88
毛利率	31.78%	29.87%	43.45%	36.07%

2023 年度，公司 CoC 光芯片老化系统毛利率有所增长，主要原因系该产品当期收入中境外大客户占比较高，向其销售的产品对标境外同类竞品，配置要求和附加值较高；2024 年度及 2025 年 1-9 月，公司 CoC 光芯片老化系统毛利率较往期有所下降，主要系公司为获取大客户批量订单，适当调低售价所致。

5) 光芯片 KGD 分选测试系统

报告期内，公司光芯片 KGD 分选测试系统产品的单价、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
单价（万元/台）	201.52	238.77	138.05	120.44
单位成本（万元/台）	90.77	90.50	71.74	80.95
毛利率	54.95%	62.10%	48.03%	32.79%

2023 年度，公司光芯片 KGD 分选测试系统产品毛利率有所增长，主要原因系该产品 2022 年度大客户批量采购单价相对较低，拉低上年同期毛利率；2024 年度，公司光芯片 KGD 分选测试系统产品毛利率有所增长，主要系当期销售以最新升级的新型号为主，其配置及附加值相对较高；2025 年 1-9 月，公司光芯片 KGD 分选测试系统毛利率有所下降，主要系当期大客户批量采购单价相对较低所致。

6) 硅光晶圆测试系统

报告期内，公司硅光晶圆测试系统产品的单价、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
单价（万元/台）	199.89	168.14	-	-
单位成本（万元/台）	125.75	96.90	-	-
毛利率	37.09%	42.37%	-	-

2025 年 1-9 月，公司硅光晶圆测试系统毛利率有所下降，系受到单价与单位成本变动综合影响，其中，产品单价有所增长，主要原因系当期销售以境外为主，且配置与性能更高的升级型号 sCT9002 系列于当期实现销售，相关产品定价相对较高，拉高整体单价水平；单位成本亦有所增长，主要系外销产品以及新型号产品的配置及交付成本相对较高，且 2024 年该产品处于转产初期成本尚未稳定所致。

7) 晶圆级老化系统

报告期内，公司晶圆级老化系统产品的单价、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
单价（万元/台）	127.50	130.44	150.56	-
单位成本（万元/台）	47.03	37.55	42.59	-
毛利率	63.12%	71.22%	71.71%	-

2024 年度，公司晶圆级老化系统产品毛利率相对稳定，单价有所下降主要系当期大客户批量采购价格相对较低所致，单位成本有所下降主要系公司优化产品物料方案所致。2025 年 1-9 月，公司晶圆级老化系统毛利率有所下降，主要原因系公司为加快产品市场推广及客户导入适当调低产品定价；单位成本有所提高，主要系新一代产品 WLBI3800 以及 WLBI370A 系列均于当期实现销售，该等系列产品配置较高。

8) 功率芯片 KGD 分选测试系统

报告期内，公司功率芯片 KGD 分选测试系统产品的单价、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
单价（万元/台）	348.91	408.05	358.36	-
单位成本（万元/台）	145.27	144.66	117.19	-
毛利率	58.36%	64.55%	67.30%	-

2024 年度，公司功率芯片 KGD 分选测试系统产品毛利率略有下降，系受到单价与单位成本变动综合影响，其中，产品单价有所增长，主要原因系公司当期成功导入境外大客户并实现批量订单，产品定价相对较高；单位成本亦有所增长，主要系外销产品的配置及交付成本相对较高，且 2023 年该产品处于转产初期成本尚未稳定所致。2025 年 1-9 月，公司功率芯片 KGD 分选测试系统产品毛利率有所下降，主要原因系公司为加快产品市场推广及客户导入适当调低产品定价。

（3）测试部件毛利率变动情况分析

报告期内，公司测试部件主要细分产品毛利率及其收入占比具体如下：

单位：%

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	毛利率	测试部件收入占比	毛利率	测试部件收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	测试部件收入占比
夹具	45.73	51.38	40.30	64.82	41.02	47.02	49.63	73.14
探针卡	56.57	26.18	64.95	22.83	71.37	28.01	-	-
其他	51.42	22.44	53.66	12.35	46.03	24.97	35.79	26.86
合计	49.84	100.00	47.58	100.00	50.77	100.00	45.91	100.00

2023年度，公司测试部件毛利率有所增长，主要原因系公司当期新推出晶圆级老化系统，其配套使用的测试部件探针卡的毛利率相对较高，拉高整体毛利率；2024年度，公司测试部件毛利率有所下降，主要原因系探针卡收入占比及毛利率均有所下降；2025 年1-9月，公司测试部件毛利率有所提升，主要原因系：一方面，当期夹具的外销收入占比有所增长；另一方面，毛利率相对较高的探针卡收入占比有所提升，带动整体毛利率增长。

5、同行业可比公司毛利率对比

报告期内，从可比性出发，选取普源精电与鼎阳科技的综合毛利率作为公司电子测量仪器业务毛利率的可比对象；选取华峰测控、长川科技、联动科技的综合毛利率，以及广立微的测试机与配件毛利率作为公司半导体测试设备毛利率的可比对象。具体对比如下：

单位：%

业务类别	公司简称	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
电子测量仪器	普源精电	55.00	59.14	56.45	52.39

业务类别	公司简称	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
	鼎阳科技	61.13	61.07	61.30	57.54
	行业均值	58.06	60.11	58.87	54.97
	联讯仪器	76.37	73.89	67.03	63.41
半导体测试设备	华峰测控	74.30	73.31	72.47	76.88
	长川科技	54.48	54.85	57.06	56.75
	联动科技	55.92	56.39	61.86	65.40
	广立微	未披露	52.07	51.89	53.76
	行业均值	61.57	59.16	60.82	63.19
	联讯仪器	45.89	55.83	54.73	31.27

注1：上述同行业可比公司数据出自其定期报告，下同；

注2：广立微2025年三季度报告未单独披露测试机与配件毛利率。

电子测量仪器方面，报告期内，公司电子测量仪器毛利率整体高于同行业可比公司，主要系两方面原因所致：一方面，公司电子测量仪器为通信测试仪器和电性能测试仪器，主要面向光通信领域和半导体集成电路领域的测试需求，产品应用场景与同行业可比公司存在差异；另一方面，公司采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪等电子测量仪器产品直接对标国际竞品，稀缺性显著，市场竞争优势突出。

半导体测试设备方面，报告期内，公司半导体测试设备毛利率变动趋势与同行业可比公司存在一定差异，2022-2024年度，公司半导体测试设备毛利率持续增长，主要系公司面向车规级应用场景下功率芯片日益严苛的可靠性要求，针对性地推出功率器件测试设备等高附加值产品线，其收入规模及占比持续增长，推动整体毛利率持续提升；2025年1-9月，公司半导体测试设备毛利率有所下降，主要系细分产品结构变动，当期光电子器件测试设备收入规模及占比有所提高，导致半导体测试设备毛利率整体有所下降。报告期各期，公司半导体测试设备毛利率低于行业均值，主要系两方面原因所致：一方面，公司将核心资源集中于产品开发和技术创新，对于设备基础装配、PCBA贴片、夹具加工等非核心环节采取外协方式进行生产，导致公司外协费用占比高于同行业可比公司；另一方面，公司产品线覆盖较广但单项产品规模相对较小，规模效应尚未充分显现。报告期各期，公司半导体测试设备毛利率均低于华峰测控，主要系其产品结构相对集中且销售规模较大，规模效应更为显著。

（五）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	5,594.15	6.94%	5,221.08	6.62%	3,252.91	11.79%	1,920.62	8.96%
管理费用	10,590.30	13.15%	10,474.06	13.28%	8,012.52	29.05%	5,438.15	25.37%
研发费用	20,052.87	24.89%	19,143.44	24.27%	10,471.57	37.97%	5,357.28	24.99%
财务费用	-390.91	-0.49%	-45.42	-0.06%	-19.72	-0.07%	-86.08	-0.40%
合计	35,846.41	44.50%	34,793.17	44.12%	21,717.28	78.74%	12,629.98	58.91%

注：上表中占比为占同期营业收入的比例。

报告期内，公司期间费用合计金额分别为12,629.98万元、21,717.28万元、34,793.17万元及35,846.41万元，占当期营业收入的比例分别为58.91%、78.74%、44.12%及44.50%。

1、销售费用

（1）销售费用构成分析

报告期内，公司销售费用明细如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,178.15	38.94%	1,947.47	37.30%	1,203.02	36.98%	723.84	37.69%
差旅费	656.93	11.74%	913.98	17.51%	409.61	12.59%	191.23	9.96%
业务招待费	764.63	13.67%	796.93	15.26%	401.44	12.34%	336.50	17.52%
样机费	629.80	11.26%	730.32	13.99%	631.34	19.41%	498.00	25.93%
服务费	1,029.23	18.40%	524.70	10.05%	389.04	11.96%	105.86	5.51%
广告及业务宣传费	200.03	3.58%	167.91	3.22%	146.78	4.51%	22.39	1.17%
折旧与摊销	30.12	0.54%	14.10	0.27%	12.50	0.38%	18.62	0.97%
其他	105.26	1.88%	125.68	2.41%	59.18	1.82%	24.19	1.26%
合计	5,594.15	100.00%	5,221.08	100.00%	3,252.91	100.00%	1,920.62	100.00%

报告期各期，公司销售费用分别为1,920.62万元、3,252.91万元、5,221.08万元和5,594.15万元，占营业收入比例分别为8.96%、11.79%、6.62%和6.94%，主要由职工薪酬、样机费、业务招待费、差旅费和服务费等构成，随着公司销售规模增长，职工薪酬、样机费、业务招待费、差旅费和服务费相应增加。

（2）同行业可比公司对比分析

公司销售费用率与同行业可比公司对比如下：

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
普源精电	15.14%	13.22%	15.75%	16.64%
鼎阳科技	15.41%	17.73%	15.50%	14.42%
长川科技	4.94%	5.60%	8.80%	6.57%
华峰测控	12.33%	14.19%	16.49%	9.17%
联动科技	17.26%	15.45%	20.23%	9.96%
广立微	8.34%	8.38%	8.12%	8.34%
行业平均值	12.24%	12.43%	14.15%	10.85%
行业平均值（不含股份支付）	未披露	12.33%	13.67%	10.00%
联讯仪器	6.94%	6.62%	11.79%	8.96%

报告期内，公司销售费用率低于同行业可比公司，主要系公司与同行业可比公司在销售模式、产品应用场景等方面存在差异所致，其中2024年度公司销售费用率低于行业平均水平，主要原因系得益于前期良好的产品线布局和客户拓展，公司主要产品已完成行业主流客户的前期导入验证，存量客户需求放量，带动营业收入快速增长，规模效应凸显。

2、管理费用

（1）管理费用构成分析

报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	3,995.75	37.73%	3,743.62	35.74%	1,916.45	23.92%	963.70	17.72%
股份支付	3,289.98	31.07%	4,436.67	42.36%	4,845.42	60.47%	3,943.74	72.52%
服务费	989.93	9.35%	702.17	6.70%	537.09	6.70%	253.66	4.66%
租赁及物业费	505.43	4.77%	506.77	4.84%	130.74	1.63%	64.72	1.19%
办公费	612.82	5.79%	322.23	3.08%	125.36	1.56%	41.59	0.76%
差旅费	482.65	4.56%	293.44	2.80%	280.82	3.50%	86.30	1.59%
业务招待费	149.17	1.41%	211.64	2.02%	57.66	0.72%	31.10	0.57%

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
折旧与摊销	462.78	4.37%	207.98	1.99%	87.49	1.09%	36.63	0.67%
其他	101.78	0.96%	49.53	0.47%	31.50	0.39%	16.72	0.31%
合计	10,590.30	100.00%	10,474.06	100.00%	8,012.52	100.00%	5,438.15	100.00%

报告期各期，公司管理费用分别为5,438.15万元、8,012.52万元、10,474.06万元和10,590.30万元，占营业收入比例分别为25.37%、29.05%、13.28%和13.15%，主要由职工薪酬和股份支付等构成，其中职工薪酬增加主要系公司业务规模增长，管理人员数量相应增加所致；股份支付为公司历史上实施过多次股权激励计划，公司依据《企业会计准则第11号——股份支付》确认股份支付费用，并全部计入管理费用。

（2）同行业可比公司对比分析

公司管理费用率与同行业可比公司对比如下：

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
普源精电	11.73%	13.23%	9.50%	10.24%
鼎阳科技	3.40%	5.21%	4.26%	3.96%
长川科技	7.37%	8.54%	12.61%	8.05%
华峰测控	4.83%	6.40%	7.89%	5.71%
联动科技	12.68%	12.06%	11.63%	7.65%
广立微	9.28%	7.79%	8.02%	7.30%
行业平均值	8.21%	8.87%	8.99%	7.15%
行业平均值（不含股份支付）	未披露	8.57%	8.64%	6.31%
联讯仪器	13.15%	13.28%	29.05%	25.37%
联讯仪器（不含股份支付）	9.06%	7.66%	11.48%	6.97%

剔除股份支付影响，2022年度、2024年度以及2025年1-9月，公司管理费用率与行业平均水平基本相当；2023年度，公司管理费用率高于同行业平均水平，主要原因系公司当期为满足业务规模增长需要增加管理人员人数，而当期收入未能充分释放，进而导致管理费用率较高。

3、研发费用

（1）研发费用构成及变动分析

报告期内，公司研发费用明细如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	10,846.06	54.09%	10,740.88	56.11%	5,463.76	52.18%	2,789.76	52.07%
材料费	6,108.15	30.46%	5,054.39	26.40%	3,199.97	30.56%	1,778.86	33.20%
专业服务费	1,148.25	5.73%	1,630.88	8.52%	764.68	7.30%	324.47	6.06%
折旧与摊销	841.81	4.20%	602.96	3.15%	216.12	2.06%	133.40	2.49%
差旅费	446.11	2.22%	550.50	2.88%	335.87	3.21%	90.30	1.69%
租赁及物业费	356.70	1.78%	370.09	1.93%	382.87	3.66%	160.57	3.00%
其他	305.80	1.52%	193.74	1.01%	108.30	1.03%	79.92	1.49%
合计	20,052.87	100.00%	19,143.44	100.00%	10,471.57	100.00%	5,357.28	100.00%

公司通过技术创新与持续研发保持核心竞争力，报告期内，公司研发费用分别为5,357.28万元、10,471.57万元、19,143.44万元和20,052.87万元，占营业收入的比例分别为24.99%、37.97%、24.27%和24.89%。报告期内，公司的研发费用主要由职工薪酬、材料费、专业服务费构成，合计占比始终超过90%。

报告期内，公司研发费用中职工薪酬分别为2,789.76万元、5,463.76万元、10,740.88万元和10,846.06万元，职工薪酬增长明显，一方面系公司大力开展研发活动，持续推进新技术和新产品的发展，研发人员数量逐期增长；同时，公司高度重视研发团队建设，报告期内持续引入优秀研发人员，并随着研发人员技术水平的提升，为其匹配相应的薪酬。

报告期内，公司研发费用中材料费分别为1,778.86万元、3,199.97万元、5,054.39万元和6,108.15万元，材料费持续增长，主要系报告期内随着公司研发项目数量的增加和复杂程度的提升，研发所需物料相应增加所致。

报告期内，公司研发费用中专业服务费用分别为324.47万元、764.68万元、1,630.88万元和1,148.25万元，专业服务费用金额有所增长主要系公司为加快产品研发进度，出于经济效益考虑和时间因素考虑，委托部分企业、高校进行研发所致。

（2）同行业可比公司对比分析

报告期内，剔除股份支付费用后，公司与同行业可比公司研发投入率对比如下：

公司简称	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
普源精电	28.43%	24.90%	20.35%	16.34%

公司简称	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
鼎阳科技	22.49%	21.94%	17.61%	14.11%
长川科技	18.81%	27.15%	43.43%	24.49%
华峰测控	19.40%	18.74%	18.28%	9.33%
联动科技	33.59%	37.77%	36.83%	17.47%
广立微	53.68%	47.72%	40.90%	32.17%
行业均值	29.40%	29.70%	29.57%	18.99%
行业均值（不含广立微）	24.54%	26.10%	27.30%	16.35%
联讯仪器	24.89%	24.27%	37.97%	24.99%

注 1：2022-2024 年同行业可比公司研发投入率均扣除股份支付，研发投入率=（研发投入-研发投入中的股份支付）/营业收入；2025 年 1-9 月同行业可比公司未披露研发费用中股份支付金额、未披露研发投入资本化金额，故 2025 年 1-9 月同行业可比公司研发投入率=研发费用/营业收入。

注 2：同行业可比公司中广立微的主营业务还包括 EDA 软件，研发投入率较高，故在计算行业均值时将其剔除。

公司高度重视技术创新，持续投入大量研发资金。2022-2023年度，公司的研发投入率高于同行业可比公司（不含广立微）的平均水平，主要原因系公司高度重视研发活动，研发投入规模较大，但报告期早期公司整体销售规模尚未释放，据此计算的研发投入率较高；2024年度及2025年1-9月，随着公司收入规模持续增长，公司研发投入率与同行业可比公司（不含广立微）的平均水平已基本一致。

（3）研发项目具体情况

报告期内，公司累计研发投入金额前十大的研发项目情况如下：

单位：万元

序号	研发项目	整体预算	报告期投入金额	截至报告期末研发进度
1	项目一	20,000.00	9,627.48	在研
2	宽频带取样示波器项目	3,289.00	2,373.16	在研
3	功率芯片 KGD 测试分选系统项目	2,400.00	2,333.06	在研
4	WAT6600 半导体参数测试系统项目	2,860.00	2,275.59	在研
5	通用级可靠性测试系统项目	2,700.00	2,033.38	在研
6	晶圆级 8 英寸全自动老化系统项目	2,110.40	1,502.70	已完成
7	晶圆级半导体参数测试系统项目	1,450.00	1,438.38	已完成
8	晶圆级 8 英寸 9 工位全自动老化系统项目	2,885.00	1,417.54	在研
9	HPB 测试分选系统项目	2,650.00	1,350.57	在研
10	ATE FT 中速测试机	1,500.00	1,308.90	在研

4、财务费用

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
利息支出	139.80	39.26	20.41	20.15
减：利息收入	555.41	98.71	137.79	17.69
汇兑净损失	4.15	-5.54	80.74	-96.57
银行手续费等	20.55	19.56	16.91	8.03
合计	-390.91	-45.42	-19.72	-86.08

报告期各期，公司财务费用分别为-86.08万元、-19.72万元、-45.42万元和-390.91万元，其中2023年度利息收入增加主要系公司2022年末以来陆续收到股权融资款，银行存款及利息增加所致；2025年1-9月利息收入增加主要系公司美元存款结息所致。

（六）其他影响经营成果的主要项目分析

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加分别为 145.51 万元、115.96 万元、467.20 万元和 489.05 万元，主要包括城市维护建设税、教育费附加和印花税等。

2、其他收益

报告期内，公司其他收益金额分别为 300.38 万元、458.53 万元、685.99 万元和 261.53 万元，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
计入其他收益的政府补助	86.03	416.59	287.66	280.79
其中：与递延收益相关的政府补助	-	-	-	72.00
直接计入当期损益的政府补助	86.03	416.59	287.66	208.79
进项税加计扣除	156.67	263.61	131.84	-
个税扣缴税款手续费及其他	18.83	5.79	39.02	19.59
合计	261.53	685.99	458.53	300.38

报告期内，公司其他收益主要包括与日常活动相关的政府补助和进项税加计扣除。

公司与科研项目相关的政府补助情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	承担角色	实施周期	总预算金额	财政资助金额	报告期计入其他收益金额			
							2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
1	5G 通信用核心光电芯片与器件智能制造新模式项目	2018 年国家智能制造综合标准化与新模式应用项目	协作承担	2018.06-2020.12	180.00	144.00	-	72.00	-	72.00
2	集成化激光器阵列芯片测试装备关键技术研发项目	2022 年省科技计划专项资金（重点研发计划产业前瞻与关键核心技术）项目	牵头承担	2022.07-2025.06	650.00	180.00	-	-	-	-
3	宽频带取样示波器项目	国家重点研发计划“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”专项	牵头承担	2022.11-2025.10	4,926.00	1,926.00	-	-	-	-
4	项目一		牵头承担	2023.03-2026.03	20,000.00	8,000.00	-	-	-	-
5	半导体器件动态伏安特性参数综合测试仪项目	国家重点研发计划“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”专项	牵头承担	2023.12-2026.11	3,300.00	1,000.00	-	-	-	-

注：如公司为牵头承担单位，总预算金额为该研发项目总预算金额（包括其他协作承担单位的预算金额），财政资助金额包括政府机构对该研发项目的总资助金额（包含对其他协作承担单位的资助金额）；如公司为协作承担单位，总预算金额仅为公司应承担的该研发项目预算金额，财政资助金额仅包括政府机构对公司在该研发项目的总资助金额。

上述政府补助中，集成化激光器阵列芯片测试装备关键技术研发项目、宽频带取样示波器项目、项目一、半导体器件动态伏安特性参数综合测试仪项目政府补助已计入递延收益，报告期内尚未达到确认条件，未计入其他收益。报告期内，公司因政府补助所产生的收益金额均已计入非经常性损益。

3、投资收益

报告期内，公司投资收益分别为 51.88 万元、486.99 万元、619.55 万元和 293.08 万元，主要为理财产品的投资收益。

4、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失分别为-363.51万元、-1,166.88万元、-462.57万元和-987.05万元，均为应收账款、应收票据、其他应收款以及长期应收款计提的坏账损失。

5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失分别为-242.52万元、-552.23万元、-1,613.76万元和-1,089.42万元，均为存货跌价损失和合同资产减值损失。

6、营业外收支

（1）营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
奖励利得	-	-	184.00	-
罚没利得	22.64	57.41	34.42	0.95
其他	19.71	3.72	39.56	1.30
合计	42.35	61.13	257.97	2.25

报告期内，公司营业外收入分别为2.25万元、257.97万元、61.13万元和42.35万元，对利润总额影响较小，其中公司2023年度营业外收入有所增长，主要系客户基于公司产品质量给予的奖励款。

（2）营业外支出

报告期内，公司营业外支出的情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
非流动资产毁损报废损失	56.30	71.56	48.35	19.65
诉讼赔偿款	-	-	-	90.00
罚款、违约金及滞纳金、公益性捐赠支出及其他	13.21	61.10	0.97	2.11
合计	69.51	132.66	49.33	111.76

报告期内，公司营业外支出分别为111.76万元、49.33万元、132.66万元和69.51万元，主要系非流动资产毁损报废损失、诉讼赔偿款等，对利润总额影响较小。

（七）主要税种纳税情况

报告期内，公司增值税缴纳情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
期初未交	-819.38	-384.69	335.80	224.28
本期应交	763.55	1,536.25	404.36	424.29
本期已交	737.45	1,970.94	1,124.85	312.77
期末未交	-793.28	-819.38	-384.69	335.80

报告期内，公司企业所得税缴纳情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
期初未交	-480.57	-108.38	-176.99	-268.76
本期应交	-	-	-	-
本期已交	462.11	372.18	-68.61	-91.77
期末未交	-942.67	-480.57	-108.38	-176.99

公司适用的主要税率以及享受的税收优惠的具体情况详见本节“七、税项”。

十、资产质量分析

（一）资产总体构成情况

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	125,476.46	77.92%	103,381.53	79.77%	68,424.79	81.70%	49,682.10	95.38%
非流动资产	35,548.84	22.08%	26,225.83	20.23%	15,329.03	18.30%	2,405.77	4.62%
合计	161,025.30	100.00%	129,607.36	100.00%	83,753.83	100.00%	52,087.87	100.00%

报告期内，随着公司经营规模的扩大，资产总额保持增长趋势，公司积极开展业务布局，不断扩充产品线，经营规模持续扩大，带动资产规模持续增长。

报告期内，公司非流动资产占比呈现增长趋势，主要系公司建设自有厂房、新增研发项目带来的固定资产采购增加所致。

（二）流动资产构成及其变动情况

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	25,676.23	20.46%	19,062.15	18.44%	17,297.60	25.28%	31,955.71	64.32%
交易性金融资产	-	-	18,056.06	17.47%	16,035.79	23.44%	0.05	0.00%
应收票据	554.68	0.44%	548.06	0.53%	3,558.66	5.20%	565.20	1.14%
应收账款	36,706.30	29.25%	23,099.50	22.34%	11,868.55	17.35%	8,245.70	16.60%
应收款项融资	2,356.66	1.88%	2,311.81	2.24%	428.95	0.63%	418.82	0.84%
预付款项	2,382.24	1.90%	866.64	0.84%	530.81	0.78%	227.28	0.46%
其他应收款	1,549.18	1.23%	887.98	0.86%	397.79	0.58%	153.12	0.31%
存货	45,370.12	36.16%	33,442.30	32.35%	17,096.63	24.99%	7,072.57	14.24%
合同资产	3,086.32	2.46%	2,673.28	2.59%	711.77	1.04%	688.88	1.39%
一年内到期的非流动资产	5,512.54	4.39%	90.13	0.09%	-	-	-	-
其他流动资产	2,282.19	1.82%	2,343.62	2.27%	498.24	0.73%	354.78	0.71%
合计	125,476.46	100.00%	103,381.53	100.00%	68,424.79	100.00%	49,682.10	100.00%

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货、合同资产、一年内到期的非流动资产和其他流动资产构成。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行存款	23,629.09	92.03%	16,685.19	87.53%	16,495.91	95.37%	31,175.94	97.56%
其他货币资金	2,047.14	7.97%	2,346.96	12.31%	772.80	4.47%	779.77	2.44%
数字货币—人民币	-	-	30.00	0.16%	28.89	0.17%	-	-

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	25,676.23	100.00%	19,062.15	100.00%	17,297.60	100.00%	31,955.71	100.00%
其中：存放在境外的款项总额	4,130.62	16.09%	1,863.38	9.78%	156.24	0.90%	98.09	0.31%

报告期各期末，公司货币资金分别为31,955.71万元、17,297.60万元、19,062.15万元和25,676.23万元，其中其他货币资金均为银行承兑汇票及保函保证金。2023年末，公司货币资金余额大幅减少，主要系公司为提高短期闲置资金的使用效率而购买保本型理财产品所致；2025年9月末，公司货币资金余额有所增加，主要系公司购买的理财产品到期赎回所致。

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产分别为 0.05 万元、16,035.79 万元、18,056.06 万元和 0 万元，均系公司为提高短期闲置资金使用效率而购买的保本型理财产品。2025 年 9 月末，公司交易性金融资产余额有所减少，主要系公司购买的理财产品到期赎回所致。

3、应收票据及应收款项融资

（1）应收票据

报告期各期末，公司应收票据的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
银行承兑汇票	517.82	481.67	3,135.57	497.55
商业承兑汇票	69.00	95.24	626.32	97.39
小计	586.82	576.91	3,761.90	594.94
减：坏账准备	32.14	28.85	203.24	29.75
合计	554.68	548.06	3,558.66	565.20

报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为565.20万元、3,558.66万元、548.06万元和554.68万元，主要为银行承兑汇票，信用风险较低；其中2023年末商业承兑汇票余额相对较高，主要系信用状况良好的央企集团开具的商业承兑汇票。

（2）应收款项融资

报告期各期末，公司应收款项融资账面价值分别为 418.82 万元、428.95 万元、2,311.81 万元和 2,356.66 万元，占流动资产的比例分别为 0.84%、0.63%、2.24%和 1.88%，均为信用等级较高的银行开具的银行承兑汇票。

4、应收账款

报告期各期末，公司应收账款金额及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30/ 2025 年 1-9 月	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度
应收账款账面余额	40,001.69	25,455.43	13,559.08	8,962.97
应收账款坏账准备	3,295.39	2,355.94	1,690.54	717.27
应收账款账面价值	36,706.30	23,099.50	11,868.55	8,245.70
应收账款账面价值较上期末增长率	58.91%	94.63%	43.94%	/
营业收入	80,562.15	78,862.99	27,579.31	21,439.06
营业收入较上期增长率	/	185.95%	28.64%	/
应收账款账面余额占当期营业收入的比例	37.24%	32.28%	49.16%	41.81%
应收账款周转率（次）	3.28	4.04	2.45	2.73

注：2025 年 1-9 月相关指标已折算全年，下同。

（1）应收账款总体情况

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为8,962.97万元、13,559.08万元、25,455.43万元和40,001.69万元，占当期营业收入的比例分别为41.81%、49.16%、32.28%和37.24%，应收账款账面余额变动情况与营业收入变动基本匹配，其中2023年末应收账款占当期营业收入的比例相对较高，主要系当期收入确认集中于下半年度所致。

（2）应收账款账龄结构

报告期各期末，公司应收账款账龄结构如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
1 年以内	36,616.16	91.54%	22,973.11	90.25%	11,741.02	86.59%	7,815.13	87.19%
1-2 年	2,290.95	5.73%	1,232.81	4.84%	855.65	6.31%	1,119.86	12.49%

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
2-3 年	89.12	0.22%	327.11	1.29%	945.03	6.97%	27.98	0.31%
3-4 年	100.80	0.25%	922.41	3.62%	17.39	0.13%	-	-
4-5 年	904.66	2.26%	-	-	-	-	-	-
小计	40,001.69	100.00%	25,455.43	100.00%	13,559.08	100.00%	8,962.97	100.00%
减：坏账准备	3,295.39	8.24%	2,355.94	9.26%	1,690.54	12.47%	717.27	8.00%
合计	36,706.30	91.76%	23,099.50	90.74%	11,868.55	87.53%	8,245.70	92.00%

报告期各期末，公司账龄在1年以内的应收账款比例分别为87.19%、86.59%、90.25%和91.54%，公司应收账款质量整体较高，回款风险较低。

（3）应收账款坏账计提

1）应收账款计提坏账准备情况

报告期各期末，公司应收账款计提坏账准备情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,230.06	3.08%	1,230.06	100.00%	-
按组合计提坏账准备	38,771.63	96.92%	2,065.33	5.33%	36,706.30
合计	40,001.69	100.00%	3,295.39	8.24%	36,706.30
项目	2024.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,005.46	3.95%	1,005.46	100.00%	-
按组合计提坏账准备	24,449.97	96.05%	1,350.48	5.52%	23,099.50
合计	25,455.43	100.00%	2,355.94	9.26%	23,099.50
项目	2023.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,005.46	7.42%	1,005.46	100.00%	-
按组合计提坏账准备	12,553.62	92.58%	685.08	5.46%	11,868.55
合计	13,559.08	100.00%	1,690.54	12.47%	11,868.55

项目	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,005.46	11.22%	301.64	30.00%	703.82
按组合计提坏账准备	7,957.51	88.78%	415.63	5.22%	7,541.88
合计	8,962.97	100.00%	717.27	8.00%	8,245.70

公司按照整个存续期的预期信用损失计提坏账准备。报告期各期末，公司应收账款坏账准备金额分别为 717.27 万元、1,690.54 万元、2,355.94 万元和 3,295.39 万元。

2) 单项计提坏账准备的情况

报告期各期末，公司单项计提坏账准备情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上海诚佃电子科技有限公司	1,005.46	1,005.46	1,005.46	1,005.46	1,005.46	1,005.46	1,005.46	301.64
海科（嘉兴）电力科技有限公司	224.60	224.60	-	-	-	-	-	-
合计	1,230.06	1,230.06	1,005.46	1,005.46	1,005.46	1,005.46	1,005.46	301.64

单项计提坏账准备的原因主要系货款回收风险相对较高，预计无法收回，公司基于谨慎性原则对回款风险较高的客户单项计提坏账准备。

3) 按照组合计提坏账情况

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，计提坏账准备。

报告期各期末，公司按组合计提坏账准备的情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	36,593.16	1,829.66	5.00
1-2 年	2,089.35	208.94	10.00
2-3 年	89.12	26.74	30.00

合计	38,771.63	2,065.33	5.33
项目	2024.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	22,973.11	1,148.66	5.00
1-2 年	1,232.81	123.28	10.00
2-3 年	226.31	67.89	30.00
3-4 年	17.75	10.65	60.00
合计	24,449.97	1,350.48	5.52
项目	2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	11,741.02	587.05	5.00
1-2 年	754.85	75.48	10.00
2-3 年	40.37	12.11	30.00
3-4 年	17.39	10.43	60.00
合计	12,553.62	685.08	5.46
项目	2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,714.33	385.72	5.00
1-2 年	215.20	21.52	10.00
2-3 年	27.98	8.39	30.00
合计	7,957.51	415.63	5.22

4）同行业可比公司比较分析

对于按组合计提坏账准备的应收账款，公司与同行业可比公司的坏账计提比例对比如下：

单位：%

公司简称	6 个月以内	6 个月-1 年	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
普源精电	0.50	0.50	10.00	30.00	100.00	100.00	100.00
鼎阳科技	5.00	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00
华峰测控	5.00	5.00	30.00	70.00	100.00	100.00	100.00
长川科技 (STI 公司)	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
长川科技(除 STI 公司外)	5.00	5.00	10.00	20.00	40.00	80.00	100.00
联动科技	5.00	5.00	10.00	20.00	40.00	80.00	100.00

公司简称	6 个月以内	6 个月-1 年	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
广立微	1.00	5.00	10.00	20.00	30.00	50.00	100.00
行业均值	3.58	4.25	13.33	31.67	60.00	81.67	100.00
联讯仪器	5.00	5.00	10.00	30.00	60.00	80.00	100.00

注：上表中计算行业均值时未包含长川科技（STI 公司）。

公司各账龄计提比例均处于同行业可比公司相应比例区间内，公司应收账款坏账计提比例与同行业可比公司基本一致。

（4）应收账款前五名单位情况

报告期各期末，公司应收账款账面余额前五名客户情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	销售模式	账面余额	占应收账款账面余额的比例
2025.9.30				
1	中际旭创	直销	3,938.82	9.85%
2	武汉科诺工贸有限公司	经销	3,643.83	9.11%
3	新易盛	直销	3,302.94	8.26%
4	Lumentum	直销	2,653.64	6.63%
5	剑桥科技	直销	2,041.70	5.10%
合计			15,580.94	38.95%
2024.12.31				
1	光迅科技	直销	3,257.75	12.80%
2	海信集团	直销	2,871.66	11.28%
3	新易盛	直销	2,690.15	10.57%
4	日本住友	直销	2,333.99	9.17%
5	讯速信远	经销	2,208.67	8.68%
合计			13,362.23	52.49%
2023.12.31				
1	海信集团	直销	3,788.82	27.94%
2	中际旭创	直销	1,878.95	13.86%
3	集团一	直销	1,623.04	11.97%
4	上海诚佃电子科技有限公司	直销	1,005.46	7.42%
5	讯速信远	经销	563.94	4.16%
合计			8,860.21	65.35%

序号	客户名称	销售模式	账面余额	占应收账款账面余额的比例
2022.12.31				
1	海信集团	直销	2,990.82	33.37%
2	上海诚佃电子科技有限公司	直销	1,005.46	11.22%
3	光彩芯辰	直销	542.88	6.06%
4	讯速信远	经销	358.78	4.00%
5	源杰科技	直销	307.45	3.43%
合计			5,205.39	58.08%

报告期各期末，公司应收账款账面余额前五名客户合计分别为 5,205.39 万元、8,860.21 万元、13,362.23 万元和 15,580.94 万元，占全部应收账款余额的比例分别为 58.08%、65.35%、52.49%和 38.95%。报告期各期末，公司应收账款余额前五单位中无公司关联方，主要为光通信、半导体行业知名企业或上市公司，该等客户业务经营及资信情况较好，应收账款可回收性较高。

(5) 应收账款期后回款情况

公司应收账款及合同资产期后回款情况具体如下：

单位：万元

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
应收账款及合同资产账面余额	43,250.44	28,269.42	14,308.31	9,688.10
期后回款金额	11,576.08	23,594.29	13,153.92	8,680.92
期后回款比例	26.77%	83.46%	91.93%	89.60%
期后未回款金额	31,674.37	4,675.12	1,154.40	1,007.18
其中：单项计提坏账准备部分	1,230.06	1,207.06	1,005.46	1,005.46
其他	30,444.31	3,468.06	148.94	1.73
期后回款比例（剔除单项计提坏账准备部分）	27.55%	87.18%	98.88%	99.98%

注：期后回款金额统计截至 2025 年 11 月 30 日。

报告期内，公司应收账款回收情况良好，不存在较大坏账风险，其中 2022 及 2023 年末尚未回款的应收账款主要系上海诚佃电子科技有限公司的应收账款，该等应收账款已单项计提坏账准备。

5、预付款项

报告期各期末，公司预付款项账龄情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	2,382.24	100.00%	847.51	97.79%	530.81	100.00%	173.28	76.24%
1-2 年	-	-	19.13	2.21%	-	-	54.00	23.76%
合计	2,382.24	100.00%	866.64	100.00%	530.81	100.00%	227.28	100.00%

报告期各期末，公司预付款项主要为预付芯片流片及设计服务款、原材料采购款等，随着公司采购规模的逐步扩大，预付款金额相应增长，其账龄主要在一年以内。

6、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
保证金及押金	1,513.76	88.74%	837.68	85.48%	333.96	74.75%	139.96	76.92%
往来款及其他	191.98	11.26%	142.34	14.52%	112.80	25.25%	42.00	23.08%
账面余额合计	1,705.74	100.00%	980.03	100.00%	446.76	100.00%	181.96	100.00%
减：坏账准备	156.56	9.18%	92.05	9.39%	48.97	10.96%	28.84	15.85%
账面价值合计	1,549.18	90.82%	887.98	90.61%	397.79	89.04%	153.12	84.15%

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 153.12 万元、397.79 万元、887.98 万元和 1,549.18 万元，占流动资产的比例较低，主要为保证金、押金、代扣代缴社保公积金等。

7、存货

（1）存货构成及变动分析

报告期各期末，公司存货账面价值构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	11,986.36	26.42%	8,430.57	25.21%	5,237.73	30.64%	2,895.17	40.94%
在产品	4,858.21	10.71%	2,600.02	7.77%	2,660.16	15.56%	768.87	10.87%
库存商品	4,621.91	10.19%	3,650.55	10.92%	1,349.25	7.89%	451.77	6.39%

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
发出商品	20,628.14	45.47%	15,985.97	47.80%	5,793.69	33.89%	2,463.24	34.83%
委托加工物资	3,275.50	7.22%	2,775.19	8.30%	2,055.81	12.02%	493.50	6.98%
合计	45,370.12	100.00%	33,442.30	100.00%	17,096.63	100.00%	7,072.57	100.00%

报告期各期末，公司存货账面价值分别为7,072.57万元、17,096.63万元、33,442.30万元和45,370.12万元，占流动资产的比例分别为14.24%、24.99%、32.35%和36.16%。公司存货主要由原材料和发出商品构成，存货整体规模随着经营规模增长同步增长。

（2）存货跌价准备计提

1）存货跌价准备计提情况

报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,423.02	1,436.66	11,986.36
在产品	4,858.21	-	4,858.21
库存商品	5,022.32	400.41	4,621.91
发出商品	20,813.56	185.43	20,628.14
委托加工物资	3,275.50	-	3,275.50
合计	47,392.62	2,022.49	45,370.12
项目	2024.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,331.59	901.02	8,430.57
在产品	2,600.02	-	2,600.02
库存商品	4,023.26	372.70	3,650.55
发出商品	16,019.36	33.38	15,985.97
委托加工物资	2,775.19	-	2,775.19
合计	34,749.41	1,307.11	33,442.30
项目	2023.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,820.48	582.75	5,237.73
在产品	2,660.16	-	2,660.16

库存商品	1,366.34	17.09	1,349.25
发出商品	5,815.83	22.14	5,793.69
委托加工物资	2,055.81	-	2,055.81
合计	17,718.61	621.97	17,096.63
项目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,207.96	312.79	2,895.17
在产品	768.87	-	768.87
库存商品	451.77	-	451.77
发出商品	2,488.29	25.04	2,463.24
委托加工物资	493.50	-	493.50
合计	7,410.40	337.83	7,072.57

公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为337.83万元、621.97万元、1,307.11万元和2,022.49万元，占存货账面余额的比例分别为4.56%、3.51%、3.76%和4.27%，存货跌价准备金额与公司库存规模整体匹配。

2) 同行业可比公司比较分析

报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例与同行业可比公司对比情况如下：

公司简称	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
普源精电	未披露	6.10%	7.40%	4.52%
鼎阳科技	未披露	2.56%	2.35%	2.60%
华峰测控	未披露	2.27%	2.24%	1.36%
长川科技	未披露	5.95%	4.67%	4.34%
联动科技	未披露	2.60%	0.88%	-
广立微	未披露	0.28%	0.03%	0.22%
行业均值	未披露	3.29%	2.93%	2.17%
联讯仪器	4.27%	3.76%	3.51%	4.56%

2022年末、2023年末及2024年末，公司存货跌价准备计提比例高于行业均值，整体而言与同行业可比公司不存在重大差异。

8、合同资产

公司合同资产主要系产品销售形成的未到期质保金，报告期各期末，公司合同资产

账面价值分别为 688.88 万元、711.77 万元、2,673.28 万元和 3,086.32 万元。公司结合客户信用状况和经营情况，对于应收客户未到期质保金按预期信用损失率计提坏账准备。

9、一年内到期的非流动资产

报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产分别为 0 万元、0 万元、90.13 万元和 5,512.54 万元，2025 年 9 月末公司一年内到期的非流动资产大幅增长，主要为到期日一年以内的 3 年期定期存款。

10、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
待结算已开票销项税额	293.61	860.11	195.35	167.46
上市发行费用	783.02	783.02	-	-
预缴企业所得税	942.67	480.57	108.38	176.99
增值税借方余额	242.92	208.14	189.34	9.48
其他	19.96	11.78	5.17	0.84
合计	2,282.19	2,343.62	498.24	354.78

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 354.78 万元、498.24 万元、2,343.62 万元和 2,282.19 万元，占流动资产的比例分别为 0.71%、0.73%、2.27%和 1.82%，主要包括待结算已开票销项税额、上市发行费用、预缴企业所得税等。

（三）非流动资产构成及其变动情况

报告期各期末，公司非流动资产具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
债权投资	-	-	5,305.75	20.23%	5,150.75	33.60%	-	-
长期应收款	21.73	0.06%	57.81	0.22%	-	-	-	-
长期股权投资	2,441.44	6.87%	1,987.65	7.58%	1,969.85	12.85%	-	-
固定资产	24,148.78	67.93%	5,202.28	19.84%	2,826.72	18.44%	1,015.04	42.19%
在建工程	1,218.90	3.43%	10,010.20	38.17%	2,978.71	19.43%	118.07	4.91%

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
使用权资产	4,278.97	12.04%	1,258.46	4.80%	560.00	3.65%	475.76	19.78%
无形资产	968.45	2.72%	663.86	2.53%	605.59	3.95%	40.86	1.70%
商誉	25.81	0.07%	25.81	0.10%	25.81	0.17%	25.81	1.07%
长期待摊费用	2,285.08	6.43%	1,614.05	6.15%	971.45	6.34%	730.23	30.35%
递延所得税资产	18.75	0.05%	4.57	0.02%	10.16	0.07%	-	-
其他非流动资产	140.95	0.40%	95.37	0.36%	229.98	1.50%	-	-
合计	35,548.84	100.00%	26,225.83	100.00%	15,329.03	100.00%	2,405.77	100.00%

报告期各期末，公司流动资产主要由债权投资、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产和长期待摊费用构成，上述资产合计占非流动资产的比例均在98%以上。

1、债权投资

报告期各期末，公司债权投资余额分别为0万元、5,150.75万元、5,305.75万元和0万元，主要为一年以上期限的定期存款。

2、长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为0万元、1,969.85万元、1,987.65万元和2,441.44万元，均为公司参股的联营企业思诺威与合晶诺，并按权益法确认长期股权投资。

3、固定资产

(1) 固定资产构成情况

报告期各期末，公司固定资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
固定资产原值				
房屋建筑物	16,199.46	-	-	-
机器设备	1,688.24	1,384.50	550.49	370.19
器具、家具	2,448.38	1,164.54	577.49	321.26
电子设备	6,471.37	4,025.92	2,352.47	655.51

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
运输设备	126.89	51.43	39.97	39.97
合计	26,934.34	6,626.39	3,520.41	1,386.93
累计折旧				
房屋建筑物	319.84	-	-	-
机器设备	387.00	211.77	74.67	29.66
器具、家具	596.97	355.08	209.55	143.56
电子设备	1,432.54	829.90	391.46	189.27
运输设备	49.20	27.36	18.00	9.39
合计	2,785.56	1,424.11	693.69	371.89
固定资产账面价值				
房屋建筑物	15,879.61	-	-	-
机器设备	1,301.23	1,172.74	475.82	340.53
器具、家具	1,851.41	809.46	367.93	177.70
电子设备	5,038.83	3,196.01	1,961.00	466.24
运输设备	77.69	24.07	21.96	30.57
合计	24,148.78	5,202.28	2,826.72	1,015.04

报告期各期末，公司固定资产的账面价值分别为1,015.04万元、2,826.72万元、5,202.28万元和24,148.78万元，占非流动资产的比例分别为42.19%、18.44%、19.84%和67.93%。报告期内，随着公司经营规模的扩大，固定资产需求持续提升，导致固定资产逐期增加，其中2025年9月末固定资产占非流动资产的比例大幅上升，主要系当期在建工程转固所致。

公司固定资产均为正常生产经营所必需的资产，资产使用与运行状况良好，报告期各期末，公司不存在因市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因而导致可收回金额低于账面价值的情形，无需计提固定资产减值准备。

（2）固定资产折旧政策及与同行业可比公司的比较分析

报告期内，公司固定资产折旧政策与同行业可比公司无明显差异，具体对比如下：

单位：年

类别	普源精电	鼎阳科技	长川科技	华峰测控	联动科技	广立微	联讯仪器
房屋建筑物	20	未披露	20	20-40	10-40	10-20	20
机器设备	5 或 10	5	未披露	10	5-10	5	5-10

类别	普源精电	鼎阳科技	长川科技	华峰测控	联动科技	广立微	联讯仪器
电子设备	3 或 5	3	未披露	3-5	未披露	5	2-5
运输设备	3-5	5	4	4	5	未披露	4
办公设备及其他	5	5	未披露	3-5	5-10	3-5	3-5

注 1：长川科技固定资产类别为房屋及建筑物、通用设备、专用设备和运输工具，未披露机器设备、电子设备和办公设备及其他折旧政策；

注 2：联动科技固定资产类别为房屋建筑物、生产设备、办公设备、运输设备，未披露电子设备的折旧政策，上表将联动科技的生产设备作为机器设备处理；

注 3：广立微固定资产类别为房屋及建筑物、电子设备、机器设备、办公及其他设备，未披露运输设备的折旧政策；

注 4：鼎阳科技固定资产类别为机器设备、电子设备、运输设备和其他设备。

4、在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
联讯仪器新厂房	-	9,907.91	2,643.77	-
待安装设备	-	28.32	321.55	-
装修工程	1,180.19	40.03	13.39	118.07
信息系统	38.72	33.94	-	-
合计	1,218.90	10,010.20	2,978.71	118.07

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为118.07万元、2,978.71万元、10,010.20万元和1,218.90万元，2022-2024年度呈现快速增长趋势，主要系联讯仪器新厂房项目建设持续投入所致，2025年9月末在建工程金额下降，主要系当期在建工程转固所致。

公司在建工程在达到可使用状态后转入固定资产或长期待摊费用，转入时点符合会计准则的要求。截至报告期末，公司在建工程不存在减值迹象，公司未对在建工程计提减值准备。

5、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产的账面价值分别为 475.76 万元、560.00 万元、1,258.46 万元和 4,278.97 万元，均由租赁房产构成。2025 年 9 月末，公司使用权资产大幅增加，主要系公司为满足业务发展需求，在武汉、杭州等地新增租赁经营场所。

6、无形资产

报告期各期末，公司无形资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
土地使用权	509.73	52.63%	523.67	78.88%	542.26	89.54%	-	-
软件及其他	458.73	47.37%	140.19	21.12%	63.33	10.46%	40.86	100.00%
合计	968.45	100.00%	663.86	100.00%	605.59	100.00%	40.86	100.00%

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 40.86 万元、605.59 万元、663.86 万元和 968.45 万元，主要为土地使用权和软件；其中 2023 年末，公司无形资产账面价值大幅增加，主要系公司当期购置新厂房土地使用权所致。

报告期各期末，公司无形资产不存在重大减值迹象，无需计提减值准备。

7、商誉

报告期各期末，公司商誉账面价值分别为25.81万元、25.81万元、25.81万元和25.81万元，均系收购日本联讯所形成，具体详见本节“十二、重大投资或重大资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项”之“（四）股权收购合并事项”。

公司于每年年末对被收购公司产生商誉的资产组合进行减值测试，报告期各期末，公司商誉不存在重大减值迹象，均未计提减值准备。

8、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用构成如下：

单位：万元

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
装修费	1,246.70	1,041.01	335.31	127.10
样机	1,038.38	573.05	636.14	603.13
合计	2,285.08	1,614.05	971.45	730.23

报告期各期末，公司长期待摊费用主要由样机和装修费构成；其中 2024 年末公司长期待摊费用大幅增加，主要系公司新租赁房产装修金额较大所致；2025 年 9 月末公司长期待摊费用进一步增长，主要系公司为推广新产品、拓展市场，样机数量有所增加所致。

（四）资产周转能力分析

1、应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率与同行业可比公司对比如下：

单位：次

公司简称	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
普源精电	4.53	5.02	5.61	8.02
鼎阳科技	7.33	6.99	5.99	5.62
华峰测控	2.75	2.72	2.06	3.95
长川科技	2.86	2.70	1.70	3.08
联动科技	2.13	2.91	2.92	4.02
广立微	1.38	1.59	1.96	2.43
行业均值	3.50	3.66	3.37	4.52
联讯仪器	3.28	4.04	2.45	2.73

注：2025 年 1-9 月相关指标已折算全年，同行业可比公司 2025 年三季度报告均未披露应收账款余额，故使用应收账款账面价值代替计算。

报告期内，公司应收账款周转率整体呈增长趋势，主要系公司业务规模不断扩大，且持续优化客户信用管理并加深与优质客户的合作所致。公司客户主要为光通信、半导体行业内上市公司或知名企业，普遍还款能力较强，信用较好，应收账款回款风险较小。

报告期内，公司应收账款周转率处于同行业可比公司相应比例区间内，不存在重大差异，其中2022及2023年度，公司应收账款周转率低于行业均值，主要系公司业务规模相对较小，并且收入确认相对集中于下半年，导致期末应收账款余额较大所致；2024年以来，公司业务规模大幅增长，应收账款周转率已与行业均值趋同。

2、存货周转率

报告期内，公司的存货周转率与同行业可比公司对比如下：

单位：次

公司简称	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
普源精电	1.17	1.24	1.47	1.99
鼎阳科技	0.98	0.85	1.01	1.29
华峰测控	1.48	1.48	1.13	1.30
长川科技	0.81	0.71	0.39	0.85
联动科技	0.69	0.75	0.56	0.87

公司简称	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
广立微	0.81	0.76	0.87	1.16
行业均值	0.99	0.97	0.91	1.24
联讯仪器	1.07	1.09	0.87	1.78

注：2025 年 1-9 月相关指标已折算全年，同行业可比公司 2025 年三季度报告均未披露存货余额，故使用存货账面价值代替计算。

报告期内，公司存货周转率整体呈下降趋势，主要原因一方面系公司各期末在手订单规模持续增长，为保障订单交付，公司各期末库存规模随之增长；另一方面系公司半导体测试设备出货后至验收完成存在一定周期，发出商品余额随销售规模增长而增长。

报告期内，公司存货周转率处于同行业可比公司相应比例区间内，不存在重大差异，其中2023年度公司存货周转率低于行业均值，主要系当期新增订单金额大幅增加，带动期末在产品、尚未验收确认收入的发出商品等存货金额增加所致。

十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债状况分析

1、负债总体构成情况

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	63,839.81	79.70%	51,530.92	83.43%	30,216.72	87.82%	13,119.35	94.30%
非流动负债	16,261.39	20.30%	10,237.26	16.57%	4,189.53	12.18%	792.88	5.70%
合计	80,101.20	100.00%	61,768.18	100.00%	34,406.25	100.00%	13,912.23	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为13,912.23万元、34,406.25万元、61,768.18万元和80,101.20万元，随着公司经营规模的快速增长而扩大，公司负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例分别为94.30%、87.82%、83.43%和79.70%。

2、流动负债构成及其变动情况

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	1,373.35	2.67%	-	-	-	-
应付票据	11,199.21	17.54%	12,824.63	24.89%	2,186.10	7.23%	1,940.15	14.79%
应付账款	27,049.02	42.37%	18,599.60	36.09%	13,401.04	44.35%	5,286.56	40.30%
合同负债	14,755.53	23.11%	12,137.73	23.55%	9,368.39	31.00%	2,671.23	20.36%
应付职工薪酬	4,079.08	6.39%	3,740.12	7.26%	2,270.68	7.51%	1,099.70	8.38%
应交税费	927.36	1.45%	471.99	0.92%	61.70	0.20%	620.19	4.73%
其他应付款	612.85	0.96%	423.53	0.82%	301.66	1.00%	1,024.52	7.81%
一年内到期的非流动负债	2,554.09	4.00%	911.73	1.77%	442.94	1.47%	224.17	1.71%
其他流动负债	2,662.66	4.17%	1,048.25	2.03%	2,184.21	7.23%	252.81	1.93%
合计	63,839.81	100.00%	51,530.92	100.00%	30,216.72	100.00%	13,119.35	100.00%

报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、应付职工薪酬、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债构成，上述负债合计占流动负债的比例均在95%以上。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 0 万元、0 万元、1,373.35 万元和 0 万元，均为信用借款，2024 年末短期借款有所增长，主要系因业务发展需求增加借款融资所致。报告期内，公司短期借款不存在逾期未偿还的情形。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 1,940.15 万元、2,186.10 万元、12,824.63 万元和 11,199.21 万元，均为银行承兑汇票。2022-2024 年，公司应付票据余额呈现增长态势，主要系公司为提高资金使用效率，更多地采用银行承兑汇票的方式结算采购款所致。报告期内，公司的应付票据不存在逾期无法兑付的情形。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
原材料	19,590.15	14,919.33	10,051.91	5,084.92
设备及工程款	6,253.85	3,113.05	2,916.02	77.96
服务及其他	1,205.03	567.21	433.11	123.68
合计	27,049.02	18,599.60	13,401.04	5,286.56

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 5,286.56 万元、13,401.04 万元、18,599.60 万元和 27,049.02 万元，主要为原材料采购款、设备及工程建设采购款等，随着公司业务规模的扩大，采购规模相应增加，应付账款余额整体呈增长态势。

（4）合同负债

公司合同负债主要为向客户预先收取的货款，报告期各期末，公司合同负债金额分别为2,671.23万元、9,368.39万元、12,137.73万元和14,755.53万元，随着公司业务规模持续扩大，尚在履行中的订单数量持续增长，公司合同负债金额变动趋势与新增订单金额增长趋势相匹配。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1,099.70 万元、2,270.68 万元、3,740.12 万元和 4,079.08 万元，占流动负债的比例分别为 8.38%、7.51%、7.26%和 6.39%，主要由公司已计提尚未支付的工资、奖金、津贴等构成。随着公司经营规模的快速扩大，公司员工人数和薪酬水平相应增长，应付职工薪酬余额呈增长趋势。

（6）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
应付暂收款	476.47	248.75	172.78	985.59
待报销款	86.51	139.51	32.96	35.91
保证金及押金	34.63	25.16	80.16	0.16
其他	15.24	10.11	15.77	2.86
合计	612.85	423.53	301.66	1,024.52

报告期各期末，公司其他应付款账面价值分别为1,024.52万元、301.66万元、423.53

万元和612.85万元，主要包括应付暂收款、待报销款、保证金及押金等，其中2022年末应付暂收款金额相对较高，主要系公司当期收到国家级研发项目政府补助应付给其他参与单位的款项。

（7）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为224.17万元、442.94万元、911.73万元和2,554.09万元，主要为一年内到期的租赁负债和一年内到期的长期借款。2025年9月末，公司一年内到期的非流动负债有所增长，主要系新厂房建设专项借款一年内到期的金额增加所致。

（8）其他流动负债

单位：万元

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
未终止确认的已背书未到期银行承兑汇票	441.67	441.83	1,702.66	169.99
待转销项税额	2,220.99	606.42	481.55	82.83
合计	2,662.66	1,048.25	2,184.21	252.81

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为252.81万元、2,184.21万元、1,048.25万元和2,662.66万元，主要由未终止确认的已背书未到期银行承兑汇票和待转销项税额构成。2023年，公司收到银行承兑汇票有所增加，使得公司年末未终止确认的已背书未到期银行承兑汇票金额有所增长；2025年9月末，公司其他流动负债金额有所增长，主要原因系公司在手订单规模快速增长，预收账款的待转销项税额有所增加。

3、非流动负债构成及其变动情况

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	7,614.27	46.82%	4,921.18	48.07%	-	-	-	-
租赁负债	3,127.70	19.23%	537.82	5.25%	153.37	3.66%	258.84	32.65%
预计负债	1,208.29	7.43%	942.50	9.21%	369.66	8.82%	241.03	30.40%
递延收益	4,294.00	26.41%	3,824.41	37.36%	3,661.01	87.38%	290.00	36.58%
递延所得税负债	17.13	0.11%	11.35	0.11%	5.49	0.13%	3.01	0.38%

项目	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	16,261.39	100.00%	10,237.26	100.00%	4,189.53	100.00%	792.88	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债主要由长期借款、租赁负债、预计负债和递延收益构成，上述负债合计占非流动负债的比例均在99%以上。

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别为 0 万元、0 万元、4,921.18 万元和 7,614.27 万元，主要为新增的在建工程项目专项借款。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债余额分别为 258.84 万元、153.37 万元、537.82 万元和 3,127.70 万元，主要因公司承租房产形成，2025 年 9 月末公司租赁负债金额大幅增长，主要系公司为满足业务发展需求，在武汉、杭州等地新增租赁经营场所。

（3）预计负债

报告期各期末，公司预计负债余额分别为 241.03 万元、369.66 万元、942.50 万元和 1,208.29 万元，主要系公司各期末对尚处于质保期内的产品收入计提的售后服务费。报告期内，公司预计负债规模持续增长，与公司业务规模变动趋势相匹配。

（4）递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 290.00 万元、3,661.01 万元、3,824.41 万元和 4,294.00 万元，均由政府补助构成。

（二）偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2025.9.30/ 2025 年 1-9 月	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度
流动比率（倍）	1.97	2.01	2.26	3.79
速动比率（倍）	1.25	1.36	1.70	3.25
资产负债率（合并）	49.74%	47.66%	41.08%	26.71%
资产负债率（母公司）	47.28%	46.76%	40.85%	26.72%

项目	2025.9.30/ 2025 年 1-9 月	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	13,062.44	16,612.24	-4,235.94	-2,893.21
利息保障倍数（倍）	70.84	360.10	/	/

注：2022及2023年度利息保障倍数不适用，系息税前利润为负所致。

报告期内，公司流动比率和速动比率有所下降、资产负债率有所增长，主要系公司业务规模持续扩大、在手订单数量持续增长，应付票据、应付账款和合同负债等快速增长。

公司息税折旧摊销前利润已于2024年实现由负转正，公司偿债能力持续提升。

2、偿债能力指标与同行业公司比较分析

报告期各期末，公司主要偿债能力指标与同行业可比公司比较情况如下：

项目	公司简称	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
流动比率 （倍）	普源精电	4.89	4.27	7.33	10.82
	鼎阳科技	16.15	14.82	18.39	16.58
	华峰测控	12.36	15.13	24.01	12.35
	长川科技	1.95	1.80	2.12	2.12
	联动科技	13.78	14.28	11.63	14.21
	广立微	8.49	12.36	13.91	12.84
	行业均值	9.60	10.44	12.90	11.49
	联讯仪器	1.97	2.01	2.26	3.79
速动比率 （倍）	普源精电	4.26	3.83	6.71	9.98
	鼎阳科技	13.96	12.57	16.01	14.91
	华峰测控	11.39	14.21	22.73	11.45
	长川科技	1.04	1.01	1.05	1.13
	联动科技	11.63	12.41	10.22	12.96
	广立微	7.32	11.10	12.59	12.30
	行业均值	8.27	9.19	11.55	10.46
	联讯仪器	1.25	1.36	1.70	3.25
资产负债率 （合并）	普源精电	15.48%	17.78%	11.53%	8.08%
	鼎阳科技	7.57%	8.58%	6.06%	7.03%
	华峰测控	7.21%	6.24%	3.88%	6.89%
	长川科技	51.23%	49.75%	41.20%	39.19%
	联动科技	6.23%	6.13%	8.11%	6.89%

项目	公司简称	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
	广立微	8.83%	7.57%	8.12%	9.30%
	行业均值	16.09%	16.01%	13.15%	12.89%
	联讯仪器	49.74%	47.66%	41.08%	26.71%

报告期内，公司流动比率、速动比率均低于同行业可比公司平均水平，与长川科技较为接近，主要系普源精电、鼎阳科技、华峰测控、联动科技、广立微等同行公司陆续在近年来完成首发上市，融资后货币资金大幅增加，导致短期偿债指标相应提高所致。

报告期内，公司资产负债率高于同行业可比公司平均水平，与长川科技较为接近，主要系同行业可比公司均为上市公司，融资渠道较广，而公司作为非上市公司，融资渠道较为受限所致。

（三）股利分配情况

公司报告期内的股利分配情况详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、发行人股利分配政策”之“（一）本次发行后的股利分配政策”之“3、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排”。

（四）现金流量分析

报告期内，公司现金流量的总体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,548.27	8,078.58	-525.90	698.05
投资活动产生的现金流量净额	7,976.70	-12,754.35	-25,691.63	1,121.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,438.35	4,860.62	11,652.99	27,275.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响	47.13	5.54	-86.60	108.82
现金及现金等价物净增加额	6,913.90	190.39	-14,651.14	29,203.47

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量明细如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	68,398.37	71,679.74	28,939.04	20,424.95

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
收到的税费返还	819.13	134.22	106.95	53.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,472.04	745.61	4,099.92	1,501.69
经营活动现金流入小计	70,689.53	72,559.58	33,145.91	21,980.49
购买商品、接受劳务支付的现金	40,912.97	34,052.85	18,730.26	13,615.55
支付给职工以及为职工支付的现金	21,621.54	18,975.51	8,737.54	4,988.15
支付的各项税费	2,598.62	3,070.16	1,704.28	727.62
支付其他与经营活动有关的现金	8,104.67	8,382.48	4,499.73	1,951.12
经营活动现金流出小计	73,237.80	64,481.00	33,671.81	21,282.44
经营活动产生的现金流量净额	-2,548.27	8,078.58	-525.90	698.05

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为698.05万元、-525.90万元、8,078.58万元和-2,548.27万元。公司经营活动现金流入主要系销售商品、提供劳务收到的现金，其变动趋势与营业收入基本一致；公司经营活动现金流出主要系公司支付供应商采购款、支付职工薪酬等。

报告期内，公司净利润调节为经营活动现金流量的情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
净利润	9,768.70	14,088.30	-5,670.31	-3,788.88
加：资产减值准备	1,089.42	1,613.76	552.23	242.52
信用减值损失	987.05	462.57	1,166.88	363.51
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,457.96	925.15	391.87	192.06
使用权资产折旧	896.83	780.50	357.15	212.69
无形资产摊销	38.64	12.94	21.93	4.27
长期待摊费用摊销	765.78	755.26	650.71	467.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	56.30	71.56	48.35	19.65
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-20.28	-35.73	-0.05
财务费用（收益以“－”号填列）	143.95	33.72	107.01	-88.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-293.08	-619.55	-486.99	-51.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-14.18	5.59	-10.16	-
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5.78	5.86	2.48	-0.64

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
填列)				
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,195.07	-17,370.90	-11,607.86	-2,712.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-17,241.76	-16,944.02	-8,894.89	-3,594.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,728.80	19,841.45	18,035.99	5,489.80
股份支付	3,289.98	4,436.67	4,845.42	3,943.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,548.27	8,078.58	-525.90	698.05

公司2023年度及2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为负，2024年经营活动产生的现金流量净额小于净利润，主要系以下两方面原因所致：一方面，报告期内，公司销售收入增长较快，且公司给予客户一定信用期，客户回款存在一定周期，造成应收账款增加，经营性应收项目持续增加；另一方面，报告期内，公司新增订单规模持续增长，经营规模和存货规模随之快速增长，使得存货占用资金持续增加。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为1,121.24万元、-25,691.63万元、-12,754.35万元和7,976.70万元。公司投资活动现金流入主要系理财产品到期赎回，投资活动现金流出主要系购买理财产品、购建长期资产等。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为27,275.37万元、11,652.99万元、4,860.62万元和1,438.35万元。公司筹资活动现金流入主要系公司收到的投资款及借款，筹资活动现金流出主要系偿还银行贷款及现金分红。

（五）持续经营能力分析

公司是国内领先的高端测试仪器设备企业，主营业务为电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务，专业为全球高速通信和半导体等领域用户提供高速率、高精度、高效率的核心测试仪器设备。

报告期内，公司营业收入分别为21,439.06万元、27,579.31万元、78,862.99万元和80,562.15万元，归属于母公司股东的净利润分别为-3,807.00万元、-5,539.38万元、14,049.48万元和9,664.30万元；得益于下游应用领域市场需求持续强劲、高端测试仪器设备国产替代进程提速、公司核心产品性能持续突破并获得境内外优质客户广泛认可、

产品线不断丰富并持续拓宽应用场景等因素，公司报告期内营业收入实现大幅增长，2024年度及2025年1-9月实现盈利。

未来，公司拟将本次募集资金用于下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目、车规芯片测试设备研发及产业化建设项目、存储测试设备研发及产业化建设项目、数字测试仪器研发及产业化建设项目和下一代测试仪表设备研发中心建设项目，进一步推动公司夯实技术水平、丰富产品线布局、巩固市场领先地位并增强竞争优势，进一步推动公司高质量增长、提升盈利能力。

整体而言，公司主营业务突出，所处行业具备良好政策环境和可观市场空间，公司产品结构、经营模式、行业环境未发生重大不利变化，公司在持续经营能力方面不存在重大不利变化，可能影响公司持续经营能力的风险因素详见本招股说明书“第三节 风险因素”的相关内容。

十二、重大投资或重大资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 252.62 万元、3,062.86 万元、11,201.10 万元和 9,802.41 万元，主要用于新厂房建设。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目，相关项目属于公司主营业务范畴，公司不存在跨行业投资的情况。

公司本次募集资金投资项目情况详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

（三）重大资产业务重组事项

报告期内，公司不存在重大资产业务重组情况。

（四）股权收购合并事项

报告期内，公司的股权收购合并事项主要系 2022 年 12 月 29 日以现金方式增资日本联讯并取得其控制权，该事项构成非同一控制下企业合并。关于日本联讯相关情况详

见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人分公司、子公司及参股公司情况”之“（一）控股子公司”之“4、日本联讯”。

十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司存在作为被告且尚未完结的诉讼，详见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼、仲裁或其他事项”。

（三）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在应披露的其他重要事项。

（四）重大担保

截至本招股说明书签署日，公司及子公司不存在对外担保的情形。

（五）重大诉讼

截至本招股说明书签署日，公司存在作为被告且尚未完结的诉讼，详见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼、仲裁或其他事项”。

十四、盈利预测

公司未编制盈利预测报告。

十五、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况

（一）审计截止日后主要经营情况

本招股说明书已披露的财务报告的审计基准日为 2025 年 9 月 30 日。财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日之间，公司经营情况良好，公司产业政策、税收政策、行业市场环境、主要经营模式、主要客户及供应商的构成、经营管理层及核心技术人员未发生重大不利变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

（二）2025 年度审阅数据

容诚会计师对公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表，2025 年度的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚阅字[2026]230Z0008 号）。

公司 2025 年度经审阅的主要财务数据情况如下：

1、合并资产负债表主要数据

公司 2025 年末经审阅的合并资产负债表主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动比例
资产总计	179,872.93	129,607.36	38.78%
负债总计	90,172.29	61,768.18	45.99%
归属于母公司所有者权益	89,725.37	67,888.99	32.16%
所有者权益合计	89,700.64	67,839.18	32.23%

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额较上年末增长 38.78%，主要系公司积极开展业务布局，不断扩充产品线，经营规模持续扩大，带动资产规模持续增长。负债总额较上年末增长 45.99%，主要系随着公司业务规模的扩大，采购规模相应增加，应付票据及应付账款余额整体呈增长态势。归属于母公司所有者权益、所有者权益较上年末有所增长，主要系公司盈利能力持续改善，期末未分配利润增长所致。

2、合并利润表主要数据

公司 2025 年度经审阅的合并利润表主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动比例
营业收入	119,406.84	78,862.99	51.41%
营业利润	17,513.10	14,170.66	23.59%
利润总额	17,464.30	14,099.13	23.87%
净利润	17,390.23	14,088.30	23.44%
归属于母公司股东的净利润	17,365.16	14,049.48	23.60%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	16,979.92	13,209.65	28.54%
项目	2025 年 10-12 月	2024 年 10-12 月	变动比例

营业收入	38,844.69	26,945.46	44.16%
营业利润	7,722.52	5,373.59	43.71%
利润总额	7,700.87	5,313.61	44.93%
净利润	7,621.53	5,314.80	43.40%
归属于母公司股东的净利润	7,700.85	5,238.14	47.02%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7,686.43	5,103.30	50.62%

2025 年度，公司实现营业收入 119,406.84 万元，较去年同期增长 51.41%，其中 2025 年 10-12 月实现营业收入 38,844.69 万元，较去年同期增长 44.16%，2025 年度及 2025 年 10-12 月公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期均有所增长，主要系公司所处行业发展趋势良好，公司下游客户需求保持高速增长，收入与利润水平较同期上升。

3、合并现金流量表主要数据

公司 2025 年度经审阅的合并现金流量表主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	7,843.04	8,078.58	-2.92%
项目	2025 年 10-12 月	2024 年 10-12 月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	10,391.31	4,043.62	156.98%

2025 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,843.04 万元，整体规模保持稳定，销售回款情况良好。2025 年 10-12 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 10,391.31 万元，较去年同期增长 156.98%，主要系公司期末加大对货款回收力度和现金流管控力度。

4、非经常性损益明细表

公司 2025 年度经审阅的非经常性损益明细表情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-73.13	-71.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	96.97	416.59

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	310.87	622.02
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	38.06	17.80
债务重组损益	-31.81	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44.25	5.81
因股份支付确认的费用	-	-150.83
非经常性损益总额	385.20	839.84
非经常性损益净额	385.20	839.84
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-0.04	0.0003
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	385.24	839.84
项目	2025 年 10-12 月	2024 年 10-12 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-16.84	-8.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10.94	79.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	39.76	92.16
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-15.72	24.80
债务重组损益	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3.72	-52.68
因股份支付确认的费用	-	-
非经常性损益总额	14.42	134.83
非经常性损益净额	14.42	134.83
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-0.01	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	14.42	134.83

2025 年度及 2025 年 10-12 月归属于公司普通股股东的非经常性损益净额较上年同期有所下降，主要系计入当期损益的政府补助与当期金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益减少所致。

（三）2026 年 1-3 月业绩预计情况

基于公司目前的经营状况和市场环境，公司预计 2026 年 1-3 月主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月（预计）	2025 年 1-3 月	变动比例
营业收入	40,000 至 43,000	20,110.50	98.90%至 113.82%
归属于母公司股东的净利润	4,300 至 5,100	1,932.87	122.47%至 163.86%
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	4,100 至 4,900	1,751.45	134.09%至 179.77%

注：2025 年 1-3 月数据已经审计。

2026 年 1-3 月，公司预计可实现营业收入约 40,000 万元至 43,000 万元，同比增幅约 98.90%至 113.82%；公司预计可实现扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润同比增幅约为 122.47%至 163.86%和 134.09%至 179.77%，主要系公司所处行业市场需求快速增长，主要客户业务发展势头良好，公司持续满足客户需求，经营规模持续增长，盈利能力稳步提升。

公司未编制和披露盈利预测信息，上述 2026 年 1-3 月业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计，未经注册会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金运用概况

根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，并经 2025 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，公司决定调整部分募投项目并取消“补充流动资金”项目，相应调整募集资金总额。

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，投向科技创新领域。本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目	51,279.22	51,279.22
2	车规芯片测试设备研发及产业化建设项目	19,885.27	19,885.27
3	存储测试设备研发及产业化建设项目	38,547.37	38,547.37
4	数字测试仪器研发及产业化建设项目	30,400.53	30,400.53
5	下一代测试仪表设备研发中心建设项目	31,031.89	31,031.89
合计		171,144.28	171,144.28

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将通过自筹资金解决；若本次发行实际募集资金高于募集资金投资项目投资额，剩余部分公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用。

本次募集资金投资项目的实施不会新增构成重大不利影响的同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

（二）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度对募集资金的存储及使用

用管理、募集资金投资项目的管理与监督等进行了详细规定。公司将严格按照《募集资金管理制度》以及中国证监会和上交所的相关规定进行募集资金的使用和管理。

（三）募集资金投资项目对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响

公司本次募集资金投向包括下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目、车规芯片测试设备研发及产业化建设项目、存储测试设备研发及产业化建设项目、数字测试仪器研发及产业化建设项目、下一代测试仪表设备研发中心建设项目，将在提升研发水平、丰富产品线布局等方面助力公司经营战略的实施。

下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目面向3.2T、6.4T光模块和硅光晶圆测试等，助力公司通信测试仪器和光电子器件测试设备的技术积累与产品性能迭代，更好地适应下游客户高速率、高集成化、高灵活度的光通信测试需求。车规芯片测试设备研发及产业化建设项目面向第三代化合物半导体材料碳化硅在功率半导体领域的前沿应用，加强公司半导体测试设备的技术积累与产品线拓展。存储测试设备研发及产业化建设项目面向集成电路存储芯片的高速、高精度的严苛测试需求，推进自主可控的高速存储芯片测试机、分选机、老化设备等产品的研发与产业化，增强公司在半导体测试设备领域的技术实力与产品线覆盖，为公司提供新的盈利增长点。数字测试仪器研发及产业化建设项目依托公司核心技术积累，推进宽带实时示波器和任意波形发生器等电子测量仪器的研发与产业化进程，拓展通信测试仪器产品线、培育新的盈利增长点。下一代测试仪表设备研发中心建设项目有助于提高公司现有研发能力，保持公司在行业内的竞争优势。

本次募集资金投资项目有利于公司夯实技术水平、提升经营规模和盈利能力、巩固市场领先地位并增强竞争优势，是公司推进未来发展规划及经营战略的重要举措。

（四）募集资金投资项目与发行人主要业务、核心技术之间的关系

本次募集资金投资项目依托公司在高速信号处理、微弱信号处理、超精密运动控制领域的核心技术积累，持续推进电子测量仪器和半导体测试设备的研发与产业化应用，是公司现有业务的进一步延伸，与公司目前主要业务以及经营战略方向相符，是公司未来业务发展规划的重要组成部分，与公司的主营业务、核心技术紧密相关。

（五）募集资金投资项目确定依据

本次募集资金投资项目系公司综合考虑发展战略、技术水平、国家产业政策、下游

需求等因素而确定，募集资金规模与公司生产规模和财务状况相适应。本次募集资金投资项目是对公司主营业务的进一步发展和深化，符合国家产业政策与公司发展战略要求，对公司持续发展有重要意义。

（六）募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

公司具备较好的技术积淀、出色的管理能力与良好的产业基础，本次募集资金投资项目是在公司现有主要业务和已掌握的核心技术基础上的延伸和扩展，募集资金均投向科技创新领域。募集资金重点投向科技创新领域的具体安排详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件六：募集资金运用情况”。

二、未来发展规划

（一）公司发展战略

高端科学仪器设备的研发是推动科学和技术发展的重要力量，公司将坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求开展技术研究，并依托强大的平台级核心技术体系，持续实现高端测试仪器设备的突破，提高我国高端科学仪器设备的自主可控水平，助力全球人工智能、新能源、半导体等前沿科技行业提升产品开发和量产效率。

电子测量仪器方面，公司是全球少数、国内极少数量产供货400G、800G、1.6T高速光模块核心测试仪器的厂商，全球第二家推出目前业内最高水平1.6T光模块全部核心测试仪器的厂商，国内极少数可以提供PXIe插卡式源表、低漏电开关矩阵、高压源表、脉冲源等多产品矩阵的厂商。未来，公司将持续关注与把握技术发展的前沿动态，一方面，持续向更高速率、更大带宽等性能指标迭代，向高集成度、高灵活度的发展方向创新；另一方面，持续挖掘精密源表作为底层硬件的技术潜力，不断拓宽产品线，以满足下游领域复杂度更高、精度更高、范围更广的测试需求。

半导体测试设备方面，公司是国内极少数覆盖芯片、晶圆等光通信产业链上游核心环节测试需求的厂商，极少数同时实现晶圆级老化系统、功率芯片 KGD 分选测试系统产业化应用的厂商，少数具备精密源表等核心测试部件自主能力的厂商。未来，公司将持续关注半导体前沿技术应用与测试需求，一方面，不断巩固和深化在光电子器件测试、功率器件测试与半导体集成电路测试领域的纵向竞争力；另一方面拓宽下游应用领域，加速推进在存储器件测试等领域的横向拓展。

公司将持续投入资金和人力资源，加强研发技术团队建设，完善内部管理，不断提升产业化运营能力，并有效发挥资本市场助力功能，不断巩固竞争优势和提升市场地位，力争成为国际高端测试仪器设备行业的领导者。

（二）已采取的措施及实施效果

1、重视研发投入，积累高端测试仪器设备的技术基础

电子测量仪器和半导体测试设备行业属于技术密集型产业，公司依托自主核心技术的积累与转化，在市场中形成较强的市场竞争力，有利于公司的可持续发展。公司具备充足的技术积累，掌握了低损耗低噪声高速信号电路设计、超微弱信号产生和测量技术、高集成度四象限源测量技术、KGD 裸芯片级测试分选技术、硅基光子芯片光电混合信号高精度耦合和测量技术等核心技术，且在发展历程中有效实现核心技术的自研积累与成果转化。

2、把握市场发展趋势拓展主要产品，提高产品核心竞争力

公司把握行业发展趋势和需求变化，专注于技术创新与产品开发，在光通信测试领域，公司是业内极少数覆盖光通信产业链中模块、芯片、晶圆等核心环节测试需求的厂商，采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪等产品综合性能业内领先；在电性能测试仪器方面，联讯仪器已拥有完全自主研发的精密源表，产品型号丰富、形态多样，可灵活满足光通信、半导体、新能源等领域的高精度电源输出与测量需求；在半导体领域，公司在巩固光通信领域竞争优势的同时，也成功实现了在功率器件、半导体集成电路等领域的横向拓展，开发了WAT测试机、晶圆级可靠性测试系统、晶圆级老化系统与功率芯片KGD分选测试系统等产品。公司自成立以来，不断拓展产品品类，实现产品性能的迭代优化，是公司实现跨越式发展的重要竞争力。

3、重视人才队伍建设，提升公司可持续发展能力

人才是公司发展的核心资源，公司建立了经验丰富的人才队伍，是公司研发、生产、销售等活动开展的重要基础。为了高效实现公司总体战略目标，公司持续加强人力资源规划，健全人力资源管理体系，优化人才激励机制，实现匹配公司发展战略、发展阶段的多元化人才储备，为可持续发展提供充足的人才支持。

（三）未来规划采取的措施

1、围绕国家产业发展战略，提升高端科学仪器设备自主可控水平

高端测试仪器设备是各下游领域开展科学研究与生产的重要基础，融合了多学科、多领域最先进的技术，具有“高科技、高性能、高价值”的特征。公司将坚持面向经济主战场、面向国家重大需求的战略方向，把握产业发展政策与战略重点，开展测试技术的原创性研究、国家重点方向核心关键技术研究，为后续电子测量技术发展奠定坚实的技术创新与产品开发基础，为我国高端科学仪器设备的自主可控作出贡献。

2、面向市场前沿需求提高产品丰富程度与协同作用

公司是国内领先的高端测试仪器设备企业，下游高速通信及半导体行业均具备技术密集型特征，技术发展及应用速度快。公司将持续关注与把握技术发展的前沿动态，不断突破产品的性能指标，提高产品的丰富程度，加强公司主要产品的竞争力。在通信测试仪器方面持续向更高速率、更大带宽等性能指标迭代，在形态上向高集成度、高灵活度的发展方向创新，满足下游客户的复杂测试需求；在电性能测试仪器方面持续提高产品测试能力、产品类型的丰富程度，满足不同应用领域、不同档次的测试需求；在半导体测试设备方面，面向集成电路产品精进迭代、第三代化合物半导体材料、先进封装工艺、硅光技术等前沿应用，实现高技术壁垒、高性能、高可靠性的半导体测试设备的自主研发。同时，随着公司产品矩阵的逐步丰富，公司将具备更加完善的测试服务能力，基于完善的产品体系为客户提供专业、一体化的测试服务方案，提高产品与客户服务质量。

3、积极加强市场拓展，提高客户服务水平

在通信测试仪器方面，公司持续提升自身的技术创新能力及高端产品开发能力，增强公司的市场竞争力，关注境内重点客户的新产品覆盖，以及欧美、日本、东南亚等海外区域目标市场的拓展；在电性能测试仪器方面，公司坚持更高精度、更广测试范围、更丰富测试功能的发展方向，加强技术研发与产品开拓，向更丰富的下游应用场景、终端应用领域拓展；在半导体测试设备方面，公司持续重视与半导体制造厂商与封测厂商的技术需求沟通，加速产品的迭代与客户验证速度，力争实现更多优质半导体下游客户的拓展。同时，公司将不断完善内部管理体系和流程，增强订单的交付效率，通过不断提升质量体系管理、稳定供应能力，增强与客户合作的粘性和业务延伸性。凭借良好的

产品质量和服务优势，公司将大力拓展市场空间，提升盈利能力和市场影响力。

4、进一步完善公司治理和规范运作水平

公司将严格依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性，为公司业务目标的实现奠定基础。

5、充分发挥资本平台的作用

公司对本次的募集资金运用做了充分的论证，公司将结合业务发展目标、市场环境变化，审慎推进募集资金的使用，充分发挥募集资金的作用。同时，公司将充分利用上市后的资本平台，合理、有效地利用资本市场多元融资渠道，为公司长远发展提供资金支持，增强公司的行业地位和竞争优势，实现股东利益最大化。

第八节 公司治理与独立性

一、发行人报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况

公司自整体变更设立股份有限公司以来，根据《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，逐步建立了股东会、董事会、监事会（适用于取消监事会前）/审计委员会、独立董事、董事会秘书等制度，制定和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》等公司治理相关的制度，形成了规范的公司治理结构。2025年9月27日，公司取消监事会，监事会职权由审计委员会承接。

自公司整体变更设立股份有限公司以来，股东会、董事会、监事会（适用于取消监事会前）/审计委员会等组织机构始终遵循相关法律法规、规范性文件及公司章程等内部制度的要求，保持规范运行与高效履职状态。目前，公司已构建起权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责清晰界定、相互制衡约束且规范有效的治理结构及运行机制。公司重大决策依照内部制度规定的程序与规则推进实施，法人治理结构及制度体系运行稳定有效，不存在公司治理缺陷。

二、发行人内部控制情况

（一）公司管理层对内部控制有效性的认定

公司建立健全了覆盖公司经营管理各个环节的内部控制制度，能够适应公司管理的要求，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司确认于2025年9月30日按照《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（二）注册会计师对公司内部控制的审计意见

容诚会计师出具了《苏州联讯仪器股份有限公司内部控制审计报告》（容诚审字[2025]230Z5128号），认为联讯仪器于2025年9月30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（三）财务内控不规范情形及整改情况

报告期内公司不存在新增资金拆借的情形，报告期外向关联方拆出的资金中，所涉本金已于 2022 年 1 月全部清偿，所涉利息已于 2023 年全部清偿。此外，报告期内公司存在为关联方代扣代缴税款的情况，相关关联方已将所涉资金全额清偿。具体情况详见本节“八、关联交易”之“（二）报告期内的关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”的相关内容。

前述款项的本息已偿还完毕，且公司股东会已对上述情形作出确认，关联股东均回避了表决，因此未对公司财务内部控制的有效性造成重大不利影响。除上述往来款项外，报告期内公司不存在其他影响财务内控或不规范的情形，公司已制定《关联交易管理制度》等内部控制管理制度，将严格按照内控制度进行资金管理，有效保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。

三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况

2024 年 11 月 25 日，上海外高桥港区海关以公司未按照规定期限将暂时出口货物复运进境的事由，出具行政处罚决定（沪外港关缉违字〔2024〕298 号），科处联讯仪器罚款人民币 39,000 元。上述处罚罚款金额及比例属于法定处罚幅度内减轻行政处罚的区间，金额相对较小，且属于程序性违规，未对公司在海关的信用等级认定构成影响，不属于重大违法违规行为。

报告期内，公司不存在重大违法违规行为。

四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况

（一）资金占用情况

公司已制定严格的内部控制管理制度。除本节“八、关联交易”之“（二）报告期内的关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”披露的相关内容外，报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）对外担保情况

报告期内，发行人不存在对外担保的情况。发行人已制定并执行《对外担保管理制

度》，在《公司章程》《对外担保管理制度》中明确规定了对外担保的审批程序，有效防范公司对外担保风险，保障公司和股东的利益。

五、发行人独立运行情况

发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运行，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人具有独立、完整的资产、业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整情况

发行人系采用整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。发行人资产独立完整、产权明晰，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用、支配发行人重要资产或者越权干预发行人对其资产的经营管理而损害发行人利益的情形。

（二）人员独立情况

发行人根据《公司法》《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、取消监事会前任监事并聘请独立董事，董事会聘用高级管理人员。发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。发行人已建立了独立的人事及工资管理体系，不存在发行人的财务人员在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职或领取薪酬的情形，员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理。

（三）财务独立情况

发行人设置了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，并根据现行的会计准则及相关法规，结合实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。发行人在银行开设了独立账户，并按照制定的会计制度独立核算各类经济业务，不存在

与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。发行人作为独立的纳税人进行纳税申报并履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。

（四）机构独立情况

发行人按照《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定建立了股东会、董事会、监事会（适用于取消监事会前）/审计委员会、经营管理层等决策、经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。发行人的生产经营、办公机构与控股股东和实际控制人控制的其他企业分开且独立运作，拥有机构设置自主权，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合经营、机构混同的情况。

（五）业务独立情况

发行人拥有独立完整的业务流程、独立的生产经营场所以及采购、销售的部门和渠道。发行人已建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织架构，能够独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。发行人所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其他企业，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在严重影响独立性或显失公平的关联交易。

（六）经营稳定性

发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均未发生重大不利变化。发行人股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷。

（七）重大变化及影响事项

发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保，不存在经营环境已经或将要发生的重大不利变化等对持续经营有重大影响的事项。截至本招股说明书签署日，发行人与Aehr公司尚未了结的诉讼情况详见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼、仲裁或其他事项”。

六、同业竞争

（一）发行人控股股东、实际控制人及其控制的企业与公司不存在同业竞争的情况

截至本招股说明书签署日，除发行人及其子公司外，发行人控股股东、实际控制人胡海洋、黄建军、杨建控制的企业均系公司的员工持股平台，未实际经营业务，不存在与发行人从事相同、相似业务的情况。因此，发行人控股股东、实际控制人及其控制的企业与发行人不存在同业竞争。

（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，发行人控股股东、实际控制人胡海洋、黄建军、杨建出具了《关于避免同业竞争的承诺》，具体内容详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”之“（八）控股股东、实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺”。

七、关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则》以及中国证监会和上交所的有关规定，公司报告期内的关联方及关联关系如下：

（一）发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人

发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”及“（二）实际控制人的一致行动人”。

（二）直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人

序号	关联方名称	关联关系
1	周晓峰	发行人员工，担任发行人员工持股平台博睿光通（直接持有公司 6.94% 的股份）的执行事务合伙人

除上述关联自然人之外，其他间接控制发行人 5%以上有表决权股份的间接自然人股东均为发行人的关联方。

（三）发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员

发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核

心技术人员”及“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”。

（四）前述关联自然人关系密切的家庭成员

前述关联自然人关系密切的家庭成员，包括其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母为发行人的关联方。

（五）直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

直接持有发行人5%以上股份的法人或其他组织的具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人控股股东、实际控制人及其他主要股东情况”之“（二）实际控制人的一致行动人”及“（五）其他持有发行人5%以上股份的主要股东”。

（六）前述 1 至 5 项关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或者其他组织（发行人及其控股子公司除外）

序号	关联方名称	与发行人的关联关系
1	思诺威	实际控制人胡海洋担任董事的企业
2	南京创芯慧联技术有限公司	发行人董事刘晋担任董事的企业
3	江苏京创先进电子科技有限公司	发行人董事刘晋担任董事的企业
4	北京恒达时讯科技股份有限公司	发行人董事刘晋担任董事的企业
5	江苏万邦微电子有限公司	发行人董事刘晋担任董事的企业
6	斯润天朗（北京）科技有限公司	发行人董事刘晋担任董事的企业
7	凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司	发行人董事刘晋担任董事的企业
8	江苏数智毅达私募基金管理有限公司	发行人董事刘晋担任董事、经理的企业
9	成都迈科科技有限公司	发行人董事刘晋担任董事的企业
10	江苏阳晓电子科技有限公司	发行人董事刘晋担任董事的企业
11	苏州赛迈测控技术有限公司	发行人董事刘晋担任董事的企业
12	太景科技（南京）有限公司	发行人董事刘晋担任董事的企业
13	上海合利微半导体有限责任公司	发行人董事刘晋担任董事的企业

序号	关联方名称	与发行人的关联关系
14	深圳市迈特芯科技有限公司	发行人董事刘晋担任董事的企业
15	南京芯岩光半导体有限公司	发行人董事刘晋担任董事的企业

除上述主要关联方之外,其他前述 1 至 5 项关联法人或关联自然人直接或者间接控制的,或者由前述关联自然人(独立董事除外)担任董事、高级管理人员的法人或者其他组织(发行人及其控股子公司除外)均构成发行人的关联方。

(七) 间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

序号	关联方名称	关联关系
1	厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司	鑫瑞集诚的执行事务合伙人,鑫瑞集诚直接持有发行人 5%以上股份
2	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	中小企业发展基金的执行事务合伙人,中小企业发展基金直接持有发行人 5%以上股份
3	南京毅达资本管理企业(有限合伙)	直接或间接合计控制江苏毅达股权投资基金管理有限公司 65%股权
4	南京毅达投资管理有限公司	南京毅达资本管理企业(有限合伙)的执行事务合伙人
5	深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司	南山架桥和架桥富凯的执行事务合伙人,南山架桥和架桥富凯合计持有发行人 5%以上股份
6	深圳市架桥资本管理股份有限公司	直接持有深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司 100%股权

(八) 发行人的控股子公司

发行人控股子公司具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人分公司、子公司及参股公司情况”之“(一) 控股子公司”。

(九) 报告期内曾经的主要关联方

序号	关联方名称 / 姓名	与发行人的关联关系
1	联讯众创	曾系发行人控股子公司,于2022年4月注销
2	联讯睿哲	曾系发行人控股子公司,于2022年11月注销
3	北京国联视讯信息技术股份有限公司	发行人董事刘晋曾任董事的企业,于2022年6月卸任
4	湖北犇星新材料股份有限公司	发行人董事刘晋曾任董事的企业,于2024年6月卸任
5	江苏联康信息股份有限公司	发行人董事刘晋曾任董事的企业,于2025年1月卸任
6	感睿智能科技(常州)有限公司	发行人董事刘晋曾任董事的企业,于2025年3月卸任
7	瞰景科技发展(上海)有限公司	发行人董事刘晋曾任董事的企业,于2025年5月卸任
8	南京天河汽车零部件股份有限公司	发行人董事刘晋曾任董事的企业,于2026年1月卸任

序号	关联方名称 / 姓名	与发行人的关联关系
9	芯未来一期	发行人股东，现持有发行人4.91%的股权，曾持有5%以上的股份
10	上海兴橙投资管理有限公司	芯未来一期的执行事务合伙人
11	王育贤	曾通过鑫瑞集诚间接持有发行人5%以上的股份
12	泉州桐翔置业有限公司	王育贤持有100%的股权并担任执行董事兼总经理的企业
13	厦门银科启瑞半导体科技有限公司	王育贤持有13.46%的股权并担任董事的企业
14	厦门亿彤贸易有限公司	王育贤配偶陈凤尾直接持股90%，王育贤哥哥王育强直接持股10%并担任执行董事、总经理兼法定代表人的企业
15	厦门桐昆贸易有限公司	王育贤哥哥王育锋直接持股51%并担任执行董事、总经理兼法定代表人，王育贤哥哥王育强直接持股49%的企业
16	常宁市芝麻山矿业发展有限责任公司	王育贤哥哥王育锋直接持股50%，王育贤直接持股20%的企业
17	泉州恒路商贸有限公司	王育贤哥哥王育强直接持股100%并担任执行董事、经理兼法定代表人的企业，于2026年1月注销
18	泉州锐取商贸有限公司	王育贤哥哥王育强直接持股60%并担任执行董事、总经理兼法定代表人的企业
19	上海麦萱	发行人董事长胡海洋配偶朱悦曾持有100%的股权的企业，于2022年10月注销
20	张照锋	曾任发行人财务负责人，于2022年10月卸任
21	苏州磁联信息咨询合伙企业（有限合伙）	张照锋担任执行事务合伙人并持有26.67%的财产份额
22	度亘核芯光电技术（苏州）股份有限公司	张照锋曾任董事的企业，于2022年10月卸任
23	苏州度亘光电器件有限公司	张照锋曾任董事的企业，于2023年4月卸任
24	度亘天元激光科技（丹阳）有限公司	张照锋曾任董事的企业，于2023年3月卸任
25	苏州奥镭光电科技有限公司	张照锋曾任董事的企业，于2023年3月卸任
26	苏州度亘垂腔芯片技术有限公司	张照锋曾任董事的企业，于2023年5月卸任
27	李丹云	曾任发行人独立董事，于2022年11月卸任
28	苏州市美麒进出口有限公司	李丹云子女的配偶唐子夏持有95%的股权并担任法定代表人、执行董事的企业
29	苏州美麟酒业有限公司	李丹云子女的配偶唐子夏曾持有100%的股权并担任法定代表人、执行董事的企业，于2022年12月注销
30	苏州美麟进出口有限公司	李丹云子女配偶的父母唐坚持持有90%的股权并担任董事的企业
31	苏州革力申信息技术有限公司	发行人取消监事会前在任监事郭孝明直接持有50%股权并实际控制的企业，于2024年8月注销
32	上海厚力电子科技有限公司	间接持有发行人5%以上股份的自然人周晓峰曾持有73%的股权并担任执行董事的企业，于2021年6月注销
33	庄松林	曾任发行人独立董事，于2025年9月卸任
34	上海光学仪器研究所	庄松林担任法定代表人的机构
35	上海科威光学技术公司	庄松林担任法定代表人的企业

序号	关联方名称 / 姓名	与发行人的关联关系
36	合肥上合光电科技有限公司	庄松林通过直接持有80%的股权控制的企业

（十）其他关联方

除上述已披露的关联方外，根据实质重于形式原则认定的发行人其他关联方：

序号	关联方名称	关联关系
1	合晶诺	发行人的参股公司
2	思诺微（上海）集成电路设计有限公司	思诺威的全资子公司（思诺威系发行人实际控制人胡海洋担任董事的企业）

八、关联交易

（一）重大关联交易判断标准

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，公司与关联人发生的交易金额（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的交易，且超过 3,000 万元，应当提交股东会审议。根据以上规定，结合报告期内公司的总资产、净资产规模与收入、净利润水平，以及公司关联交易的频率、性质、金额等，公司将与关联法人年度交易额在 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）以上的交易及与关联自然人年度交易额在 30.00 万元（含 30.00 万元）以上的交易认定为重大关联交易。此外，公司向关联自然人提供薪酬为公司正常经营活动的必要支出，为一般关联交易。

报告期内，公司不存在重大关联交易。

（二）报告期内的关联交易情况

报告期内，公司发生的全部关联交易简要汇总如下：

单位：万元

类型	关联交易内容	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经常性关联交易	向关联方采购商品、接受劳务	1,527.13	1,234.21	367.92	133.17
	向关联方出售商品、提供劳务	7.43	32.74	-	-
	关键管理人员报酬	416.91	722.94	580.53	400.83
偶发性关联交易	关联担保	详见本节“八、关联交易”之“（二）报告期内的关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“（1）关联担保情况”			
	关联方资金拆	详见本节“八、关联交易”之“（二）报告期内的关联交易情况”之			

类型	关联交易内容	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
	借	“2、偶发性关联交易”之“（2）关联方资金拆借”			
	代扣代缴税款	详见本节“八、关联交易”之“（二）报告期内的关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“（3）代扣代缴税款”			
	专家评审费用	详见本节“八、关联交易”之“（二）报告期内的关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“（4）专家评审费用”			

1、经常性关联交易

（1）向关联方采购商品、接受劳务的关联交易

报告期内，公司向关联方采购商品、接受劳务情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
思诺威	采购商品、技术服务	1,387.54	1,234.21	367.92	132.99
合晶诺	采购商品	139.59	-	-	-
上海麦萱	广告服务	-	-	-	0.18
合计	-	1,527.13	1,234.21	367.92	133.17

报告期内，公司关联采购金额分别为 133.17 万元、367.92 万元、1,234.21 万元和 1,527.13 万元，占各期营业成本的比例分别为 1.10%、3.38%、4.30%和 4.64%，占比较小，对公司生产经营不构成重大影响。

（2）向关联方出售商品、提供劳务的关联交易

报告期内，公司向关联方出售商品、提供劳务情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
思诺威	出售商品	7.43	7.43	-	-
苏州赛迈测控技术有限公司	出售商品	-	25.31	-	-
合计	-	7.43	32.74	-	-

报告期内，公司仅 2024 年度和 2025 年 1-9 月涉及关联销售，金额为 32.74 万元和 7.43 万元，占当期营业收入的比例为 0.04%和 0.01%，占比较小，对公司生产经营不构成重大影响。

（3）关键管理人员报酬

报告期内，公司关键管理人员薪酬如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员报酬	416.91	722.94	580.53	400.83

2、偶发性关联交易

（1）关联担保情况

报告期内，公司仅存在作为被担保方的关联担保，具体情况如下：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡海洋	最高限额 725 万	2020-2-25	2023-2-20	是
胡海洋	最高限额 3,375 万	2021-4-16	2024-4-15	是
胡海洋	最高限额 1,000 万	2021-6-21	2022-6-21	是
胡海洋	最高限额 1,000 万	2021-9-23	2022-9-22	是
胡海洋	最高限额 1,000 万	2021-9-23	2022-9-22	是
胡海洋	最高限额 5,500 万	2022-8-30	2025-4-14	是

（2）关联方资金拆借

报告期内，公司不存在新增资金拆借的情形，具体如下：

单位：万元

关联方名称	期初金额	本期拆出	本期归还	期末金额
2022 年资金拆出情况				
胡海洋	0.12	-	0.12	-
黄建军	0.89	-	0.89	-
杨建	2.55	-	2.55	-
陈晓东	32.66	0.10	30.00	2.76
周晓峰	14.98	-	14.98	-
2023 年资金拆出情况				
陈晓东	2.76	-	2.76	-

其中，陈晓东 2022 年度拆出的资金系以前年度拆借资金相应计提的利息，其拆借本金已于 2022 年 1 月归还，拆借利息已于 2023 年度归还；其他关联方期初期末金额均为以前年度资金拆借所计提的利息，已于 2022 年度全部归还。

（3）代扣代缴税款

报告期内，公司存在为关联方代扣代缴个人所得税、印花税等税费的情况，相关关

联方已将公司代扣代缴的税款向公司足额缴纳。

(4) 专家评审费用

公司独立董事庄松林担任公司“宽频带取样示波器”项目（国家重点研发计划之“基础科研条件与重大仪器设备研发”专项）的重点专家委员会委员，公司于 2023 年 3 月向庄松林支付 0.84 万元专家评审费。

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：万元

项目名称	关联方	2025.9.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州赛迈测控技术有限公司	-	-	6.00	-	-	-	-	-
其他应收款	陈晓东	-	-	-	-	-	-	2.76	0.50
预付账款	思诺威	82.94	-	81.12	-	95.39	-	-	-
合计	-	82.94	-	87.12	-	95.39	-	2.76	0.50

(2) 应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
应付账款	思诺威	668.00	-	183.96	75.47
应付账款	合晶诺	83.90	-	-	-
预收账款	苏州赛迈测控技术有限公司	-	2.00	-	-
合计	-	751.90	2.00	183.96	75.47

(三) 关联交易对公司报告期内财务状况、经营成果和主营业务的影响

报告期内，公司发生的经常性关联交易主要系公司日常经营中向关联方采购商品和服务、出售商品，交易内容合理。公司与关联方保持独立运作，独立核算，关联交易定价参考同类交易的市场价格，交易价格公允。与公司生产经营规模相比，上述关联交易金额较小，不存在损害公司及其他股东利益的情况，未对公司财务状况和经营成果造成不利影响。报告期内，公司偶发性关联交易不存在损害公司及其股东利益的情况，未对

公司财务状况和经营成果造成不利影响。

（四）规范关联交易的制度安排

依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规，公司已在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》中对关联交易的批准权限及表决程序等事项作了相应规定。公司制定了《独立董事工作制度》，明确规定了独立董事对关联交易决策的特别职权；公司制定了《关联交易管理制度》，明确规定了关联方及关联交易认定、关联交易的披露及决策程序、关联交易定价等具体问题。

（五）报告期内关联交易制度的履行情况及独立董事意见

1、关联交易制度履行情况

公司已召开董事会、股东会对报告期内发生的关联交易予以确认。公司与关联方发生的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，公司对报告期内发生的关联交易均履行了公司章程规定的相应的审批程序。

2、独立董事对关联交易的意见

根据公司独立董事出具的独立意见，认为公司已发生关联交易基于公司正常业务经营，符合公司实际经营情况和发展需要，定价依据遵循了公正合理的交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议关联交易事项时，表决程序合法、关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（六）未来规范和减少关联交易的措施

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的定价、批准权限和决策程序均作了严格细致的规定，以规范公司未来的关联交易行为。对不可避免的关联交易，公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了回避制度、决策权限、决策程序、信息披露等内容，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，以确保关联交易的公开、公允、合理，保护广大股东的利益。

为促进公司持续规范运作，避免公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、持有发行人 5%以上股份的其他股东、公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员

员在生产经营活动中损害公司利益，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、持有发行人 5%以上股份的其他股东、公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员就规范和减少关联交易事项出具相应承诺，具体详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺”之“（九）控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东关于规范关联交易和避免资金占用的承诺”。

第九节 投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，公司首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东按照持股比例共同享有。

二、发行人股利分配政策

（一）本次发行后的股利分配政策

1、公司章程中利润分配相关规定

2025 年 4 月 28 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《苏州联讯仪器股份有限公司章程（草案）》，自发行人首次公开发行股票并上市后适用，约定了公司本次发行后的股利分配政策如下：

（1）公司的利润分配原则：公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（2）公司的利润分配形式：可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金方式分配股利。公司采用股票方式分配股利的，应结合公司的经营状况和股本规模，充分考虑成长性、每股净资产的摊薄等因素。

（3）现金分红的条件：1）公司累积可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的 10%，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（4）股票股利分红的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润与上一年度相比保持增长，且董事会认为公司进行股票股利分配不会造成公司股本规模及股权结构不合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票

股利分配预案。

(5) 利润分配的比例及期间间隔：在符合利润分配原则及条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后可以进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，半年度财务报告可不经审计。

公司应保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

考虑到公司目前处于成长期，如公司有重大资金支出安排的，公司进行利润分配时现金分红在该次利润分配中所占比例不低于 20%；如公司无重大资金支出安排的，公司进行利润分配时现金分红在该次利润分配中所占比例不低于 30%。

前款所称“重大资金支出”指预计在未来一个会计年度一次性或者累计资金支出超过 5,000 万元或公司未来一个会计年度内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 30%。

(6) 公司利润分配的制定和审议程序：

1) 公司利润分配政策和利润分配方案应由公司董事会制订，并经董事会审议通过后提交公司股东会批准，独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。审计委员会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。

①董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

②董事会在决策和形成利润分配预案时，应详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、审计委员会意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

③股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充

分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2) 公司因特殊原因而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报中详细披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益事项，并经股东会审议通过。

(7) 公司利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、本章程的有关规定，分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事、审计委员会应当对利润分配政策调整方案发表意见。

(8) 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

2、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司制订了公司上市后未来三年股东分红回报规划。2024年1月26日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案。

制定该规划的原则如下：公司董事会根据相关法律法规要求及当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证股利分配政策的稳定性和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制，在兼顾股东回报和企业发展的同时，保证股东长期利益的最大化，从而确定合理的利润分配规划及具体方案。

制定该规划考虑的因素如下：公司上市后未来三年股东回报规划是在综合分析企业

整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。

3、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排

(1) 发行人上市后三年内的利润分配计划

1) 利润分配方式

公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序：具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2) 实施现金分配的条件

①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②公司累计可供分配利润为正值；

③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

④公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项(募集资金项目除外)，重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来一个会计年度内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 30%或在未来一个会计年度一次性或者累计资金支出超过 5,000 万元。

3) 实施股票分红的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

4) 现金分配的比例

①公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时公司应当优先采用现金分红进行利润分配，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。

②公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；

B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之四十；

C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理；
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

5) 现金分配的时间间隔

在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会审议通过后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东会审议批准。

6) 公司利润分配的制定和审议程序

①公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的

问题。

②公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

③监事会应当审议利润分配方案，并作出决议。

④董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东会审议批准。

⑤股东会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决。股东对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

⑥公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会审议通过后 2 个月内完成利润分配事项。

7) 公司利润分配政策的调整机制

公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。根据公司发展阶段变化、生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合章程规定的条件等事项发表明确意见，且公司应在股东会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，必要时，可通过网络投票系统征集股东意见。

公司调整现金分红政策的具体条件：

①公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；

②自利润分配的股东会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；

③按照既定分红政策执行将导致公司股东会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；

④董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

8) 利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见，同时在召开股东会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

（2）制订的依据和可行性

公司上市后三年内的利润分配计划的制定依据详见本节“二、发行人股利分配政策”之“（一）本次发行后的股利分配政策”之“2、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由”，上述利润分配计划具有可行性。

（3）未分配利润的使用安排

报告期内公司利润分配情况如下所示：

期间	利润分配情况
2022 年度	2022 年 7 月，联讯有限召开股东会，全体股东一致同意：联讯有限以截至 2022 年 6 月 30 日的可供股东分配利润向截至 2022 年 7 月 25 日全体在册股东按照出资比例进行现金分红，合计分配 21,064,108.00 元（含税）
2023 年度	2023 年度未进行利润分配
2024 年度	2024 年度未进行利润分配

期间	利润分配情况
2025 年 1-9 月	2025 年 1-9 月未进行利润分配

截至本招股说明书签署日，公司已完成上述利润分配。

4、公司长期回报规划内容及制定考虑因素

公司将着眼于长远和可行性发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的稳定性和连续性。

公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当前资金需求，制定年底或中期分红方案。

公司长期回报规划的内容详见本节“二、发行人股利分配政策”之“（一）本次发行后的股利分配政策”之“1、公司章程中利润分配相关规定”及“3、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排”。

（二）发行前后股利分配政策的差异情况

与发行前股利分配政策相比，本次发行后的股利分配政策进一步细化了在利润分配的比例及期间间隔、公司利润分配的制定和审议程序等方面的具体规定，以更好地保障公众投资者利益，给予投资者合理、稳定的投资回报。

三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况

根据《公司章程（草案）》，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。《公司章程（草案）》未针对特定股东设置特别表决权股份，公司股东亦不存在协议控制的特殊安排情况。

截至本招股说明书签署日，公司不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

本节所披露的重大合同是指报告期内公司及子公司履行完毕、正在履行和将要履行且对公司生产经营、财务状况或未来发展具有重要影响的合同，公司结合自身业务特点，参照重要性水平的确定标准和依据，综合考虑总资产、营业收入、净利润等财务指标，确定了各类重大合同的标准，具体情况如下：

（一）销售合同

截至报告期末，公司含税金额合计在3,000.00万元人民币或300.00万美元以上（含）的重大销售合同如下：

序号	签署主体	合同当事人	合同标的	合同价款	履行期限	截至本招股说明书签署日履行情况
1	联讯仪器	绍兴比亚迪半导体有限公司	晶圆级老化系统	4,271.40 万元	2024 年 9 月 2 日至合同标的履行完毕	履行完毕
2	新加坡联讯	Applied Optoelectronics, Inc.	光芯片 KGD 分选测试系统	590.08 万美元	2025 年 1 月 7 日至合同标的履行完毕	正在履行
3	联讯仪器	厦门士兰明镓化合物半导体有限公司	晶圆级老化系统	4,104.00 万元	2024 年 9 月 20 日至合同标的履行完毕	履行完毕
4	联讯仪器	客户一	采样示波器、时钟恢复单元	3,740.14 万元	2024 年 4 月 30 日至合同标的履行完毕	履行完毕
5	联讯仪器	株洲中车时代半导体有限公司	晶圆级老化系统	3,626.00 万元	2025 年 3 月 13 日至合同标的履行完毕	正在履行
6	联讯仪器	成都新易盛通信技术股份有限公司	CoC 光芯片老化测试系统	3,604.48 万元	2024 年 9 月 12 日至合同标的履行完毕	履行完毕
7	联讯仪器	客户三	采样示波器	3,008.37 万元	2025 年 3 月 17 日至合同标的履行完毕	履行完毕
8	联讯仪器	TERAHOP (THAILAND) CO., LTD.	采样示波器、时钟恢复单元	316.83 万美元	2025 年 3 月 18 日至合同标的履行完毕	履行完毕
9	联讯仪器	新易盛（香港）有限公司	CoC 光芯片老化测试系统	472.93 万美元	2025 年 9 月 15 日至合同标的履行完毕	正在履行

（二）采购合同

截至报告期末，公司含税金额合计在500.00万元人民币或50.00万美元以上（含）的重大采购合同如下：

序号	签署主体	合同当事人	合同标的	合同价款	履行期限	截至本招股说明书签署日履行情况
1	联讯仪器	PANGAEA (H.K.) LIMITED	光接收模块	165.15 万美元	2024 年 4 月 13 日至合同标的履行完毕	履行完毕
2	联讯仪器	深圳市鞍点科技有限公司	弹簧继电器	1,015.59 万元	2025 年 3 月 17 日至合同标的履行完毕	正在履行
3	联讯仪器	PANGAEA (H.K.) LIMITED	光接收模块	93.00 万美元	2023 年 7 月 3 日至合同标的履行完毕	履行完毕
4	联讯仪器	矽电半导体设备（深圳）股份有限公司	探针台	648.00 万元	2024 年 12 月 20 日至合同标的履行完毕	履行完毕
5	联讯仪器	万机仪器(中国)有限公司	光学平移台、光学探头等	580.75 万元	2025 年 2 月 24 日至合同标的履行完毕	履行完毕
6	联讯仪器	PANGAEA (H.K.) LIMITED	光接收模块	76.88 万美元	2023 年 5 月 16 日至合同标的履行完毕	履行完毕
7	联讯仪器	PANGAEA (H.K.) LIMITED	光接收模块	73.40 万美元	2024 年 7 月 10 日至合同标的履行完毕	履行完毕
8	联讯仪器	南京博芯电子科技有限公司	光罩	1,161.29 万元	2025 年 5 月 23 日至合同标的履行完毕	履行完毕
9	联讯仪器	佛山市联动科技股份有限公司	测试机	610.00 万元	2025 年 4 月 11 日至合同标的履行完毕	履行完毕
10	联讯仪器	Mirae Corporation	分选机	54.10 万美元	2025 年 7 月 17 日至合同标的履行完毕	履行完毕
11	联讯仪器	PANGAEA (H.K.) LIMITED	光接收模块	91.75 万美元	2025 年 5 月 30 日至合同标的履行完毕	履行完毕

（三）委托研发合同

截至报告期末，公司含税金额合计在500.00万元人民币以上（含）的重大委托研发合同如下：

序号	签署主体	合同当事人	合同标的	合同价款	履行期限	截至本招股说明书签署日履行情况
1	联讯仪器	思诺威科技（无锡）有限公司	IC 设计服务	1,600.00 万元	2024 年 7 月 10 日至合同标的履行完毕	正在履行
2	联讯仪器	南京博芯电子科技有限公司	IC 设计服务	1,600.00 万元	2024 年 7 月 15 日至合同标的履行完毕	正在履行
3	联讯仪器	思诺威科技（无锡）有限公司	IC 设计服务	650.00 万元	2023 年 3 月 15 日至合同标的履行完毕	履行完毕
4	联讯仪器	思诺威科技（无锡）有限公司	IC 设计服务	500.00 万元	2024 年 6 月 18 日至合同标的履行完毕	正在履行
5	联讯仪器	思诺威科技（无锡）有限公司	IC 设计服务	1,200.00 万元	2025 年 5 月 9 日至合同标的履行完毕	正在履行

（四）建设工程合同

截至报告期末，公司含税金额合计在 2,000 万元人民币以上（含）的重大建设工程合同如下：

序号	发包人	承包人	工程内容	合同价款	履行期限	截至本招股说明书签署日履行情况
1	联讯仪器	苏州中设建设集团有限公司	年产 2,000 台套光通信测试仪表、光芯片及功率芯片测试装备新建项目总承包工程	7,218.88 万元	2023 年 9 月 23 日至工程内容履行完毕	正在履行

（五）借款及授信合同

截至报告期末，公司含税金额合计在 10,000 万元人民币以上（含）的重大银行借款及授信合同如下：

序号	类型	签署主体	借款银行/额度授予银行	借款/授信金额	借款/授信期限	截至本招股说明书签署日履行情况	担保情况
1	授信	联讯仪器	中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	16,000.00 万元	2024 年 1 月 24 日至 2029 年 1 月 23 日	正在履行	无
2	授信	联讯仪器	招商银行股份有限公司苏州分行	20,000.00 万元	2025 年 2 月 17 日起到 2028 年 2 月 16 日	正在履行	无

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保事项。

三、重大诉讼、仲裁或其他事项

截至本招股说明书签署日，公司与 Aehr 之间的专利侵权纠纷案相关情况如下：

（一）案件受理情况

2024 年 9 月，Aehr 以公司侵犯其在中国申请的两项专利权向苏州市中级人民法院提起诉讼。2024 年 10 月，苏州市中级人民法院予以立案。

2024 年 11 月至 12 月，公司向国家知识产权局提交《专利权无效宣告请求书》，申请宣告两起侵害发明专利权纠纷涉及的专利权无效。

（二）基本案情、诉讼或仲裁请求及案件进展

1、侵害发明专利权纠纷（(2024)苏05民初1316号）及公司请求宣告涉案专利权无效（案件编号：10000534160435/4W119149）

（1）侵害发明专利权纠纷诉讼

原告	Aehr
被告	联讯仪器
诉讼请求	1、判令被告立即停止侵害第 ZL201310159573.4 号发明专利的行为，包括停止制造、使用、销售、许诺销售、进口侵犯原告专利权的所有产品，停止使用涉案专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照涉案专利方法获得的产品。 2、判令被告赔偿原告为制止侵权行为而产生的费用，并承担本案诉讼费用，暂定人民币 100 万元。 2025 年 10 月 17 日开庭时，Aehr 提交变更后的书面起诉状，主要诉讼请求包括： 1、判令被告立即停止侵害第 ZL201310159573.4 号发明专利的行为，包括停止制造、使用、销售、许诺销售、进口侵犯原告专利权的所有产品，停止使用涉案专利方法。 2、判令被告赔偿原告经济损失共计人民币 500 万元。 3、判令被告承担本案诉讼费用。
基本案情	Aehr 是涉案专利的专利权人。涉案专利的专利号为 ZL201310159573.4，发明名称为“测试微电子电路的方法、测试器设备及便携式组装装置”，申请日为 2008 年 4 月 4 日，授权公告日为 2014 年 2 月 12 日。 原告认为被告制造、许诺销售、销售、进口的晶圆级老化系统可能侵犯了原告的专利权。
进展	截至本招股说明书签署日，一审法院已作出《民事判决书》，判决驳回原告的全部诉讼请求。Aehr 和发行人均已提起上诉，人民法院已立案

（2）公司请求宣告涉案专利权无效

无效宣告请求人	联讯仪器
无效宣告专利权人	Aehr
案件编号	10000534160435/4W119149
无效申请事由	根据专利法第 45 条及专利法实施细则第 69 条的规定，对 ZL201310159573.4，发明名称为“测试微电子电路的方法、测试器设备及便携式组装装置”专利权提出无效宣告请求。
进展	2025 年 5 月 28 日，国家知识产权局作出《无效宣告请求审查决定书（第 587312 号）》，宣告 Aehr 持有的 ZL201310159573.4 号发明专利的权利要求 1-39、52-77、91-93 无效。截至本招股说明书签署日，Aehr 已就上述无效宣告请求审查决定提起发明专利无效行政诉讼，被告为国家知识产权局，公司为该案第三人

2、侵害发明专利权纠纷（(2024)苏05民初1317号）及公司请求宣告涉案专利权无效（案件编号：10000535263454/4W119262）

（1）侵害发明专利权纠纷诉讼

原告	Aehr
被告	联讯仪器
诉讼请求	1、判令被告立即停止侵害第 ZL200880018734.5 号发明专利的行为，包括停止制造、使用、销售、许诺销售、进口侵犯原告专利权的所有产品，停止使用涉案专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照涉案专利方法获得的产品。 2、判令被告赔偿原告为制止侵权行为而产生的费用，并承担本案诉讼费用，暂定人民币 100 万元。 2025 年 10 月 17 日开庭时，Aehr 提交变更后的书面起诉状，主要诉讼请求包括： 1、判令被告立即停止侵害第 ZL200880018734.5 号发明专利的行为，包括停止制造、使用、销售、许诺销售、进口侵犯原告专利权的所有产品，停止使用涉案专利方法。 2、判令被告赔偿原告经济损失共计人民币 500 万元。 3、判令被告承担本案诉讼费用。
基本案情	Aehr 是涉案专利的专利权人。涉案专利的专利号为 ZL200880018734.5，发明名称为“测试微电子电路的方法、测试器设备及便携式组装装置”，申请日为 2008 年 4 月 4 日，授权公告日为 2014 年 2 月 12 日。 原告认为被告制造、许诺销售、销售、进口的晶圆级老化系统可能侵犯了原告的专利权。
进展	截至本招股说明书签署日，一审法院已作出《民事判决书》，判决驳回原告的全部诉讼请求。Aehr 和发行人均已提起上诉，人民法院已立案

（2）公司请求宣告涉案专利权无效

无效宣告请求人	联讯仪器
无效宣告专利权人	Aehr
案件编号	10000535263454/4W119262
无效申请事由	根据专利法第 45 条及专利法实施细则第 69 条的规定，对 ZL200880018734.5，发明名称为“测试微电子电路的方法、测试器设备及便携式组装装置”专利权提出无效宣告请求。

进展	2025 年 7 月 16 日，国家知识产权局作出《无效宣告请求审查决定书（第 587724 号）》，宣告 AeHR 持有的 ZL200880018734.5 号发明专利的权利要求 18-52 无效。截至本招股说明书签署日，AeHR 已就上述无效宣告请求审查决定提起发明专利无效行政诉讼，被告为国家知识产权局，公司为该案第三人

（三）案件对发行人的影响

AeHR 主张公司侵权的产品均系公司自主研发成果，不存在侵犯 AeHR 专利权的情况。目前 AeHR 持有的涉案专利已经被国家知识产权局宣告部分无效，相关侵害发明专利权纠纷诉讼一审法院已作出《民事判决书》，判决驳回原告的全部诉讼请求。此外，公司采用不同设计方案的迭代产品产业化进展顺利，基于上述事实，公司评估后认为相关诉讼将不会对公司持续经营产生重大不利影响。

第十一节 声明

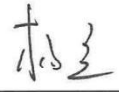
一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

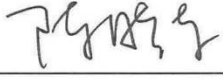
全体董事：

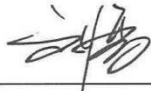

胡海洋

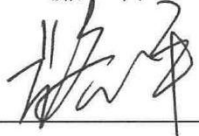

黄建军

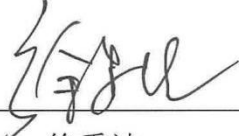

杨 建

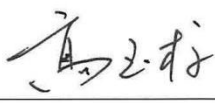

廉 哲


陈晓东


刘 晋

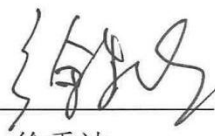

路国平

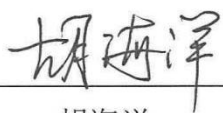

徐秀法


高玉标

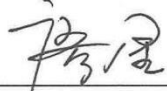
全体审计委员会成员：


路国平


徐秀法


胡海洋

除董事以外的全体高级管理人员：


廖 金

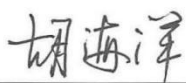
苏州联讯仪器股份有限公司

2026 年 4 月 20 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：



胡海洋

实际控制人：



胡海洋



黄建军



杨 建



三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：



赵 耀



孟 硕

项目协办人：



周 欢

法定代表人：



张佑君



保荐人（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读苏州联讯仪器股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

董事长：

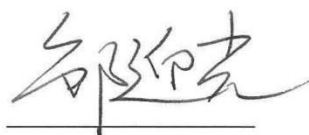

张佑君



保荐人（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读苏州联讯仪器股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

总经理：



邹迎光



四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

负责人：_____



王 丽

经办律师：_____



戴 祥



李超然



胡承浩

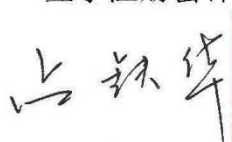


2026 年 4 月 20 日

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、审阅报告（如有）、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


占铁华

中国注册会计师
占铁华
340501610002


王鸣灿

中国注册会计师
王鸣灿
110100323969


蔡的伟

中国注册会计师
蔡的伟
110100321093

会计师事务所负责人：


刘维

中国注册会计师
刘维
350200020149

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

1101020362092

2026 年 4 月 20 日

六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资产评估师：



武志平
(已离职)

资产评估机构负责人：



江苏中企华中天资产评估有限公司



2026 年 4 月 20 日

关于签字资产评估师武志平离职的说明

2022年9月23日，江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“本公司”）出具的《苏州联讯仪器有限公司拟改制设立股份有限公司涉及的该公司净资产价值资产评估报告》（苏中资评报字（2022）第2085号）的签字资产评估师为于景刚和武志平，其中，签字资产评估师武志平已从本公司离职，因此无法在本公司出具的资产评估机构声明页中签字，但签字资产评估师的离职不影响本公司已出具的上述资产评估报告的法律效力。

特此说明。

资产评估机构负责人：



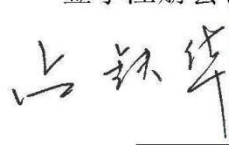
江苏中企华中天资产评估有限公司



七、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

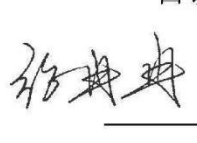
占铁华

王鸣灿

蔡的伟

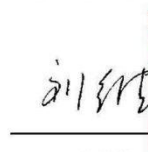
 

张冉冉

黄景辉

(已离职)

会计师事务所负责人：

刘维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



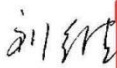
2026 年 4 月 20 日

关于验资机构签字注册会计师黄景辉离职的说明

2021年4月28日至2022年11月1日期间，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）出具的苏州联讯仪器股份有限公司验资报告容诚验字[2021]230Z0085号（报告日2021年4月28日）、容诚验字[2022]230Z0089号（报告日2022年4月20日）、容诚验字[2022]230Z0090号（报告日2022年4月25日）、容诚验字[2022]230Z0238号（报告日2022年9月5日）和容诚验字[2022]230Z0316号（报告日2022年11月1日），签字注册会计师为占铁华、张冉冉和黄景辉，其中签字注册会计师黄景辉已从本所离职，因此无法在本所出具的验资机构声明页中签字，但签字注册会计师的离职不影响本所已出具的上述验资报告的法律效力。

特此说明。

会计师事务所负责人：



刘维

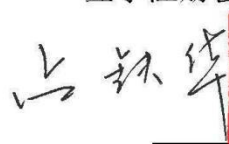



容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2026 年 4 月 20 日

八、验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，确认招股说明书与本所出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

占铁华

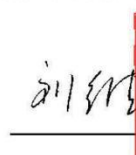
 

王鸣灿

蔡的伟

会计师事务所负责人：

刘维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



2025 年 4 月 20 日

第十二节 附件

一、备查文件

- (一) 发行保荐书；
- (二) 上市保荐书；
- (三) 法律意见书；
- (四) 财务报告及审计报告；
- (五) 公司章程（草案）；
- (六) 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；
- (七) 与投资者保护相关的承诺；
- (八) 发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；
- (九) 内部控制审计报告；
- (十) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- (十一) 股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；
- (十二) 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
- (十三) 募集资金具体运用情况；
- (十四) 子公司、参股公司简要情况；
- (十五) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间及地点

- (一) 发行人

查阅地点：苏州联讯仪器股份有限公司

办公地点：苏州高新区泰山路 315 号

查阅时间：工作日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00

联系人：廖金

电话：0512-68780583

（二）保荐人

查阅地点：中信证券股份有限公司

办公地点：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 层

查阅时间：工作日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00

联系人：孟硕

电话：021-20262230

附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

（一）投资者关系的主要安排

为规范公司的信息披露行为，保护投资者依法享有的权利，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程（草案）》的要求，结合公司实际情况制定了保护投资者权益的措施。具体如下：

1、信息披露制度和流程

公司通过制定《信息披露管理制度》，对公司信息披露的总体原则、披露内容、信息披露事务管理、信息沟通制度等事项进行了详细规定，确保公司按照有关法律法规履行信息披露义务，加强信息披露的管理工作，明确信息披露的具体流程。

2、投资者沟通渠道的建立情况

公司制定了《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》与《信息披露管理制度》等，明确公司董事长系投资者关系管理工作的第一责任人，由公司董事会秘书负责投资者关系管理的具体事务，完善了公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制；制定了详细的投资者关系管理原则、方式及内容，保证投资者与公司的顺利沟通。

3、未来开展投资者关系管理的规划

为加强投资者关系管理，提高信息披露质量，促进投资者对公司的了解，公司将严格按照《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程（草案）》的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。

公司将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东利益，特别是中小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（二）股利分配决策程序

公司的股利分配决策程序详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、发行

人股利分配政策”之“（一）本次发行后的股利分配政策”。

（三）股东投票机制建立情况

公司通过采用累积投票、中小投资者单独计票机制、网络投票、征集投票等方式，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策和选择管理者等事项的权利。

1、累积投票制度

根据《公司章程（草案）》相关规定，股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票；股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制；单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司，应当采用累积投票制。

2、中小投资者单独计票机制

根据《公司章程（草案）》相关规定，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

3、提供股东会网络投票方式

根据《公司章程（草案）》相关规定，公司召开股东会应当设置会场，以现场会议的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司还将提供网络投票/通讯投票的方式，为股东参加会议提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席，并应在会后提供股东身份证明、书面表决结果等文件。

4、征集投票权的相关安排

根据《公司章程（草案）》相关规定，公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

附件二：与投资者保护相关的承诺

（一）关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺

1、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

（1）胡海洋、黄建军、杨建承诺

自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不得转让或者委托他人管理首发上市前本人直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

自发行人股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价（指发行人首次公开发行股票的发行人价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者发行人股票上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行上市的发行价，则本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

发行人上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限12个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限12个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限12个月。

本人所持发行人股份锁定期届满后，如本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%，所持股份总数不超过1,000股的除外；自本人离职之日起六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守前述限制。

本人在所持发行人股份锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行上市的发行价。本人持有发行人股票在满足上述锁定期之后，在锁定期届满后二十四个月内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。

若发行人因重大违法情形触及退市标准的，本人自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市并摘牌前不减持发行人股份。

发行人上市后，若上市公司存在破发、破净等中国证监会规定的情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的，本人作为发行人的控股股东、实际控制人或其一致行动人不通过二级市场减持本公司股份。

在前述承诺的股份锁定期限届满后，本人减持发行人首发前股份时将明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。

本人在减持所持有的发行人股份前，如通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；如采取其他方式减持的，将提前三个交易日予以公告。本人采取集中竞价、大宗交易方式减持股份的，在计算减持比例时，如果本人存在一致行动人，本人与一致行动人的持股比例应当合并计算。

本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行；本人持股锁定期届满后拟减持发行人股份的，将严格遵守包括但不限于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《科创板上市规则》等减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等公司内部治理制度的有关最新规定。

如本人未遵守上述承诺，对发行人造成任何损失的，本人同意依法承担相应责任。

（2）联睿光通、博睿光通、博恒睿哲承诺

自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业不得转让或者委托他人管理其直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

自发行人股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价（指发行人首次公开发行股票的发行人价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行上市的发行价，则本企业持有发行人股票的锁定期自动延长六个月。

发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,延长本企业届时所持股份锁定期限 12 个月;发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,在前项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 12 个月;发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,在前两项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 12 个月。

本企业在所持发行人股份锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行上市的发行价。本企业持有发行人股票在满足上述锁定期之后,在锁定期届满后二十四个月内本企业每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%,每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。

若发行人因重大违法情形触及退市标准的,本企业自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市并摘牌前不减持发行人股份。

发行人上市后,若上市公司存在破发、破净等中国证监会规定的情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的,本企业作为发行人的控股股东、实际控制人的一致行动人或发行人的员工持股平台不通过二级市场减持本公司股份。

在前述承诺的股份锁定期届满后,本企业减持发行人首发前股份时将明确并披露发行人的控制权安排,保证发行人持续稳定经营。

本企业在减持所持有的发行人股份前,如通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持股份的,在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告;如采取其他方式减持的,将提前三个交易日予以公告。本企业采取集中竞价、大宗交易方式减持股份的,在计算减持比例时,如果本企业存在一致行动人,本企业与一致行动人的持股比例应当合并计算。

本企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,本企业持股锁定期届满后拟减持发行人股份的,将严格遵守包括不限于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《科创板上市规则》等减持时有有效的法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等公司内部治理制度的有关最新规定。

如本企业未遵守上述承诺，对发行人造成任何损失的，本企业同意依法承担相应责任。

2、单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东承诺

自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的首发前发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

本企业在所持发行人股份锁定期届满后两年内减持的，减持发行人股票价格将结合发行人股票市场交易价格，不低于减持时发行人每股净资产的价格（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整），且在符合法律、法规及相关规则的前提下，本企业减持的股份数量最高不超过本企业所持发行人股份的 100%。

在本企业持有发行人 5%以上股份期间，本企业在减持所持有的发行人股份前，如通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所报告减持计划并予以公告，如采取其他方式减持的，依照减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件有关最新规定执行；本企业采取集中竞价、大宗交易方式减持股份的，在计算减持比例时，如果本企业存在一致行动人，本企业与一致行动人的持股比例应当合并计算。本企业及一致行动人（如有）直接或间接合计持有发行人股份低于 5%以下时，则本企业减持适用减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件有关最新规定。

本企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，本企业持股锁定期届满后拟减持发行人股份的，将严格遵守包括不限于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《科创板上市规则》等减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等公司内部治理制度的有关最新规定。

若中国证监会、证券交易所对创业投资基金、私募股权投资基金等减持股份另有规定的，从其规定执行。

如本企业未遵守上述承诺，对发行人造成任何损失的，本企业同意依法承担相应责任。

3、其他直接股东承诺

自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的首次公开发行前发行人股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致其持有的发行人股份发生变化的，本企业/本人仍将遵守上述承诺。

本企业/本人将严格遵守上述关于股份锁定的相关承诺，本企业/本人持股锁定期届满后拟减持发行人股份的，将严格遵守包括不限于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《科创板上市规则》等减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等公司内部治理制度的有关最新规定。

若中国证监会、证券交易所对创业投资基金、私募股权投资基金等减持股份另有规定的，从其规定执行。

如本企业/本人未遵守上述承诺，对发行人造成任何损失的，本企业/本人同意依法承担相应责任。

4、其他董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员承诺

(1) 廉哲承诺

自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不得转让或者委托他人管理首发上市前本人直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

自发行人股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价（指发行人首次公开发行股票的发行人价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者发行人股票上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行上市的发行价，则本人持有

发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

本人所持发行人股份锁定期届满后，如本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，所持股份总数不超过 1,000 股的除外；自本人离职之日起六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守前述限制。

本人在所持发行人股份锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行上市的发行价。本人持有发行人股票在满足上述锁定期之后，在锁定期届满后二十四个月内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。

若发行人因重大违法情形触及退市标准的，本人自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市并摘牌前不减持发行人股份。

发行人上市后，若上市公司存在破发、破净等中国证监会规定的情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30% 的，本人不通过二级市场减持本公司股份。

在前述承诺的股份锁定期届满后，本人减持发行人首发前股份时将明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。

本人在减持所持有的发行人股份前，如通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；如采取其他方式减持的，将提前三个交易日予以公告。本人采取集中竞价、大宗交易方式减持股份的，在计算减持比例时，如果本人存在一致行动人，本人与一致行动人的持股比例应当合并计算。

本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行；本人持股锁定期届满后拟减持发行人股份的，将严格遵守包括不限于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《科创板上市规则》等减持时

有效的法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等公司内部治理制度的有关最新规定。

如本人未遵守上述承诺，对发行人造成任何损失的，本人同意依法承担相应责任。

(2) 陈晓东、刘晋、彭兴贵、赵山、郭孝明、廖金、邵毅男、潘朝松承诺

自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不得转让或者委托他人管理首发上市前本人持有的发行人股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

自发行人股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者发行人股票上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行上市的发行价，则本人持有发行人股票的锁定期自动延长六个月。

如本人为发行人核心技术人员的，自本人所持发行人股份锁定期届满之日起4年内，本人每年转让的股份不得超过本人持有的本次发行上市时发行人股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

本人所持发行人股份锁定期届满后，本人在发行人担任董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%，所持股份总数不超过1,000股的除外；自本人离职之日起六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守前述限制。

本人在所持发行人股份锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行上市的发行价。本人持有发行人股票在满足上述锁定期之后，在锁定期届满后二十四个月内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。

若发行人因重大违法情形触及退市标准的，本人自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市并摘牌前不减持发行人股份。

本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且不因本人职务变更、离职

等原因而放弃履行。本人持股锁定期届满后拟减持发行人股份的，将严格遵守包括但不限于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《科创板上市规则》等减持时有效的法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等公司内部治理制度的有关最新规定。

如本人未遵守上述承诺，对发行人造成任何损失的，本人同意依法承担相应责任。

（二）稳定股价的措施和承诺

1、首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案

（1）启动和停止股价稳定预案的条件

1) 预警条件

当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的 120%时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

2) 启动条件

公司首次公开发行股票并上市后 3 年内，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，若公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产（第 20 个交易日构成“稳定股价措施触发日”，最近一期审计基准日后，公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）或者连续 20 个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到 30%时，则启动股价稳定预案。

3) 停止条件

公司在稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：①公司股票连续 20 个交易日的收盘价均达到或高于公司最近一期末经审计的每股净资产或者连续 20 个交易日内公司股票收盘价

跌幅累计未达到 30%；②单一会计年度内增持或回购金额累计已达到下述具体措施规定的上限要求；③继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件。

因上述第①项条件达成而实施的稳定股价具体措施实施期满或方案终止执行后，如再次发生符合上述第①项的启动条件，则再次启动股价稳定预案。

（2）股价稳定的具体措施

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。

公司稳定股价的具体措施包括公司回购股票，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股票、公司董事（独立董事除外，下文如无额外说明，公司董事均不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票、公司回购公司股票。当公司某一交易日的股票收盘价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将视股票市场情况、公司实际情况，按如下优先顺序：①公司回购股票；②控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股票；③董事、高级管理人员增持股票，实施股价稳定措施，直至触发稳定股价预案的条件消除。

具体措施如下：

1）公司回购股票

在不影响公司正常生产经营、持续盈利能力的情况下，经董事会、股东会审议通过，由公司通过法定方式回购公司股票。

①公司回购股份应符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2025 年 3 月修订）》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

②公司应当在稳定股价措施触发日起十五个交易日内召开董事会，审议稳定股价具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容）。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票（如有投票权），具体方案需经全体董事的过半数表决通过，独立董事应当对具体方案进行审核并发表独

立意见。

③公司股东会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺就该等回购事宜在股东会上投赞成票。

④在股东会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

⑤公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项要求：

A.公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；B.公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额，单次用于回购股份的资金金额不低于人民币 1,000 万元；C.公司累计回购股份总数不超过公司总股本的 10%，单次回购股份数量不得超过公司总股本的 2%。

公司通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。

公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续 20 个交易日回升到或超过最近一期未经审计的每股净资产或连续 20 个交易日内公司股票收盘价跌幅累计未达到 30%，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。

⑥在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2) 控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股票

在触发启动条件的情况下，如果发行人未能在 10 个交易日内公告股份回购计划，或因各种原因导致股份回购计划未能通过股东会的，或发行人实施稳定股价措施后仍不

满足“连续 10 个交易日发行人股份收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产”的，控股股东、实际控制人及其一致行动人应自触发启动条件之日起 20 个交易日内，或自知道发行人股份回购计划未通过股东会之日起 10 个交易日内，或自发行人稳定股价措施实施完毕之日起 10 个交易日内，就其采取稳定股价措施的具体计划书面通知发行人并由发行人进行公告，具体包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股票的措施如下：

①公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当在符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件规定的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易方式或者中国证监会、证券交易所认可的其他方式增持公司股票。

②控股股东、实际控制人及其一致行动人应当在公司回购股份具体措施实施完毕后连续 10 个交易日的收盘价低于每股净资产时采取增持公司股票方式稳定股价。

③公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应在稳定股价措施触发日起十五个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。

④公司控股股东、实际控制人及其一致行动人为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项：

A. 单次触发启动条件时用于增持公司股票的资金不少于其上一会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的 20%，单一会计年度内用于增持公司股票的资金累计不超过其上一个会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的 100%；

B. 增持价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产；

C. 合计单次增持金额不少于人民币 300 万元，每十二个月内合计增持股票数量不超过公司总股本的 2%。

3) 公司董事及高级管理人员增持公司股票

若公司控股股东、实际控制人及其一致行动人一次或多次实施增持后“启动条件”再次被触发，且控股股东、实际控制人及其一致行动人用于增持公司股份的资金总额累

计已经达到其上一个会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的 50%的，则控股股东、实际控制人及其一致行动人不再进行增持，而由各董事、高级管理人员进行增持。公司董事、高级管理人员增持股票的措施如下：

①公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易方式或者中国证监会、证券交易所认可的其他方式增持公司股票。

②公司董事、高级管理人员应在稳定股价措施触发日起十五个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。

③公司的董事、高级管理人员单次增持金额应不少于其上年度自公司领取薪酬的税后金额的 20%，每个自然年度内，公司的董事、高级管理人员因稳定股价而投入的资金不超过其上年度在公司领取薪酬（税后）的 40%，且增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。

④在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，公司董事、高级管理人员以不高于公司最近一期末经审计的每股净资产的价格进行增持。

⑤公司董事、高级管理人员不得因职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。自本稳定股价预案生效之日起至公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，公司若聘任新的董事、高级管理人员的，将在聘任前要求其签署承诺书，保证其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。

（3）约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司；控股股东、实际控制人及其一致行动人；负有增持义务的董事、高级管理人员均未采取上述稳定股价的具体措施或经协商应由相关主体采取稳定公司股价措施但相关主体未履行增持/回购义务以及无合法合理理由对公司股份回购方案投反对票或弃权票并导致股份回购方案未获得公司董事会/股东会通过的，公司；控股股东、实际控制人及其一致行动人；负有增持义务的董事、高级管理人员或未履行承诺的相关主体承诺接受以下约束措施：

1) 对公司的约束措施

公司将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，公司将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东会审议，公司将暂停向董事发放薪酬或津贴，直至其履行相关承诺为止。

2) 对控股股东、实际控制人及其一致行动人的约束措施

控股股东、实际控制人及其一致行动人增持计划完成后 6 个月内不得转让所增持的公司股份。公司可扣留其下一年度与履行增持股份义务所需金额相对应的应得现金分红。如下一年度其应得现金分红不足用于扣留，该扣留义务将顺延至以后年度，直至累计扣留金额与其应履行增持股份义务所需金额相等或控股股东、实际控制人及其一致行动人采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，控股股东、实际控制人及其一致行动人将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。

3) 对负有增持义务的董事、高级管理人员的约束措施

负有增持义务的董事、高级管理人员在增持计划完成后 6 个月内不得转让所增持的公司股份。如未采取上述稳定股价措施，董事、高级管理人员将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司将扣留该董事或高级管理人员与履行上述增持股份义务所需金额相对应的薪酬，直至该等人员采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，董事、高级管理人员将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。

任何对本预案的修订均应经股东会审议通过，且需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。

2、发行人承诺

已了解并知悉《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的全部内容。

愿意遵守和执行《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的内容并承担相应的法律责任。

3、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

已了解并知悉《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的全部内容。

愿意遵守和执行《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的内容并承担相应的法律责任。

在发行人就回购股份事宜召开的股东会或董事会上，对发行人承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如有）。

4、其他董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺

已了解并知悉《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的全部内容；

愿意遵守和执行《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》的内容并承担相应的法律责任；

在发行人就回购股份事宜召开的董事会上，对发行人承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如为董事）。

（三）股份回购和股份买回的措施和承诺

1、发行人承诺

当《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》中约定的触发条件成就时，发行人将按照《关于稳定股价的承诺》履行回购发行人股份的义务。

如证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人存在欺诈发行行为的，则发行人承诺将依法按照《关于欺诈发行上市的股份购回承诺》从投资者手中购回本次公开发行的全部新股。

若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则发行人承诺将按照《关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺》依法回购本次公开发行的全部新股。

以上为发行人关于股份回购和股份购回的措施和承诺，如发行人未能依照上述承诺履行义务的，发行人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

当《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》中约定的触发条件成就时，本人/本企业将按照《关于稳定公司股价的承诺》促使发行人履行回购发行人股份的义务。

如证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人存在欺诈发行行为的，则本人/本企业承诺将依法按照《关于欺诈发行上市的股份购回承诺》从投资者手中购回本次公开发行的全部新股。

若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人/本企业承诺将按照《关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺》促使发行人依法回购或由本人/本企业依法回购本次公开发行的全部新股。

以上为本人/本企业关于股份回购和股份购回的措施和承诺，如本人/本企业未能依照上述承诺履行义务的，本人/本企业将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

（四）对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺

1、发行人承诺

发行人本次发行上市不存在不符合发行条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

若中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权部门认定发行人存在欺诈发行行为的，发行人将在该等违法事实被中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权部门最终认定之日起五个工作日内启动股份回购程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。股票回购根据相关法律法规规定的程序实施，回购价格按照中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件依法确定，且不低于本次发行上市的公司股票发行价。如果发行人上市后因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整。

如发行人未履行相关承诺事项，发行人将及时、充分披露未履行承诺的具体情况、

原因并向股东和社会公众投资者道歉；发行人将在有关监管部门要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

发行人本次发行上市不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

若中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权部门认定发行人存在欺诈发行行为的，本人/本企业将在该等违法事实被中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权部门最终认定之日起五个工作日内启动股票回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。股票购回根据相关法律法规规定的程序实施，购回价格按照中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件依法确定，且不低于本次发行上市的公司股票发行价，如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整。同时本人/本企业将督促发行人依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。

如本人/本企业未履行相关承诺事项，本人/本企业将及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；本人/本企业将在有关监管部门要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。

（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、发行人承诺

本次募集资金到位后，预计公司每股收益（包括扣除非经常性损益后的每股收益和稀释后每股收益）受股本摊薄影响，相对上年度每股收益呈下降趋势。在后续运营中，公司拟采取以下具体措施，以应对本次发行摊薄即期回报。

（1）积极提高公司竞争力，加强市场开拓

公司将不断加大研发投入，加强技术创新，完善管理制度及运行机制，积极研发新产品。同时，公司将不断增强市场开拓能力和快速响应能力，进一步提升公司品牌影响力及主要产品的市场占有率。

（2）加强内部控制，提升经营效率

公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，完善内控体系、制度建设，提高资金

使用效率，节省公司的费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率和盈利能力。

（3）建立持续、稳定的利润分配政策，强化对股东的回报措施

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定和要求，在公司依照科创板相关业务规则制订的《公司章程》中明确规定利润分配政策的具体内容及分配条件，以及利润分配政策调整的决策程序和机制。公司已制定了上市后三年股东分红回报的具体计划，将按照上述规定和计划实施持续、稳定、科学的利润分配政策，以实现股东的合理回报，保护投资者的合法权益。

（4）积极实施募集资金投资项目，加强募集资金管理

本次发行募集资金投资项目经过公司充分论证，符合行业发展趋势及公司发展规划。在募集资金到位前，对于部分募集资金投资项目，公司将以自有资金先行投入建设，同时，公司将加快推进募集资金投资项目的建设，以争取尽早实现预期效益。

公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储及使用、募集资金使用的管理与监督等进行了详细规定。本次发行募集资金到位后，募集资金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，做到专户存储、专款专用。公司将按照相关法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的使用进行严格管理，并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐人对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金使用的合法合规性，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

（1）胡海洋、黄建军、杨建承诺

本人将忠实、勤勉地履行作为实际控制人和/或控股股东的职责，维护发行人和全体股东的合法权益，不侵占发行人公司利益。

本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或者薪酬与考核委员会

制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

如果发行人拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使发行人拟公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。

（2）联睿光通、博睿光通、博恒睿哲承诺

本企业将忠实、勤勉地履行作为实际控制人和/或控股股东的一致行动人职责，维护发行人和全体股东的合法权益，不侵占发行人公司利益。

本企业承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

本企业承诺不动用发行人资产从事与本企业履行职责无关的投资、消费活动。

本企业承诺在自身职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

如果发行人拟实施股权激励，本企业承诺在自身职责和权限范围内，全力促使发行人拟公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本企业违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本企业作出处罚或采取相关管理措施。

3、董事、高级管理人员承诺

本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。

本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

如果发行人拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使发行人拟公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。

（六）发行人关于利润分配政策的承诺

发行人在本次发行上市后将严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程（草案）》及《苏州联讯仪器股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》等法律、法规和其他规范性文件的规定及发行人公司治理制度的规定执行利润分配政策。如遇相关法律、法规和其他规范性文件修订的，发行人将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。

如发行人未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，发行人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

（七）依法承担赔偿责任的承诺

1、发行人承诺

发行人承诺包括招股说明书在内的上市申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，而致使投资者在证券交易中遭受损失的，则发行人将依照相关法律、法规和其他规范性文件的规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门或其他有权部门认定的方式或金额确定。

若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，且该等情形对判断是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则发行人承诺将依法回购本次公开发行的全部新股。股票回购根据相关法律法规规定的程序实施，回购价格按照证券监督管理

部门颁布的规范性文件依法确定，且不低于本次发行上市的公司股票发行价。如果发行人上市后因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整。

若法律、法规和其他规范性文件及证券监督管理部门或其他有权部门对发行人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，发行人自愿无条件地遵从该等规定。

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

本人/本企业承诺包括招股说明书在内的上市申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，而致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人/本企业将依照相关法律、法规和其他规范性文件的规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门或其他有权部门认定的方式或金额确定。

若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人/本企业将促使发行人依法回购或由本人/本企业依法回购本次公开发行的全部新股。股票回购根据相关法律法规规定的程序实施，回购价格按照证券监督管理部门颁布的规范性文件依法确定，且不低于本次发行上市的公司股票发行价。如果发行人上市后因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整。

若法律、法规和其他规范性文件及证券监督管理部门或其他有权部门对本人/本企业因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人/本企业自愿无条件地遵从该等规定。

3、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员承诺

本人承诺包括招股说明书在内的上市申请文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若包含招股说明书在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，而致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规和其他规范性文件的规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门或其他有权部门认定的方式或金额确定。

若法律法规、规范性文件及证券监督管理部门或其他有权部门对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

（八）控股股东、实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺

1、胡海洋、黄建军、杨建承诺

截至本承诺签署日，本人及本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员（以下合称“本人及近亲属”）目前没有投资或控制其他对发行人构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对发行人构成直接或间接竞争的业务或活动；本人及近亲属控制的其他企业未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务。

自本承诺函出具之日起，本人及近亲属保证不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或控制从事与发行人有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

如发行人进一步拓展其业务范围，本人及近亲属承诺将不与发行人拓展后业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的业务产生竞争的情形，本人及近亲属将按照包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。

本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的企业遵守上述承诺。

如因本人及近亲属未履行在本承诺中的承诺给发行人或其他股东造成损失的，本人将赔偿发行人或其他股东的实际损失。

上述承诺自签署之日起生效，直至本人不再为发行人控股股东和/或实际控制人之日止。

2、联睿光通、博睿光通、博恒睿哲承诺

截至本承诺函签署日，本企业目前没有投资或控制其他对发行人构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对发行人构成直接或间接竞争的业务或活动；本企业控制的其他企业（如有）未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务。

自本承诺函出具之日起，本企业保证不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或控制从事与发行人有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

如发行人进一步拓展其业务范围，本企业承诺将不与发行人拓展后业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的业务产生竞争的情形，本企业将按照包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。

如本企业控制其他企业，本企业将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。

如因本企业未履行在本承诺函中的承诺给发行人或其他股东造成损失的，本企业将赔偿发行人或其他股东的实际损失。

上述承诺自签署之日起生效，直至本企业不再为发行人控股股东和/或实际控制人的一致行动人之日止。

（九）控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、取消监事会前在任监事、高级

管理人员、单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东关于规范关联交易和避免资金占用的承诺

本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业(不包括发行人及其控制的企业,下同)将尽可能避免与发行人及其控制的企业发生关联交易(自发行人领取薪酬或津贴的情况除外)。对于将来不可避免发生的关联交易事项,本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与发行人及其控制的企业发生交易。

作为发行人关联方期间,本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益,亦不通过关联交易为发行人输送利益。如关联交易无法避免,本人/本企业保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、发行人章程的规定履行交易审批程序及信息披露义务。

本人/本企业保证不会利用关联交易转移发行人利润,不会通过影响发行人的经营决策以损害发行人及其他股东的合法权益。

在持有发行人股份期间,本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及发行人相关规章制度的规定,不得以任何方式违规占用或使用发行人的资金和资产,不得以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。

作为发行人关联方期间,本人/本企业将促使本人的近亲属及本人/本企业控制的企业按照同样的标准遵守上述承诺。

若违反上述承诺,本人/本企业将承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给发行人及其他股东造成的损失承担赔偿责任。本人/本企业拒不赔偿相关损失的,发行人有权相应扣减其应向本人/本企业支付的分红并向应当受偿的主体进行支付。

上述承诺自签署之日起生效,直至本人/本企业不再为发行人关联方之日止。

(十) 关于未能履行承诺的约束措施承诺

1、发行人承诺

鉴于发行人在申请首次公开发行股票并上市过程中出具了一系列承诺,若非因不可

抗力原因导致相关承诺未能完全履行、明确已无法履行或无法按期履行的，发行人将采取如下措施：

及时在股东会及证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

若未能履行的相关承诺存在继续履行必要的，发行人将继续履行该承诺。

若有关监管机关要求期限内予以整改或对本公司进行处罚的，发行人将依法予以整改或接受处罚。

如因发行人未能履行相关承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿，赔偿方式和金额依据发行人与投资者协商或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

如发行人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

根据届时有关规定可以采取的其他措施。

2、控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员承诺

鉴于本人作为发行人的控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，在发行人申请首次公开发行股票并上市过程中出具了一系列承诺，为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定，若非因不可抗力原因导致相关承诺未能完全履行、明确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施：

立即告知发行人及发行人其它股东，并在证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

若未能履行的承诺存在继续履行必要的，本人将继续履行该承诺。

若有关监管机关要求期限内予以整改或对本人进行处罚的，本人将依法予以整改或接受处罚。

本人因违反相关承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失且经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，本人将依法对发行人或投资者进行赔偿，赔偿方式和金额依据本人与投资者协商或证券监督管理部门、司法机

关认定的方式或金额确定。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人直接或间接持有的发行人股份（如有）在其履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人薪酬、津贴或所获分配的现金红利（如有）用于承担前述赔偿责任。

本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

根据届时的有关规定可以采取的其他措施。

本人保证不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。

3、法人股东承诺

鉴于本企业作为发行人的股东，在发行人申请首次公开发行股票并上市过程中出具了一系列承诺，为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定，若非因不可抗力原因导致相关承诺未能完全履行、明确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取如下措施：

立即告知发行人及发行人其它股东，并在证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

若未能履行的相关承诺存在继续履行必要的，本企业将继续履行该承诺。

若有关监管机关要求期限内予以整改或对本企业进行处罚的，本企业将依法予以整改或接受处罚。

本企业因违反相关承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失且经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本企业应承担责任的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，赔偿方式和金额依据本企业与投资者协商或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

本企业在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

根据届时有关规定可以采取的其他措施。

4、自然人股东承诺

鉴于本人作为发行人的股东，在发行人申请首次公开发行股票并上市过程中出具了

一系列承诺，为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定，若非因不可抗力原因导致相关承诺未能完全履行、明确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施：

立即告知发行人及发行人其它股东，并在证券监管机构指定的披露媒体上说明相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

若未能履行的相关承诺存在继续履行必要的，本人将继续履行该承诺。

若有关监管机关要求期限内予以整改或对本人进行处罚的，本人将依法予以整改或接受处罚。

本人因违反相关承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失且经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，赔偿方式和金额依据本人与投资者协商或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。

根据届时有关规定可以采取的其他措施。

（十一）其他承诺事项

1、发行人关于股东信息披露的承诺

本企业已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息；

本企业股东及其上层股东直接或间接持有发行人的股份均具备持有本企业股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本企业股份的情形；

本企业历史沿革中股权代持、委托持股等情形已经完全清理，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；本企业目前股东不存在股权代持、委托持股等情形，不存在纠纷和潜在纠纷；

本次发行的保荐人及主承销商中信证券股份有限公司的子公司中信证券投资有限公司通过持有发行人股东聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙) 8.3333%的财产份额间接持有发行人 0.1365%股份；此外中信证券股份有限公司及子公司中信证券投资有限公司通过投资其他主体间接持有发行人股份，穿透后合计持股比例约 0.00000011%。除上述情形外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服

务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他利益关系；

不存在以本企业股权进行不当利益输送的情形；

本企业现任股东不存在离开中国证监会系统未满十年的原工作人员（以下简称“证监会系统离职人员”），具体包括从中国证监会会机关、派出机构、证券交易所、全国股转公司离职的人员；从中国证监会其他会管单位离职的原会管干部；在中国证监会发行监管司或公众公司监管司借调累计满十二个月并在借调结束后三年内离职的中国证监会其他会管单位人员；从中国证监会会机关、派出机构、证券交易所、全国股转公司调动到中国证监会其他会管单位并在调动后三年内离职的人员；

本企业现任股东不存在中国证监会系统离职人员的父母、配偶、子女及其配偶；

本企业及本企业股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

2、发行人关于在审期间不进行现金分红的承诺

公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有；

自本承诺出具日至公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市前，公司将不再提出新的现金分红方案；

上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自觉接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。

附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项

（一）关于社会保险金及住房公积金的相关承诺

发行人实际控制人胡海洋、黄建军、杨建出具承诺函：如因发行人及控股子公司因公开发行人前未严格遵守劳动用工相关法律法规及规范性文件，或未严格执行为员工缴纳社会保险和住房公积金政策事宜被有权机关处罚或要求补缴社会保险或住房公积金的，或因未足额缴纳需要承担任何罚款、滞纳金，或因有关人员向发行人及控股子公司追索，或因上述情形给发行人或其子公司造成损失的，本人将对公司作出全额赔偿，并承担连带责任，且在承担后不向发行人及其控股子公司追偿，保证发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。

（二）关于租赁房产相关事项的相关承诺

发行人控股股东、实际控制人胡海洋、黄建军、杨建出具承诺函：如发行人因租赁物业的权属存在瑕疵或未办理房屋租赁备案等原因而无法继续承租/使用该等物业遭受损失的，本人将积极采取有效措施（包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的房产供相关企业经营使用等），促使发行人业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响。若发行人因其租赁的房产被有关政府主管部门要求收回房产或被处以处罚或承担其他法律责任，或因此产生其他损失的，在相关损失无法向出租方追索的情况下，由本人承担所产生的损失、罚款、费用和其他开支，且在承担相关费用和开支后不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受损失。

附件四：公司治理制度的建立健全及运行情况

（一）股东会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司制定了《股东会议事规则》，为规范化运作提供了进一步制度保障。《公司章程》中规定了股东的权利、股东会的职责、权限及股东会会议的基本制度，同时《股东会议事规则》针对股东会的召开程序制定了详细规则。

报告期内公司股东会在召集、出席、议事、表决、决议及会议记录等方面均符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，各股东均认真履行职责，充分行使股东权利，股东会依法忠实履行了《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》所赋予的权利和义务。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司设董事会，由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事会设董事长一名。公司根据《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定了《董事会议事规则》，对董事会的组成、职权、召开方式与条件、表决方式等进行了明确规定，董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

报告期内公司董事会会议在召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等方面均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法忠实履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。独立董事均出席历次董事会并按相关规定发表独立审核意见。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司取消监事会前，监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职工代表监事。2025 年 9 月 27 日，公司召开 2025 年度第二次临时股东大会，决议取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自整体变更成立股份公司以来至取消监事会之日，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

报告期内公司监事会会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，监事会依法忠实履行了《公司法》

《公司章程》《监事会议事规则》赋予的职责。

（四）独立董事工作制度的建立健全及运行情况

公司本届董事会设3名独立董事，达到董事会总人数的三分之一。公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权利，履行职责。公司独立董事积极参与公司重大经营决策，完善了公司治理结构，维护了全体股东的利益，在完善公司治理结构、公司战略发展选择等方面起到了促进作用。截至本招股说明书签署日，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，公司制定了《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书的任职资格、职责、任免及工作程序进行了规定。

自公司聘任董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》有关规定履行职责，认真筹备董事会和股东会，并及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东会正常行使职责发挥了重要作用。

（六）董事会专门委员会制度的建立健全及运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作细则。董事会各专门委员会组成如下：

名称	召集人、主任委员	委员
战略委员会	胡海洋	胡海洋、黄建军、路国平
审计委员会	路国平	路国平、徐秀法、胡海洋
薪酬与考核委员会	路国平	路国平、徐秀法、胡海洋
提名委员会	路国平	路国平、徐秀法、胡海洋

自公司董事会有关专门委员会成立以来，各专门委员会能够根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则等规定，勤勉尽职地履行职责。各专门委员会的日常运作、会议的召集、召开、表决程序符合公司《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的有关规定，规范、有效。

附件五：公司专利具体情况

（一）境内专利权

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
1	联讯仪器	一种基于垂直耦合的双环级联光学传感器	2017106331478	发明专利	2017.7.28	原始取得	无
2	联讯仪器	一种基于双环谐振腔直通端级联的光学传感器	2017113433921	发明专利	2017.12.14	原始取得	无
3	联讯仪器	一种超高效小体积高低温控制设备	2018109161401	发明专利	2018.8.13	原始取得	无
4	联讯仪器	一种级联傅里叶变换光谱仪的双环光学传感器	2018112472586	发明专利	2018.10.24	原始取得	无
5	联讯仪器	一种基于受激布里渊散射效应的高稳定微波信号生成方法	2018116360202	发明专利	2018.12.29	原始取得	无
6	联讯仪器	用于激光器芯片的固定装置	2019100218521	发明专利	2019.1.10	原始取得	无
7	联讯仪器	高功率激光器芯片的可靠性测试设备	201910264587X	发明专利	2019.4.3	原始取得	无
8	联讯仪器	激光芯片用可靠性测试系统	2019102918504	发明专利	2019.4.12	原始取得	无
9	联讯仪器	激光芯片用自调节夹具	2019109374760	发明专利	2019.9.30	原始取得	无
10	联讯仪器	芯片可靠性测试用老化设备	2019109374493	发明专利	2019.9.30	原始取得	无
11	联讯仪器	用于激光器芯片的测试系统	202010883677X	发明专利	2020.8.28	原始取得	无
12	联讯仪器	高可靠性的激光器芯片测试系统	2020110524935	发明专利	2020.9.29	原始取得	无
13	联讯仪器	高功率芯片的老化测试系统	2020110494179	发明专利	2020.9.29	原始取得	无
14	联讯仪器	光模块老化装置	202011379707X	发明专利	2020.12.1	原始取得	无
15	联讯仪器	风淋式光模块老化系统	202011383067X	发明专利	2020.12.1	原始取得	无
16	联讯仪器	光通讯器件的测试装置	2020115779733	发明专利	2020.12.28	原始取得	无
17	联讯仪器	光通信模块的多温测试系统	2020115779822	发明专利	2020.12.28	原始取得	无
18	联讯仪器	探针座	2021108556913	发明专利	2021.7.28	原始取得	无
19	联讯仪器	芯片测试机	2021108563809	发明专利	2021.7.28	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
20	联讯仪器	激光器芯片的自动化测试装置	2022103057769	发明专利	2021.7.28	原始取得	无
21	联讯仪器	用于芯片测试的探针台	2021109067100	发明专利	2021.8.9	原始取得	无
22	联讯仪器	测试用探针结构	2022103679930	发明专利	2021.8.9	原始取得	无
23	联讯仪器	激光器芯片的老化测试装置	2021111475907	发明专利	2021.9.29	原始取得	无
24	联讯仪器	光通讯用芯片的老化测试系统	202111147468X	发明专利	2021.9.29	原始取得	无
25	联讯仪器	通讯芯片的自动贴片机	2021112349352	发明专利	2021.10.22	原始取得	无
26	联讯仪器	光通讯激光器芯片测试机	2021112355207	发明专利	2021.10.22	原始取得	无
27	联讯仪器	光通讯芯片的测试机构	2022101559900	发明专利	2021.10.22	原始取得	无
28	联讯仪器	光模块芯片的自动测试机构	2022101615949	发明专利	2021.10.22	原始取得	无
29	联讯仪器	用于芯片测试的取放组件及方法	202111302262X	发明专利	2021.11.4	原始取得	无
30	联讯仪器	光通讯芯片测试用上下料模组	2021113021824	发明专利	2021.11.4	原始取得	无
31	联讯仪器	光通讯用芯片测试设备	2021113184643	发明专利	2021.11.9	原始取得	无
32	联讯仪器	用于光通讯的激光芯片测试系统	2021113185006	发明专利	2021.11.9	原始取得	无
33	联讯仪器	一种模块化误码测试装置	2021116087185	发明专利	2021.12.27	原始取得	无
34	联讯仪器	一种模块化误码测试装置	2022101459495	发明专利	2021.12.27	原始取得	无
35	联讯仪器	高精度数字源表	2021116388055	发明专利	2021.12.29	原始取得	无
36	联讯仪器	一种提高采样保持器增益范围的装置、方法	2022101816007	发明专利	2022.2.25	原始取得	无
37	联讯仪器	一种四象限输出的开关电源	2022101968866	发明专利	2022.3.1	原始取得	无
38	联讯仪器	一种 AM 码的插入方法、装置及计算机可读存储介质	2022101951704	发明专利	2022.3.2	原始取得	无
39	联讯仪器	光采样示波器的光电转换及采样保持直流耦合互联装置	2022102425636	发明专利	2022.3.11	原始取得	无
40	联讯仪器	一种用于 SPI 总线的通信方法、装置、设备及存储介质	2022103193867	发明专利	2022.3.29	原始取得	无
41	联讯仪器	一种数据传输系统及其 RS 编码装置和	2022103893972	发明专利	2022.4.14	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
		方法					
42	联讯仪器	一种伸缩式芯片探针及芯片测试系统	2022105205002	发明专利	2022.5.13	原始取得	无
43	联讯仪器	一种芯片测试系统	202210792521X	发明专利	2022.5.13	原始取得	无
44	联讯仪器	用于光模块的夹紧装置、压接盒及误码测试设备	202210550960X	发明专利	2022.5.18	原始取得	无
45	联讯仪器	光模块测试用的夹紧装置、压接盒及误码测试设备	2023103066194	发明专利	2022.5.18	原始取得	无
46	联讯仪器	一种误码测试装置	2022105556511	发明专利	2022.5.19	原始取得	无
47	联讯仪器	一种驱动电源板的自动校准设备、方法、装置及介质	2022105464064	发明专利	2022.5.20	原始取得	无
48	联讯仪器	用于芯片的多探针测试装置	2022105671134	发明专利	2022.5.24	原始取得	无
49	联讯仪器	芯片测试用探针调节支架	2022105745848	发明专利	2022.5.24	原始取得	无
50	联讯仪器	一种温控夹紧装置、压接盒以及误码测试装置	2022105817831	发明专利	2022.5.26	原始取得	无
51	联讯仪器	用于光模块的温控夹紧装置、压接盒以及误码测试装置	2022108282439	发明专利	2022.5.26	原始取得	无
52	联讯仪器	一种设备定位方法、装置以及介质	2022105839760	发明专利	2022.5.27	原始取得	无
53	联讯仪器	一种芯片可靠性测试装置	2022105889223	发明专利	2022.5.27	原始取得	无
54	联讯仪器	一种芯片测试装置	202210852094X	发明专利	2022.5.27	原始取得	无
55	联讯仪器	一种降低继电器泄漏电流的方法、电路、装置及介质	2022105978513	发明专利	2022.5.30	原始取得	无
56	联讯仪器	一种低通滤波器及光通信测试装置	2022106470664	发明专利	2022.6.9	原始取得	无
57	联讯仪器	一种光电探针总成	2022106814065	发明专利	2022.6.16	原始取得	无
58	联讯仪器	一种多功能探针	202211021482X	发明专利	2022.6.16	原始取得	无
59	联讯仪器	DMA 数据传输方法、DMA 数据传输装置及数据传输系统	2022108080475	发明专利	2022.7.11	原始取得	无
60	联讯仪器	一种协同扫描方法、电子设备及计算机可读存储介质	2022108385331	发明专利	2022.7.18	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
61	联讯仪器	一种时钟信号恢复方法及系统	2022108767143	发明专利	2022.7.25	原始取得	无
62	联讯仪器	一种光波长测量方法及系统	2022108745515	发明专利	2022.7.25	原始取得	无
63	联讯仪器	一种误码测试仪 reset 信号时序确定方法及相关组件	2022108843857	发明专利	2022.7.26	原始取得	无
64	联讯仪器	一种数字源表控制方法、系统、装置及存储介质	2022108894011	发明专利	2022.7.27	原始取得	无
65	联讯仪器	一种采样示波器前端装置及采样示波器	202210888313X	发明专利	2022.7.27	原始取得	无
66	联讯仪器	多通道光口采样示波器模块化联接装置	2022108958210	发明专利	2022.7.27	原始取得	无
67	联讯仪器	数据处理方法、系统、电子设备及计算机可读存储介质	2022109021120	发明专利	2022.7.29	原始取得	无
68	联讯仪器	一种弹片折弯设备及弹片折弯方法	202210952010X	发明专利	2022.8.9	原始取得	无
69	联讯仪器	一种闭环电压源表的上电方法及电路	2022109588653	发明专利	2022.8.11	原始取得	无
70	联讯仪器	一种可快速切换量程的源表及其温度补偿方法	2022109777759	发明专利	2022.8.16	原始取得	无
71	联讯仪器	一种多波长检测方法、装置、系统	2022110027931	发明专利	2022.8.22	原始取得	无
72	联讯仪器	数据时钟恢复系统和方法	2022110224323	发明专利	2022.8.25	原始取得	无
73	联讯仪器	一种用于示波器的多带宽光口采样电路	2022110371271	发明专利	2022.8.29	原始取得	无
74	联讯仪器	用于激光器的夹具、贴片工装、打线工装及测试工装	2022112311345	发明专利	2022.10.10	原始取得	无
75	联讯仪器	一种数据包提取方法、装置、设备及介质	2022115882057	发明专利	2022.12.12	原始取得	无
76	联讯仪器	一种 RS 译码中的伴随式计算方法、装置、设备及介质	2022116380984	发明专利	2022.12.20	原始取得	无
77	联讯仪器	一种芯片测试结构	2023100560464	发明专利	2023.1.17	原始取得	无
78	联讯仪器	用于晶圆级可靠性测试的探针安装结构及可靠性测试系统	2023100544724	发明专利	2023.2.3	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
79	联讯仪器	一种低漏电流线缆装置	2023100792052	发明专利	2023.2.8	原始取得	无
80	联讯仪器	一种低漏电流校准系统	2023100902616	发明专利	2023.2.9	原始取得	无
81	联讯仪器	一种高压晶体管测试电路及系统	2023101152602	发明专利	2023.2.15	原始取得	无
82	联讯仪器	一种吸附式芯片搬运装置	2023101871441	发明专利	2023.3.1	原始取得	无
83	联讯仪器	一种电信号采样通道装置及采样示波器	2023102211966	发明专利	2023.3.9	原始取得	无
84	联讯仪器	一种矫正失真信道响应的方法、系统及装置	2023103011308	发明专利	2023.3.27	原始取得	无
85	联讯仪器	芯片取放机构和芯片测试机	2023103597390	发明专利	2023.4.6	原始取得	无
86	联讯仪器	通信模块的稳定性评估方法、装置、设备及可读存储介质	2023104578058	发明专利	2023.4.26	原始取得	无
87	联讯仪器	一种错误码元标志数量确定方法、装置、设备及介质	202310460591X	发明专利	2023.4.26	原始取得	无
88	联讯仪器	一种晶圆级别的半导体高压可靠性测试夹具	2023108201968	发明专利	2023.7.5	原始取得	无
89	联讯仪器	一种信号传输误码率确定方法及相关组件	2023109467884	发明专利	2023.7.31	原始取得	无
90	联讯仪器	一种以太网包 CRC 校验方法	2023113479579	发明专利	2023.10.18	原始取得	无
91	联讯仪器	一种误码插入方法、装置、系统及计算机存储介质	2023114723310	发明专利	2023.11.7	原始取得	无
92	联讯仪器	多通道采集方法、装置、系统、FPGA 及采样示波器	2023114791229	发明专利	2023.11.8	原始取得	无
93	联讯仪器	一种脉冲信号调节电路及高压脉冲源	2023115252536	发明专利	2023.11.16	原始取得	无
94	联讯仪器	一种通道锁定方法、装置、系统及计算机存储介质	2023115465852	发明专利	2023.11.20	原始取得	无
95	联讯仪器	一种并行 RS 编码方法、装置、系统及计算机存储介质	202311546573X	发明专利	2023.11.20	原始取得	无
96	联讯仪器	一种继电器自检电路及供电设备	2023115437848	发明专利	2023.11.20	原始取得	无
97	联讯仪器	一种用于晶圆测试的夹具	2023115502936	发明专利	2023.11.21	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
98	联讯仪器	一种多通道比特偏移计算方法、装置、设备及介质	2024101633626	发明专利	2024.2.5	原始取得	无
99	联讯仪器	一种晶圆级老化测试夹具及晶圆级老化测试装置	2024101788684	发明专利	2024.2.8	原始取得	无
100	联讯仪器	一种晶圆级老化测试装置	202410179074X	发明专利	2024.2.8	原始取得	无
101	联讯仪器	脉冲生成电路及其控制方法、信号发生器	2024109399434	发明专利	2024.7.15	原始取得	无
102	联讯仪器	一种高压限流控制保护电路和半导体测试设备	2024110611895	发明专利	2024.8.5	原始取得	无
103	联讯仪器	一种过采样方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质	2024111369704	发明专利	2024.8.19	原始取得	无
104	联讯仪器	一种过采样方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质	2024111369719	发明专利	2024.8.19	原始取得	无
105	联讯仪器	一种脉冲宽度调制驱动电路、方法及测试设备	2024113165203	发明专利	2024.9.20	原始取得	无
106	联讯仪器	一种进程通信方法、装置及电子设备	202411328761X	发明专利	2024.9.24	原始取得	无
107	联讯仪器	一种电压校准电路及采样电压拟合、电压校准方法	2024113588509	发明专利	2024.9.27	原始取得	无
108	联讯仪器、上海理工大学	一种信号检测设备、系统及方法	2025100739098	发明专利	2025.1.17	原始取得	无
109	联讯仪器	一种生成晶圆图的方法、装置及测试晶圆的设备	2025100966176	发明专利	2025.1.22	原始取得	无
110	联讯仪器	一种生成晶圆图、测试晶圆的方法、装置及设备	2025100966833	发明专利	2025.1.22	原始取得	无
111	联讯仪器	一种编码方法、装置、电子设备及存储介质	2025101039717	发明专利	2025.1.23	原始取得	无
112	联讯仪器	一种基于垂直耦合的双环级联光学传感器	2017209350688	实用新型	2017.7.28	原始取得	无
113	联讯仪器	一种基于双环谐振腔直通端级联的光学传感器	2017217478575	实用新型	2017.12.14	原始取得	无
114	联讯仪器	一种基于双谐振腔级联的光学传感器	2018208257915	实用新型	2018.5.30	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
115	联讯仪器	新型快速升降温测试装置	2018209068111	实用新型	2018.6.12	原始取得	无
116	联讯仪器	一种激光器芯片老化测试夹具弹片以及应用其的定位夹具	2018209053205	实用新型	2018.6.12	原始取得	无
117	联讯仪器	一种改进型激光器芯片老化测试弹片以及应用其的定位夹具	2018209068323	实用新型	2018.6.12	原始取得	无
118	联讯仪器	一种组合式激光器芯片老化测试弹片以及应用其的定位夹具	2018209052804	实用新型	2018.6.12	原始取得	无
119	联讯仪器	一种简化的激光器芯片定位夹具	2018209313293	实用新型	2018.6.15	原始取得	无
120	联讯仪器	一种激光器芯片测试用弹簧探针组件以及应用其的测试装置	2018209321694	实用新型	2018.6.15	原始取得	无
121	联讯仪器	一种新型的激光器芯片定位治具	201820936691X	实用新型	2018.6.15	原始取得	无
122	联讯仪器	一种新型的激光器芯片测试夹具	2018209365601	实用新型	2018.6.15	原始取得	无
123	联讯仪器	一种应用新型探针的激光器芯片测试装置	2018209367861	实用新型	2018.6.15	原始取得	无
124	联讯仪器	一种新型小型化高低温温循测试装置	2018209366924	实用新型	2018.6.15	原始取得	无
125	联讯仪器	一种级联傅里叶变换光谱仪的双环光学传感器	2018217320034	实用新型	2018.10.24	原始取得	无
126	联讯仪器	用于激光器芯片的固定装置	2019200386170	实用新型	2019.1.10	原始取得	无
127	联讯仪器	激光器芯片金线键合夹具	201920038520X	实用新型	2019.1.10	原始取得	无
128	联讯仪器	芯片加工用多功能夹具	2019200386062	实用新型	2019.1.10	原始取得	无
129	联讯仪器	激光器芯片加工用高精度夹具	2019200374953	实用新型	2019.1.10	原始取得	无
130	联讯仪器	具有测试功能的芯片夹具	2019200730977	实用新型	2019.1.16	原始取得	无
131	联讯仪器	具有加热功能的芯片夹具	2019200730996	实用新型	2019.1.16	原始取得	无
132	联讯仪器	多功能芯片固定装置	2019200730981	实用新型	2019.1.16	原始取得	无
133	联讯仪器	激光芯片的集成化夹具	2019200730962	实用新型	2019.1.16	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
134	联讯仪器	用于芯片的自适应固定装置	2019201711901	实用新型	2019.1.31	原始取得	无
135	联讯仪器	高稳定性芯片定位夹具	2019201711899	实用新型	2019.1.31	原始取得	无
136	联讯仪器	便于测试的激光芯片夹具	201920171187X	实用新型	2019.1.31	原始取得	无
137	联讯仪器	高功率激光器芯片的可靠性测试设备	2019204426285	实用新型	2019.4.3	原始取得	无
138	联讯仪器	激光器芯片用测试装置	2019204426270	实用新型	2019.4.3	原始取得	无
139	联讯仪器	具有冷却功能的芯片老化测试装置	2019204426266	实用新型	2019.4.3	原始取得	无
140	联讯仪器	芯片老化用高效测试设备	2019204425615	实用新型	2019.4.3	原始取得	无
141	联讯仪器	高精度芯片测试装置	2019204912955	实用新型	2019.4.12	原始取得	无
142	联讯仪器	激光芯片用高精度检测夹具	2019204913572	实用新型	2019.4.12	原始取得	无
143	联讯仪器	半导体激光芯片组件的测试装置	2019204913407	实用新型	2019.4.12	原始取得	无
144	联讯仪器	高效率光器件测试系统	2019206398434	实用新型	2019.5.7	原始取得	无
145	联讯仪器	多功能高速并行的光模块性能测试系统	201920639842X	实用新型	2019.5.7	原始取得	无
146	联讯仪器	误码分析仪	2019208423445	实用新型	2019.6.5	原始取得	无
147	联讯仪器	高精度误码分析仪	201920842345X	实用新型	2019.6.5	原始取得	无
148	联讯仪器	多通道误码分析仪	2019208423924	实用新型	2019.6.5	原始取得	无
149	联讯仪器	具有噪声抑制功能的采样示波器	2019208424414	实用新型	2019.6.5	原始取得	无
150	联讯仪器	用于光采样的示波器	2019208424062	实用新型	2019.6.5	原始取得	无
151	联讯仪器	半导体芯片的老化测试装置	2019216488579	实用新型	2019.9.30	原始取得	无
152	联讯仪器	半导体芯片加工用夹具	2019216489707	实用新型	2019.9.30	原始取得	无
153	联讯仪器	高功率激光芯片用测试装置	201921648968X	实用新型	2019.9.30	原始取得	无
154	联讯仪器	激光芯片用定位装置	2019216478806	实用新型	2019.9.30	原始取得	无
155	联讯仪器	激光芯片用高效测试系统	2019216488564	实用新型	2019.9.30	原始取得	无
156	联讯仪器	具有温控功能的半导体测试箱	2019216488583	实用新型	2019.9.30	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
157	联讯仪器	电子器件测试用装夹机构	2020211311062	实用新型	2020.6.17	原始取得	无
158	联讯仪器	电子器件测试夹具的压紧机构	2020211310394	实用新型	2020.6.17	原始取得	无
159	联讯仪器	用于 TO 光通信器件测试的装夹模组	2020211311081	实用新型	2020.6.17	原始取得	无
160	联讯仪器	发光器件用测试压紧机构	2020211310360	实用新型	2020.6.17	原始取得	无
161	联讯仪器	光通信器件的测试夹具	2020211308958	实用新型	2020.6.17	原始取得	无
162	联讯仪器	发光器件测试用夹具	2020211310375	实用新型	2020.6.17	原始取得	无
163	联讯仪器	光通信器件的高低温测试夹具	2020211308943	实用新型	2020.6.17	原始取得	无
164	联讯仪器	用于光器件的多功能夹具	2020211308924	实用新型	2020.6.17	原始取得	无
165	联讯仪器	TO 光通信器件的测试装置	2020211308939	实用新型	2020.6.17	原始取得	无
166	联讯仪器	用于发光器件的多功能测试装置	202021128439X	实用新型	2020.6.17	原始取得	无
167	联讯仪器	用于光通信器件的测试系统	2020211302449	实用新型	2020.6.17	原始取得	无
168	联讯仪器	TO 光通信器件的多功能测试系统	2020211231138	实用新型	2020.6.17	原始取得	无
169	联讯仪器	光通信器件用高精度测试系统	2020211231104	实用新型	2020.6.17	原始取得	无
170	联讯仪器	激光器芯片测试一体设备	2020211302453	实用新型	2020.6.17	原始取得	无
171	联讯仪器	光通信芯片的测试系统	2020218499710	实用新型	2020.8.28	原始取得	无
172	联讯仪器	TO 光通信器件的低常高温测试系统	2020218500116	实用新型	2020.8.28	原始取得	无
173	联讯仪器	光通信器件的测试夹具	2020218499744	实用新型	2020.8.28	原始取得	无
174	联讯仪器	用于激光器芯片的高效测试夹具	2020218499759	实用新型	2020.8.28	原始取得	无
175	联讯仪器	器件老化测试用分光系统	202022188912X	实用新型	2020.9.29	原始取得	无
176	联讯仪器	高功率器件的测试夹具	2020221849813	实用新型	2020.9.29	原始取得	无
177	联讯仪器	用于光模块的高精度老化测试装置	202022836961X	实用新型	2020.12.1	原始取得	无
178	联讯仪器	光模块的高温老化机构	2020228369709	实用新型	2020.12.1	原始取得	无
179	联讯仪器	用于光电转换模块的老化系统	2020228369624	实用新型	2020.12.1	原始取得	无
180	联讯仪器	激光器芯片的高低温测试台	202023213184X	实用新型	2020.12.28	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
181	联讯仪器	高精度激光器测试台	2020232137757	实用新型	2020.12.28	原始取得	无
182	联讯仪器	用于芯片测试的探针安装架	2021217305727	实用新型	2021.7.28	原始取得	无
183	联讯仪器	光通信芯片的测试机构	2021217305816	实用新型	2021.7.28	原始取得	无
184	联讯仪器	可调节的探针安装架	2021218431905	实用新型	2021.8.9	原始取得	无
185	联讯仪器	芯片测试组件	2021218431144	实用新型	2021.8.9	原始取得	无
186	联讯仪器	宽波段光谱测量仪	2021218555058	实用新型	2021.8.10	原始取得	无
187	联讯仪器	高可靠性光波长测量系统	2021223465314	实用新型	2021.9.27	原始取得	无
188	联讯仪器	光通信用光谱测量仪	2021223542823	实用新型	2021.9.27	原始取得	无
189	联讯仪器	通讯芯片用多轴贴片装置	2021225518617	实用新型	2021.10.22	原始取得	无
190	联讯仪器	半导体芯片的自动化加工装置	2021225601328	实用新型	2021.10.22	原始取得	无
191	联讯仪器	用于光通讯芯片的高精度贴片机	202122554176X	实用新型	2021.10.22	原始取得	无
192	联讯仪器	用于光通讯芯片的吸嘴机构	2021225600857	实用新型	2021.10.22	原始取得	无
193	联讯仪器	光通讯芯片贴片用运料装置	2021225601347	实用新型	2021.10.22	原始取得	无
194	联讯仪器	用于通讯芯片加工的吸附运料装置	2021225541717	实用新型	2021.10.22	原始取得	无
195	联讯仪器	一种可调式温控总成及模块化误码测试仪	202123161112X	实用新型	2021.12.15	原始取得	无
196	联讯仪器	高精密源表	2021232004660	实用新型	2021.12.17	原始取得	无
197	联讯仪器	用于光信号的检测与同步装置	2021233612061	实用新型	2021.12.27	原始取得	无
198	联讯仪器	基于 Flash 配置的 FPGA 电路	2021233170189	实用新型	2021.12.27	原始取得	无
199	联讯仪器	用于芯片测试的探针调节装置	2022211816155	实用新型	2022.5.17	原始取得	无
200	联讯仪器	用于激光器芯片的高效测试装置	2022211816140	实用新型	2022.5.17	原始取得	无
201	联讯仪器	用于芯片测试的探针安装座	2022212619667	实用新型	2022.5.24	原始取得	无
202	联讯仪器	探针调节支架	2022212700141	实用新型	2022.5.24	原始取得	无
203	联讯仪器	用于光通信芯片的性能测试装置	2022212677319	实用新型	2022.5.24	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
204	联讯仪器	一种光电探测卡	2022214340422	实用新型	2022.6.8	原始取得	无
205	联讯仪器	一种分光器模块及具有其的测试设备	2022218901318	实用新型	2022.7.20	原始取得	无
206	联讯仪器	用于芯片的定位弹片及具有其的芯片测试夹具	2022221091566	实用新型	2022.8.9	原始取得	无
207	联讯仪器	一种采样时钟路径延时优化装置及采样示波器	2022230750810	实用新型	2022.11.18	原始取得	无
208	联讯仪器	一种芯片测试连接装置	2023201275400	实用新型	2023.1.17	原始取得	无
209	联讯仪器	电源转接装置	2023201298065	实用新型	2023.1.17	原始取得	无
210	联讯仪器	一种激光器稳频系统	2023201095677	实用新型	2023.1.19	原始取得	无
211	联讯仪器	一种晶圆级可靠性测试装置	2023201072181	实用新型	2023.2.3	原始取得	无
212	联讯仪器	一种批量测试线缆装置	2023201598426	实用新型	2023.2.8	原始取得	无
213	联讯仪器	一种低漏电流校准装置	2023201689177	实用新型	2023.2.9	原始取得	无
214	联讯仪器	一种芯片测试装置	2023203581078	实用新型	2023.3.1	原始取得	无
215	联讯仪器	一种吸附式芯片搬运装置	2023203576915	实用新型	2023.3.1	原始取得	无
216	联讯仪器	一种芯片移动装置	2023203580304	实用新型	2023.3.1	原始取得	无
217	联讯仪器	一种 WAT 测试装置及系统	2023204577883	实用新型	2023.3.13	原始取得	无
218	联讯仪器	自动取放芯片机构	2023207425168	实用新型	2023.4.6	原始取得	无
219	联讯仪器	光通信芯片的测试装置	2023207425098	实用新型	2023.4.6	原始取得	无
220	联讯仪器	芯片自动运送装置	2023207427587	实用新型	2023.4.6	原始取得	无
221	联讯仪器	一种用于源表的自动化测试系统	2023210000996	实用新型	2023.4.27	原始取得	无
222	联讯仪器	芯片测试的下压机构	2023214214388	实用新型	2023.6.6	原始取得	无
223	联讯仪器	芯片测试的合模下压组件	2023214214138	实用新型	2023.6.6	原始取得	无
224	联讯仪器	一种用于光模块测试的测试装置	2023216687865	实用新型	2023.6.28	原始取得	无
225	联讯仪器	分体式芯片测试座	2023217844717	实用新型	2023.7.10	原始取得	无
226	联讯仪器、苏州	一种芯片外观 AOI 检测设备	2023220759813	实用新型	2023.8.3	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
	策林智能科技有限公司						
227	联讯仪器	芯片拾取吸嘴的安装结构	2023221105578	实用新型	2023.8.8	原始取得	无
228	联讯仪器	可调节的芯片吸附组件	2023221105563	实用新型	2023.8.8	原始取得	无
229	联讯仪器	稳定型芯片拾取组件	2023221519060	实用新型	2023.8.11	原始取得	无
230	联讯仪器	芯片的转塔分选机	2023221511707	实用新型	2023.8.11	原始取得	无
231	联讯仪器	可旋转的芯片吸取机构	2023221511694	实用新型	2023.8.11	原始取得	无
232	联讯仪器	锁紧组件	2023222503233	实用新型	2023.8.22	原始取得	无
233	联讯仪器	晶圆夹具	2023222503229	实用新型	2023.8.22	原始取得	无
234	联讯仪器	晶圆高压密封装置	2023222503197	实用新型	2023.8.22	原始取得	无
235	联讯仪器	一种 WAT 测试机和 WAT 测试系统	2023226277458	实用新型	2023.9.26	原始取得	无
236	联讯仪器	芯片校准机构	2023228251679	实用新型	2023.10.20	原始取得	无
237	联讯仪器	夹持式芯片校准机构	2023228251630	实用新型	2023.10.20	原始取得	无
238	联讯仪器	全方位芯片夹持与校准装置	202322825165X	实用新型	2023.10.20	原始取得	无
239	联讯仪器	一种晶圆测试装置的升降结构及晶圆测试装置	2023229045109	实用新型	2023.10.27	原始取得	无
240	联讯仪器	一种晶圆老化测试装置	202322901525X	实用新型	2023.10.27	原始取得	无
241	联讯仪器	一种晶圆老化设备	2023229015245	实用新型	2023.10.27	原始取得	无
242	联讯仪器	一种晶圆老化测试装置的加电结构	2023229213301	实用新型	2023.10.27	原始取得	无
243	联讯仪器	一种用于晶圆测试的夹具	2023229215256	实用新型	2023.10.30	原始取得	无
244	联讯仪器	一种晶圆测试装置	202322922994X	实用新型	2023.10.30	原始取得	无
245	联讯仪器	一种用于晶圆测试的测试装置	2023229265467	实用新型	2023.10.30	原始取得	无
246	联讯仪器	一种晶圆测试装置的连接结构及晶圆测试装置	2023229232088	实用新型	2023.10.30	原始取得	无
247	联讯仪器	一种晶圆测试装置的支撑结构及晶圆测试装置	2023229265363	实用新型	2023.10.30	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
248	联讯仪器	一种用于晶圆测试装置的通气结构及晶圆测试装置	202322921486X	实用新型	2023.10.30	原始取得	无
249	联讯仪器	一种用于晶圆老化测试的组合式机柜	2023229215133	实用新型	2023.10.30	原始取得	无
250	联讯仪器	一种用于夹具的散热柜	2023229229795	实用新型	2023.10.30	原始取得	无
251	联讯仪器	一种用于夹具的特氟龙密封圈	2023229265414	实用新型	2023.10.30	原始取得	无
252	联讯仪器	一种夹具的连接结构	2023229372721	实用新型	2023.10.31	原始取得	无
253	联讯仪器	一种晶圆测试装置	2023229372736	实用新型	2023.10.31	原始取得	无
254	联讯仪器	一种用于拆卸夹具的拆卸装置	2023229372774	实用新型	2023.10.31	原始取得	无
255	联讯仪器	一种晶圆夹具的热沉结构	2023229372755	实用新型	2023.10.31	原始取得	无
256	联讯仪器	一种晶圆测试装置的加热结构及晶圆测试装置	2023229372789	实用新型	2023.10.31	原始取得	无
257	联讯仪器	一种晶圆测试夹具	2023229397964	实用新型	2023.10.31	原始取得	无
258	联讯仪器	一种晶圆级别的老化测试夹具	2023229404525	实用新型	2023.10.31	原始取得	无
259	联讯仪器	一种晶圆夹具	2023230564563	实用新型	2023.11.13	原始取得	无
260	联讯仪器	一种晶圆夹具的热沉装置	2023230564614	实用新型	2023.11.13	原始取得	无
261	联讯仪器	一种晶圆测试装置的加热结构及晶圆测试装置	2023230564506	实用新型	2023.11.13	原始取得	无
262	联讯仪器	一种开关矩阵装置以及 WAT 测试系统	202323054248X	实用新型	2023.11.13	原始取得	无
263	联讯仪器	顶升式晶圆上料组件	2023231056243	实用新型	2023.11.17	原始取得	无
264	联讯仪器	晶圆拾取组件	2023231055560	实用新型	2023.11.17	原始取得	无
265	联讯仪器	晶圆水平搬运机构	2023231055541	实用新型	2023.11.17	原始取得	无
266	联讯仪器	高效上料装置	2023231055522	实用新型	2023.11.17	原始取得	无
267	联讯仪器	一种芯片调整装置	2023232778552	实用新型	2023.12.1	原始取得	无
268	联讯仪器	晶圆夹持组件	2023233274717	实用新型	2023.12.7	原始取得	无
269	联讯仪器	自动化晶圆上料机构	2023233274651	实用新型	2023.12.7	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
270	联讯仪器	晶圆角度调节机构	2023233276553	实用新型	2023.12.7	原始取得	无
271	联讯仪器	一种产品的防拆装置	2023235190824	实用新型	2023.12.22	原始取得	无
272	联讯仪器	一种干簧继电器	2023236425780	实用新型	2023.12.29	原始取得	无
273	联讯仪器	一种干簧继电器	2023236425795	实用新型	2023.12.29	原始取得	无
274	联讯仪器	一种干簧管继电器	2023236425831	实用新型	2023.12.29	原始取得	无
275	联讯仪器	一种变压器绕线装置及变压器	2023236415191	实用新型	2023.12.29	原始取得	无
276	联讯仪器	一种光模块的误码测试装置	2024200717066	实用新型	2024.1.11	原始取得	无
277	联讯仪器	一种光模块测试装置的控温结构	2024200735327	实用新型	2024.1.11	原始取得	无
278	联讯仪器	角度校准调节机构	202420062495X	实用新型	2024.1.11	原始取得	无
279	联讯仪器	晶圆转运校准装置	2024200624945	实用新型	2024.1.11	原始取得	无
280	联讯仪器	一种测试探针	2024202137366	实用新型	2024.1.29	原始取得	无
281	联讯仪器	一种晶圆级老化测试夹具	2024202905248	实用新型	2024.2.8	原始取得	无
282	联讯仪器	一种热沉、晶圆上下料设备及晶圆级老化测试系统	202420291570X	实用新型	2024.2.8	原始取得	无
283	联讯仪器	一种晶圆搬运装置及晶圆上下料设备	2024202915729	实用新型	2024.2.8	原始取得	无
284	联讯仪器	一种晶圆级老化测试装置及测试系统	2024202915714	实用新型	2024.2.8	原始取得	无
285	联讯仪器	一种晶圆级老化测试夹具及晶圆级老化测试装置	2024202920360	实用新型	2024.2.8	原始取得	无
286	联讯仪器	一种屏蔽装置及具有其的校准装置	2024203439772	实用新型	2024.2.23	原始取得	无
287	联讯仪器	一种低漏电的屏蔽装置、测试单元及半导体测试装置	2024203444304	实用新型	2024.2.23	原始取得	无
288	联讯仪器	一种干簧管及干簧继电器	2024203992807	实用新型	2024.3.1	原始取得	无
289	联讯仪器	一种上料装置及喷砂机	2024206836533	实用新型	2024.4.3	原始取得	无
290	联讯仪器	一种芯片剥离装置及芯片上料设备	2024208923998	实用新型	2024.4.26	原始取得	无
291	联讯仪器	一种用于测试探针的清洁装置及芯片测试系统	2024208944617	实用新型	2024.4.26	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
292	联讯仪器	一种芯片测试装置及芯片测试系统	2024208944284	实用新型	2024.4.26	原始取得	无
293	联讯仪器	一种芯片测试设备及芯片测试系统	2024208942433	实用新型	2024.4.26	原始取得	无
294	联讯仪器	一种芯片测试治具及芯片测试系统	2024208941801	实用新型	2024.4.26	原始取得	无
295	联讯仪器	一种芯片上料设备及芯片测试系统	2024208955325	实用新型	2024.4.26	原始取得	无
296	联讯仪器	一种用于半导体测试装置的刀片针机构及半导体测试装置	2024208944797	实用新型	2024.4.26	原始取得	无
297	联讯仪器	一种用于半导体测试装置的刀片针机构及半导体测试装置	2024208942876	实用新型	2024.4.26	原始取得	无
298	联讯仪器	一种芯片测试治具的温度调节装置及芯片测试设备	2024208923983	实用新型	2024.4.26	原始取得	无
299	联讯仪器	一种刀片针机构及半导体测试装置	2024208955382	实用新型	2024.4.26	原始取得	无
300	联讯仪器	一种晶圆供料装置及晶圆测试设备	2024208924007	实用新型	2024.4.26	原始取得	无
301	联讯仪器	一种低漏电流干簧继电器及半导体测试设备	202420996002X	实用新型	2024.5.9	原始取得	无
302	联讯仪器	一种用于晶圆夹具的装卸工装	2024213501055	实用新型	2024.6.13	原始取得	无
303	联讯仪器	一种用于晶圆测试的夹具及半导体测试设备	2024213504354	实用新型	2024.6.13	原始取得	无
304	联讯仪器	一种低漏电流线缆及半导体测试设备	2024213918468	实用新型	2024.6.18	原始取得	无
305	联讯仪器	一种高速光探测器	2024214500295	实用新型	2024.6.24	原始取得	无
306	联讯仪器	一种芯片测试机的插拔机构及芯片测试机	2024214990453	实用新型	2024.6.27	原始取得	无
307	联讯仪器	一种探针座的烫平设备	2024218945993	实用新型	2024.8.6	原始取得	无
308	联讯仪器	一种助插拔器	2024221309391	实用新型	2024.8.30	原始取得	无
309	联讯仪器	一种助插拔的自锁扳手	2024223463295	实用新型	2024.9.25	原始取得	无
310	联讯仪器	一种芯片测试设备	2024223461938	实用新型	2024.9.25	原始取得	无
311	联讯仪器	一种用于晶圆测试的热沉及晶圆测试	202422374402X	实用新型	2024.9.27	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
		设备					
312	联讯仪器	一种光模块测试用夹具及光模块测试设备	2024223970942	实用新型	2024.9.30	原始取得	无
313	联讯仪器	一种用于光模块测试的夹具及光模块测试设备	2024223971146	实用新型	2024.9.30	原始取得	无
314	联讯仪器	一种拼装式机柜	202422468726X	实用新型	2024.10.12	原始取得	无
315	联讯仪器	误码测试机（大机箱）	2018306728613	外观设计	2018.11.26	原始取得	无
316	联讯仪器	误码测试机（小机箱）	2018306728401	外观设计	2018.11.26	原始取得	无
317	联讯仪器	光通信测试仪器仪表（2U 大机箱）	2020300401910	外观设计	2020.1.20	原始取得	无
318	联讯仪器	光通信测试仪器仪表（2U 小机箱）	2020300411880	外观设计	2020.1.20	原始取得	无
319	联讯仪器	晶圆老化测试夹具	2023307553547	外观设计	2023.11.17	原始取得	无
320	联讯仪器	晶圆老化设备	2023307553528	外观设计	2023.11.17	原始取得	无
321	联讯仪器	显示屏幕面板的晶圆测试图形用户界面	2023307553532	外观设计	2023.11.17	原始取得	无
322	联讯仪器	用于电子设备的晶圆自动上下料图形用户界面	202330843198X	外观设计	2023.12.21	原始取得	无
323	联讯仪器	用于电子设备的晶圆老化系统图形用户界面	2023308431994	外观设计	2023.12.21	原始取得	无
324	联讯仪器	晶圆接驳装置	2024100397109	发明专利	2024.01.11	原始取得	无
325	联讯仪器	竖向晶圆搬运设备	2024100383182	发明专利	2024.1.11	原始取得	无
326	联讯仪器	光器件测试的运料机构	2023101906065	发明专利	2021.11.4	原始取得	无
327	联讯仪器、苏州策林智能科技有限公司	一种芯片对位剥离平台	2022110733249	发明专利	2022.9.2	原始取得	无
328	联讯仪器	一种光模块测试设备	2024223970181	实用新型	2024.9.30	原始取得	无
329	联讯仪器	一种用于光模块测试的夹具及光模块测试设备	2024223970694	实用新型	2024.9.30	原始取得	无
330	联讯仪器	一种用于芯片测试	2024221693606	实用新型	2024.9.4	原始	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	申请日	取得方式	他项权利
		的测试装置				取得	
331	联讯仪器	一种芯片测试设备	2024222176787	实用新型	2024.9.10	原始取得	无
332	联讯仪器	一种用于调节棱镜组件的调节工装	2024223938415	实用新型	2024.9.30	原始取得	无
333	联讯仪器	光模块测试仪	2024306252513	外观设计	2024.9.30	原始取得	无
334	联讯仪器	硅光晶圆测试设备	2024308438610	外观设计	2024.12.31	原始取得	无

(二) 境外专利权

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日	取得方式	申请国家/地区	他项权利
1	联讯仪器	CHIP MOVING DEVICE	18427124	2024.1.30	原始取得	美国	无
2	联讯仪器	WAFER-LEVEL SEMICONDUCTOR HIGH-VOLTAGE RELIABILITY TEST FIXTURE	18427064	2024.1.30	原始取得	美国	无
3	联讯仪器	HEATING STRUCTURE AND WAFER TEST DEVICE	18427094	2024.1.30	原始取得	美国	无
4	联讯仪器	ADAPTIVE FLEXIBLE CHIP TEST SOCKET AND FORMATION METHOD THEREOF	18432932	2024.2.5	原始取得	美国	无
5	联讯仪器	CHIP TEST PRESSING-DOWN APPARATUS AND FORMATION METHOD THEREOF	18432968	2024.2.5	原始取得	美国	无

附件六：募集资金运用情况

（一）下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目

1、项目建设概况

本项目实施主体为联讯仪器，总投资51,279.22万元，建设期3年。本项目将以公司现有的通信测试仪器的技术为基础，对产品进行优化升级，实现测试速率、精度等性能提升，具体包括新一代误码分析仪、网络测试仪、时钟恢复单元、采样示波器、高速光模块测试机、硅光晶圆并行测试机等仪器设备的研发和产业化应用。本项目建成后将提升公司通信测试仪器的产品性能与生产能力，优化产品结构，面向3.2T、6.4T光模块和硅光晶圆测试需求，更好地适应下游客户高速率、高集成化、高灵活度的光通信测试需求，增强公司电子测量仪器的竞争力，项目建设完成后将实现年产并出货新一代误码分析仪500台、新一代网络测试仪140台、新一代采样示波器240台等。

2、项目建设的必要性

（1）提升高速光通信领域测试能力，抢抓市场机遇

AI推动高速光模块市场需求增长。自2022年11月OpenAI推出ChatGPT以来，亚马逊、微软、谷歌、百度等国内外厂商相继推出AIGC相关产品与服务。云计算厂商提高AI方向资本开支，高速光模块作为超大数据中心核心器件，是建设高质量算力网络的必要基础，带来采购需求。中际旭创、新易盛等光模块厂商陆续推出多款800G光模块产品，1.6T光模块也逐步进入商业化应用阶段。

此外，数据中心、5G基站、光纤等应用场景对于光模块速率要求存在差异，不同速率光模块需求并存。随着数据中心建设加速以及5G基站数量持续增长，光模块市场需求有望进一步增长。根据LightCounting测算，2023年全球数通光模块市场规模达62.5亿美元，2024-2029年预计将以27%的CAGR增长，2029年有望达258亿美元。

（2）助力高端科学仪器的自主可控，提升通信测试仪器国产化水平

光模块作为光通信系统的关键器件，产品性能与质量直接决定通信传输效率，下游客户对于光模块产品质量提出较高要求。因此，测试及质量检测环节是光模块研发和生产制造的重要环节，是光模块产业发展的必要基础。

目前我国通信测试仪器的产业化仍处于较低水平，相比欧美、日本等国家，我国行业起步较晚，研发基础相对薄弱，Keysight、Anritsu等国际领先企业产品种类齐全或产品性能突出，在行业中处于领先地位；根据Frost&Sullivan数据，2024年本土企业仅占据中国光通信测试仪器市场16%的份额。

公司作为国内光通信测试仪器领先厂商，本项目实施进一步提高产品性能，加快产品技术迭代，力争实现公司光通信测试仪器产品国内领先水平向国际领先水平的突破，提高产品竞争力，加强我国高端科学仪器的自主可控，提高我国电子测量仪器本土产业化水平。

3、项目建设的可行性

（1）国家产业政策支持通信测试仪器行业发展

近年来，国家高度重视通信测试仪器行业的发展，国务院、工信部、科技部等相关部委相继出台各项具体产业政策，支持鼓励市场发展。《“十四五”数字经济发展规划》《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》等文件提出着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力；加快推进基站、核心网、终端、芯片和仪器仪表等设备研发及产业化。各项政策在财政、税收、技术、人才、知识产权等多方面为通信测试仪器行业提供了良好的支持，推动行业发展，为项目实施提供良好的政策基础。

（2）公司核心技术持续突破，具备良好技术基础

公司聚焦光通信测试领域，把握光通信行业发展趋势和需求变化，专注于技术创新与产品开发，实现了跨越式发展。经过技术研发与产品迭代，成长为目前国内极少数能提供高速光模块测试所需通信测试仪器的厂商，产品已基本覆盖全球头部光模块厂商。目前，公司已自主研发掌握低损耗低噪声高速信号电路设计、高速时钟恢复和时序控制系统设计等关键核心技术，具备光通信领域的核心测试测量能力，为项目实施提供良好的技术基础。

（3）公司客户资源优质，销售渠道广

公司在行业内建立了良好的口碑，持续为客户提供优质的售前、售中及售后服务，有助于保持稳定的现有合作关系并开拓优质的下游客户，采用“直销为主，经销为辅”的销售模式，满足产品下游市场需求特点。公司与国内外各大光通信厂商建立稳定的合

作关系，在光通信领域已覆盖集团一、中际旭创、新易盛、光迅科技、海信集团、华工正源、赛丽科技、Lumentum、Coherent、Broadcom、环球广电、日本住友、日本古河等国内外主流光通信产业链客户。

(4) 公司拥有优秀的管理团队和完善的管理体系

公司着眼于全球化布局，形成了健全的公司治理结构和管理体系，通过多年的磨合与沉淀，打造了兼具国际化战略视野与自主创新基因，执行力强且富有凝聚力的管理与研发团队，不断驱动公司技术革新和突破，进而保障本次相关募投项目的顺利实施。

4、项目投资概算

本项目总投资51,279.22万元，包括固定资产投资4,973.00万元，软件投资962.00万元，研发投入43,659.90万元，基本预备费991.90万元，铺底流动资金692.42万元。

5、项目备案与环评

本项目已取得苏州高新区（虎丘区）数据局出具的《江苏省投资项目备案证》（苏高新项备〔2025〕301号）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，本项目不属于建设项目环境影响评价审批范围，无需进行环评审批程序。

6、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备												
2	设备采购												
3	人员招聘及培训												
4	项目持续研发												
5	流片试产												

(二) 车规芯片测试设备研发及产业化建设项目

1、项目建设概况

本项目实施主体为联讯仪器，总投资19,885.27万元，建设期3年。本项目以公司现有功率半导体测试设备产品和技术为依托，提升公司现有晶圆级老化系统与功率芯片KGD分选测试系统产品测试范围、测试精度等性能指标，同时进一步开发大脉冲源表、

半导体参数测试仪等新产品，以适应下游碳化硅功率器件不断变化的特点，满足高电压大电流等测试需求。本项目将进一步拓展公司产品应用领域，完善企业功率半导体测试设备产品线，满足下游客户测试需求，提高公司竞争优势。本项目实施有利于帮助公司抢占市场先机，提升本土企业在功率半导体测试设备领域的产业化水平，项目建设完成后将实现年产并出货大脉冲源表350台、新一代半导体参数测试仪50台、新一代高压WAT测试机30台等。

2、项目建设的必要性

（1）提升产品性能并拓宽产品线，抢抓市场机遇

根据Frost&Sullivan数据，全球碳化硅功率器件的市场渗透率已从2020年的3.5%迅速增长至2024年的15.1%，预计2029年进一步增长至26.3%，2024年全球市场规模达227亿元人民币，2029年预计增长至1,106亿元人民币。比亚迪半导体、ONSEMI、Infineon、芯联集成、士兰微、三安光电等国内外主流厂商陆续发布碳化硅产线扩产计划，产能释放带动功率半导体测试设备购置需求，行业成长空间广阔。

公司是国内率先实现晶圆级老化系统、功率芯片KGD分选测试系统商业化应用的厂商。通过本项目的实施，公司将进一步提升公司现有产品的测试范围与测试性能，并推动半导体参数测试仪、大脉冲源表等面向功率器件测试的仪器设备研发，不断丰富拓宽产品线覆盖和产业化进程，满足客户多样化的测试需求。

（2）助力半导体测试设备自主可控，提升国产化水平

中国半导体测试设备市场的本土化仍处于较低水平，根据Frost&Sullivan数据，目前中国半导体测试设备市场份额主要被以Advantest、Teradyne为代表的海外企业占据。碳化硅功率器件测试设备作为新兴细分领域，市场仍处于发展初期，国内厂商有望抢占市场先机。

本项目将推动多个技术领先的国产碳化硅功率半导体测试仪器设备，如3,500V晶圆级老化系统、半导体参数测试仪、大脉冲源表等，提升本土企业在半导体测试仪器设备的产业化水平，增强本土企业的自主研发能力，推动我国半导体测试设备行业发展。

3、项目建设的可行性

（1）国家产业政策支持第三代半导体及相关测试设备行业发展

国家高度重视第三代半导体及相关测试设备行业发展，国务院等相关部委出台各项具体产业政策，支持行业发展。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》对于国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业提供税收减免；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出需要集中优势资源攻关多领域关键核心技术，其中集成电路领域包括集成电路设计工具开发、重点装备和高纯靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。相关产业政策为项目实施提供良好的基础。

（2）公司核心技术持续突破，具备良好技术基础

近年来，公司半导体测试领域产品从光电子半导体向功率半导体拓展，紧跟功率半导体的前沿测试需求，推出晶圆级老化系统与功率芯片KGD分选测试系统，产业化进程顺利推进。此外，公司重视功率半导体测试领域相关技术积累，目前公司已自主研发掌握高压下的保护和漏电控制技术、高压大电流功率芯片探针结构和探针卡、芯片与器件测试的温控结构与热传导技术等重要核心技术，实现功率半导体测试领域的核心关键技术自主可控，为项目实施提供良好的技术基础。

（3）公司客户资源优质，销售渠道广

公司在行业内建立了良好的口碑，持续为客户提供优质的售前、售中及售后服务，有助于保持稳定的现有合作关系并开拓优质的下游客户。公司采用“直销为主，经销为辅”的销售模式，满足产品下游市场需求特点。公司在功率器件领域已覆盖比亚迪半导体、芯联集成、士兰微、三安光电、芯聚能、长飞先进、株洲中车、瞻芯电子、ONSEMI、Power Master等国内外主流功率芯片厂商。

（4）公司拥有优秀的管理团队和完善的管理体系

公司着眼于全球化布局，形成了健全的公司治理结构和管理体系，通过多年的磨合与沉淀，打造了兼具国际化战略视野与自主创新基因，执行力强且富有凝聚力的管理与研发团队，不断驱动公司技术革新和突破，进而保障本次相关募投项目的顺利实施。

4、项目投资概算

本项目总投资19,885.27万元，包括固定资产投资1,416.00万元，软件投资167.00万元，研发投入16,174.75万元，基本预备费355.16万元，铺底流动资金1,772.37万元。

5、项目备案与环评

本项目已取得苏州高新区（虎丘区）数据局出具的《江苏省投资项目备案证》（苏高新项备〔2025〕315号）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，本项目不属于建设项目环境影响评价审批范围，无需进行环评审批程序。

6、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备												
2	设备采购												
3	人员招聘及培训												
4	项目持续研发												

（三）存储测试设备研发及产业化建设项目

1、项目建设概况

本项目实施主体为联讯仪器，总投资38,547.37万元，建设期3年。本项目将以公司半导体测试设备技术基础为依托，自主研发推出DRAM测试机等产品，填补国内高速存储测试机的空白，满足下游存储器厂商测试需求，拓展产品应用领域，带来新的盈利增长点，为公司持续发展提供重要支撑，项目建设完成后将实现年产并出货产高速存储芯片测试系统75台、HBM芯片KGD分选测试系统50台等。

2、项目建设的必要性

（1）开拓存储芯片测试业务，抢抓市场增量机遇

存储芯片市场是半导体行业重要细分领域。根据WSTS数据，虽然存储芯片市场存在周期性，2022年全球存储市场下滑13%，存储芯片市场规模仍然达到1,410亿美元，占全球半导体行业市场规模的23.17%，是半导体行业第一大细分领域。

目前，全球存储芯片市场寡头垄断，国内厂商加速技术迭代与产线建设，主流的存储芯片DRAM、NAND Flash前五大厂商合计占比（CR5）均超90%，主要包括三星、SK海力士、美光等全球领先企业占据超80%市场份额。作为国家信息安全基础设施供应链的关键组成部分，近年来，中国存储器厂商加速技术迭代与产线建设。

存储芯片市场前景广阔，随着存储芯片产能逐步释放，将拉动相关测试设备的采购需求。本项目的实施将推进自主可控的高速存储芯片测试机、分选机、老化设备等产品的研发与产业化应用，满足下游存储芯片厂商测试需求。

（2）填补国内空白，实现相关技术自主可控

存储测试机通过对写入数据并进行读回、校验，对存储器进行测试。由于测试速度、精度要求高，存储测试机软件、算法、调试工具系统庞大复杂，技术难度极高。目前全球存储测试机主要生产厂商为Advantest和Teradyne，国内厂商存储测试机多处于研发阶段，产品性能与国际领先企业存在较大差距，而高速产品更是处于空白阶段。随着国产存储器厂商的产能扩张，解决存储测试机的“卡脖子”问题迫在眉睫，本项目的实施将推动存储测试机、分选机、老化设备等产品研发与产业化，缩小公司产品与国际先进水平的技术代差并填补国内空白，助力存储芯片厂商提升测试效率，实现高速存储测试机相关核心技术自主可控。

（3）丰富公司产品种类，拓展产品应用场景

公司半导体测试设备覆盖光电子器件测试设备、功率器件测试设备和电性能测试设备三大产品线，存储测试设备的研发与产业化将增强公司在半导体测试设备领域的技术实力与产品线覆盖，降低细分应用行业波动对公司业绩造成的影响，进一步提升公司的整体盈利能力和产品矩阵优势。

3、项目建设的可行性

（1）国家产业政策支持存储芯片及相关测试设备行业发展

国家高度重视存储芯片及相关测试设备行业的发展，国务院等相关部委出台各项具体产业政策，支持行业发展。2023年5月，国家互联网信息办公室宣布美国芯片龙头美光公司未通过我国安全网络安全审查办公室的审查，停止采购美光公司产品，利好国产存储芯片厂商发展；《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》制定实施战略性科学计划和科学工程，瞄准前沿领域，关注先进存储技术升级。政策支持为项目实施提供良好的基础。

（2）半导体测试产品基础与技术储备，具备项目实施基础

公司从事半导体领域高端测试仪器研发与生产，具备产品基础与技术储备。公司高

度重视半导体测试设备产品开发与技术储备。近年来，公司推出WAT测试机、晶圆级可靠性测试系统、晶圆级老化系统、功率芯片KGD分选测试系统等半导体测试设备，在高速信号处理、微弱信号处理、超精密运动控制等领域积累了丰富经验，形成了具备高度复用价值的核心技术体系，为项目实施提供良好的技术基础。

（3）公司客户资源优质，销售渠道广

公司在行业内建立了良好的口碑，持续为客户提供优质的售前、售中及售后服务，有助于保持稳定的现有合作关系并开拓优质的下游客户，采用“直销为主，经销为辅”的销售模式，满足产品下游市场需求特点。在半导体测试领域，公司凭借突出的技术实力、可靠的产品质量、良好的销售服务积累了优质的客户资源，为项目实施奠定了良好客户基础。

（4）公司拥有优秀的管理团队和完善的管理体系

公司着眼于全球化布局，形成了健全的公司治理结构和管理体系，通过多年的磨合与沉淀，打造了兼具国际化战略视野与自主创新基因，执行力强且富有凝聚力的管理与研发团队，不断驱动公司技术革新和突破，进而保障本次相关募投项目的顺利实施。

4、项目投资概算

本项目总投资38,547.37万元，包括固定资产投资694.00万元，软件投资211.00万元，研发投入36,473.50万元，基本预备费747.57万元，铺底流动资金421.30万元。

5、项目备案与环评

本项目已取得苏州高新区（虎丘区）数据局出具的《江苏省投资项目备案证》（苏高新项备〔2025〕302号）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，本项目不属于建设项目环境影响评价审批范围，无需进行环评审批程序。

6、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备												
2	设备采购												

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
3	人员招聘及培训												
4	项目持续研发												
5	流片试产												

（四）数字测试仪器研发及产业化建设项目

1、项目建设概况

本项目实施主体为联讯仪器，总投资30,400.53万元，建设期3年。本项目将以公司现有的通信测试仪器的生产技术为基础，自主研发宽带实时示波器和任意波形发生器并实施量产，在满足不同客户的个性化需求的同时，拓展公司产品应用领域，增加新的盈利增长点，为公司可持续发展提供重要支撑，项目建设完成后将实现年产并出货宽带实时示波器140台、任意波形发生器280台。

2、项目建设的必要性

（1）提升通信测试仪器自主可控水平，服务国家重大战略需求

当前，5G、人工智能等新兴技术的快速发展，对高精度、高效率的数字测试仪器需求激增，推动了数字测试仪器市场的持续扩张。然而，我国数字测试仪器产业仍面临产业化程度不高、核心技术受制于国外、创新生态系统不完善等挑战。为应对这些挑战，国家相继推出了一系列规划和政策措施，旨在加速关键测试仪器行业的崛起。如2023年9月，市场监管总局印发《计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》，意见提出到2035年，国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际先进水平，部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际领先水平。突破一批“卡脖子”的计量测试关键技术，涌现一批具有领先测量水平和研发设计能力的仪器仪表创新企业。

公司紧跟国家政策导向，致力于研发高性能的数字测试仪器，积极掌握数字测试仪器的核心技术，力求实现我国数字测试仪器的自主可控，逐步缩小与国际领先技术的差距，构建自身的竞争优势。本项目的实施，正是积极响应国家发展战略，致力于提升数字测试仪器国内产业化水平的必要行动。

（2）满足日益旺盛的下游市场需求，抢占市场先机

随着5G通信、物联网、大数据及人工智能等技术的飞速发展，数字测试仪器的下

游市场需求呈现出爆发式增长态势，尤其是在智能制造、电子消费等关键领域。这一趋势不仅推动了数字测试仪器技术的不断革新，还使得市场对高精度、多功能数字测试仪器的需求急剧上升。本项目正是基于数字测试仪器下游市场的这一旺盛需求而展开，旨在通过自主研发和创新，为企业提供高效、精准的数字测试仪器解决方案。通过精准把握市场动态和技术趋势，本项目将帮助企业迅速抢占国内数字测试仪器市场的先机，满足来自智能制造、电子消费等多个领域下游客户的多样化测试需求，从而助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。

3、项目建设的可行性

（1）国家产业政策支持通信测试仪器行业发展

近年来，国家高度重视通信测试仪器行业的发展，国务院、工信部、科技部等相关部委相继出台各项具体产业政策，支持鼓励市场发展。《“十四五”数字经济发展规划》《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》等文件提出着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力；加快推进基站、核心网、终端、芯片和仪器仪表等设备研发及产业化。各项政策在财政、税收、技术、人才、知识产权等多方面为通信测试仪器行业提供了良好的支持，推动行业发展，为项目实施提供良好的政策基础。

（2）完善的核心技术体系，具备项目实施基础

公司在电子测量仪器领域深耕多年并取得了大量原创性的研究成果，建立了高速信号处理技术、微弱信号处理技术、超精密运动控制技术等领域具有高复用性的核心技术，搭建起可高效响应新产品开发需求的技术平台，为宽带实时示波器和任意波形发生器等电子测量仪器的研发与产业化进程提供了技术基础。

（3）公司客户资源优质，销售渠道广

公司在行业内建立了良好的口碑，持续为客户提供优质的售前、售中及售后服务，有助于保持稳定的现有合作关系并开拓优质的下游客户，采用“直销为主，经销为辅”的销售模式，满足产品下游市场需求特点。在通信测试领域，公司凭借突出的技术实力、可靠的产品质量、良好的销售服务积累了优质的客户资源，为项目实施奠定了良好客户基础。

（4）公司拥有优秀的管理团队和完善的管理体系

公司着眼于全球化布局，形成了健全的公司治理结构和管理体系，通过多年的磨合与沉淀，打造了兼具国际化战略视野与自主创新基因，执行力强且富有凝聚力的管理与研发团队，不断驱动公司技术革新和突破，进而保障本次相关募投项目的顺利实施。

4、项目投资概算

本项目总投资30,400.53万元，包括固定资产投资4,674.00万元，软件投资922.00万元，研发投入23,506.25万元，基本预备费582.05万元，铺底流动资金716.24万元。

5、项目备案与环评

本项目已取得苏州高新区（虎丘区）数据局出具的《江苏省投资项目备案证》（苏高新项备〔2025〕300号）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，本项目不属于建设项目环境影响评价审批范围，无需进行环评审批程序。

6、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备												
2	设备采购												
3	人员招聘及培训												
4	项目持续研发												
5	流片试产												

（五）下一代测试仪表设备研发中心建设项目

1、项目建设概况

本项目实施主体为联讯仪器，项目总投资31,031.89万元，规划建设期3年。本项目通过新建厂房及配套设施满足研发中心的建设需要，将公司的研发活动提供良好基础设施，加快研发成果的产业化应用。

2、项目建设的必要性

（1）满足公司业务发展需求

公司自成立以来保持高速发展，近年来推出多款电子测量仪器和半导体测试设备，

产品矩阵不断丰富、研发与产业化进程不断深入，逐步成长为国内领先的测试仪器设备企业。报告期内，公司人员数量和产量快速增长，现有研发场所的空间容量已趋于饱和，难以满足公司业务扩张需求，本项目将通过新建厂房及配套设施，为公司的研发活动提供良好的基础设施，进而满足公司旺盛的业务需求。

（2）助力公司战略实施，服务国家战略需求

电子测量仪器与半导体测试设备是基础性和战略性新兴产业，其发展水平已成为一个国家科技水平、综合国力和国际竞争力的标志，是光通信、半导体等国家重大战略需求行业的关键基础支撑。本项目实施将有利于提升公司经营效率，助力公司聚焦光通信、半导体等国家重大战略需求领域，推进公司电子测量仪器与半导体测试设备的研发与产业化进程。

3、项目建设的可行性

（1）国家产业政策支持电子测量仪器行业与半导体测试设备行业发展

近年来，国家高度重视电子测量仪器与半导体测试设备行业的发展，国务院、工信部、科技部等相关部委相继出台各项具体产业政策，为行业的发展提供了良好政策空间，支持行业企业突破核心技术、加快产品开发，从财政、税收、技术、人才、知识产权等多方面为项目实施提供良好的政策基础。

（2）公司具备突出的研发与产业化能力

公司在电子测量仪器和半导体测试设备领域深耕多年并取得了大量原创性的研究成果，建立了高速信号处理技术、微弱信号处理技术、超精密运动控制技术等领域具有高复用性的核心技术，支持公司快速对产品线进行纵向升级和横向拓展。同时，公司建立了完善的业务流程体系，形成了专业的研发人才与工程化人才团队，具备丰富的项目经验，能实现科技成果与产业进行深度融合。

4、项目投资概算

本项目建设拟投资31,031.89万元，包括工程建设费用27,794.18万元、工程建设其他费用2,629.24万元、基本预备费608.47万元。

5、项目备案与环评

本项目已取得苏州高新区（虎丘区）数据局出具的《江苏省投资项目备案证》（苏

高新项备〔2025〕750号）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，本项目不属于建设项目环境影响评价审批范围，无需进行环评审批程序。

6、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

序号	项目	T1				T2				T3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	购买及清理场地												
2	工程施工及装修												
3	设备采购及安装												

附件七：公司租赁情况

（一）发行人及其境内控股子公司租赁情况

截至本招股说明书签署日，发行人及其境内控股子公司租赁的用于生产、经营活动的主要不动产具体情况如下：

序号	承租人	出租人	地点	租赁期限	租赁面积 (m ²)	用途
1	联讯仪器	苏州高新区枫桥工业园有限公司	苏州新区湘江路 1508 号 5 幢	2025.7.15-2027.7.15	106.21	生产、办公、仓储
2	联讯仪器	苏州艾福电子通讯股份有限公司	苏州高新区鹿山路 369 号 14 号厂房西侧	2024.5.1-2029.4.30	1,170.00	车间、办公室、产品展示厅、仓库
3	联讯仪器	苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	苏州高新区鹿山路 369 号 40 幢厂房 102、202 室	2024.4.1-2029.3.31	4,237.12	生产、办公、研发
4	联讯仪器	苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司	苏州高新区鹿山路 369 号 40 幢 101、103、201、203、204 室	2025.4.1-2030.3.31	10,913.48	生产、办公、研发
5	苏州联讯仪器股份有限公司无锡分公司	无锡鑫选企业管理有限公司	无锡市梁溪区江海西路 88 号 A 幢 2060	2025.6.9-2026.6.8	10.00	商业
6	苏州联讯仪器股份有限公司上海分公司	上海快颐企业管理有限公司	上海市闵行区苏虹路 333 号 1 幢 C 栋 7 楼 613-4 室（C706 室）	2024.10.15-2026.12.14	165.00	办公
7	联讯仪器	深圳市精佳美财务咨询有限公司	深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园 A 栋 707	2025.10.31-2026.10.31	20.00	办公
8	杭州联讯	杭州新芯智谷科技合伙企业（有限合伙）	杭州市西湖区学院路 77 号黄龙国际中心 1 幢（G 楼）地上 1001/02/03/04/05/06/07 室（实际楼层为地上 9 层 01/02/03/04/05/06/07 室）	2025.4.20-2030.4.19	1,398.90	办公
9	联讯仪器	武汉光谷国际生命健康产业园发展有限公司	武汉市东湖高新区九峰一路 1 号的生物创新园二期	2025.9.1-2030.8.31	6,700.06	办公

序号	承租人	出租人	地点	租赁期限	租赁面积 (m ²)	用途
10	联讯仪器	合肥恒创智能科技有限公司	合肥经开区硕放路 1 号研发楼 5 层南室	2025.11.1-2027.10.31	432.15	办公

(二) 发行人境外控股子公司租赁情况

截至本招股说明书签署日，发行人境外控股子公司租赁的用于生产、经营活动的主要不动产具体情况如下：

序号	承租人	出租人	地点	租赁期限	租赁面积 (m ²)	用途
1	新加坡联讯	HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited	10 Science Park Road The Alpha Singapore Science Park II Singapore 117684	2024.3.1-2027.3.31	151.00	办公
2	韩国联讯	Lucky Scientec Co., Ltd.	83-12 Dodang-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do	2024.11.21-2026.11.20	419.00	办公
3	马来西亚联讯	Escatec Electronics Sdn. Bhd.	No. Lot 8136, Mukim 12, Daerah Barat Daya, Negeri Pulau Pinang	2024.3.6-2027.2.28	7,814.00	办公
4	泰国联讯	NAVA NAKORN PUBLIC Company LIMITED	60/125, Moo 9 (A13-A14), Khlong Nueng Subdistrict, Khlong Luang District, Pathum Thani Province, Thailand	2025.1.1-2026.12.31	160.00	办公
5	日本联讯	Japan Properties 合同会社	日本东京都江东区有明三丁目 7 番 18 号 6 阶-5 区面	2023.3.1-2029.2.28	299.59	办公场所及陈列室
6	日本联讯	古**子	日本三重县铃鹿市道伯町 2147-26B 栋	2024.4.1-2028.3.31	270.00	办公场所及陈列室
7	美国联讯	FREMONT SHORELINE PROPERTY ES BK6/7. LLC	47787 FREMONT BLVD FREMONT, CA 94538	2026.1.1-2031.4.30	539.13	办公